

浙江东晶电子股份有限公司
ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO., LTD.

(浙江省金华市宾虹路二段 555 号)

首次公开发行股票招股说明书

保荐人（主承销商）

 **国信证券有限责任公司**
GUOSEN

(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦)

浙江东晶电子股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书

发行概况

发行股数: 1,600 万股	发行股票类型: 人民币普通股 (A 股)
每股面值: 1.00 元	发行日期: 2007 年 12 月 10 日
发行价格: 8.80 元/股	拟上市证券交易所: 深圳证券交易所
发行后总股本: 6,200 万股	保荐人 (主承销商): 国信证券有限责任公司
招股说明书签署日期: 2007 年 12 月 6 日	
本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺:	<p>公司控股股东、实际控制人李庆跃承诺: 自公司股票上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人收购其持有的股份 (包括由该部分派生的股份, 如送红股、资本公积金转增等)。</p> <p>公司其他股东池旭明、吴宗泽、金良荣、陈利平、杨亚平、赵晖、蒋旭升、俞尚东、方琳、陈玉花、方永进承诺: 自公司股票上市之日起36个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人收购其持有的股份 (包括由该部分派生的股份, 如送红股、资本公积金转增等)。</p> <p>除上述承诺外, 持有公司股份的董事李庆跃、池旭明、吴宗泽、金良荣、陈利平和监事杨亚平、俞尚东、方琳承诺: 在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%; 离职后 6 个月内, 不转让其所持有的本公司股份。</p>

声 明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

重大事项提示

一、本次发行前公司总股本4,600万股，本次拟发行1,600万股，发行后总股本为6,200万股。公司控股股东、实际控制人李庆跃承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。公司其他股东池旭明、吴宗泽、金良荣、陈利平、杨亚平、赵晖、蒋旭升、俞尚东、方琳、陈玉花、方永进承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份（包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等）。

除上述承诺外，持有公司股份的董事李庆跃、池旭明、吴宗泽、金良荣、陈利平和监事杨亚平、俞尚东、方琳承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的本公司股份。

二、根据2007年2月11日召开的2006年度股东大会决议，公司本次发行前滚

存利润分配方案为：

2006 年度利润分配完成后剩余未分配利润中的 15,000,000 元归老股东享有，并在本次发行前进行分配。该次分配后剩余未分配利润连同 2007 年 1 月 1 日至本次发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有。

根据公司 2007 年第二次临时股东大会决议，公司对本次发行前的滚存利润进行了分配，其中归老股东享有的 15,000,000 元滚存利润已于 2007 年 11 月 14 日分配完毕。以 2007 年 6 月 30 日经审计的净资产为计算基础，该次利润分配实施后，公司的净资产相应减少至 86,167,240.71 元，每股净资产下降至 1.87 元。该次利润分配实施后，剩余的未分配利润 25,993,751.35 元（按公司 2007 年 6 月 30 日经审计的未分配利润计算）连同 2007 年 6 月 30 日至本次发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有。

三、 2007年1~6月、2006年度、2005年度、2004年度，公司取得的非经常性损益分别为422.30万元、445.22万元、283.09万元、306.30万元，占当期利润总额的比例分别为28.71%、15.78%、13.35%、23.23%，非经常性损益的主要构成为公司获得的各项政府补助，分别为415.40万元、461.50万元、293.55万元、328.67万元。扣除非经常性损益后，公司2007年1~6月、2006年度、2005年度、2004年度净利润分别为699.61万元、1,827.56万元、1,460.69万元、853.51万元，每股收益分别为0.15元、0.40元、0.32元、0.19元。若国家和地方政府的有关财政补贴优惠政策发生重大调整，如降低或者取消，可能对本公司利润产生一定的影响。

四、 公司的主营业务收入、净利润和销售回款（即销售商品、提供劳务收到的现金）在会计年度内分布不均衡，一般情况下，下半年高于上半年。2006年度、2005年度和2004年度，公司在下半年（7~12月）的主营业务收入占公司当年主营业务收入的比例分别为56.28%、56.31%和58.30%；下半年的净利润占公司当年净利润的比例分别为61.31%、57.94%和53.04%；下半年销售回款占公司当年全部销售回款的比例分别为61.47%、61.69%和46.73%。

五、 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

（一）人民币持续升值的风险

公司产品90%以上出口。报告期内公司出口产品以美元为主要结算货币，进口原材料主要以日元、美元结算，进口设备主要以日元结算，其余采购原材料、设备和主要费用支出以人民币支付。如果人民币保持对美元、日元的持续升值，

将有利于降低原材料、机器设备的采购成本，但会对产品出口造成不利影响。一方面，如果人民币标价不变，则出口产品外币标价上升，可能削弱公司产品在国际市场的比价优势；另一方面，如果以外币标价不变，则相应人民币标价下降，相当于产品价格下降，产品销售收入可能减少；此外，公司还可能遭受出口收入转化成人民币时的汇兑损失。

预计未来几年，公司产品出口和原材料、设备进口格局不会发生重大变化，随着公司经营规模的扩大，公司通过国际市场采购和销售的金额可能进一步增加。因此，人民币持续升值可能对公司经营成果带来一定的负面影响。

（二）依赖国际市场的风险

公司为顺应石英晶体元器件的全球市场需求，产品主要用于出口，且随着产品档次的提升，出口比例维持在较高的水平，公司2007年1~6月、2006年度、2005年度和2004年度的产品出口比例分别为95.47%、92.20%、94.67%和86.37%。出口地区主要集中在中国台湾、新加坡和日本等地，产品的最终客户多为大型跨国公司。一方面，世界经济的景气程度和国际信息产业的发展变化，将可能对本公司出口业务带来影响。另一方面，尽管目前公司产品出口尚不存在贸易壁垒，与进口国（地区）发生贸易摩擦的可能性较小，但并不排除未来可能在知识产权纠纷、反倾销调查和技术贸易壁垒等方面出现不利变化，因而存在一定的国际市场风险。

（三）产品价格下降的风险

本公司主要产品为石英晶体谐振器，其销售额占主营业务收入的95%以上。公司通过加大新产品的研发和产品结构优化力度，提高附加值较高的SMD石英晶体元器件的销售比重，从而增强对下游产品价格波动的承受能力并保持相对稳定的综合毛利率，2007年1~6月、2006年度、2005年度和2004年度石英晶体谐振器产品毛利率分别为28.92%、27.42%、25.89%和23.92%。

尽管国际、国内市场对石英晶体元器件需求量近年来一直保持较快的增长速度，但随着技术进步、规模化生产以及石英晶体元器件市场竞争的加剧，主要产品价格呈下降趋势；同时，下游行业如通信设备、家电、计算机等电子整机产品价格持续下降，挤压了石英晶体元器件的利润空间。如果行业内产品价格仍保持下降的趋势，而公司产品结构优化不足以弥补产品降价的负面影响，则主要产品销售价格的下降将可能影响公司未来的盈利能力。

（四）税收优惠政策变动的风险

根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290号文《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》，经金华市地方税务局批准，公司2006年度、2005年度、2004年度因技术改造购买国产设备投资抵免所得税额分别为171.61万元、188.88万元、172.47万元，上述抵免所得税直接增加公司当年净利润，所得税抵免额分别占公司当年净利润的7.55%、10.83%、14.87%。如果未来国家关于技术改造国产设备投资抵免所得税政策发生变化，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。

本公司出口产品增值税采用“免、抵、退”的计算办法，根据《财政部、国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知》（财税[2003]222号）的规定，自2004年1月1日起，公司产品的出口退税率由17%降为13%，这对公司的经营业绩产生了一定影响，2004年1~10月，由于出口退税率的下降直接导致公司净利润减少181.96万元。根据财政部、国家税务总局财税[2004]200号文《关于提高部分信息技术（IT）产品出口退税率的通知》规定，从2004年11月1日起本公司经营产品的出口退税率由13%提高到17%。根据财政部、国家税务总局财税[2007]90号文《关于调低部分商品出口退税率的通知》规定，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率，本公司经营产品不在调整目录之列，仍执行17%的出口退税率。

公司报告期内平均产品的出口比例为92.18%，按2008年开始企业所得税率25%计算，未来公司产品出口退税率如果每下调1%，公司净利润将下降0.69%。

上述风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注“风险因素”一节关于上述风险的内容。

目 录

第一节	释 义	11
第二节	概 览	14
	一、 发行人基本情况	14
	二、 控股股东、实际控制人简要情况	17
	三、 发行人主要财务数据及指标	17
	四、 本次发行情况	19
	五、 募股资金用途	20
第三节	本次发行概况	22
	一、 本次发行的基本情况	22
	二、 本次发行有关当事人	23
	三、 发行人与中介机构关系的说明	25
	四、 本次发行主要时间表	25
第四节	风险因素	27
	一、 人民币持续升值的风险	27
	二、 市场风险	28
	三、 经营风险	30
	四、 财政优惠政策变化风险	31
	五、 实际控制人风险	32
	六、 商标风险	32
	七、 技术风险	33
	八、 担保风险	33
	九、 人力资源风险	33
	十、 募股资金投资项目实施风险	34
	十一、 税收优惠政策变动的风险	35
	十二、 因违规资金拆借可能遭受有关部门处罚的风险	35

十三、 统计数字及各种公开资料来源可能不可靠的风险	36
十四、 前瞻性陈述可能不准确的风险	36
第五节 发行人基本情况	37
一、 发行人基本情况.....	37
二、 发行人改制重组情况.....	37
三、 发行人股本形成、变化及重大资产重组情况.....	40
四、 历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.....	50
五、 发行人的组织结构.....	52
六、 公司发起人、持有公司 5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况	54
七、 发行人股本情况.....	56
八、 员工及其社会保障情况.....	57
九、 本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺.....	58
第六节 业务与技术	60
一、 公司业务概述.....	60
二、 公司所处行业基本情况.....	61
三、 公司在行业中的竞争地位.....	71
四、 公司主要业务经营情况.....	76
五、 主要固定资产和无形资产.....	90
六、 技术情况.....	96
七、 公司境外生产经营情况.....	99
八、 公司质量控制情况.....	99
第七节 同业竞争与关联交易	102
一、 关于同业竞争.....	102
二、 关于关联方和关联关系.....	102
三、 关联交易的性质和内容.....	107
四、 关联交易决策的制度安排.....	110

五、发行人最近三年一期关联交易决策的执行情况及独立董事的意见.....	112
六、发行人拟采取的减少关联交易的措施.....	114
第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 ...	115
一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介.....	115
二、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在发行前持有发行人股份的情况.....	118
三、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况.....	119
四、公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员收入情况.....	119
五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况及相互亲属关系.....	120
六、与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所签定的协议及上述人员重要承诺.....	120
七、稳定董事、监事、高级管理人员和核心技术人员措施.....	121
八、董事、监事、高级管理人员是否符合法律法规规定的任职资格的情况.....	121
九、发行人董事、监事、高级管理人员最近三年变动情况.....	122
第九节 公司治理.....	123
一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.....	123
二、发行人最近三年一期违法违规行为情况.....	134
三、发行人最近三年一期资金占用和对外担保的情况.....	134
四、发行人内部控制制度情况.....	135
第十节 财务会计信息.....	139
一、审计意见类型及会计报表编制基准.....	139
二、简要会计报表.....	140
三、发行人采用的主要会计政策和会计估计.....	149
四、最近一年收购兼并情况.....	157
五、非经常损益明细表.....	157
六、主要资产.....	158

七、主要负债.....	162
八、股东权益.....	165
九、现金流量.....	167
十、其他重要事项.....	168
十一、 财务指标.....	173
十二、 资产评估情况.....	175
十三、 公司历次验资情况.....	177
第十一节 管理层讨论与分析.....	178
一、财务状况分析.....	178
二、盈利能力分析.....	184
三、资本性支出分析.....	204
四、财务趋势分析.....	204
第十二节 业务发展目标.....	207
一、经营宗旨及发展战略.....	207
二、总体经营目标.....	208
三、主要发展规划.....	209
四、拟定上述计划所依据的假设条件.....	214
五、实施上述计划所面临的主要困难.....	215
六、上述计划与现有业务的关系.....	215
七、本次募股资金运用对实现上述计划的作用.....	215
第十三节 募股资金运用.....	217
一、预计募股资金总量及投向.....	217
二、募股资金投资项目的市场前景及必要性分析.....	218
三、募股资金投资项目的技术来源和技术保障.....	224
四、募股资金投资项目概况.....	227
五、募股资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响.....	239

第十四节	股利分配政策.....	241
一、	公司最近三年股利分配的一般政策.....	241
二、	最近三年股利分配情况.....	241
三、	本次发行后的股利分配政策.....	242
四、	利润共享安排.....	242
第十五节	其他重要事项.....	243
一、	信息披露制度和为投资者服务计划.....	243
二、	重大合同.....	246
三、	重大诉讼或仲裁.....	249
第十六节	董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明..	错误！未定义书签。
一、	发行人全体董事、监事及高级管理人员的声明	错误！未定义书签。
二、	保荐人（主承销商）声明	错误！未定义书签。
三、	发行人律师声明	错误！未定义书签。
四、	发行人会计师事务所声明	错误！未定义书签。
五、	验资机构声明	错误！未定义书签。
六、	资产评估机构声明	错误！未定义书签。
第十七节	备查文件.....	256
一、	备查文件.....	256
二、	查阅时间.....	256
三、	查阅地址.....	256

第一节 释 义

本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

公司、本公司、发行人、东晶电子	指	浙江东晶电子股份有限公司
国信证券、保荐人、主承销商	指	国信证券有限责任公司
金华东晶	指	公司前身金华市东晶电子有限公司
发起人	指	李庆跃等 12 个自然人
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所有限公司及其前身上海立信长江会计师事务所有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会	指	公司股东大会
董事会	指	公司董事会
监事会	指	公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江东晶电子股份有限公司章程》
本次发行	指	公司本次向不特定对象首次公开发行 1,600 万股 A 股的行为
A 股	指	每股面值 1.00 元的人民币普通股
元	指	人民币元
压电石英晶体元器件	指	利用石英晶体（即水晶）的逆压电效应（在外电场作用下产生弹性形变的特性）制成的机电能量耦合的频率控制元器件，因其较高的频率稳定度和高 Q 值（品

		质因数)以及主要原材料人造水晶价格较低等突出优点,成为频率控制、稳定频率和频率选择的重要元器件,主要包括谐振器、振荡器和滤波器三大类
谐振器	指	石英晶体谐振器,是通过在石英晶片两面镀上电极而构成的频率控制元件,交变信号加到电极上时谐振器会在特定的频率上起振。厚度剪切型谐振器频率和晶体的厚度有关系,通过仔细的加工,谐振器可以工作在一定的频率上
振荡器	指	石英晶体振荡器,是一种频率稳定器件,按频率温度特性技术要求不同,分为普通晶体振荡器(或称钟振,主要用于计算机时钟,英文简称“OSC”)、温度补偿晶体振荡器(主要用于移动通信)、恒温控制式晶体振荡器(主要用于频率综合器、时间频率标准等)三类,每一类又可以分为压控的和非压控型振荡器
电容器、瓷介管状电容器	指	一种以圆管形的陶瓷为电介质的电容器,通常由陶瓷管、银电极层、引线三部分组成,在电子线路中配合电感线圈构成 LC 振荡电路
HC-49U	指	电阻焊封 13×11×4.5mm 的金属壳石英晶体谐振器,简称 49U
HC-49S	指	电阻焊封 11×4.5×3.5mm 或 11×4.5×2.5mm 的金属壳石英晶体谐振器,简称 49S
HC-49SMD	指	将 49S 晶体谐振器的引线压扁后,向两侧折弯后形成的一种可用于表面贴装石英晶体谐振器,是 DIP 向 SMD 过渡的一种中间产品,但由于这类产品的外形尺寸与内部结构与 49S 相同,通常还将其归为 DIP 类,简称 49SMD
DIP	指	Dual In-line Package 的缩写,译为“双列直插式封装”,此封装形式具有适合 PCB(印刷电路板)穿孔安装,布线和操作较为方便等特点。本公司的 DIP 石英晶

		体谐振器包括 49S、49U、49SMD 三大类
SMD	指	Surface Mount Device 的缩写，译为“表面贴装的电子元器件”，区别于传统的有引线产品
OEM	指	Original Equipment Manufacturer 的缩写，直译为“原始设备制造商”，也叫“贴牌”，在本招股说明书中指公司利用自身的加工优势，为同类大型压电石英晶体元器件生产商加工标明其品牌的产品，并由其包销的一种生产经营方式
SMD8045（7050、6035、5032、4025、3225、2520、2016）	指	外形尺寸分别为 8.0mm×4.5mm、7.0mm×5.0mm、6.0mm×3.5mm、5.0mm×3.2mm、4.0mm×2.5mm、3.2mm×2.5mm、2.5mm×2.0mm、2.0mm×1.6mm 的 SMD 石英晶体谐振器

第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人基本情况

(一) 发行人简介

- 1、发行人名称：浙江东晶电子股份有限公司
- 2、英文名称： ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO., LTD.
- 3、法定代表人：李庆跃
- 4、经营范围： 电子元件、计算机及网络产品、通信产品的研发、设计、生产与销售
- 5、注册资本： 4,600 万元
- 6、住所： 浙江省金华市宾虹路二段 555 号
- 7、邮政编码： 321017
- 8、联系电话： 0579-82272001
- 9、联系传真： 0579-82273318
- 10、互联网址： <http://www.ecec.com.cn>
- 11、电子邮箱： ecec@ecec.com.cn

(二) 设立情况

浙江东晶电子股份有限公司是 2004 年 7 月 27 日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2004]55 号文《关于同意变更设立浙江东晶电子股份有限公司的批复》同意，由金华市东晶电子有限公司整体变更设立的股份有限公司，股本总额 4,600 万元。发起人为李庆跃、池旭明、吴宗泽、金良荣、陈利平、杨亚平、俞尚东、方琳、方永进、蒋旭升、陈玉花、赵晖等 12 名自然人。2004 年 7 月 30 日，浙江东晶电子股份有限公司在浙江省工商行政管理局登记注册，企

业法人营业执照注册号为 3300001010780。

（三） 业务概况

本公司是国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省高新技术企业、中国电子元件百强企业，主要产品为石英晶体谐振器，包括 SMD 和 DIP 两大类，是各类电子产品的基本元件，主要应用于通讯、资讯、网络、汽车电子和家用电器等领域。其中，SMD 谐振器系列属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2005 年本）》“第一类 鼓励类 第二十四条 信息产业”中“23.新型电子元器件制造”的国内投资项目，符合国家产业政策和信息产业发展方向。

公司位列国内压电晶体电子元器件企业综合排名前 3 强（摘自中国电子元器件网中国电子元件 2005 年百强企业名录）。截至 2007 年 6 月 30 日，公司石英晶体谐振器生产能力已达到年产 3.1 亿只，其中 SMD 谐振器年生产能力达到 1.1 亿只。经中国电子元件行业协会压电晶体分会确认，公司 SMD 石英晶体谐振器生产规模、产品档次、设备自动化程度名列国内同行业首位。公司产品 90% 以上出口中国台湾、新加坡、日本等地，已通过松下、索尼、佳能等公司的供应商资质认证，并与国际知名电子企业建立了良好的合作关系。

公司注重研发投入和技术创新，培养和造就了一支能够跟踪和吸收国际先进技术、具备持续创新能力的研究开发团队。新型频率器件研发中心于 2006 年被浙江省科技厅列入“省级高新技术研究开发中心”计划。最近几年来，公司承担了多个国家和省级技术改造项目，取得了多项专利、专有技术、资质和荣誉，具体情况如下：

公司承担的多项国家和省级技术改造项目

序号	项 目	称 号	授予部门	年 份
1	玻璃封装 SMD 石英晶体谐振器	国家重点新产品	科技部	2006 年
2	低功耗 HC49SMD 石英晶体谐振器	国家重点火炬计划项目	科技部	2006 年
3		国家重点新产品	科技部	2005 年
4		国家火炬计划项目	科技部	2004 年
5		浙江省技术创新项目	浙江省科技厅	2003 年
6		SMD3225 表面贴装石英晶体谐振器	浙江省新产品试制项目	浙江省经贸委
7	超薄型手机配套用 SMD 石英晶体元器件产业化	国家信息产业企业技术和产业升级专项项目	国家发展和改革委员会	2004 年
8	低功耗片式手机配套用石英晶体元器件产业化	电子发展基金	信息产业部	2003 年

公司拥有的专利情况

序号	技术名称	专利	取得时间
1	金属封装 SMD 石英晶体谐振器	ZL200420110632.5	2006 年
2	玻璃封装 SMD 石英晶体谐振器	ZL200420110635.9	2006 年
3	防潮型瓷介管状电容器	ZL200420110633.X	2006 年

公司拥有的专有技术情况

序号	技术名称	鉴定情况	年份
1	玻璃封装 SMD 石英晶体谐振器设计制造技术	浙江省科技厅组织的专家鉴定 (浙科鉴字 05 第 456 号)	2005 年
2	金属封装 SMD 石英晶体谐振器设计制造技术	浙江省科技厅组织的专家鉴定 (浙科鉴字 05 第 457 号)	2005 年
3	低功耗 HC49SMD 石英晶体谐振器设计制造技术	浙江省科技厅组织的专家鉴定 (浙科鉴字 02 第 073 号)	2002 年
4	SMD 石英晶体振荡器设计制造技术		2006 年
5	SMD3225 超小型石英晶体谐振器设计制造技术		2006 年
6	石英晶体谐振器与应用线路的匹配技术		2005 年
7	石英晶体谐振器的无铅化技术		2004 年
8	小尺寸 SMD 石英晶体谐振器用的晶片设计制造技术		2004 年
9	DIP 型石英晶体谐振器设计制造技术		1999 年
10	防潮型瓷介管状电容器设计制造技术		1999 年

公司拥有的主要荣誉或资质

序号	荣誉或资质名称	授予部门	年份
1	浙江省信息产业系统“十五”企业技术进步与产业升级工作先进单位	浙江省信息产业厅	2006 年
2	浙江省“十五”技改优秀企业	浙江省经贸委	2006 年
3	Certificate of Green Activity(环境管理优良证书)	佳能公司	2006 年
4	ISO 14001:2004	上海凯瑞克质量体系认证有限公司	2006 年
5	中国电子元件百强企业	中国电子元件行业协会	2005 年
6	国家火炬计划重点高新技术企业	科技部	2005 年
7	中国晶体十佳名优品牌	中国名优品牌发展促进会	2005 年
8	索尼绿色伙伴认证证书	索尼公司	2004 年
9	松下供应商资格认证	松下公司	2003 年
10	ISO9001:2000	鹏程国际认证有限公司	2003 年
11	浙江省高新技术企业产业科技创新重点单位	浙江省科学技术协会	2003 年
12	浙江省高新技术企业	浙江省科技厅	2002 年
13	中国电子行业知名品牌	中国电子质量管理协会	2002 年

公司根据多年实施技术创新管理的成功经验而总结的现代化管理成果——论文《中小型民营企业快速成长的技术创新管理》荣获“第十二届全国企业管理现代化创新成果二等奖”、“2005年浙江省企业管理现代化创新成果一等奖”。

（四） 股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股本结构如下表：

股东（发起人）名称	股权性质	持有股数（万股）	持股比例
李庆跃	自然人股	1,821.60	39.60%
池旭明	自然人股	345.00	7.50%
吴宗泽	自然人股	345.00	7.50%
金良荣	自然人股	248.40	5.40%
陈利平	自然人股	230.00	5.00%
杨亚平	自然人股	230.00	5.00%
俞尚东	自然人股	230.00	5.00%
赵晖	自然人股	230.00	5.00%
蒋旭升	自然人股	230.00	5.00%
方琳	自然人股	230.00	5.00%
陈玉花	自然人股	230.00	5.00%
方永进	自然人股	230.00	5.00%
合 计		4,600.00	100.00%

二、 控股股东、实际控制人简要情况

本公司控股股东、实际控制人为李庆跃，本次发行前持有公司股份 1,821.60 万股，占股本总额的 39.60%。

李庆跃同时担任本公司董事长兼总经理，基本情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司发起人、持有公司 5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况”的相关内容。

三、 发行人主要财务数据及指标

根据立信会计师事务所出具的信会师报字（2007）第 23241 号审计报告，

公司最近三年一期（指：2007年1~6月、2006年度、2005年度、2004年度。以下同）的主要财务数据如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：元

项 目	2007.6.30.	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.
流动资产	114,344,979.54	95,240,017.82	102,308,221.02	64,104,597.64
非流动资产	146,251,742.46	153,652,101.03	120,907,406.88	101,734,607.61
其中：固定资产	135,066,778.62	135,536,053.33	105,146,827.77	92,992,620.62
无形资产	9,286,351.84	9,753,049.18	10,686,443.86	4,556,196.91
资产总计	260,596,722.00	248,892,118.85	223,215,627.90	165,839,205.25
流动负债	74,299,231.29	70,765,799.56	91,177,278.51	101,047,570.06
非流动负债	85,130,250.00	80,358,181.25	55,398,000.00	10,039,137.96
其中：长期负债	85,130,250.00	80,358,181.25	55,398,000.00	10,039,137.96
负债总计	159,429,481.29	151,123,980.81	146,575,278.51	111,086,708.02
股东权益合计	101,167,240.71	97,768,138.04	76,640,349.39	54,752,497.23

（二）利润表及利润分配表主要数据

单位：元

项 目	2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度	
				合并	母公司
营业收入	85,701,192.47	158,334,046.82	122,620,510.11	108,821,605.03	103,806,310.02
营业利润	10,656,590.73	23,820,381.56	18,420,279.38	10,311,422.52	10,297,590.95
利润总额	14,707,609.81	28,217,047.53	21,206,225.45	13,187,816.17	13,173,984.60
净利润	11,219,102.67	22,727,788.65	17,437,852.16	11,598,114.76	11,633,504.92
每股收益	0.24	0.49	0.38	0.25	0.25

（三）所有者权益（股东权益）变动表主要数据

单位：元

项 目	2007.6.30.	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.	
				合并	母公司
实收资本	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
资本公积	7,320,000.00	7,320,000.00	6,620,000.00	920,000.00	920,000.00

浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

盈余公积	6,853,489.36	6,853,489.36	4,580,710.49	1,965,032.66	1,965,032.66
未分配利润	40,993,751.35	37,594,648.68	19,439,638.90	5,867,464.57	5,867,464.57
所有者权益合计	101,167,240.71	97,768,138.04	76,640,349.39	54,752,497.23	54,752,497.23

(四) 现金流量表主要数据

单位：元

项 目	2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度	
				合并	母公司
经营活动产生的现金流量净额	8,057,637.21	31,843,967.64	42,415,729.64	14,312,666.30	13,617,771.81
投资活动产生的现金流量净额	-7,064,662.07	-46,523,156.21	-26,742,741.86	-18,472,744.51	-17,626,688.24
筹资活动产生的现金流量净额	1,937,734.04	-14,803,008.82	26,173,905.86	6,890,462.36	6,899,641.29
现金及现金等价物净增加额	2,930,709.18	-29,482,197.39	41,846,893.64	2,730,384.15	2,890,724.86

(五) 主要财务指标

指 标	2007.6.30.	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.
流动比率	1.54	1.35	1.12	0.63
速动比率	0.99	0.90	0.87	0.39
资产负债率(母公司口径)	61.18%	60.72%	65.67%	66.98%
每股净资产(元)	1.87注	2.13	1.67	1.19
指 标	2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度
应收账款周转率(次/年)	2.68	5.79	4.52	4.59
存货周转率(次/年)	1.71	4.27	3.81	3.98
每股收益(以扣除非经常性损益后的净利润,全面摊薄,元)	0.15	0.40	0.32	0.19
净资产收益率(以扣除非经常性损益后的净利润,全面摊薄)	6.92%	18.69%	19.06%	15.57%
每股经营活动的现金流量净额(元)	0.18	0.69	0.92	0.31
每股现金流量净额(元)	0.06	-0.64	0.91	0.06

注：以截至2007年6月30日经审计的净资产值，扣除发行前老股东已分配的1,500万元滚存利润，按照发行前股本摊薄计算。

四、本次发行情况

股票种类：人民币普通股（A股）

每股面值：1.00元

发行数量:	1,600 万股
发行股数占发行后总股本的比例:	25.81%
发行价格:	8.80 元/股
发行前每股净资产:	1.87 元/股 (以截至 2007 年 6 月 30 日经审计的净资产值, 扣除发行前老股东已分配的 1,500 万元滚存利润, 按照发行前股本摊薄计算)
发行市盈率:	29.83 倍 (以 2006 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润, 按照发行后股本摊薄计算)
发行方式:	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式
发行对象:	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式:	由国信证券作为主承销商, 采取余额包销方式

五、募股资金用途

本次发行募股资金拟投入以下三个项目:

序号	项目名称	总投资 (万元)	项目备案情况
1	新型高精度 SMD 石英晶体元器件技改项目	8,800	金经投资备案[2006]003 号
2	玻璃封装 SMD 石英晶体谐振器技改项目	3,243	金经投资备案[2006]024 号
3	表面贴装元件用石英晶体频率片技术改造项目	3,341	金经投资备案[2006]72 号
	合 计	15,384	

上述项目预计总投资 15,384 万元, 本次发行募股资金将按上述项目排列顺序安排实施, 如本次募股资金不能满足拟投资项目的资金需求, 公司将以自有资

金或银行贷款解决资金缺口；如本次募股资金超过拟投资项目的资金需求，剩余资金将用于补充公司流动资金。募股资金到位前，银行贷款和自有资金先行实施了部分上述项目，募股资金到位后将优先偿还公司因先行实施上述项目所使用的银行贷款及抵补相应的自有资金。

上述项目具体情况详见本招股说明书第十三节“募股资金运用”。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

(一) 本次发行的一般情况

股票种类:	人民币普通股 (A 股)
每股面值:	1.00 元
发行数量:	1,600 万股
发行股数占发行后总股本的比例:	25.81%
发行价格:	8.80 元/股
发行市盈率:	29.83 倍 (以 2006 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润, 按照发行后股本摊薄计算)
发行前每股净资产:	1.87 元/股 (以截至 2007 年 6 月 30 日经审计的净资产值, 扣除发行前老股东已分配的 1,500 万元滚存利润, 按照发行前股本摊薄计算)
发行后每股净资产:	3.45 元/股 (以截至 2007 年 6 月 30 日经审计的净资产值, 扣除发行前老股东已分配的 1,500 万元滚存利润, 加本次募股资金净额, 按照发行后股本摊薄计算)
市净率:	2.55 倍 (以公司发行后每股净资产值计算)

(二) 发行方式与发行对象

发行方式: 采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结

合的发行方式。

发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

（三） 承销方式

承销方式：由国信证券作为主承销商，采取余额包销方式。

（四） 本次发行预计发行费用和实收募股资金概算

单位：万元

费用名称	金 额
1、承销费用	700
2、保荐费用	300
3、审计及验资费用	180
4、律师费用	80
5、评估复核费用	2
6、发行手续费用	39.42
合 计	1301.42

本次发行预计募股资金总额为 14,080 万元，扣除发行费用约 1,301.42 万元后，公司预计募股资金净额约为 12,778.58 万元。

二、 本次发行有关当事人

（一） 发行人

名 称： 浙江东晶电子股份有限公司
 法定代表人： 李庆跃
 住 所： 浙江省金华市宾虹路二段 555 号
 邮政编码： 321017
 联系电话： 0579-82272001
 联系传真： 0579-82273318

互联网址：<http://www.ecec.com.cn>

电子信箱：ecec@ecec.com.cn

联系人：刘洋

（二）保荐人（主承销商）

名称：国信证券有限责任公司

法定代表人：何如

住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

联系电话：0571-87153536

联系传真：0571-87153519

保荐代表人：季诚永、赵勇

项目主办人：刘建毅

（三）发行人律师事务所

名称：上海市锦天城律师事务所

法定代表人：史焕章

住所、联系地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 14 楼

邮政编码：200120

联系电话：021-61059029

联系传真：021-61059100

经办律师：章晓洪、张小燕

（四）审计、验资机构

名称：立信会计师事务所有限公司

法定代表人：朱建弟

住所：上海市南京东路 41 号 4 楼

联系地址：浙江省杭州市江干区新塘路元华商务大厦旺座中心 A
座 20 层

邮政编码：310020

联系电话：0571-85800472

联系传真： 0571-85800465
经办注册会计师： 沈建林、沈利刚

（五） 资产评估复核机构

名 称： 浙江勤信资产评估有限公司
法定代表人： 朱永勤
住所、联系地址： 浙江省杭州市西溪路 128 号西楼 6 楼
邮政编码： 310012
联系电话： 0571-88216952
联系传真： 0571-88216860
经办资产评估师： 喻建军、胡海青

（六） 股票登记机构

名 称： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址： 深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
联系电话： 0755-25938000
传 真： 0755-25988122

（七） 收款银行

名 称： 工商银行深圳市深港支行
户 名： 国信证券有限责任公司
账 号： 4000029119200021817

三、 发行人与中介机构关系的说明

发行人及全体董事与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、 本次发行主要时间表

询价推介时间：2007 年 11 月 30 日至 2007 年 12 月 4 日
定价公告刊登日期：2007 年 12 月 7 日
申购日期和缴款日期：2007 年 12 月 10 日

预计股票上市日期：2007年12月21日

第四节 风险因素

投资者在评价本公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但并不表明风险依排列次序发生。

一、人民币持续升值的风险

自1994年外汇体制改革起，至2005年上半年，我国实行有管理的浮动汇率制度，人民币盯住美元且其汇率仅在一定范围内小幅浮动，公司汇率风险较小。2005年7月21日以来，国家实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。人民币汇率形成机制改革后，人民币总体呈升值趋势，对作为出口型生产企业的本公司有较大的影响。

公司产品90%以上出口。报告期内出口产品以美元为主要结算货币，进口原材料主要以日元、美元结算，进口设备主要以日元结算，其余采购原材料、设备及主要费用支出以人民币支付。如果人民币保持对美元、日元的持续升值，将有利于降低原材料、机器设备的采购成本，但会对产品出口造成不利影响。一方面，如果人民币标价不变，则出口产品外币标价上升，可能削弱公司产品在国际市场的比价优势；另一方面，如果以外币标价不变，则相应人民币标价下降，相当于产品价格下降，产品销售收入可能减少；此外，公司还可能遭受出口收入转化成人民币时的汇兑损失。

自2005年我国人民币汇率形成机制改革以来，人民币有较大幅度的升值，通过2005年7月以后的汇率与人民币升值前汇率比较，经计算对公司2005年7月以后经营业绩情况的影响如下表所示：

单位：元

项目	2007年1-6月	2006年度	2005年7-12月
外币销售影响收入金额	-5,790,976.81	-5,593,499.73	-1,252,018.72

外币采购原材料影响成本金额	-1,287,662.00	-968,534.47	-28,292.21
外币采购设备计提折旧影响成本金额	-10,219.13	-112,274.55	-1,151.84
汇兑损益	-491,117.77	39,583.91	2,197,292.65
利润总额	-4,984,213.45	-4,473,106.80	974,717.98
所得税	-1,644,790.44	-1,476,125.24	321,656.93
净利润	-3,339,423.01	-2,996,981.56	653,061.05

预计未来几年，公司产品出口和原材料、设备进口格局不会发生重大变化，随着公司经营规模的扩大，公司通过国际市场采购和销售的金额可能进一步增加。因此，人民币持续升值将可能对公司经营成果带来一定的负面影响。

二、市场风险

（一）依赖国际市场的风险

公司致力于中高端石英晶体元器件的研发、生产和销售，该等产品在移动电话、笔记本电脑和汽车电子等领域的广泛应用是近几年来推动行业发展的重要因素，目前上述电子整机产品核心零部件的设计、研发和装配大多集中在国外的行业骨干企业。公司为顺应石英晶体元器件的全球市场需求，产品主要用于出口，且随着产品档次的提升，出口比例一直维持在较高的水平，公司2007年1~6月、2006年度、2005年度和2004年度的产品出口比例分别为95.47%、92.20%、94.67%和86.37%。出口地区主要集中在中国台湾、新加坡和日本等地，产品的最终客户多为大型跨国公司。一方面，全球经济的景气程度和国际信息产业的发展变化，将可能对本公司出口业务带来影响。另一方面，尽管目前公司产品出口尚不存在贸易壁垒，与进口国（地区）发生贸易摩擦的可能性较小，但并不排除未来可能在知识产权纠纷、反倾销调查和技术贸易壁垒等方面出现不利变化，因而存在一定的国际市场风险。

（二）产品价格下降的风险

从长期看，以技术突破为先导的信息产业，其市场竞争有一定的规律可循，如降价规律。每当一项技术被突破，单位产品的成本（价值）就会大幅度下降，

从而给市场竞争带来大幅度的降价空间。一个产品降价（特别是元器件），带来了整个产业链的连锁降价。产品降价通常能带来销售量的大幅提升，企业通过技术革新和规模化量产降低产品单位成本，从而实现利润增长和推动行业发展。

本公司主要产品为石英晶体谐振器，其销售额占公司主营业务收入的 90% 以上。尽管国际、国内市场对石英晶体元器件需求量近年来一直保持较高的增长速度，但随着技术进步、规模化生产以及石英晶体元器件市场竞争的加剧，主要产品价格呈下降趋势；同时，下游行业如通信设备、家电、计算机等电子整机产品价格持续下降，挤压了石英晶体元器件的利润空间。如日本 2000 年石英晶体元器件的产量为 51 亿只，营业额为 2,817 亿日元，2005 年产量达到 64.9 亿只，但营业额却降至 2,241.7 亿日元（数据来源：中国电子元件行业协会压电晶体分会 2006 年年会资料）。

最近三年一期，公司主要产品 SMD 谐振器、DIP 谐振器平均售价的变动情况如下表所示：

单位：元/万只

产品类别	2007 年 1~6 月		2006 年度		2005 年度		2004 年度
	平均单价	增幅	平均单价	增幅	平均单价	增幅	平均单价
SMD 谐振器	10,554.03	-2.42%	10,815.88	-4.55%	11,331.71	-13.95%	13,168.11
DIP 谐振器	3,797.86	-15.30%	4,483.73	-4.93%	4,716.26	-14.11%	5,491.30

公司通过加大新产品研发和产品结构优化力度，提高附加值较高的产品——SMD 石英晶体元器件的销售比重，从而增强对下游产品价格波动的承受能力并保持相对稳定的毛利率，2007 年 1~6 月、2006 年度、2005 年度和 2004 年度石英晶体谐振器产品毛利率分别为 28.92%、27.42%、25.89%和 23.92%。但如果行业内产品价格仍保持下降的趋势，而公司产品结构优化不足以弥补产品降价的负面影响，则主要产品销售价格的下降将可能影响公司未来的盈利能力。

三、经营风险

(一) 客户集中度较高的风险

2007年1~6月、2006年度、2005年度和2004年度，公司对前五名客户合计的销售额占当期主营业务收入的比重分别为59.99%、42.90%、46.41%和83.63%。近年来，公司不断加强营销力度，拓展销售渠道，客户群体趋于分散，但客户集中度仍然较高。

在多年经营中，公司已经培育了一批稳定的客户群体，与主要客户建立起良好的互利合作关系。2007年1~6月、2006年度、2005年度和2004年度，公司前五名客户合计的应收账款期末余额占当期应收账款期末余额的比重分别为47.71%、35.56%、25.75%和79.26%。这些客户多为行业内知名企业，资金实力较为雄厚，回款历史记录良好，但如果主要客户自身经营状况或市场销售情况不佳，或财务状况出现恶化等大的变化，可能减少乃至取消对本公司的订单，或者对本公司应收账款的及时回收等产生不利影响。

公司虽通过松下、索尼、佳能供应商资格认证，且与国外同类产品相比价格优势显著，相对而言，公司有一定的定价能力，但随着中国电子元器件制造企业全方位、深层次地参与国际竞争及国外电子元器件制造企业向中国转移，电子元器件的市场竞争加剧，可能削弱公司的定价能力，进而可能影响公司未来的盈利能力。

(二) 主要供应商较为集中的风险

石英晶体谐振器的原材料主要有晶片、外壳、基座，三者的采购成本占公司产品原材料成本的75%左右。综合原材料供应质量、供货及时性及集中采购成本等方面的因素，本公司对同一种原材料供应商的选择基本控制在3家以内。目前生产SMD产品所需的基座和外壳国内已有企业完成研发并开始试生产，但尚不能大批量供应，生产SMD产品所需的基座和外壳目前仍以进口为主，随着本公司SMD石英晶体元器件产销比例的逐步提高，本公司与我国台湾晶技股份有限公司（以下简称“台湾晶技”）等公司建立了共享采购平台的合作伙伴关系，通过集合同行业多家企业的采购需求后向国际厂商集中采购，该措施有利于降低采购成本并保证供货的及时性。

2007年1~6月、2006年度、2005年度和2004年度公司向前五名供应商合计的采购额占当期公司对外采购总额的比重分别为54.45%、60.28%、52.97%和40.66%，其中，公司从第一大供应商台湾晶技及其关联企业台晶（宁波）电子有限公司（以下简称“宁波台晶”）合计采购的金额占当期总采购金额的比例分别为24.72%、37.02%、30.99%和13.87%。

如果公司的原材料供应商进一步集中，有可能削弱公司在采购中的议价能力，引起公司采购成本的增加；如果公司与主要供应商的合作关系发生不利变化，或者公司主要供应商的经营或财务状况出现不利变化，有可能导致不能足量、及时供货或采购成本的增加，由此一方面有可能增加公司与新供应商的磨合成本，另一方面可能使公司因原材料暂时供应不足而带来产能利用不足或生产成本的提高，从而影响本公司的正常经营和盈利能力。

（三）产品结构单一风险

本公司主要生产和经营压电石英晶体元器件。为了顺应石英晶体元器件小型化、精密化、片式化的发展方向，公司近年来逐步调整产品结构，2007年1~6月、2006年度、2005年度和2004年度，公司各类SMD石英晶体元器件的销售额占本公司主营业务收入的比重分别为56.43%、55.85%、45.97%和35.46%。与此同时，公司不断开发高精度、小型化的SMD谐振器系列产品，其中，代表内资企业先进水平的SMD5032于2005年下半年已经量产，更小规格的SMD3225也已于2006年完成研发设计，计划2007年下半年开始批量生产。

与国内同行相比，公司在SMD谐振器的产品开发和工艺技术方面处于领先地位。募股资金投资项目达产后，公司产品结构还将进一步优化，附加值高的产品比重将大幅增加。但公司产品结构仍然比较单一，主要集中在谐振器产品系列。这种相对集中的产品结构说明本公司主营业务突出，生产专业化程度较高，并在科学管理、规模化经营和降低成本方面受益，但同时也使本公司抵御石英晶体元器件市场的非系统风险的能力降低，如果石英晶体谐振器的市场需求或价格发生较大的波动，将会对本公司收入和盈利水平带来影响。

四、财政优惠政策变化风险

公司自成立以来，一直立足于强化主业，不断扩大经营规模和提升技术创

新能力，以增强公司的市场竞争能力和盈利能力。公司主营业务收入、主营业务利润保持快速增长，最近三年一期增长情况如下：

财务指标	2007年1~6月		2006年度		2005年度		2004年度
	金额(元)	同比增长	金额(元)	增幅	金额(元)	增幅	金额(元)
营业收入	85,701,192.47	24.24%	158,334,046.82	29.13%	122,620,510.11	12.68%	108,821,605.03
营业利润	10,656,590.73	37.90%	23,820,381.56	29.32%	18,420,279.38	78.64%	10,311,422.52
其中：营业外收入	4,154,000.02	19.31%	4,615,000.00	57.21%	2,935,536.00	-10.69%	3,286,724.00
利润总额	14,707,609.81	32.31%	28,217,047.53	33.06%	21,206,225.45	60.80%	13,187,816.17
净利润	11,219,102.67	27.58%	22,727,788.65	30.34%	17,437,852.16	50.35%	11,598,114.76

公司在主营业务快速增长的同时，作为国家重点高新技术企业和行业内重要的出口创汇企业，得到了国家和当地政府的重视和支持。2007年1~6月、2006年度、2005年度和2004年度，公司获得的各项重点技改项目专项补助、技改贴息和出口贴息等政策优惠资金合计分别为415.40万元、461.50万元、293.55万元和328.67万元，占当期利润总额的比重分别为28.24%、16.36%、13.84%和24.92%。若国家和地方政府的有关财政补贴优惠政策发生重大调整，如降低或者取消，可能对本公司利润产生一定的影响。

五、实际控制人风险

本次发行前李庆跃持有本公司39.60%的股份，是公司的控股股东和实际控制人；本次发行后其持有本公司的股份比例降至29.38%，仍为本公司的第一大股东；李庆跃还担任公司的董事长兼总经理。尽管公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《关联交易决策权限与程序规则》等规则，建立了独立董事制度、累积投票制度，实际控制人也做出不利用其实际控制人地位损害本公司利益、避免同业竞争等承诺，但控股股东（实际控制人）仍可凭借其控制地位对本公司生产经营带来一定的影响。

六、商标风险

公司目前使用三项商标，其中，“”文字图形商标已取得第3212425号

商标注册证，“ECEC”商标已取得第 1642225 号商标注册证，“^{ECEC}东晶电子”目前尚处于异议未裁定阶段。报告期内本公司使用“^{ECEC}东晶电子”商标销售的产品占主营业务收入的比例分别为 8.35%、8.02%、7.95%、5.86%。如果公司未来不能使用该商标，可能影响公司的销售和盈利情况。

七、技术风险

随着电子产品的不断小型化，为之配套的石英晶体元器件高精度、小型化趋势也必然加快。同时，石英晶体元器件应用领域的迅速拓展，要求石英晶体元器件生产企业具备更为敏锐的把握市场的能力、强大的技术实力以及掌握最新技术信息的能力。公司新产品开发主要体现为对国际高端产品的跟踪和研制。虽然目前本公司的研发水平和生产工艺在国内同行业中处于领先地位，但与国际行业一流企业相比，仍有较大的差距。如果公司未来的研发、制造等不能及时跟上本行业技术更新换代的速度，将可能削弱公司的市场竞争优势。

八、担保风险

公司与浙江今飞机械集团有限公司及其控股子公司浙江今飞凯达轮毂有限公司存在银行借款互保关系。截至本招股说明书签署日，公司为浙江今飞凯达轮毂有限公司累计人民币1,500万元的银行借款提供担保，协议履行期为自2005年10月31日至2007年12月31日，浙江今飞凯达轮毂有限公司则为公司1,000万元银行借款和395.26万元的银行承兑汇票提供担保。

本公司与浙江今飞凯达轮毂有限公司不存在关联关系。根据浙江今飞凯达轮毂有限公司 2006 年度审计报告，截至 2006 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 45,476.90 万元，净资产为 19,298.70 万元，资产负债率为 57.56%，2006 年度实现销售收入 48,953.14 万元，净利润 2,615.47 万元，财务状况较好。但如果浙江今飞凯达轮毂有限公司到期不能及时归还银行贷款，则公司可能被要求依法承担连带责任，因而存在一定的担保风险。

九、人力资源风险

本公司在多年的发展中，已积累了一定的管理经验并培养出了一批具有丰

富实践经验的管理人才和专业技术人才，截至2007年6月30日，本公司大学本科以上学历人员为96人，占人员总数的11.79%，但与公司发展的要求相比，高级人才比例仍然偏低。随着股票公开发行和上市、募股资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、原材料采购和产品销售规模将迅速扩大，各类人才的需求将大量增加。若人力资源发展未能跟上公司内外环境的变化，将给公司带来不利影响。此外，公司也面临市场竞争加剧引致的人力资源成本上升的问题，由此可能影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，从而降低公司的市场竞争力。

十、募股资金投资项目实施风险

公司本次发行募股资金投资项目的可行性分析是基于当前国内外市场环境、产品价格、原材料供应及本行业工艺技术水平等因素作出的。由于市场和行业的情况不断发展变化，募股资金项目实施仍可能面临诸多风险，如：

1、技术风险

虽然公司已经掌握本次募集资金投资项目所涉及生产的技术，产品的加工工艺业已成熟，且 SMD5032 已经实现大批量生产，但这些技术和工艺在项目的实施过程中仍然有不断完善与优化要求。此外，电子元器件行业的技术更新迅速，如果公司不能及时跟踪和掌握行业前沿的新技术和新工艺，募集资金项目产品在国内同行业的竞争优势将难以持续。

2、成本风险

近几年来，国内劳动力和能源的价格一直处于上升通道，公司募集资金投资项目实施后，生产规模迅速扩大，劳动力和能源的使用量快速上升，公司将面临生产成本上涨的压力。此外，如果原材料采购价格上涨，而产品售价不能同步提升，募集资金投资项目可能将面临无法取得预期经营效果的风险。

3、市场风险

公司本次发行股票募集资金投资项目实施后，产能将大幅度提高；如果市场开拓滞后，募集资金投资项目将不能如期增效。虽然本次募集资金投资项目经过了充分、审慎的可行性分析并经过专家严密论证，但是电子行业是一个充分竞争和开放的行业，若募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场大环境发生变化、行业竞争程度超过预期或项目建设过程管理不善导致不能如期实施，将存在募集资金投资项目预期效益降低的风险。

十一、税收优惠政策变动的风险

根据财政部、国家税务总局财税字[1999]290号文《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》，经金华市地方税务局批准，2006年度、2005年度、2004年度，公司因技术改造购买国产设备投资抵免所得税额分别为171.61万元、188.88万元、172.47万元，上述抵免所得税直接增加公司当年净利润，所得税抵免额分别占公司当年净利润的7.55%、10.83%、14.87%。如果未来技术改造国产设备投资抵免所得税政策发生变化，可能会对公司的经营业绩产生一定的影响。

本公司出口产品增值税采用“免、抵、退”的计算办法，根据《财政部、国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知》（财税[2003]222号）的规定，自2004年1月1日起，公司产品的出口退税率由17%降为13%，这对公司的经营业绩产生了一定影响，2004年1~10月，由于出口退税率的下降直接导致公司净利润减少181.96万元。根据财政部、国家税务总局财税[2004]200号文《关于提高部分信息技术（IT）产品出口退税率的通知》规定，从2004年11月1日起本公司经营产品的出口退税率由13%提高到17%。根据财政部、国家税务总局财税[2007]90号文《关于调低部分商品出口退税率的通知》规定，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率，本公司经营产品不在调整目录之列，仍执行17%的出口退税率。

公司报告期内平均产品的出口比例为92.18%，按2008年开始企业所得税率25%计算，未来公司产品出口退税率如果每下调1%，公司净利润将下降0.69%。

十二、因违规资金拆借可能遭受有关部门处罚的风险

报告期内，公司为了解决日常生产经营的临时资金周转需要，与原参股企业金华惠成投资担保有限公司（以下简称“惠成公司”）发生资金拆借的偶发性关联交易，2006年度、2005年度、2004年度，公司分别借入惠成公司短期资金400万元、2,750万元、1,760万元，支付资金占用费80,180元、285,600元、49,925元，同期，分别向惠成公司借出短期资金300万元、750万元、450万元，收取资金占用费30,000元、165,110元、29,125元，上述短期资金均已在当期偿还完毕。

公司与惠成公司之间的资金拆借行为违反了中国人民银行《贷款通则》第六十七条的“企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务”的规定，

公司为惠成投资提供短期资金的行为，中国人民银行可根据《贷款通则》第七十三条的规定，对公司累计收取的资金占用费 224,235 元处以一倍以上五倍以下的罚款。公司已明确表示，若中国人民银行对公司因该事项而进行处罚，愿意承担相应的责任，公司本次发行前的全体股东已书面承诺，愿意代公司承担处罚款项。

十三、统计数字及各种公开资料来源可能不可靠的风险

本招股说明书所刊载的有关我国宏观经济、行业等各种统计数字及其他资料来自于各种公开资料，可能不准确、不完全或者已经过时。此外，不同的资料可能并非按照同样的标准编制。本公司不对该等资料的准确性或者正确性作出任何声明或承诺，同时，亦提醒投资者注意，不应不适当地依赖上述资料。

十四、前瞻性陈述可能不准确的风险

本招股说明书刊载有若干前瞻性陈述，涉及本公司未来经营管理、技术开发、产业化、盈利能力等方面的预期或相关的讨论。尽管本公司相信，该等预期或讨论所依据的假设是合理的，但亦提醒投资者注意，该等预期或讨论涉及风险和不确定因素可能不准确。鉴于该等风险及不确定因素的存在，本招股说明书所刊载的任何前瞻性陈述，不应视为本公司的承诺或声明。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

注册中文名称：浙江东晶电子股份有限公司

英文名称： ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO., LTD.

法定代表人： 李庆跃

成立日期： 1999年4月23日

住 所： 浙江省金华市宾虹路二段555号

邮政编码： 321017

电 话： 0579—82272001

传 真： 0579—82273318

互联网网址： <http://www.ecec.com.cn>

电子信箱： ecec@ecec.com.cn

二、发行人改制重组情况

（一） 公司的设立方式

经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2004]55号文《关于同意变更设立浙江东晶电子股份有限公司的批复》同意，金华市东晶电子有限公司整体变更为浙江东晶电子股份有限公司。2004年7月30日，公司经浙江省工商行政管理局核准注册登记，取得注册号为3300001010780的企业法人营业执照。

（二） 公司的发起人

本公司的发起人为李庆跃、池旭明、吴宗泽、金良荣、陈利平、杨亚平、俞尚东、方琳、方永进、蒋旭升、陈玉花、赵晖等12名自然人。

（三） 发行人设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

李庆跃为本公司主要发起人、控股股东，持有本公司39.60%的股份，并担任

公司董事长兼总经理。

李庆跃在本公司改制设立前，除持有本公司前身金华东晶的股权并经营外，还曾经出资20万元投资金华市宏凯电子有限公司（以下简称“宏凯电子”），但未参与该公司的经营管理。关于宏凯电子的有关情况请参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联关系”之“二、关于关联方和关联关系”。

本公司改制设立后，李庆跃除持有本公司股份并参与本公司经营外，并无投资和参与经营其他经营性实体的情形。

本公司其他发起人除持有本公司股份外，均无投资和参与经营其他经营性实体的情形。

（四） 发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务

发行人成立时拥有的主要资产为：与压电石英晶体谐振器、振荡器、瓷介管状电容器生产经营相关的房屋及建筑物、专用设备、通用设备、其他设备、土地使用权、商标权等。

发行人成立时从事的主要业务为研发、设计、生产、销售压电晶体元器件，主要产品为石英晶体谐振器（SMD和DIP）和瓷介管状电容器。

（五） 公司业务流程

公司系有限责任公司整体变更设立，设立前后公司业务流程没有发生变化。具体的业务流程参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、公司主要业务经营情况”。

（六） 发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况

主要发起人李庆跃除担任公司董事长兼总经理外，与发行人在生产经营方面不存在其他关联关系。

（七） 发起人出资资产的产权变更

本公司系由金华东晶在整体变更的基础上发起设立，原金华东晶资产、负债、权益全部由发行人承继，资产权属及负债的变更均已履行必要的法律手续。

（八） 公司独立运营情况

公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与股东及关联方相互独立。

1、业务独立

本公司由金华东晶整体变更设立，拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。控股股东除投资本公司外，并无其他经营性投资和参与经营的事项，其他主要股东也未从事与公司可能存在同业竞争的业务。

2、资产完整

本公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司资产与发起人资产产权已明确界定和划清，发起人股东投入资产足额到位。金华东晶整体变更为股份有限公司后，公司依法办理了相关资产、股权的变更登记，专利、专有技术和商标等资产亦全部为本公司独立拥有。

3、机构独立

本公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，股东全部为自然人，不存在与股东混合经营的情形。

4、人员独立

本公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员（不含独立董事）均专职在本公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有较完善的管理制度和体系。

5、财务独立

本公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行

账户或混合纳税现象。

截至本招股说明书签署日，本公司不存在以公司资产、权益或信誉为股东或其他关联方债务提供担保的情形，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在货币资金或其他资产被股东占用而损害公司利益的情况。

三、 发行人股本形成、变化及重大资产重组情况

（一） 发行人股本形成及变化

本公司由金华市东晶电子有限公司整体变更设立，股本形成及变化如下：

1、1999年4月金华东晶成立

1999年4月23日，李庆跃等28名自然人以现金出资组建金华东晶，注册资本50万元，注册地址为金华市人民东路1193号。经营范围为：电子器件及电子设备配件的生产、销售。金华东晶成立时，股东出资金额及出资比例如下表。

1999年金华东晶成立时的股本结构

股东姓名	出资金额 (万元)	出资比例	股东姓名	出资金额 (万元)	出资比例
李庆跃	6.00	12.00%	张兴肇	1.20	2.40%
金良荣	3.00	6.00%	杨亚平	1.20	2.40%
池旭明	3.00	6.00%	陈利平	1.20	2.40%
吴宗泽	3.00	6.00%	徐天云	1.20	2.40%
吴桂香	3.00	6.00%	徐正良	1.20	2.40%
程汉霖	3.00	6.00%	徐雁芬	1.20	2.40%
骆红莉	2.00	4.00%	辛向荣	1.20	2.40%
李娜	1.80	3.60%	赵晖	1.20	2.40%
蒋阳花	1.80	3.60%	刘金刚	1.20	2.40%
朱晓阳	1.80	3.60%	蒋旭升	1.20	2.40%
俞尚东	1.20	2.40%	蒋惠芳	1.20	2.40%
张笑琴	1.20	2.40%	程建华	1.20	2.40%
吴金林	1.20	2.40%	陈莲清	1.20	2.40%
赵瑞华	1.20	2.40%	姚耿前	1.20	2.40%
合 计			50.00		100.00%

浙江金华会计师事务所以浙金会师厅验（1999）第11号《验资报告》对金华东晶设立时的出资情况进行了审验。

2、2000年2月金华东晶增加注册资本

2000年2月29日，金华东晶召开股东会，通过了将注册资本由50万元增加至500万元的决议。金华东晶全体股东分别按照原出资比例进行增资，新增加的注册资金由三部分构成：新增现金出资403,000元；1999年税后未分配利润中提取638,230元按出资比例送股增资；经评估价值为3,458,770元的机器设备投入增资。用于增资的机器设备的情况详见第十节“财务会计信息”之“十二、资产评估情况”。

金华东晶股东增资情况表

单位：元

股东名称	原始出资		本次增资金额			累计出资	
	金额	比例	现金增资	送红股增资	设备增资	金额	比例
李庆跃	60,000.00	12.00%	48,360.00	76,587.60	415,052.40	600,000.00	12.00%
金良荣	30,000.00	6.00%	24,180.00	38,293.80	207,526.20	300,000.00	6.00%
池旭明	30,000.00	6.00%	24,180.00	38,293.80	207,526.20	300,000.00	6.00%
吴宗泽	30,000.00	6.00%	24,180.00	38,293.80	207,526.20	300,000.00	6.00%
吴桂香	30,000.00	6.00%	24,180.00	38,293.80	207,526.20	300,000.00	6.00%
程汉霖	30,000.00	6.00%	24,180.00	38,293.80	207,526.20	300,000.00	6.00%
骆红莉	20,000.00	4.00%	16,120.00	25,529.20	138,350.80	200,000.00	4.00%
李娜	18,000.00	3.60%	14,508.00	22,976.28	124,515.72	180,000.00	3.60%
蒋阳花	18,000.00	3.60%	14,508.00	22,976.28	124,515.72	180,000.00	3.60%
朱晓阳	18,000.00	3.60%	14,508.00	22,976.28	124,515.72	180,000.00	3.60%
俞尚东	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
张笑琴	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
吴金林	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
赵瑞华	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
张兴肇	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
杨亚平	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
陈利平	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
徐天云	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
徐正良	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
徐雁芬	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
辛向荣	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
赵晖	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
刘金刚	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
蒋旭升	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
蒋惠芳	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
程建华	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
陈莲清	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
姚耿前	12,000.00	2.40%	9,672.00	15,317.52	83,010.48	120,000.00	2.40%
合计	500,000.00	100.00%	403,000.00	638,230.00	3,458,770.00	5,000,000.00	100.00%

金华天鉴会计师事务所有限公司对金华东晶增加注册资本进行了验资，并于2000年3月14日出具了金华天鉴验（2000）第68号《验资报告》。2000年3月22日，金华东晶取得变更登记后的营业执照，注册资本500万元。增资后各股东持股比例和管理层均未发生变化。

2000年金华东晶增资后的股本结构

股东姓名	出资金额 (万元)	出资比例	股东姓名	出资金额 (万元)	出资比例
李庆跃	60.00	12.00%	张兴肇	12.00	2.40%
金良荣	30.00	6.00%	杨亚平	12.00	2.40%
池旭明	30.00	6.00%	陈利平	12.00	2.40%
吴宗泽	30.00	6.00%	徐天云	12.00	2.40%
吴桂香	30.00	6.00%	徐正良	12.00	2.40%
程汉霖	30.00	6.00%	徐雁芬	12.00	2.40%
骆红莉	20.00	4.00%	辛向荣	12.00	2.40%
李娜	18.00	3.60%	赵晖	12.00	2.40%
蒋阳花	18.00	3.60%	刘金刚	12.00	2.40%
朱晓阳	18.00	3.60%	蒋旭升	12.00	2.40%
俞尚东	12.00	2.40%	蒋惠芳	12.00	2.40%
张笑琴	12.00	2.40%	程建华	12.00	2.40%
吴金林	12.00	2.40%	陈莲清	12.00	2.40%
赵瑞华	12.00	2.40%	姚耿前	12.00	2.40%
合 计			500.00		100.00%

3、2001年9月金华东晶股权结构变动

2001年7月12日，张兴肇、徐雁芬、徐正良、辛向荣、陈莲清、刘金刚、吴金林、赵瑞华、蒋惠芳、张笑琴、姚耿前、程建华向李庆跃转让其对金华东晶合计27.6%的出资；吴桂香向方琳转让其对金华东晶5%的出资；程汉霖向方永进转让其对金华东晶5%的出资；吴桂香、金良荣、程汉霖向俞尚东转让其对金华东晶合计2.6%的出资；朱晓阳、徐天云向池旭明转让其对金华东晶合计1.5%的出资；朱晓阳向杨亚平转让其对金华东晶2.6%的出资；徐天云、蒋阳花向吴宗泽转让其对金华东晶合计1.5%的出资；程建华、徐天云向陈利平转让其对金华东晶合计2.6%的出资；骆红莉向蒋旭升转让其对金华东晶2.6%的出资；李娜、骆红莉向陈玉花转让其对金华东晶合计5%的出资；蒋阳花向赵晖转让其对金华东晶2.6%的出资。上述股权转让各方均签订了相应的《股权转让协议》，转让价格均为出资金额的1.5倍，转让款项均于2001年8月交讫。2001年7月28日，金华东晶

召开2001年第2次临时股东会，审议通过了上述股权转让事项。金华天鉴会计师事务所有限公司对金华东晶截至2001年8月31日的出资转让情况进行了审验，并出具了金华天鉴验（2001）第046号《验资报告》。

上述股权转让具体情况如下表：

单位：万元

转让方	出资比例	转让价格	受让方	原出资比例	受让比例	累计出资	
						出资额	比例
张兴肇	2.40%	18.00	李庆跃	12.00%	27.60%	198.00	39.60%
徐雁芬	2.40%	18.00					
徐正良	2.40%	18.00					
辛向荣	2.40%	18.00					
陈莲清	2.40%	18.00					
刘金刚	2.40%	18.00					
吴金林	2.40%	18.00					
赵瑞华	2.40%	18.00					
蒋惠芳	2.40%	18.00					
张笑琴	2.40%	18.00					
姚耿前	2.40%	18.00					
程建华	1.20%	9.00					
朱晓阳	1.00%	7.50	池旭明	6.00%	1.50%	37.50	7.50%
徐天云	0.50%	3.75	吴宗泽	6.00%	1.50%	37.50	7.50%
蒋阳花	1.00%	7.50					
徐天云	0.50%	3.75	金良荣	6.00%	-0.60%	27.00	5.40%
金良荣	0.60%	4.50					
吴桂香	1.00%	7.50	俞尚东	2.40%	2.60%	25.00	5.00%
程汉霖	1.00%	7.50					
朱晓阳	2.60%	19.50	杨亚平	2.40%	2.60%	25.00	5.00%
徐天云	1.40%	10.50	陈利平	2.40%	2.60%	25.00	5.00%
程建华	1.20%	9.00					
蒋阳花	2.60%	19.50	赵晖	2.40%	2.60%	25.00	5.00%
骆红莉	2.60%	19.50	蒋旭升	2.40%	2.60%	25.00	5.00%
吴桂香	5.00%	37.50	方琳	-	5.00%	25.00	5.00%
李娜	3.60%	27.00	陈玉花	-	5.00%	25.00	5.00%
骆红莉	1.40%	10.50					
程汉霖	5.00%	37.50	方永进	-	5.00%	25.00	5.00%
合计	58.60%	439.50		42.00%	58.00%	500.00	100.00%

此次股权结构变更后，金华东晶的股东及其出资情况为：

股东名称	出资金额 (万元)	出资比例	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例
李庆跃	198.00	39.60%	赵 晖	25.00	5.00%
金良荣	27.00	5.40%	蒋旭升	25.00	5.00%
池旭明	37.50	7.50%	俞尚东	25.00	5.00%
吴宗泽	37.50	7.50%	方 琳	25.00	5.00%
陈利平	25.00	5.00%	陈玉花	25.00	5.00%
杨亚平	25.00	5.00%	方永进	25.00	5.00%
合 计			500.00		100.00%

4、金华东晶享受的所得税减免优惠及其所形成资产的处置情况

金华东晶于2000年12月取得浙江省就业管理服务局颁发的劳动就业服务企业证书，注册号为浙金劳字027号。2001年~2003年，金华东晶的劳动就业服务企业资格分别通过了金华市就业管理服务局和金华市地方税务局的联合年检认证，安置城镇失业人员的比例达到相关要求。

根据财政部、国家税务总局财税【1994】1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，经浙江省地方税务局批准，金华东晶2000年、2001年免征企业所得税。根据浙江省地方税务局浙地税发[2003]24号文《浙江省地方税务局关于所得税若干问题的通知》，自2002年度起，劳动就业服务（安置）企业有关减免所得税事项，下放由各主管地税局进行审批。经金华市地方税务局批准，金华东晶2002年、2003年减半征收企业所得税。

在各级税务部门对金华东晶所得税减免的批复文件中，金华市地方税务局金市地税所[2001]08号文、金华市地方税务局江北征管局金市地税北[2002]12号文分别明确，2000年度、2001年度免征税款全额计入“盈余公积—国家扶持资金”科目单独反映，全部用于发展生产经营，不得用于职工福利和奖励。

金华东晶在对劳动就业服务企业的所得税减免进行财务处理时，均列入“盈余公积—国家扶持资金”科目。金华市财政局、金华市国有资产管理委员会办公室于2004年7月15日出具《关于财政税收优惠形成的国家扶持资金确权的函》，明确：截至2003年底，金华东晶由财政税收优惠而形成的国家扶持资金13,366,394.33元归投资者所有。

金华市地方税务局于 2007 年 4 月 30 日同意金华东晶 2000 年度、2001 年度、2002 年度、2003 年度的所得税减免按照现行会计制度进行会计处理，列入当期损益。2007 年 5 月 15 日，浙江省地方税务局同意金华东晶 2000 年度、2001 年度、2002 年度、2003 年度的所得税减免按现行企业会计制度的有关规定处理。

金华市劳动和社会保障局、金华市人民政府国有资产监督管理委员会和金华市地方税务局于 2007 年 5 月 8 日以金市劳复[2007]3 号《关于原金华市东晶电子有限公司享受劳动就业服务企业所得税优惠政策而形成的资产所有权的批复》确认：金华市东晶电子有限公司是劳动就业服务企业，2000 年~2003 年经税务机关批准享受财政部、国家税务总局[1994]财税字第 001 号文件规定的劳动就业服务企业所得税减免政策，四年合计减免税额 1,336.64 万元，根据劳动部、国家国有资产管理局、国家税务总局《劳动就业服务企业产权界定规定》（劳部发[1997]181 号），上述减免税为金华市东晶电子有限公司投资者所有。

发行人律师认为：发行人因劳动就业服务企业而享受的税收优惠经审计后列入公司净资产并折股给发行人的发起人股东真实、合法、有效。

保荐人认为：金华东晶由财政税收优惠而形成的国家扶持资金划归投资者所有以及金华东晶股权的形成合法有效。

5、2004 年 7 月整体变更设立股份有限公司

2004 年 6 月 12 日，金华东晶召开股东会，全体股东一致通过了依法整体变更设立股份有限公司的决议，同时确定拟变更后公司的注册资本为 4,600 万元，将金华东晶截至 2004 年 6 月 30 日经审计的净资产中超过 4,600 万元的部分按股东持股比例进行分配。

根据立信会计师事务所于 2004 年 7 月 15 日出具的信长会师报字（2004）第 21738 号《审计报告》，截至 2004 年 6 月 30 日，公司的净资产为 4,600 万元，按 1:1 比例折合成公司的股本，由股东按原出资比例持有相应的股份。立信会计师事务所对公司截至 2004 年 6 月 30 日的股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验，并出具了信长会师报字（2004）第 21740 号《验资报告》。

金华东晶自设立以来至 2004 年 6 月 30 日的净资产形成及变动情况如下表所示：

单位：元

项目	2004年1~6月	2003年度	2002年度	2001年度	2000年度	1999年度	累计
股东直接投入	-	-	-	-	3,861,770.00	500,000.00	4,361,770.00
公司经营积累	5,050,730.51	-385,469.22	6,900,181.25	6,001,531.95	7,614,878.01	2,632,476.49	27,814,328.99
政府补贴	1,261,990.00	3,027,100.00	1,575,493.00	25,589.00	-	-	5,890,172.00
税收减免	-	828,892.46	4,190,700.17	5,139,876.57	4,923,656.33	592,984.64	15,676,110.17
接受捐赠	-	-	-	13,000.00	-	-	13,000.00
债务重组收益	37,350.00	324,011.62	-	-	-	-	361,361.62
股东分红	-170,605.84	-3,000,000.00	-3,800,000.00	-500,000.00	-646,136.94	-	-8,116,742.78
合计	6,179,464.67	794,534.86	8,866,374.42	10,679,997.52	15,754,167.40	3,725,461.13	46,000,000.00

注1、 税收减免具体明细如下表所示：

单位：元

项目	2004年1~6月	2003年度	2002年度	2001年度	2000年度	1999年度	累计
劳动就业服务企业享受企业所得税减免	-	828,892.46	2,473,968.97	5,139,876.57	4,923,656.33	-	13,366,394.33
技术改造国产设备投资抵免企业所得税	-	-	1,716,731.20	-	-	592,984.64	2,309,715.84
合计	-	828,892.46	4,190,700.17	5,139,876.57	4,923,656.33	592,984.64	15,676,110.17

注2、 1999年至2001年数据系在公司提供的1999~2001年财务会计报表的基础上，按照立信会计师事务所对2002年度审计时对期初数进行追溯调整后得出的相应数据。

注3、 2002年至2004年1~6月数据业经立信会计师事务所审计。

注4、 公司经营积累数据系公司当期净利润减去税收减免和计入损益部分的政府补贴，2003年因公司厂房整体搬迁导致经营业绩下降。

注5、 股东分红系公司分配现金股利。

2004年7月27日，浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2004]55号文批复同意本公司设立，2004年7月30日，公司在浙江省工商行政管理局领取了注册号为3300001010780的企业法人营业执照，注册资本4,600万元，经营范围为：电子元件、计算机及网络产品、通信产品的研发、设计、生产与销售。

此次整体变更设立股份有限公司前后，公司股东结构和管理层均未发生变化，也未对公司主营业务和经营业绩产生重大影响。

公司设立时的股本结构为：

股东姓名	出资金额 (万元)	出资比例	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例
李庆跃	1,821.60	39.60%	赵 晖	230.00	5.00%
池旭明	345.00	7.50%	蒋旭升	230.00	5.00%
吴宗泽	345.00	7.50%	俞尚东	230.00	5.00%
金良荣	248.40	5.40%	方 琳	230.00	5.00%
陈利平	230.00	5.00%	陈玉花	230.00	5.00%
杨亚平	230.00	5.00%	方永进	230.00	5.00%
合 计			4,600.00		100.00%

公司自整体变更设立以来，股东及股本结构均未发生变化。

(二) 发行人资产重组情况

1、收购金华市电池厂和华通电子有限公司的相关资产

(1) 金华东晶与华通电子有限公司的交易情况

1999年4月25日，金华东晶与华通电子有限公司（以下简称“华通电子”）签署《存货转让合同》，金华东晶以代华通电子分期偿还中国工商银行铁岭头支行及中国银行金华市分行贷款本息的方式收购华通电子的部分库存商品，收购价格按其账面价值确认为8,848,558.94元。

2000年9月1日，华通电子由金华市中级人民法院裁定进入破产还债程序，华通电子破产清算组对华通电子的机器设备向社会进行二次公开拍卖，该部分资产的评估价值为450.98万元，因无人应标，拍卖未能举行。经法院同意，华通电子破产清算组与金华东晶签订了《华通电子有限公司电子、机器设备转让协议书》，约定华通电子破产清算组以原向社会公开拍卖底价260万元协议转让给金华东晶，评估值与协议转让价的差额190.98万元，冲减破产前华通电子有限公司欠金华东晶的往来账款。2000年12月26日，金华东晶向华通电子破产清算组支付了260万元转让款，取得了华通电子相关机器设备的所有权。

2001年8月13日，华通电子经金华市中级人民法院裁定破产程序终结。

(2) 金华东晶与金华市电池厂的交易情况

2000年5月9日，金华市电池厂经金华市中级人民法院裁定进入破产程序，

金华市电池厂破产清算组委托金华市融华拍卖有限公司对金华市电池厂的财产向社会公开拍卖。金华东晶经过拍卖竞价以 324 万元的价格收购了金华市电池厂位于金华市人民东路 1193 号的厂房建筑物、土地使用权、机器设备等资产，其中土地使用权面积为 7,286 平方米。2000 年 6 月 27 日，金华东晶与金华市电池厂破产清算组签订《转让金华市电池厂人民东路厂区财产合同》。2000 年 6 月 30 日，金华东晶向金华市融华拍卖有限公司支付了上述款项并取得了相关土地的使用权和实物资产的所有权。

金华东晶收购金华市电池厂和华通电子的上述资产后，拥有了独立、完整的生产经营设施，经营规模得到了较大的提升。

2、变更土地用途

经金华市人民政府批准，金华东晶位于人民东路 1193 号厂区的两宗面积分别为 3,230 平方米和 7,286 平方米（共计 10,516 平方米，合 15.775 亩）的工业用地于 2001 年改变为商住用地。金华东晶与金华市国土管理规划局于 2001 年签署了《国有土地使用权出让合同》（专用于土地改变用途），约定：宗地面积为 3,230 平方米的土地改变用途时，应补交的土地使用权出让金为每平方米 329.20 元，总额为 1,063,316.00 元；宗地面积为 7,286 平方米的土地改变用途时，应补交的土地使用权出让金为每平方米 413.00 元，总额为 3,009,118.00 元；合同按照金华市人民政府（2001）13 号市长办公会议纪要“改变用地性质后应补交的土地出让金，全部留企业用于弥补安置费缺口，仍有不足，则由企业承担。”的规定执行。

上述两宗土地合计需要补交土地使用权出让金 4,072,434.00 元，而金华东晶于 2000 年 8 月至 2001 年 8 月间共向金华市电池厂清算组和华通电子清算组支付职工安置费共计 4,230,080.00 元。

3、受让金华市工业园区内相关土地的使用权

金华东晶与浙江省金华市经济技术开发区委员会签署了《国有土地使用权出让合同》，约定由金华东晶受让位于宾虹路以南、秋涛路以西的市工业园区 S2~04 地块，面积为 40,200.9 平方米的土地使用权。该宗土地的土地使用权出让金为每平方米 117 元人民币，总额为 4,703,505.00 元。

金华东晶分别于 2000 年 9 月 29 日、2001 年 5 月 9 日向浙江省金华市经济

技术开发区委员会支付共计 4,703,505.00 元的土地出让金，取得了金华市工业园区 S2~04 地块的土地使用权。

自 2002 年 5 月起，公司的生产经营场所逐步搬迁至该宗土地及其附属的建筑物内。

4、拍卖部分土地使用权与房屋建筑物

2002 年 11 月，金华东晶委托浙江方圆拍卖有限公司金华分公司对位于人民东路 1193 号的原办公楼、土地使用权、厂房及附属设施等进行了公开拍卖，其中土地使用权面积为 10,516 平方米。金华东晶取得上述资产拍卖款 1,850 万元。

5、出资组建金华市东晶经贸有限公司以及转让对金华市东晶经贸有限公司的出资

2001 年 8 月，金华东晶与自然人杨亚平共同组建了金华市东晶经贸有限公司（以下简称“东晶经贸”），其中金华东晶以现金出资 90 万元，占注册资本的 90%。东晶经贸的主要业务是批发或零售各类商品、自营或代理进出口业务。

公司整体变更设立前，金华东晶转让了持有的东晶经贸的全部股权。

有关东晶经贸的情况详见第七节“同业竞争和关联交易”之“二、关联方和关联关系”。

6、投资参股金华惠成投资担保有限公司以及转让对金华惠成投资担保有限公司的出资

金华惠成投资担保有限公司原名金华市惠成民营企业担保有限公司，是当地政府为缓解地方中小企业融资困难，于 2000 年 3 月 15 日设立的，主营业务是为民营企业向金融机构贷款提供担保，设立时注册资本 720 万元，金华市财政局为该公司第一大股东，持有其 55.55% 的股权。截至 2006 年 12 月 31 日，惠成公司资产总额 98,540,615.93 元，净资产 69,419,525.12 元，2006 年度实现净利润 9,739,374.72 元（未审计）。本公司对惠成公司的历次出资情况如下表所示：

工商变更时间	出资额（万元）	占惠成公司注册资本的比例
2003 年 1 月 17 日	150	10%
2003 年 9 月 25 日	200	6.62%
2004 年 9 月 23 日	300	6.86%

2006年10月11日	500	8.92%
2007年3月29日	-500	-

2006年9月21日,惠成公司全体股东一致同意股东浙江东风齿轮有限公司将其所持股权500万元(占惠成公司注册资本的8.91%)以1:1.1的价格比例转让给其他股东,其中转让给公司200万元股权。其他股东放弃上述股权转让的优先权。同月29日,浙江东风齿轮有限公司与公司签署股权转让协议,浙江东风齿轮有限公司同意将其所持惠成公司200万元股权(占惠成公司注册资本的3.57%)以现金1:1.1的价格比例转让给公司,截至2006年8月31日,惠成公司未经审计净资产值为6,761.26万元,3.57%股权净值为241.38万元,以此作为股权转让作价参考依据,因股权增值不大,协议转让价款220万元。该项股权转让已于2006年9月29日交割完毕,并于2006年10月11日在金华市工商局办妥变更登记手续。本公司对惠成公司投资增至530万元,持有其500万元的股权,占其注册资本的8.92%。2007年1月31日,公司将上述股权转让价款支付给浙江东风齿轮有限公司。

2007年1月25日,本公司与金华市火腿有限公司签订《股权转让协议》,本公司将所持惠成公司全部股权转让给金华市火腿有限公司,转让价格为530万元,其他股东放弃优先购买权,2007年3月29日在金华市工商局办妥了上述股权变更登记手续。

四、 历次验资情况及发起人投入资产的计量属性

(一) 历次验资情况

1、 金华东晶设立时的验资

1999年4月,李庆跃等28名自然人以现金出资方式组建金华市东晶电子有限公司,浙江金华会计师事务所接受委托,对拟设立的金华东晶截至1999年4月9日的实收资本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验,并于1999年4月12日出具了浙金会师厅验(1999)第11号《验资报告》。根据验资结果,金华东晶申请的注册资本为人民币50万元,截至1999年4月9日,金华东晶已收到公司各发起人投入的资本50万元,其中实收资本50万元。与上述投入资本相关的资产总额为50万元,其中货币资金50万元。

2、金华东晶增加注册资本时的验资

2000年2月金华东晶进行增资扩股，金华天鉴会计师事务所有限公司接受委托，对金华东晶截至2000年2月29日的注册资本、投入资本变更情况的真实性和合法性进行了审验，并于2000年3月14日出具了金华天鉴验（2000）第68号《验资报告》。根据验资结果，金华东晶变更前的注册资本和投入资本均为50万元，变更后的注册资本为500万元，截至2000年2月29日，金华东晶增加投入资本450万元。变更后的投入资本总额601万元，其中实收资本500万元，盈余公积22.6万元（其中公益金7.5万元），未分配利润78.4万元。与上述变更后投入资本总额相关的资产总额为3,012万元，负债总额为2,411万元。

3、金华东晶股权结构变动时的验资

2001年9月金华东晶股权结构发生变动，金华天鉴会计师事务所有限公司接受委托，对公司截至2001年8月31日的股权转让情况进行了审验，并于2001年9月12日出具了金华天鉴验（2001）第046号《验资报告》。根据验资结果，截至2001年8月31日，金华东晶股权转让后的注册资本为500万元。

4、整体变更设立股份有限公司时的验资

2004年7月金华东晶整体变更为股份有限公司，立信会计师事务所接受委托，审验了浙江东晶电子股份有限公司（筹）截至2004年6月30日申请变更设立登记的注册资本实收情况，并于2004年7月15日出具了信长会师报字（2004）第21740号《验资报告》。根据验资结果，截至2004年6月30日，浙江东晶电子股份有限公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币4,600万元，各股东均以净资产出资。

（二）公司设立时发起人投入资产的计量属性。

2004年7月30日，金华市东晶电子有限公司以2004年6月30日经审计的账面净资产4,600万元为基础，按照1:1的比例折为股份4,600万股，整体变更为浙江东晶电子股份有限公司。立信会计师事务所接受委托，对公司设立时各发起人投入资本进行了验证，并出具了信长会师报字（2004）第21740号验资报告。

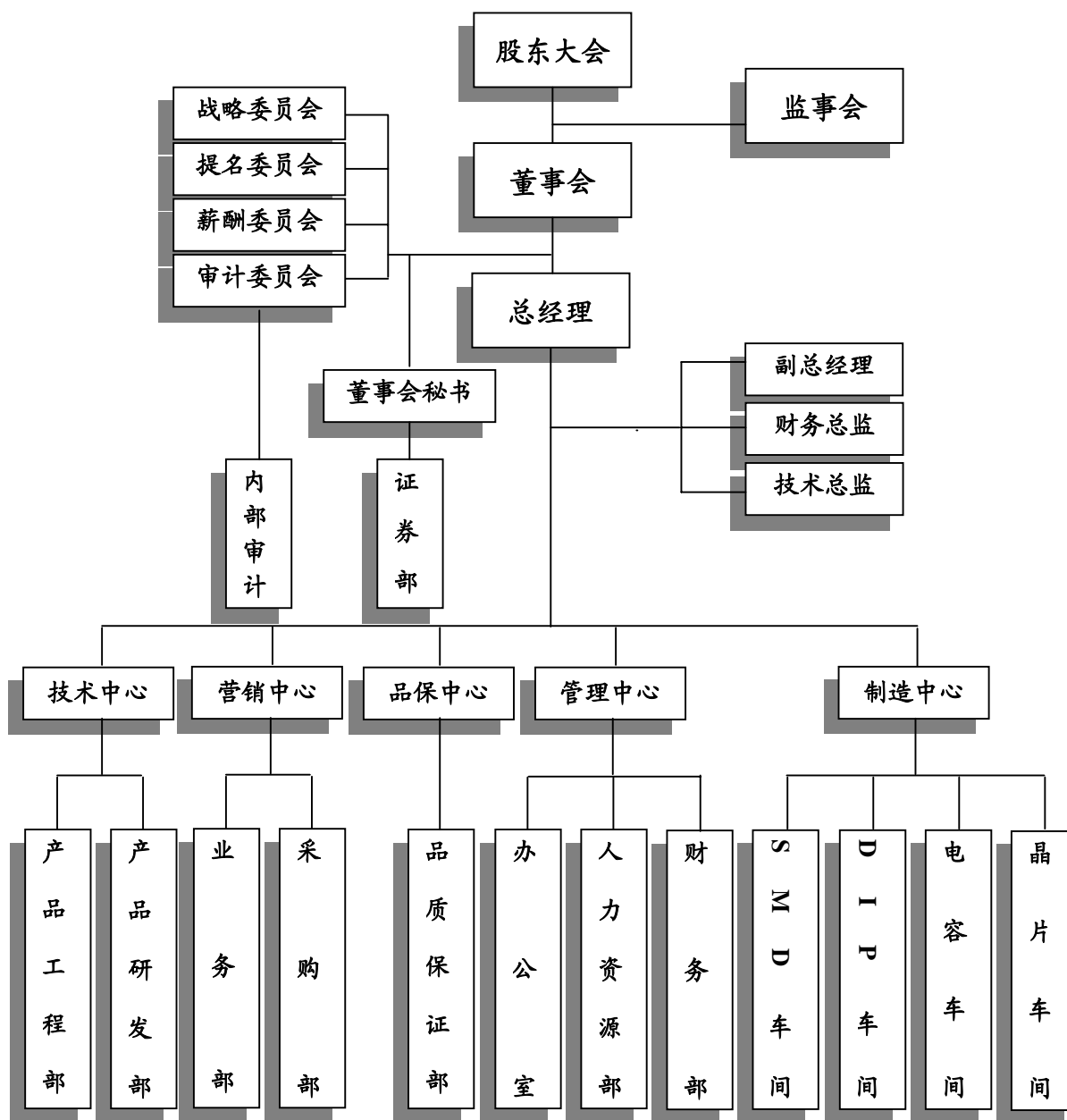
根据该验资报告，截至2004年6月30日，公司注册资本已全部缴清，变更后

注册资本为4,600万元。

发行人自股份公司设立至今，未进行增资扩股、送股及公积金转增，股本未发生变化。

五、发行人的组织结构

本公司的权力机构是股东大会，董事会由股东大会选举产生，总理由董事会聘任。本公司内部组织结构如下图所示。



本公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬委员会和审计委员会，其

中战略委员会的主要职责是对公司长远发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；提名委员会的主要职责是对董事、经理人员的选择标准和程序提出建议，广泛搜寻合格的董事、经理人员的人选，以及对董事和经理候选人进行审查并提出建议；薪酬委员会的主要职责是研究董事与经理人员的考核标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；审计委员会的主要职责是负责审查公司的内部审计制度并监督其实施，审核公司的财务信息及其披露，提议聘请或更换外部审计机构等。

公司建立了经营班子，由总经理、副总经理、财务总监、技术总监等组成，在董事会领导下，负责领导公司的日常经营与管理。

（一）本公司各部门的职能分工情况

技术中心下设产品工程部和产品研发部，产品工程部负责生产设备的管理和维护、技术资料收集和研究；产品研发部负责新产品设计、开发和试制，为产品品质管理与客户服务提供技术支持。

营销中心下设业务部、采购部，业务部负责产品的市场调研和预测，客户的开发和维护，产品推广和销售；采购部负责原材料和设备的采购。

品保中心下设品质保证部，主要负责产品品质的控制与管理，产品售后质量跟踪与服务。

管理中心下设办公室、人力资源部和财务部。办公室负责公司的综合行政事务管理；人力资源部负责公司人事、劳资管理工作，具体包括员工的招聘、培训与考核，工资、福利与社会保险管理等；财务部负责公司的会计核算、资金管理、费用控制以及财务分析等工作。

制造中心下设SMD车间、DIP车间、电容车间和晶片车间，负责公司主要产品石英晶体谐振器和瓷介管状电容器以及晶片的生产。

证券部负责收集国家宏观经济政策及证券市场信息；办理公司股票托管登记、信息披露事务、投资者关系管理及其他证券事务。

内部审计部负责制定和实施公司内部审计工作计划，建立健全内部控制制度并对执行情况进行审计监督；协助监事会和审计委员会检查和审计有关事项，为其提供所需资料和依据；配合公司聘请的审计机构，完成年度和专项审计。

（二）控股或参股公司情况

本公司无控股子公司，有参股公司一家——浙江大通集团股份有限公司，具体情况如下：

该公司经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]47号文批准，以定向募集方式设立，注册资本为10,160万元。2001年2月金华东晶与华通电子清算组签署了《法人股转让协议书》，以每股0.593元的价格收购了华通电子所持有的20万股浙江大通集团股份有限公司股份。

由于浙江大通集团股份有限公司近几年出现巨额连续亏损，持续经营出现困难，公司已于2002年对该项长期投资全额计提了减值准备。

六、公司发起人、持有公司 5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况

公司于 2004 年 7 月 30 日由金华东晶整体变更设立，发起人为李庆跃等 12 名自然人。公司自设立以来，股东及各股东的持股数量、持股比例均未发生变动。

（一）发行人控股股东、实际控制人情况简介

李庆跃，男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：330702195911260453，住所：浙江省金华市；1959 年出生，高级经济师，硕士研究生学历；历任金华市电池厂车间主任、华通电子业务经理、金华东晶董事长兼总经理，现任本公司董事长兼总经理。李庆跃曾获得“金华市劳动模范”、首届“中国双优民营企业家”和“浙江省杰出青年民营企业家”等称号，主创的管理成果《中小型民营企业快速成长的技术创新管理》于 2005 年荣获第十二届全国企业管理现代化创新成果二等奖。李庆跃为本公司控股股东、实际控制人，本次发行前持有本公司 39.60%的股份。截至本招股说明书签署日，李庆跃除投资本公司外无其他经营性投资和参与经营的事项。

截至本招股说明书签署日，李庆跃所持有的本公司股票不存在被质押或其他有争议的情况。

（二）持有发行人 5%以上股份的其他主要股东情况简介

1、池旭明

男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：120104196906146336，住所：浙江省金华市；1969年出生，高级工程师，本科学历（硕士研究生在读），毕业于天津大学材料系；历任华通电子车间主任、工程师、金华东晶总工程师，现任本公司董事、技术总监。池旭明主持研发的“低功耗 HC49SMD 石英晶体谐振器”项目列入“国家重点火炬计划项目”，“玻璃封装 SMD 石英晶体谐振器”列入“国家重点新产品”。本次发行前池旭明持有本公司 7.5%的股份。

2、吴宗泽

男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：330107680518097，住址：浙江省金华市；1968年出生，硕士研究生学历；历任华通电子车间主任、金华东晶总经理助理，本公司总经理助理，现任本公司董事、管理者代表。本次发行前吴宗泽持有本公司 7.5%的股份。

3、金良荣

男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：330702195808280018，住址：浙江省金华市；1958年出生，大专学历；历任金华市电池厂技术员、华通电子技术部部长、金华东晶副总经理，现任本公司董事、副总经理。本次发行前金良荣持有本公司 5.4%的股份。

4、陈利平

女，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：330702196210300023，住址：浙江省金华市；1962年出生，大专学历；历任金华市电池厂车间副主任、华通电子办公室主任、金华东晶办公室主任兼工会主席，现任本公司董事、办公室主任兼工会主席。本次发行前陈利平持有本公司 5%的股份。

5、俞尚东

男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：330724570116001，住址：浙江省金华市；1957年出生，大专学历；历任华通电子车间主任、金华东晶监事。现任本公司监事，制造中心晶片车间副主任。本次发行前俞尚东持有本公司 5%的股份。

6、杨亚平

男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：330702570815001，住址：浙江省金华市；1957年出生，大专学历（硕士研究生在读）；历任华通电子总经理秘书、金华东晶监事，现任本公司监事会主席、制造中心 SMD 车间副主任。

本次发行前杨亚平持有本公司 5%的股份。

7、赵晖

男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：330702700801001，住址：浙江省金华市；1970 年出生，大专学历；曾就职于华通电子、金华东晶，现任本公司技术中心产品研发部副经理。本次发行前赵晖持有本公司 5%的股份。

8、蒋旭升

男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：330702196804191231，住址：浙江省金华市；1968 年出生，硕士研究生学历；曾就职于金华市电池厂、华通电子、金华东晶，现任本公司制造中心晶片车间主任。本次发行前蒋旭升持有本公司 5%的股份。

9、方琳

女，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：330702196908250822，住址：浙江省金华市；1969 年出生，大专学历；曾就职于金华市制药厂、华通电子、金华东晶，现任本公司监事、制造中心统计主管。本次发行前方琳持有本公司 5%的股份。

10、陈玉花

女，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：330702196908071226，住址：浙江省金华市；1969 年出生，大专学历（硕士研究生在读）；曾就职于金华市电池厂、华通电子、金华东晶。本次发行前陈玉花持有本公司 5%的股份。

11、方永进

男，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：330721196911203014，住址：浙江省金华市；1969 年出生，高中学历；曾就职于华通电子、金华东晶，现任本公司职员。本次发行前方永进持有本公司 5%的股份。

七、发行人股本情况

本公司发行前总股本4,600万元，本次拟发行社会公众股1,600万股，占发行后总股本的比例为25.81%。

本次发行前，发行人前 10 大股东均为自然人，且均持有公司 5%或以上股份，有 8 位自然人并列公司第五大股东。

本次发行前后公司股本结构变化及前十大自然人股东任职情况如下表所示：

股份类别 (股东名称)	本次发行前		本次发行后			在公司任职情况
	持有股数 (万股)	持股比 例	持有股数 (万股)	持股比 例	限售期	
1、有限售条件流通股	4,600.00	100.00%	4,600.00	74.19%		
李庆跃	1,821.60	39.60%	1,821.60	29.38%	自上市之日起 36 个月	董事长、总经理
池旭明	345.00	7.50%	345.00	5.56%	同上	董事、技术总监
吴宗泽	345.00	7.50%	345.00	5.56%	同上	董事、管理者代表
金良荣	248.40	5.40%	248.40	4.01%	同上	董事、副总经理
陈利平	230.00	5.00%	230.00	3.71%	同上	董事、办公室主任、 工会主席
杨亚平	230.00	5.00%	230.00	3.71%	同上	监事会主席、制造中 心 SMD 车间副主任
俞尚东	230.00	5.00%	230.00	3.71%	同上	监事，制造中心晶片 车间副主任
赵晖	230.00	5.00%	230.00	3.71%	同上	技术中心产品研发部 副经理
蒋旭升	230.00	5.00%	230.00	3.71%	同上	制造中心晶片车间主 任
方琳	230.00	5.00%	230.00	3.71%	同上	监事、制造中心统计 主管
陈玉花	230.00	5.00%	230.00	3.71%	同上	无
方永进	230.00	5.00%	230.00	3.71%	同上	职员
2、本次发行流通股	-	-	1,600.00	25.81%		
合计	4,600.00	100.00%	6,200.00	100.00%		

本公司无国有或外资、战略投资者持股情况，上述全部 12 名自然人股东中，相互之间均不存在关联关系。

本公司未发行过内部职工股，也不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情形。

八、员工及其社会保障情况

(一) 员工情况

截至2007年6月30日，本公司在职员工总数814人，无退休人员。

1、按专业结构划分

类别	职工人数	占总人数比例
管理人员	67	8.23%

工程技术人员	163	20.02%
生产工人	502	61.67%
销售人员	18	2.21%
辅助工人	64	7.86%
合计	814	100.00%

2、按受教育程度划分

类别	职工人数	占总人数比例
本科及以上学历	96	11.79%
大专	179	21.99%
中专	122	14.99%
其他	417	51.23%
合计	814	100.00%

3、按年龄划分

类别	职工人数	占总人数比例
50岁以上	4	0.49%
41~49岁	51	6.27%
31~40岁	176	21.62%
30岁以下	583	71.62%
合计	814	100.00%

(二) 公司职工管理体制

1、劳动合同管理制度

本公司根据《中华人民共和国劳动法》及其它有关法律、法规的规定，实行全员劳动合同制。截至2007年6月30日，公司职工均与本公司签署了《劳动合同》，并在金华市劳动和社会保障局进行了职工录用备案和劳动合同备案。

2、社会保险及福利管理制度

本公司根据国家及省、市有关法律、法规和政策规定，按照《浙江省社会保险费征缴办法》和《金华市区社会保险费征缴管理实施办法》的要求，依法为员工办理基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，并定期向社会保险统筹部门缴纳各项保险基金。本公司员工还依法享有住房公积金、医疗保障等各项福利。

九、本次发行前股东所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺

详见本招股说明书之发行概况之“本次发行前股东所持股份的流通限制及

股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

第六节 业务与技术

一、公司业务概述

公司自设立以来主要从事石英晶体元器件产品的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。

本公司的前身金华市东晶电子有限公司成立于 1999 年 4 月，2000 年股东购买了有关生产设备，以增加注册资本的方式投入金华东晶，使 DIP 谐振器的产量得到大幅提升，2002 年金华东晶搬入新厂区后，陆续购入新设备用于扩大 DIP 谐振器的生产规模，2003 年 8 月，金华东晶引进了国际先进的 SMD 石英晶体元器件生产技术与设备，并在当年实现 SMD8045、SMD7050 产品的批量生产；股份公司设立后开始批量生产 SMD6035 产品，2005 年下半年开始批量生产 SMD5032 产品。截至 2007 年 6 月 30 日，公司已拥有年产 SMD 石英晶体谐振器 1.1 亿只、DIP 石英晶体谐振器 2 亿只、瓷介管状电容器 5 亿只的生产能力。

公司重视新产品的开发，通过持续的资金投入，不断提高产品档次和附加值。对比国内石英晶体谐振器生产企业，公司在技术水平及生产规模方面均处于领先地位。

公司本次募股资金投向 SMD 石英晶体元器件的技术改造项目和 SMD 石英晶体元器件的主要原材料——晶片的生产线技术改造项目，项目实施后，公司的生产能力、技术含量和附加值将得到提升，公司产品结构进一步优化，参与国际高端市场的竞争力增强。

公司从早期生产 DIP 系列产品发展到 SMD 系列产品，以及本次募股资金投资项目的选择，都是与电子元器件行业小型化、片式化、表面贴装化的发展趋势以及国家的产业政策导向一致的。

二、公司所处行业基本情况

（一）压电石英晶体元器件概览

石英晶体元器件由于品质因数（即“Q值”）较高，而且受温度影响所造成的频率偏移较小，相对其他振荡元器件更加准确和稳定，特别适用于对频率准确度要求较高的通讯产品。产品广泛应用于通讯、资讯、网络、汽车电子和家用电器等领域，规格通常以频率（MHz）、精度（PPM）、尺寸（mm×mm）以及封装方式区别。

石英晶体元器件产品可分为以下三大类：

1、石英晶体谐振器

石英晶体谐振器是由满足一定频率标准、具有一定形状、尺寸和切型的石英晶片与电极、封装外壳组成。它利用石英晶体本身的压电效应与逆压电效应产生频率，发挥频率控制作用。凡需要频率信号的电路，在一定范围内均可以利用石英晶体压电效应振荡取得，因而是大部分电子产品不可缺少的重要元件。

2、石英晶体振荡器

石英晶体振荡器是由品质因数极高的谐振器和专门的振荡电路组成。晶体振荡器广泛运用于资讯、通讯及消费性电子产品。

3、石英晶体滤波器

以石英晶体与线圈、电容、电阻组合封装即为石英晶体滤波器。滤波器可使特定频率通过，或者使某一特定范围内的频率通过，主要应用于通讯领域。

（二）行业管理体制

公司的主要产品石英晶体谐振器属电子元件行业中的压电晶体子行业，电子元件行业为开放性、完全竞争性行业，不存在行政性准入管制。行业管理体制已经由传统的政府部门直接管理转变为行业协会自律管理。中国电子元件行业协会（CECA）是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、全国性的行业组织，不受部门、地区和所有制的限制，具有社会团体法人资格，业务主管单位为国家信息产业部，现有会员1,600多家，本公司是电子元件行业协会压电晶体分会的理事单位之一。

（三）行业竞争状况

1、行业竞争格局和市场化程度

压电晶体行业是市场化竞争较为充分的行业，压电晶体厂商主要集中在日本、我国大陆及台湾地区。日系厂商在全球的市场占有率超过 60%，全球前四大压电晶体厂商均为日系企业，产业集中度高。

1958 年我国建成第一个石英晶体元件专业工厂，即现在的国营 707 厂，80 年代前，石英晶体元件基本上为军事用途，从 80 年代起大量转为民用。1990 年以后，在家电及 PC 产业大发展的共同推动下，中国压电晶体行业迎来了发展的黄金时期，本地厂商逐渐以低成本及产量优势占据这一市场。历经十多年的发展，中国大陆已成为全球石英晶体元器件的重要生产基地，这主要得益于本地生产厂家的迅速增多及生产规模的大幅扩充。另外，中国台湾、韩国、日本企业等将生产基地向中国大陆转移也起到了重要作用。

从竞争格局看，在高档产品领域，主要是境外行业知名企业间竞争，从目前情况看，这些企业依赖强大技术储备及市场营销网络支持，在高端客户方面占据了较大的优势。在中档产品领域，主要是知名内资企业与境内外资企业之间的竞争，竞争重点是在满足较高品质标准下的相对低廉价格。在低档产品领域，主要是众多小型民营企业之间的竞争，价格是竞争重点。

目前我国生产石英晶体元器件的企业较多，其中大多数为规模较小、产品档次低的小企业。根据中国电子元件行业协会信息中心的统计，截至 2005 年年底，国内可以生产 SMD 石英晶体元器件产品的企业大约有 40 余家，年度生产能力达到 2,400 万只的仅有 10 家左右，其中外资企业约占 60%左右，其生产线大部分是近几年迁移到国内的。从产品技术水平和企业管理水平看，国内领先的内资企业与日本、我国台湾的大企业的差距在逐步缩小，我国台湾压电晶体企业的迅速发展壮大为中国内地压电晶体企业提供了宝贵的经验借鉴，得益于我国近年来的良好经济发展趋势及世界经济一体化所带来的制造业向中国的转移，我国压电晶体企业近几年保持了较快的发展势头，随着行业的进一步整合，国内领先的内资企业的生产规模、研发能力和管理水平将进一步增强，与全球一流企业的差距将进一步缩小。以晶体谐振器的发展为例，我国企业经过十多年的快速发展，在 DIP 产品的生产技术、设备、原材料等从原先的依赖进口到目前全面实现国

产化，我国的 DIP 产品以较高的技术质量和价格优势在国际市场中已占据了主导地位。我国目前 SMD 产品的部分生产设备、原材料等尚依赖进口，但从发展势头看，国内企业完全有能力以更短的时间使 SMD 产品走完 DIP 产品的发展道路。

2、行业内的主要企业

(1) 全球行业主要企业及其市场份额

世界晶体元器件行业前四强全部为日本企业，其中，EPSON TOYOCOM 2006 年度的销售收入达 6.45 亿美元，列世界第一，NDK 2006 年度实现销售收入 6.26 亿美元，列世界第二。

下表为全球前六大厂商 2004~2006 年的销售收入和市场占有率情况：

单位：亿美元

厂商	2006 年度			2005 年度		2004 年度
	销售收入	增幅	市场占有率	销售收入	增幅	销售收入
爱普生东洋通讯机 (Epson Toyocom)	6.45	9.51%	19.60%	5.89	3.33%	5.70
日本电波 (NDK)	6.26	21.55%	19.10%	5.15	7.74%	4.78
京瓷 (Kyocera Kinseki)	3.72	10.06%	11.30%	3.38	8.33%	3.12
大真空 (KDS)	2.90	14.62%	8.80%	2.53	0.00%	2.53
威克创 (VECTRON)	2.11	12.23%	6.40%	1.88	2.73%	1.83
台湾晶技 (TXC)	1.61	37.61%	4.90%	1.17	27.17%	0.92

数据来源：台湾晶技股份有限公司 2006 年年报

(2) 国内压电石英晶体行业的主要企业

除本公司外，国内生产石英晶体元器件的主要厂家有：湖北东光电子股份有限公司（以下简称“湖北东光”）、唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“晶源电子”）、南京华联兴电子有限公司（上市公司南京华东电子信息科技股份有限公司之控股子公司）、廊坊中电大成电子有限公司、烟台大明电子有限公司、铜陵市峰华电子有限公司（上市公司安徽铜峰电子股份有限公司的控股子公司）等。其中晶源电子、湖北东光及本公司均为中国电子元件百强企业，代表了行业的较高水平。

国内主要石英晶体元器件企业 2006 年度经营情况

企业名称	主要产品	压电晶体产品销售收入 (亿元)	SMD 产品 产量(万只)	DIP 产品 产量(万只)
本公司	石英晶体谐振器	1.58	8,197	14,335
南京华联兴电子有限公司	石英晶体谐振器	1.30	5,000	8,000
唐山晶源裕丰电子股份有限公司	石英晶体谐振器和石英晶体振荡器	2.06	3,916	20,211
烟台大明电子有限公司	石英晶体谐振器	0.80	3,000	8,000
廊坊中电大成电子有限公司	SMD 石英晶体谐振器、TCXO (温度补偿振荡器)、OSC (时钟振荡器)、高档次石英晶片和晶棒	0.50	3,000	-
湖北东光电子股份有限公司	石英晶体谐振器、石英晶体振荡器、厚膜混合集成电路等三大类	1.00	1,000	10,000
铜陵市峰华电子有限公司	石英晶体谐振器	0.30	1,000	1,000

数据来源：晶源电子、华东科技、铜峰电子 2006 年报、中国电子元器件行业协会信息中心及本公司业务部门。

3、进入本行业的主要障碍

(1) 资金壁垒

随着 SMD 石英晶体元器件的小型化趋势，其工艺技术要求必须是高精度自动化生产线，按目前投资测算，从晶棒切割到产品包装，月产 100 万件普通规格 SMD 石英晶体元器件的生产线需要投入资金 200 多万美元，合理的经济规模至少应投资 5 条生产线。

(2) 技术壁垒

目前生产 SMD 石英晶体元器件所需的关键设备以进口为主，这些设备供应商提供的标准型设备通常需要改进后才能达到预期效果，通常的做法是需求方根据自己产品的设计思路、工艺方法、技术特点提出要求，由设备供应商提供解决方案或由需求方自行改造。因此，掌握和改进关键设备性能，对石英晶体元器件生产企业提高产品合格率、技术含量并维持其市场竞争力，具有重要的意义。

本行业需要的专业知识包括电学、力学、化工、材料、自动化控制等方面，属于一种交叉科学，国内高校通常没有直接对口的专业。因此，本行业的技术人员必须通过较长时间的专业学习和实践才能适应和提高，在工作中发挥作用。

(3) 资质壁垒

目前，国内晶体行业产品约80%出口。国际大型企业通常对供应商的资质审定至少在一年以上，在审定过程中将对供应商的生产流程、质量管理、工作环境甚至经营状况等各个方面提出严格要求，一般需要多次审核、整改后方能通过资质认定，再通过相当一段时间的小批量供货测试后才能正式成为其供应商。因此，严格的供应商资质认定，对拟进入本行业的企业形成资质壁垒，新厂商要开拓市场短期内面临较大的不确定性。

（四）影响本行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）国家产业政策重点扶持

《十一五规划纲要》第十章“加快发展高新技术产业”第一节“提升电子信息制造业”提出，“根据数字化、网络化、智能化总体趋势，大力发展集成电路、软件和新型元器件等核心产业”；本公司主要产品属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类鼓励类第二十四条信息产业中“23.新型电子元器件制造”国内投资项目，属于国家重点扶持的产业；同时也属于《浙江省先进制造业基地建设重点领域、关键技术及产品导向目录》（2004年12月7日）第一、（一）5（13）“新型电子元器件”建设项目。公司有多项产品被列为国家或省级重点新产品并获得国家财政资金支持。

（2）行业发展前景广阔

本公司的产品主要用于资讯、通讯、消费性电子和汽车电子产品。从全球范围看，手机、平板电视、蓝牙产品、电脑、笔记本、PDA、数码相机等产品连续多年保持了稳定增长的趋势。特别是手机，由于彩屏、拍照、蓝牙、上网、MP3等功能的不断增加，每只手机所使用的石英晶体元器件数量成倍增长，3G通讯业务的开展有望带来巨大的市场需求；其次在汽车电子领域，由于汽车音响、汽车定位系统、遥控系统、安全感应、自动空调等功能的不断丰富，每辆汽车中所需使用的晶体元件数量稳步增长，汽车电子用晶体元件存在较为广阔的市场空间。在更广阔的高科技领域如智能系统和生物技术等热门行业，高精度石英晶体谐振器作为传感器的核心元件也有着极为重要的前景。

（3）全球制造中心向中国转移的机遇

随着全球经济一体化进程的加快，电子产品生产和市场日益国际化。亚太地

区已成为世界电子元器件的最大生产地和消费地，特别是中国越来越多地在世界电子元器件产业中占到了举足轻重的地位。美、欧及亚太地区元器件业的一些大公司，加速了中、低档电子元器件产品加工生产向中国转移的步伐，从而确立了中国成为世界电子元件生产大国的地位。未来几年是世界电子技术和电子产品更新换代的关键时期，世界电子元器件市场正从传统的消费类电子产品移向信息化产品。这为国内的电子元器件优势企业拓展了广阔的市场空间。

2、不利因素

(1) 市场竞争因素

从世界范围看，高端石英晶体元器件的生产基本被以日本、美国为主的少数厂商所垄断，台湾等厂商是世界晶体产业第二梯队的力量。近年来国内民营石英晶体元器件厂商力量也在不断成长，但市场集中度不高。从长期看，由于下游电子行业产品不断推陈出新、价格阶段性下降的特点，使竞争的压力向晶体元器件行业传递，必然带来行业竞争的升级，对生产厂家投资规模、生产技术的要求也越来越高，资源将向生产规模大、技术开发能力强、市场信誉好的企业转移，竞争将有利于形成占有较大市场份额的强势企业。

(2) 相关产业配套不足

目前国内生产普通的 DIP 石英晶体元器件所需的设备及原材料具备成熟的工艺和充足的市场供应，但生产 SMD 石英晶体元器件所需的关键设备和原材料国内目前尚处于研发和仿制阶段，尚难以完全替代进口产品。

(3) 汇率波动的影响

从 2005 年 7 月我国完善人民币汇率形成机制以来，人民币步入升值通道，而我国压电石英晶体行业产品出口比例基本在 80%左右，产品对外依存度高，根据中国电子信息产业发展研究中心 IT 经济研究所的预测，如人民币继续升值 20%以上，内资企业电子信息产品以现有条件出口将可能面临亏损。

(五) 行业技术水平及技术特点

1、行业技术水平

目前，国内压电晶体元器件行业主要呈现出以下特点：

(1) 大部分厂家集中于生产引线型的传统产品，产品多为劳动密集型产品，在代表行业发展方向的 SMD 石英晶体元器件方面能实现规模生产的厂家较

少。而在日本，2006 年度 SMD 石英晶体元器件已占有所有晶体元器件的 78%，我国内资企业的 SMD 比例仅在 10%左右。

(2) 研发资金和技术力量不足，国内内资企业侧重于成熟产品的生产和解决生产中出现的技术问题，跟踪国外产品的发展方向，但缺乏以企业为主体的技术创新体系。

从 SMD 石英晶体元器件的规格看，在日本 2005 年度 SMD3225 的生产数量已超过 SMD5032 的产量，SMD2520 也开始规模生产，SMD2016 已完成研发并开始少量供应。而在国内目前大多数企业仅能生产 SMD7050、SMD6035 产品，能实现规模化生产 SMD5032 产品的厂家较少，本公司从 2005 年度开始批量生产 SMD5032 产品，目前已完成 SMD3225 产品的研发工作，计划 2007 年下半年批量生产 SMD3225 产品。

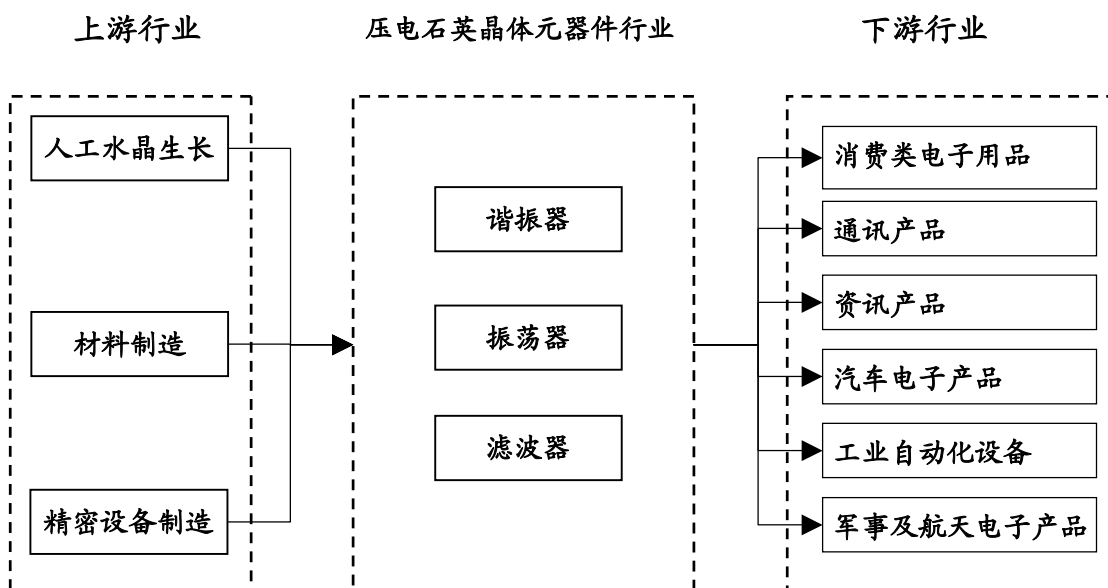
2、行业的周期性、季节性、区域性特征

压电晶体元器件的主要应用领域为通讯电子等信息产品，产品以出口为主，公司产品销售无明显的季节性，但由于节假日的影响，每年的一季度一般为销售和生产的淡季。从二季度开始步入正常。

公司努力开拓新的市场及客户，分散销售区域和客户过于集中的风险。从目前情况看，公司的销售格局已取得了较好的优化和调整。

(六) 公司所处行业与上、下游行业之间的关联性

与石英晶体元器件系列产品构成上下游关系的行业情况如下图所示：



从国内目前行业情况看，在上游产业，我国在人工水晶生长技术及设备方面较为成熟，还有俄罗斯高品质水晶的大量进口，人工水晶市场供应充足。在精密设备及材料制造方面，我国企业已开始研制，但尚难以完全代替进口。从下游产业看，近年来信息电子产业的迅猛发展带动了对石英晶体元器件系列产品的需求大幅增长，石英晶体元器件行业面临良好的发展机遇。

（七）行业发展趋势

从技术发展趋势看，在下游电子产业发展的推动下，产品开发方向主要呈以下发展态势：

1、小型化

随着电子产品不断向小型化方向发展，为之配套的元器件也随之向小型化方向发展。石英晶体元件小型化包含两方面的内容：一方面指石英晶体元件由带引线的产品（DIP，如49U、49S）向不含引线的表面贴装元件（SMD）方向发展；另一方面是指SMD石英晶体元器件向小尺寸方向发展（8045→7050→6035→5032→3225→2520→2016）。

2、高频化、高精度、模块化

低频应用终端已逐渐饱和，相互干扰的问题加剧，因而高频发展显得日益重要。在通讯行业的移动电话、无线局域网络等系统逐步向高频化、高传输速度发展，同时对其相应的精确度要求也同步提高，代表世界晶体行业最高水平的日本企业已达到将误差控制在2PPM以内的水平。

此外，为了适应下游电子产品自动化大规模装配的需要，晶体元器件逐步向模块化方向发展。

3、低功耗

由于大量的便携式电子产品均使用电池供电，为了最大限度地延长电池寿命，电子产品的低功耗设计是大势所趋。

4、绿色环保要求逐步提高

欧盟的“关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令”（以下简称“RoHS指令”）于2003年2月13日起成为欧盟范围内的正式法律。根据该法案，自2006年7月1日起，所有在欧盟市场上出售的电子电气设备必须禁止使用铅、水银、镉、六价铬等重金属，以及聚溴二苯醚（PBDE）和聚溴联苯（PBB）等阻

燃剂。对于目前技术上尚无替代产品或在经济上替代品带来的成本增加远远超出原产品的，则可免于适用。

我国制定的《电子信息产品污染控制管理办法》已于2006年2月28日颁布并于2007年3月1日起实施，其中要求污染控制的六种有害物质与RoHS指令相同。

（八）产品出口情况

本行业 80%左右的产品出口，2006 年度、2005 年度、2004 年度我国压电石英晶体行业的产品出口情况如下表所示：

年份	2006 年度	2005 年	2004 年
出口额（亿美元）	8.11	7.10	6.33

石英晶体元器件生产及出口企业主要集中在珠三角、长三角、京津唐环渤海地区，其中江浙地区出口占总出口额的 50%、出口量的 35%左右，已成为我国石英晶体元器件的主要生产基地和出口货源地。

从出口地区看，中国香港、日本、中国台湾和东南亚地区占我国总出口量的 80%，欧美地区只占 12.5%，出口到其他地区占 7.5%。目前这些进口地对从中国出口的石英晶体元器件没有配额或高关税等贸易壁垒。我国出口的产品与进口国（地区）的该类产品基本为错位竞争、互补的关系，发生贸易摩擦的可能性较小。

随着越来越多的国家开始重视环保问题，许多国家将环保条款列入对产品的强制要求。欧盟的 RoHS 指令要求从 2006 年 7 月 1 日起，所有在欧盟市场上出售的电子电气设备必须禁止使用铅、水银、镉、六价铬等重金属，以及聚溴二苯醚（PBDE）和聚溴联苯（PBB）等阻燃剂。对于目前技术上尚无替代产品或在经济上替代品带来的成本增加远远超出原产品的，则可免于适用。从目前情况看，RoHS 指令所作用的范围已远超出欧盟，越来越多的国家采用了 RoHS 指令的环保标准或根据 RoHS 指令制定了本国（本地区）的电子产品环保要求。我国也相应制定了《电子信息产品污染控制管理办法》，该办法已于 2006 年 2 月 28 日颁布并于 2007 年 3 月 1 日起实施，其中要求污染控制的六种有害物质与 RoHS 指令相同。上述环保条款对本公司产品的主要要求为无铅化，公司从 2002 年即开始研究无铅化问题，通过对原材料的选择，工艺的调整和改进，公司产品连续三年通过世界权威实验室的检测，符合 RoHS 指令的要求，业已通过索尼、佳能

等企业的产品环保体系认证。

公司产品在出口国（地）不存在专利方面的贸易壁垒。

（九）行业市场容量

根据NDK的年报数据，2005年度世界石英晶体的需求量为31亿美元左右，根据ISUPPLI（ISUPPLI是一家全球领先的针对电子制造领域的市场研究公司）的预测，到2008年国际石英晶体的需求量将达到38亿美元。

由于石英晶体元器件主用应用于电子信息产品，因此可以根据下游电子信息产品的发展情况分析石英晶体元器件的市场前景。

下表所列电子整机产品平均每台使用晶体元器件3.2只以上，随着全球无线通信和互联网的高速发展，石英晶体元器件的需求量与日俱增，市场前景广阔。

近三年全球主要电子产品需求情况表

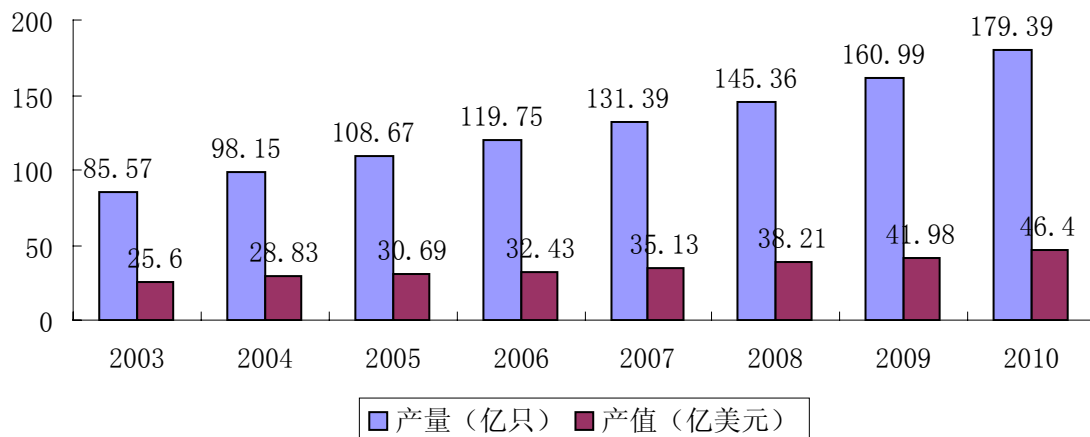
单位：万台

产品	2006年度(预测)	2005年度	2004年度	平均复合增长率
平板电视	4,050.80	1,967.20	880.00	114.73%
数字用户线路	15,534.00	12,755.50	4,621.10	98.91%
调制解调器	5,029.20	2,224.30	1,804.10	74.70%
MP3	7,749.10	5,925.00	3,492.00	50.23%
无线局域网	15,397.50	12,413.00	7,376.60	46.16%
液晶显示器	10,639.50	8,823.50	6,741.50	25.73%
笔记本电脑	7,102.90	5,943.50	4,611.00	24.20%
路由器	2,407.10	1,915.10	1,566.00	23.99%
数码相机	9,529.10	8,742.30	6,646.00	20.27%
手机	95,500.00	79,500.00	67,000.00	19.39%
服务器	793.40	714.80	642.50	11.12%
汽车	6,442.90	6,146.40	5,500.00	8.29%
电脑主板	15,600.70	14,425.90	13,751.5	6.52%
机顶盒	4,005.80	3,742.20	4,499.00	-4.89%
游戏机	2,734.70	2,893.00	4,754.40	-22.31%

数据来源：《压电晶体技术》2007年第1期

下图为全球石英晶体元器件需求量成长趋势图：

全球石英晶体元器件需求量成长趋势（包括晶体谐振器和振荡器）



注：上图数据中包括音叉晶体约占30%，数据来源：《压电晶体技术》2007年第1期

从地区分布看，日本是全球最大的生产国和使用国，2005年度石英晶体元器件的产量达18.56亿美元，占全球总产量的比例超过60%，我国台湾石英晶体元器件的产量约占世界总产量的7%，由于近年来电子信息产品的快速发展，我国台湾晶体元器件的需求量约占全球总需求的25%，每年需从世界各地大量进口石英晶体元器件，因此，日本与我国台湾市场对国内石英晶体元器件企业具有重要的战略意义。

三、公司在行业中的竞争地位

（一）竞争优势

作为行业内的知名企业，公司具有技术优势、品牌优势、规模优势、管理优势、客户优势及质量优势等方面的竞争优势。

1、技术优势

公司为国家重点高新技术企业、浙江省高新技术企业。公司新型频率器件研发中心于2006年被浙江省科学技术厅列入省级高新技术研究开发中心计划。公司拥有三项专利技术和多项专有技术，两项新产品荣获“国家重点新产品”，三

项新产品获“省级重点新产品”。公司 2006 年被浙江省信息产业厅评为浙江省信息产业系统“十五”企业技术进步与产业升级工作先进单位；同时被浙江省经贸委评为浙江省“十五”技术进步优秀企业。

中国电子元件行业协会压电晶体分会评定本公司 2004 年度、2006 年度 SMD 石英晶体谐振器生产规模、产品档次位居内资企业第一，技术水平国内领先，达到国外先进水平，设备自动化程度国内排名第一。

公司采取内培外聘相结合的方式，通过多年持续的在岗培训和技术实践，造就了一批研发、生产、设备调试、产品质量控制等方面的专业技术人才；技术负责人及技术骨干人员在电子元器件领域有 10 年以上的专业从业经历，同时公司还聘用了日本技术专家担任副总经理；与中国台湾最大晶体元器件企业——台湾晶技建立了长期的技术合作关系，并与浙江大学等高校合作建立新型频率器件研发中心等。此外，公司获得了国家、省、市多项科研计划和技术创新经费的支持，其中“超薄型手机配套用 SMD 石英晶体元器件产业化”项目被国家发展和改革委员会列为“国家信息产业企业技术进步和产业升级专项重点项目”。

与主要竞争对手相比，公司具有生产工艺完整，技术成熟的优势。公司已经建立了一套完整、成熟的从晶片到石英晶体谐振器生产工艺。而且在国内同行中设备的自动化程度最高，并且率先采用了特别的双层电极膜溅射技术和离子刻蚀技术。

由于欧盟 RoHS 指令的实施，所以电子产品的焊接均使用无铅焊料，而无铅焊接需要焊接温度高达 260℃。由于石英晶体中水晶与电极材料银的膨胀系数不同，在如此高的焊接温度下，会导致银电极与水晶的结合力大幅度下降，将严重影响石英晶体谐振器的性能，严重时会导致石英晶体谐振器的失效。公司在国内同行中率先采用了特别的双层电极膜溅射技术，利用在银电极和水晶之间增加一层不同的金属膜的方法，解决了焊接温度提高时电极结合力下降的难题。

在常规的石英晶体谐振器生产工艺中，通常采用在银电极上再增加银的方法调整频率精度，这种技术可以用在产品尺寸较大的产品。如果在小型化的 SMD 产品中使用，会带来两个缺陷：一是新增加的银的形状有时候会与原来的银电极不能重合；二是在银电极溅射之后和频率调整之前有一个高温的烤胶工艺，由于高温的影响，会使银电极产生氧化膜，如果这时候再增加银来调整频率精度，将会使电极氧化膜包在电极内，导致石英晶体谐振器性能的恶化。而公司采用的是

离子刻蚀频率微调技术，这项技术和前述的技术采用了相反的方法，是采用在银电极上减少银的方法来调整频率精度。离子刻蚀技术正好能够解决上述两个缺点。

2、品牌优势

公司坚持“以优异的产品质量和良好的信誉赢得客户信任”的经营理念，曾被评为浙江省新千年质量计量信得过单位、浙江省诚信企业、浙江省 AAA 级守合同重信用单位，中国电子行业知名品牌、全国 AAA 级对外贸易诚信企业、中国晶体十佳名优品牌。公司先后通过松下、索尼、佳能公司的供应商资质认证。

3、规模优势

公司于 2004 年、2005 年、2006 年连续入选中国电子元件百强企业，其中 2004 年度、2006 年度 SMD 石英晶体谐振器生产规模、产品档次在内资企业中排名第一。公司最近三年自营出口均超过 1,000 万美元。

公司拥有从晶片到谐振器完整的生产线，产品规格齐全，频率范围覆盖了从低频到高频所有的频段，产品型号包括了 DIP 系列的 HC-49U、HC-49S、HC-49SMD、和 SMD 系列的 GLASS8045、GLASS5032、SEAM7050、SEAM6035、SEAM5032、SEAM3225 等。其中 GLASS 系列产品是国内内资企业中唯一能量产的。

4、管理优势

公司管理团队在生产经营上积累了较丰富的管理经验，除了在岗学习之外，公司还派出 20 多名中层管理人员到国内知名院校和中国香港进行 MBA 等课程培训，逐步提升了管理人员的整体素质。公司采用现场 5S 管理制度，提高了公司的生产效率和产品合格率，减少了生产过程中的浪费，对公司生产经营绩效的改善起到了积极的作用。

公司建立健全了完善的管理制度和议事规则，形成了决策民主、管理科学、运作规范的现代企业管理制度。公司还聘请了专业咨询公司对公司发展战略及各项管理制度进行规划论证，公司的“十一五”发展战略，明确了愿景目标和企业核心理念，在此基础上形成并不断强化的企业文化建设，成为公司核心竞争力的重要组成部分。

公司通过技术创新管理快速发展，根据历年管理心得总结提交的论文《中小型民营企业快速成长的技术创新管理》于 2005 年获浙江省现代化企业管理成果一等奖、国家企业管理现代化创新成果二等奖。

公司导入现代人力资源管理理念，实施员工职务分析、目标制定分解、绩效考核、职业生涯规划等系统，对公司人力资源整合发挥了积极作用。公司加大对中层以上管理人员的目标激励考核，对其业绩考核采取逐月例会分析总结，公示监督等措施，指导年度工作计划的落实。

公司成功实施第一期ERP管理，生产、供应、销售按ERP实施，整合企业内部资源，提高了财务、车间和仓库的工作效率，使公司内部管理科学化、规范化。

5、客户优势

通过持续多年的市场开拓，公司的产品获得了一批世界知名企业的认同，目前已与松下、东芝、夏普、佳能、台湾晶技等国际知名公司建立了良好的业务合作关系。公司除了与中间商保持稳定的业务合作关系外，还积极开拓直接客户，优化客户结构。近几年公司主要产品处于供不应求状态，目前正通过提高产品技术含量、扩大产能的方式满足市场需求。

6、质量优势

公司先后通过 ISO9001 2000 质量管理体系、ISO14000 2004 环境管理体系认证以及索尼、佳能的绿色产品环境体系认证。先进的工艺技术、自动化的设备、严格的生产管理保证了公司的产品质量达到了国内领先、国际先进水平。公司产品生产合格率达到 95%以上，客户交收不良率控制在 100PPM 以内，而行业平均的生产合格率和客户交收不良率分别为 85%和 500PPM。公司以严格的质量要求获得了大量国际知名客户的认同并获得其产品订单。近几年公司的产品先后通过了日本松下、佳能、索尼、东芝等国际一流厂商的严格认证，2006 年获得了松下电子的优秀供应商荣誉。公司拥有完整的生产过程品质管理控制流程，实行目标管理，并运用 SPC、管制图、特效要因图等多种 QC 手法进行过程控制，同时对生产信息实行数据化、可视化管理，对生产过程进行有效监控。QC 巡回小组定期对作业情况进行审查，使得质量体系得以有效运行。

公司拥有优质的供应商群体，所有的原材料供应商都经过严格的审查认定，保证了原材料的高品质。在与国际知名客户的合作过程中，先进的质量管理方法不断地应用于实际的生产管理中，公司的质量管理水平不断提高。

7、成本优势

在电子整机产品降价压力的驱动下，电子元器件产品价格也呈下降趋势。公司通过加大研发投入，不断优化产品结构，使产品向小型化、高频化发展，以较高的技术含量提升产品附加值，满足国际高端客户的需求，同时通过规模效应、提高产品合格率及生产效率等措施不断降低产品成本。因此在近年全球范围内压电晶体元器件价格呈逐年下降趋势下，本公司近三年的产品综合毛利率一直维持在 25%左右且逐年小幅提升。

公司具有较强的 Design-in（共同设计）能力，即在顾客的新产品设计阶段，由顾客提供成本与性能指标，公司提供石英晶体谐振器与应用线路的匹配测试技术，通过匹配试验或提请顾客修改电路设计或修改石英晶体谐振器参数规格，以使石英晶体谐振器在线路中形成最佳匹配，降低发生潜在问题的可能性。同时，特别注重对产品成本的关注，尽量提出低成本的解决方案。

（二） 竞争劣势

公司目前的竞争劣势主要表现在与国际大企业及其在国内的独资或合资企业的差距。如日本 NDK、TOYOCOM 等晶体行业知名企业均有 50 年以上的历史，积累的技术、资金和市场优势超过目前中国的内资企业。公司与国际知名企业的差距主要体现在以下几个方面：

（1） 资金实力的差距

国际知名企业的年销售额均在 1 亿美元以上，我国国内全部压电晶体企业的年总产值不如日本 NDK 一家企业的年产值。此外国际知名压电晶体企业多数为上市公司，拥有充裕的资金来源，而本公司目前基本依赖于自身积累及债务融资，资金实力相对较弱。

（2） 研发力量的差距

国际一流企业在压电晶体行业有 50 年以上的研发和生产经验，掌握了压电晶体行业最尖端的研发和生产能力，如 NDK2006 年投入的研发费用超过 2,000 万美元，其积累的研发技术、研发产品及研发人才远领先于国内企业。

（3） 高端客户的市场营销差距

国际知名企业通过几十年的市场开拓，掌握了大量的高端客户资源，由于高档电子产品的生产和销售主要集中在欧美、日本等发达国家，国际知名企业通过

市场先发优势及品牌优势已与电子整机厂建立了稳固的合作关系，国内企业在技术和品牌均存在弱势的前提下要进入国际高端客户市场存在较大的困难。

本次募集资金主要投资于高精度、小型化的压电晶体谐振器和振荡器，募集资金投资项目的实施，将大幅提高公司的生产规模和增加产品品种，同时通过提高产品技术含量，逐步向通讯和汽车电子应用领域发展，进一步缩小与国际知名企业的差距。

（三） 市场份额变化情况及趋势

据中国电子元件行业协会统计，2006 年度中国 SMD 石英晶体元器件的产量 20 亿只，其中外资占 70% 以上的市场份额，中国内资企业 2006 年度 SMD 石英晶体元器件产量约为 5 亿只左右，2006 年度公司共生产 SMD 谐振器 8,196.96 万只，占国内总产量的 4.10%、内资企业产量的 16.39%。目前公司已达到年产 1.1 亿只 SMD 谐振器的生产能力，在内资企业中 SMD 石英晶体谐振器生产规模名列第一，随着募股资金投资项目的投入，产品技术含量和生产规模将得到大幅的提升，市场占有率有望进一步扩大。

四、 公司主要业务经营情况

（一） 主要产品及用途

本公司主要从事石英晶体谐振器系列产品的研发、生产和销售。石英晶体谐振器作为频率控制和频率选择的核心元件，广泛应用于通讯领域（手机、无绳电话、小灵通、对讲机）；资讯领域（笔记本电脑、台式微机、服务器、打印机、移动硬盘、光盘驱动器、传真机）；网络产品（网络控制、网络接口及适配器、网络连接器、网络检测设备）；家用电器（液晶电视、数码摄像机、数码相机、机顶盒、DVD、MP3、光盘刻录机、家用音响）；汽车电子以及航天航空产品等方面，近年来汽车电子、GPS、数码相机、液晶电视、蓝牙产品、MP3 等新兴产品的发展，扩大了石英晶体元器件的应用领域。

产品应用领域

(1) 通讯产品



手机



无绳电话



小灵通



对讲机

(2) 资讯产品



笔记本电脑



台式机



服务器



打印机



移动硬盘



光盘驱动器



掌上电脑



传真机

(3) 网络产品



网络控制设备



网络接口和适配器



网络连接设备



网络检测设备

(4) 家用电器



液晶电视



数码摄像机



数码相机



机顶盒



DVD



MP3、MP4 播放器

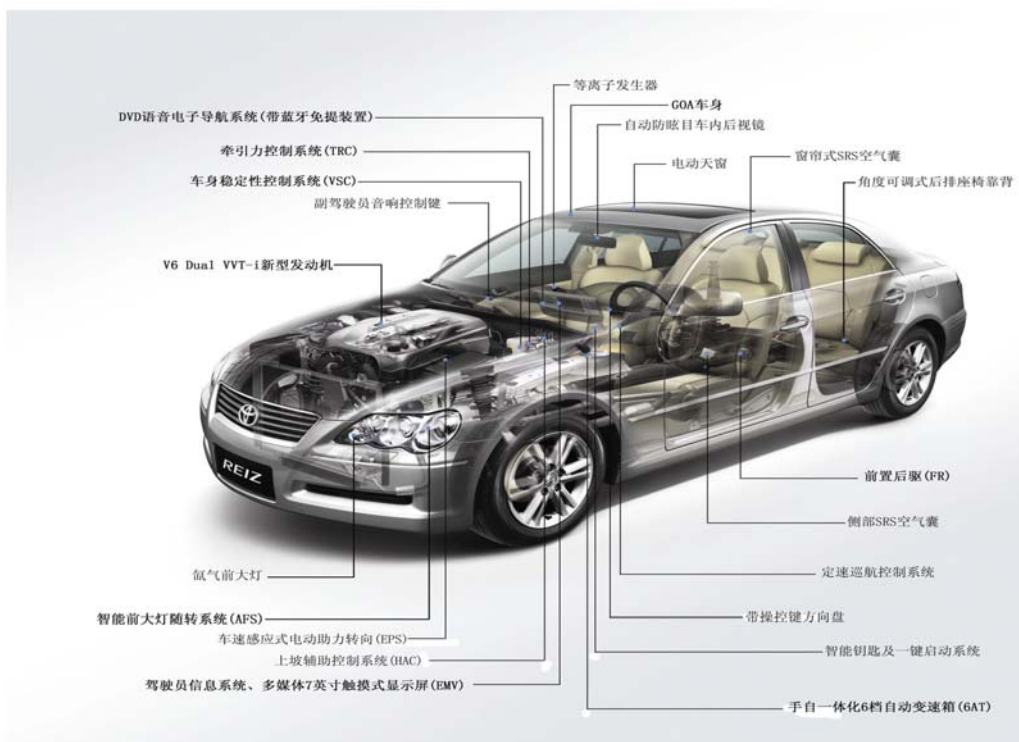


光盘刻录机



家用音响

(5) 汽车电子



汽车应用石英晶体明细表

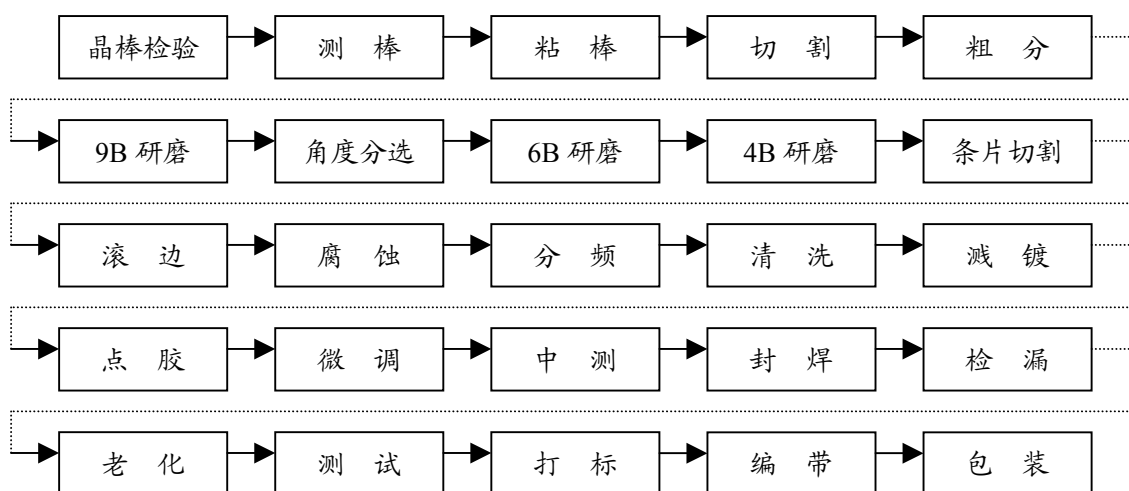
用途	主要应用	数量(个)	用途	主要应用	数量(个)
引擎动力	引擎控制	4	车体	车门窗传感器	3
	引擎监控	4		数字电子式仪表盘	4
	引擎室信息接收	2		车用遥控器	2
安全	安全气囊传感器	4	多媒体	车用影音娱乐设备	8
	TPMS	6		GPS	4
	ABS传感器	2	通讯	Radio、蓝牙、WLAN	4

(资料来源: IEK, 2005)

(二) 主要产品的工艺流程

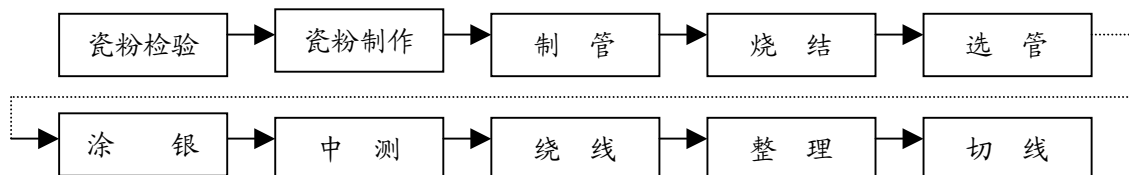
公司的主要产品分为 DIP 谐振器 (包括 HC-49U、HC-49S、HC-49SMD)、SMD 谐振器 (包括 SMD8045、SMD7050、SMD6035、SMD5032 系列产品) 及瓷介管状电容器。其中生产 DIP 谐振器和 SMD 谐振器所需要的晶片 80%左右由本公司自给, 不足部分通过外部采购解决。上述产品独立分区进行生产, 分别由器件 (DIP) 车间、SMD 车间、电容车间、晶片车间负责相关产品的生产。

SMD 谐振器工艺流程图如下:



DIP 与 SMD 谐振器的生产工艺流程基本相同，仅在局部工艺有所调整。

生产瓷介管状电容器的工艺流程图如下所示：



（三）经营模式

公司一方面利用自有品牌开拓客户，不断扩大公司知名度；另一方面也利用 OEM 方式融入国际知名企业的供应商队伍，参与国际市场的竞争和分工。

OEM 客户一般属行业内知名企业，其对代加工制造商的生产规模、供货能力、技术水平、产品质量均有较高的要求，一般从小批量试用到大规模采购需要较长的时间周期，其主要特点为，一旦与石英晶体元器件生产企业建立长期合作关系，订单较为稳定。

1、采购模式

公司制定了较为完善的供应商管理体系，对供货能力和材料品质进行综合评审，多家选择，比价采购。主要产品晶体谐振器的主要原材料为基座、外壳、晶棒。公司在储备适量库存的基础上，按单定期采购。公司与供应商具有多年稳定的业务合作关系，原材料供应充足。

2、生产模式

公司对不同产品进行独立分区生产，具备生产石英晶体谐振器及瓷介管状电容器的完整生产设备和工艺，不存在依赖外部厂商进行协同生产的情况。

公司采取订单生产的模式，按客户订单要求组织生产。业务部接受客户订购意向后，会同技术部门、生产部门确定生产技术方案及交货期，业务部将相关信息反馈给客户并经客户确认后签定订单，由制造中心向各车间下发生产计划，各车间按计划组织生产。

3、销售模式

公司产品销售采取订单管理的办法，以销定产，对自有品牌或通用性强的产品，中间商销售和直销方式并重。

中间商通常不从事石英晶体元器件的生产，但由于其多年的专业销售积累了大量的客户资源，能够集合多家终端客户的需求向专业生产厂商下订单。

由于石英晶体元器件行业品种规格多样，技术指标要求严格且差异悬殊，长期以来，行业形成了中间商销售的模式，由中间商集合下游各元器件厂商的诸多产品后向大客户统一供应。这种合作方式有利于发挥各自的专业优势，减少交易费用，从而提高整个电子元器件行业的经营效率，因而被行业内的企业所广泛采用。在销售收入的确认上，公司与中间商是卖断的关系，产品按合同约定发售给中间商后，中间商再将产品销售给终端客户。本公司销售收入的确认不以中间商是否销售给终端客户为前提条件。

公司直销客户一般为电子整机生产厂家，在客户新产品设计阶段，本公司提供石英晶体谐振器与应用线路的匹配测试，使石英晶体谐振器在线路中形成最佳匹配，产品经客户鉴定认可后按单供应。

最近三年一期公司各种销售方式的销售额在销售总额中所占比重如下表所示：

销售模式		2007年1~6月		2006年度		2005年度		2004年度	
		金额 (万元)	占销售总 额比重	金额 (万元)	占销售总 额比重	金额 (万元)	占销售总 额比重	金额 (万元)	占销售总 额比重
自有 品牌 销售	小计	5,891.85	68.99%	11,239.52	71.24%	8,513.90	69.88%	4,536.28	44.65%
	其中：直销	3,389.37	39.69%	6,093.26	38.62%	4,353.06	35.73%	2,630.33	25.89%
	中间商销售	2,502.48	29.30%	5,146.26	32.61%	4,160.84	34.15%	1,905.95	18.76%
OEM		2,648.16	31.01%	4,537.46	28.76%	3,669.70	30.12%	5,623.37	55.35%
合计		8,540.01	100.00%	15,776.98	100.00%	12,183.60	100.00%	10,159.65	100.00%

公司贴牌销售（OEM），主要是顺应客户需要，在产品上包装上贴客户品牌或客户指定的其他品牌，客户一般通过传真或邮件写明贴牌名称、数量、频率等产品技术参数指标、交货期、交货地等要求，经双方确认后公司组织生产。公司采取按订单生产的模式，以销定产，公司目前不存在未履行完毕的重大的 OEM 合同。

公司根据 OEM 客户的订单从国内外市场自主采购原材料并安排生产，经检验合格后销售给 OEM 客户，本公司与 OEM 客户是普通商品买卖关系而非委托加工关系。公司借助 OEM 方式提高技术水平、学习先进管理经验、融入国际知名企业的供应商队伍，参与国际市场的竞争和分工，从而提升公司自身的核心竞争力。

公司主要贴牌销售客户有台湾晶技股份有限公司、亚陶晶体科技股份有限公司等，基本情况如下：

（1）台湾晶技股份有限公司

台湾晶技作为台湾上市公司，是全球晶体行业第五大公司，2006 年销售额 1.61 亿美元，在台湾市场规模第一，宁波台晶为台湾晶技实际控制的子公司。公司与台湾晶技及宁波台晶有多年稳定的合作关系，双方协同发展，优势互补。截至本招股说明书签署日，公司与台湾晶技及宁波台晶之间不存在股权或合作投资的关系，不存在排他性或限制性的合同或协议，与台湾晶技及宁波台晶的交易均按独立第三方的合理市场价格进行。

由于台湾电子信息产业的快速发展，晶体元器件的需求量已占全球的 25%，而台湾晶体行业生产总量仅占全球的 7%，存在较大缺口，每年需要向内地企业大量采购及配套。

2004年~2006年公司新客户的开发及自主品牌销售占比逐步提高，公司对台湾晶技及宁波台晶的销售比例呈逐年下降趋势，公司2006年度、2005年度及2004年度对台湾晶技及宁波台晶的销售额分别为1,600.90万元、2,749.59万元、6,052.09万元，占当期主营业务收入的比例分别为10.15%、22.57%、56.77%。2007年1~6月，公司提高了SMD5032等技术含量和产品附加值均较高的产品的生产，而这些产品在市场开拓初期以台湾晶技、亚陶晶体科技股份有限公司等老客户为主要销售对象，2007年1~6月公司对台湾晶技及宁波台晶的销售额为1,637.09万元，占

当期主营业务收入的的比例分别为19.17%，销售占比有所上升。随着本公司市场开拓的深入，本公司的产品被更多客户所认同，公司产品的客户集中度将趋向更加合理，对台湾晶技及宁波台晶的销售占比也将逐步回落。

报告期内，公司对台湾晶技及宁波台晶的原材料采购额分别为 1,417.54 万元、3,443.57 万元、1,908.08 万元、877.23 万元，占当期原材料采购总额的比例分别为 24.72%、37.02%、30.99%、13.87%。公司对台湾晶技及宁波台晶的原材料采购额占公司原材料采购总额的比例较高，主要原因是近几年行业内生产 SMD 产品所需的基座和外壳基本被日本三家企业所垄断，公司基于降低采购成本和供货及时性等方面的考虑，与台湾晶技及宁波台晶共享采购平台，由台湾晶技及宁波台晶集合国内多家 SMD 产品生产企业的需求后向日本企业进行集中采购。随着本公司 SMD 产品比例的逐步提高，公司通过台湾晶技及宁波台晶的采购比例维持在较高的水平。目前日本三家基座、外壳生产企业已有两家在中国国内建立了生产基地，国内也有企业开始试制和小批量生产，自 2007 年起，公司部分 SMD 产品的基座、外壳通过中国内地厂家直接采购。公司 2007 年 1~6 月 SMD 产品的比例稳步提高，但通过台湾晶技及宁波台晶的采购比例反而出现了下降。随着公司募集资金到位后生产规模的扩大，未来公司在批量采购中的议价能力将进一步增强，采购灵活性将进一步提高。

公司销售给台湾晶技及宁波台晶的产品包括多种规格的 SMD 产品和 DIP 产品，且主要采用 OEM 形式。公司从台湾晶技及宁波台晶的采购产品为生产 SMD 产品所需的基座和外壳，这些基座和外壳为生产各种规格的 SMD 产品所通用，与公司向台湾晶技及宁波台晶销售的 OEM 产品不存在数量、规格等方面的对应关系，公司利用从台湾晶技及宁波台晶采购的基座和外壳，加工制造出 SMD 产品后销售给任一客户。

（2）亚陶晶体科技股份有限公司

亚陶晶体科技股份有限公司成立于 2000 年，资本额达新台币 6.78 亿元，是台湾第一家通过 ISO9001 国际质量认证之专业石英振荡器厂商。截至 2006 年底有员工 325 人，2006 年、2005 年、2004 年的销售收入分别为 0.347 亿美元、0.265 亿美元、0.206 亿美元，2006 年共生产 SMD 产品 1.088 亿只，DIP 产品 0.258 亿只。2005 年和 2004 年 SMD 产品的产量分别达到 0.70 亿只、0.52 亿只。

公司近三年一期 OEM 主要客户交易情况表

单位：元

公司全称	经营地	2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度
台湾晶技电子股份有限公司	台湾	16,370,907.37	16,009,014.76	27,495,870.30	52,442,451.68
亚陶晶体科技股份有限公司	台湾	13,037,144.61	15,550,772.32	1,438,206.54	-
川扬电子有限公司	台湾	6,872,657.52	6,973,565.45	1,210,182.65	-
津统石英科技股份有限公司	台湾	1,299,436.38	3,495,492.27	3,949,800.29	3,610,337.10
ITTI Company Ltd	美国	493,726.26	1,528,143.36	-	-
KEO SUNG ELECTRONICS CO.,LTD	韩国	-	600,032.71	1,600,609.37	165,904.63
友桂电子有限公司	台湾	217,808.73	56,198.92	391,622.43	113,721.18
台宙晶体科技股份有限公司	台湾	-	-	492,140.86	-
小计		38,291,680.87	44,162,400.82	36,457,506.71	56,198,763.06

注：2007年1~6月公司向上述OEM主要客户销售的产品中，其中OEM金额为25,754,703.72元，自有品牌销售金额为12,536,977.15元。

公司贴牌销售与自主品牌销售模式的关系：

公司坚持“以自有品牌为主、贴牌为辅”的战略，与贴牌客户是既竞争又合作的关系。公司与贴牌客户有着长期合作关系，订单较为稳定，通过与贴牌厂家合作，可以学习他们先进的管理经验，进一步提升质量管理水平，拓展国际高端产品市场。公司与贴牌客户同时存在竞争关系，主要表现在品牌、质量、价格、市场定位等多方面，通过竞争，有助于推进行业整合，提升公司核心竞争力。

（四）产品产销情况

1、公司最近三年一期主要产品的生产能力和实际产量

单位：万只

产品	2007年1~6月			2006年度		
	产量	产能	产能利用率	产量	产能	产能利用率
SMD 谐振器	4,849.59	5,400.00	89.81%	8,196.97	8,500	96.43%
DIP 谐振器	9,198.89	10,000.00	91.99%	14,335.22	15,000	95.57%
电容器	14,571.01	25,000.00	58.28%	25,968.66	50,000	51.94%

单位：万只

产品	2005年度	2004年度
----	--------	--------

	产量	产能	产能利用率	产量	产能	产能利用率
SMD 谐振器	4,829.90	5,000	96.60%	2,741.44	3,000	91.38%
DIP 谐振器	12,035.50	12,500	96.28%	10,114.23	11,000	91.95%
电容器	41,468.82	50,000	82.94%	40,259.26	50,000	80.52%

公司报告期内谐振器的产能利用率均处于较高的水平,由于受春节因素的影响,2007年上半年的产能利用率相对略低。2006年瓷介管状电容器的主要原材料银浆大幅涨价,对公司制造成本影响很大,公司及时调整年度生产计划,减少了瓷介管状电容产量。2006年公司压缩瓷介管状电容器库存周转量,在降低成本快速上升风险的同时,消化了绝大部分的库存产品。由于银浆在2007年继续大幅涨价,公司继续减少了瓷介管状电容器的生产。

电容产品属于公司发展中的非战略性业务,具体运作方面,今后将采取独立运作——分立转让的分步走策略,将电容业务独立出来,以事业部或子公司模式独立运作,通过独立核算、机制转换等措施,提高运营效率。

2、公司最近三年一期主要产品的销量和销售收入

(1) 主要产品产量和销量

单位:万只

产品	2007年1-6月			2006年度		
	产量	销量	产销率	产量	销量	产销率
SMD 谐振器	4,849.59	4,566.46	94.16%	8,196.97	8,146.18	99.38%
DIP 谐振器	9,198.89	8,934.83	97.13%	14,335.22	13,984.70	97.55%
电容器	14,571.01	15,274.48	104.83%	25,968.66	32,610.50	125.58%

单位:万只

产品	2005年度			2004年度		
	产量	销量	产销率	产量	销量	产销率
SMD 谐振器	4,829.90	4,942.88	102.34%	2,741.44	2,736.24	99.81%
DIP 谐振器	12,035.50	12,392.71	102.97%	10,114.23	10,373.27	102.56%
电容器	41,468.82	33,070.10	79.75%	40,259.26	37,239.04	92.50%

(2) 主要产品的销售收入

单位:万元

浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

产品	2007年1-6月		2006年度		2005年度		2004年度	
	销售收入	比例	销售收入	比例	销售收入	比例	销售收入	比例
SMD 谐振器	4,819.46	56.43%	8,810.81	55.85%	5,601.13	45.97%	3,603.11	35.46%
DIP 谐振器	3,393.32	39.73%	6,270.36	39.74%	5,844.72	47.97%	5,696.27	56.07%
电容器	327.23	3.84%	695.81	4.41%	737.74	6.06%	860.27	8.47%
合计	8,540.01	100.00%	15,776.98	100.00%	12,183.59	100.00%	10,159.65	100.00%

3、公司最近三年一期主要产品销售价格变动情况

单位：元/万只

	2007年1-6月		2006年度		2005年度		2004年度
	平均单价	增幅	平均单价	增幅	平均单价	增幅	平均单价
SMD 谐振器	10,554.03	-4.21%	10,815.88	-4.55%	11,331.71	-13.95%	13,168.11
DIP 谐振器	3,797.86	-18.88%	4,483.73	-4.93%	4,716.26	-14.11%	5,491.30

注：2007年1-6月平均单价增幅系与2006年1-6月数据（未审计数）相比较得出。

4、公司最近三年一期向主要客户的销售情况

2007年1-6月前五大客户销售统计

单位：元

客户名称	经营地	交易内容	当期销售额	占全部销售收入的比重	应收账款期末余额	占应收账款期末余额的比重
台湾晶技股份有限公司	台湾	晶体谐振器	16,370,907.37	19.17%	4,653,816.51	12.53%
亚陶晶体科技股份有限公司	台湾	晶体谐振器	13,037,144.61	15.27%	5,364,160.88	14.44%
兼松半导体（新）有限公司	新加坡	晶体谐振器	7,618,829.13	8.92%	1,722,793.64	4.64%
长丰电子有限公司	台湾	晶体谐振器	7,327,718.41	8.58%	2,511,443.40	6.76%
川杨电子有限公司	台湾	晶体谐振器	6,872,657.52	8.05%	3,470,981.17	9.34%
合计			51,227,257.04	59.99%	17,723,195.60	47.71%

2006年度前五大客户销售统计

单位：元

客户名称	经营地	交易内容	本年销售额	占全部销售收入的比重	应收账款年末余额	占应收账款年末余额的比重
台湾晶技电子股份有限公司	台湾	晶体谐振器	16,009,014.76	10.15%	2,704,733.97	8.99%

浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

亚陶晶体科技股份有限公司	台湾	晶体谐振器	15,550,772.32	9.86%	5,934,846.26	19.73%
日本佳能公司	日本	晶体谐振器	12,557,641.99	7.96%	1,907,323.39	6.34%
金正电子有限公司	韩国	晶体谐振器	11,897,480.43	7.54%	149,528.64	0.50%
谏早电子集团公司	日本	晶体谐振器	11,668,458.07	7.40%	-	-
合计			67,683,367.57	42.90%	10,696,432.26	35.56%

2005 年度前五大客户销售统计

单位：元

客户名称	经营地	交易内容	本年销售额	占全部销售收入的比重	应收账款年末余额	占应收账款年末余额的比重
台湾晶技电子股份有限公司	台湾	晶体谐振器	27,495,870.30	22.57%	2,855,415.01	10.47%
津统石英科技股份有限公司	台湾	晶体谐振器	8,498,106.14	6.98%	1,452,276.55	5.33%
日本松下公司	日本	晶体谐振器	8,266,695.17	6.79%	215,549.10	0.79%
长丰电子有限公司	日本	晶体谐振器	6,704,641.22	5.50%	1,412,559.39	5.18%
金正电子有限公司	韩国	晶体谐振器	5,576,425.79	4.58%	1,084,799.27	3.98%
合计			56,541,738.62	46.41%	7,020,599.32	25.75%

2004 年度前五大客户销售统计

单位：元

客户名称	经营地	交易内容	本年销售额	占全部销售收入的比重	应收账款年末余额	占应收账款年末余额的比重
台湾晶技电子股份有限公司	台湾	晶体谐振器	52,442,451.68	49.19%	13,278,151.94	44.77%
日本松下公司	日本	晶体谐振器	13,999,331.86	13.13%	3,783,384.88	12.76%
香港上扬有限公司	香港	晶体谐振器	9,338,395.53	8.76%	4,349,193.16	14.67%
台晶(宁波)电子有限公司	宁波	晶体谐振器	8,078,447.05	7.58%	-	-
昌禾科技股份有限公司	台湾	晶体谐振器	5,303,998.82	4.98%	2,096,561.60	7.07%
合计			89,162,624.94	83.63%	23,507,291.58	79.26%

(五) 公司最近三年一期能源和原材料供应情况

1、最近三年一期主要能源消耗情况

	2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度
水(万吨)	2.08	4.13	3.72	4.95
电(万度)	427.60	800.35	753.71	708.82

2、最近三年一期主要产品成本构成情况

单位: 元/万只

产品	成本构成	2007年1~6月		2006年度		2005年度		2004年度	
		单位成本	比例	单位成本	比例	单位成本	比例	单位成本	比例
SMD 谐振器	原材料	5,910.37	80.19%	6,567.58	80.76%	6,815.73	78.35%	8,928.07	77.92%
	制造费用	1,164.88	15.80%	1,229.82	15.12%	1,361.36	15.65%	1,830.66	15.98%
	工资及福利	124.10	1.68%	145.21	1.79%	241.12	2.77%	269.54	2.35%
	动力	171.56	2.33%	189.79	2.33%	280.45	3.22%	430.05	3.75%
	小计	7,370.91	100.00%	8,132.39	100.00%	8,698.66	100.00%	11,458.31	100.00%
DIP 谐振器	原材料	2,190.98	78.81%	2,329.72	74.84%	2,494.44	73.90%	2,890.63	75.82%
	制造费用	217.55	7.82%	342.09	10.99%	295.29	8.75%	346.46	9.09%
	工资及福利	264.99	9.53%	283.58	9.11%	413.73	12.26%	413.10	10.84%
	动力	106.64	3.84%	157.65	5.06%	172.12	5.10%	162.29	4.26%
	小计	2,780.16	100.00%	3,113.04	100.00%	3,375.58	100.00%	3,812.49	100.00%

3、主要原材料价格变动情况

公司最近三年一期主要原材料的平均采购价格如下:

单位: 元/万只

产品	类别	2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度
SMD 谐振器	基座	3,444.12	3,594.59	3,288.80	4,974.30
	外壳	932.66	1,107.24	1,308.28	1,047.15
	晶片	760.48	780.78	927.97	1,439.36
DIP 谐振器	基座	762.80	823.61	906.27	960.04
	外壳	239.79	245.83	249.35	279.09
	晶片	607.39	627.36	704.41	839.60

4、公司最近三年一期向主要供应商的采购情况

供应商名称	2007年1~6月		2006年度		2005年度		2004年度	
	采购金额(万元)	占材料采购总额的比例	采购金额(万元)	占材料采购总额的比例	采购金额(万元)	占材料采购总额的比例	采购金额(万元)	占材料采购总额的比例
前五大供应商合计	3,121.81	54.45%	5,606.81	60.28%	3,260.73	52.97%	2,498.69	40.66%

2007年1~6月向主要供应商采购统计

单位：元

供应商名称	原材料名称	单位	采购金额
台晶(宁波)电子有限公司	基座/外壳	万套	13,411,384.99
日照旭日电子有限公司	基座	万只	5,172,171.26
上海先翼电子有限公司	基座/外壳	万套	4,943,184.01
宁波晶鑫电子材料有限公司	晶片/外壳	万套	4,077,672.20
东荣电子有限公司	外壳	万只	3,613,714.32
合计			31,218,126.78

2006年度向主要供应商采购统计

单位：元

供应商名称	原材料名称	单位	采购金额
台晶(宁波)电子有限公司	基座/外壳	万套	31,941,077.03
日照旭日电子有限公司	基座	万只	9,420,769.36
上海先翼电子有限公司	基座/外壳	万套	7,613,001.97
日照汇丰电子有限公司	基座	万只	4,392,460.58
珠海东锦电子有限公司	晶片	万片	2,700,764.12
合计			56,068,073.06

2005年度向主要供应商采购统计

单位：元

供应商名称	原材料名称	单位	采购金额
台晶(宁波)电子有限公司	基座/外壳	万套	17,471,223.41
日照旭日电子有限公司	基座	万只	5,584,230.82
日照汇丰电子有限公司	基座	万只	3,707,056.47

宁波晶鑫电子材料有限公司	银浆	公斤	3,539,792.48
技宝电子(日照)电子有限公司	基座	万只	2,304,991.44
合计			32,607,294.62

2004年度向主要供应商采购统计

单位: 元

供应商名称	原材料名称	单位	采购金额
上海先翼电子有限公司	基座/外壳	万套	8,053,418.80
台晶(宁波)电子有限公司	基座/外壳	万套	6,810,691.85
技宝电子(日照)电子有限公司	基座	万只	3,991,880.34
日照汇丰电子有限公司	基座	万只	3,697,976.50
珠海东锦电子有限公司	晶片	万片	2,432,923.08
合计			24,986,890.57

(六) 公司主要关联方在前五大客户和供应商中占有权益情况

本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员以及主要关联方,或持有本公司5%以上股份的股东,与本公司报告期内的前五名客户或供应商均不存在权益关系。

(七) 最近三年一期安全生产和环保支出及未来支出情况

公司目前从事的行业为低污染行业,生产过程排放的废水、废气及噪音符合国家规定的排放标准。公司在生产经营中遵守国家环保法律法规,报告期内公司没有发生污染事故和纠纷,也没有因违反环保法律法规而受到处罚。

公司2007年1~6月、2006年度、2005年度、2004年度的排污费支出分别为1.53万元、2.43万元、1.37万元、1.74万元。公司石英晶体谐振器等系列产品的生产与服务所涉及的环境管理已于2006年5月通过ISO14001环境管理体系认证,同时公司制定了《环境卫生管理制度》、《绿化美化管理规定》、《固定废弃物管理规程》等系列管理制度,使公司的环保管理制度贯穿于所有的生产经营活动。

五、主要固定资产和无形资产

本公司设立后,原金华东晶拥有的机器设备等资产由本公司依法承继,商标、专利、房屋、土地使用权等资产权属均已变更至本公司名下。

(一) 主要固定资产

1、固定资产基本情况

根据立信会计师事务所信会师报字(2007)第23241号审计报告、已审会计报表中的财务会计资料及公司实际情况,截至2007年6月30日,公司固定资产情况如下:

单位:元

类别	账面原值	累计折旧	成新率	固定资产减值准备	固定资产净额
房屋及建筑物	18,040,601.24	2,763,129.64	84.68%	45,177.24	15,232,294.36
专用设备	164,011,741.98	50,841,414.13	69.00%	235,141.55	112,935,186.30
通用设备	8,631,518.29	3,432,401.50	60.23%	49,531.05	5,149,585.74
运输设备	2,435,143.34	670,995.08	72.45%	14,436.04	1,749,712.22
合计	193,119,004.85	57,707,940.35	70.12%	344,285.88	135,066,778.62

2、生产所需主要设备情况

设备名称	数量(台)	账面原值(元)	尚可使用年限(年)	技术先进性
全自动封焊机	4	17,915,628.97	7~9	国际先进
连续式离子刻蚀微调装置	9	30,990,769.93	9	国际先进
连续式频率调速机用装载机与下载机	8	11,672,413.92	7~9	国际先进
上片点胶机	10	14,641,443.60	7~9	国际先进
自动粗漏测试仪	6	10,617,097.10	7~9	国际先进
连续溅射镀银装置	3	8,050,148.09	7	国际先进
晶体制品特性检查装置	7	6,663,332.20	7~9	国际先进
五层式清洁粘合剂硬化炉	4	5,753,416.82	7~9	国际先进
连续式玻璃封焊炉	2	1,921,603.42	9	国际先进
频率调整机	1	1,474,310.00	9	国际先进

空调净化设备系统	1	1,429,000.00	7	国际先进
全自动插片机	2	1,336,003.58	9	国际先进
自动装载机	1	1,223,526.92	9	国际先进
纯水设备	1	838,600.00	7	国际先进
SMD 晶体激光打印机	1	691,540.78	7	国际先进
切割机	1	1,154,867.30	7	国际先进

公司现有主要设备运行良好,符合生产所需的各项技术指标,无经营性租出、不需用或闲置等情况。

3、房屋建筑物情况

截至本招股说明书签署日,公司拥有的房产共计 8 处,全部取得了房产权证。其中公司办公和生产用房 6 处,合计面积为 13,563.14 平方米,房产权证号为金房权证婺字第 00188979~00188981、00188983、00188984、00188824 号;公司职工集体宿舍用房 2 处,合计面积 6,047.94 平方米,房产权证号为 00196331 和 00196332 号。具体情况如下:

房产证号	座落地	面积 ()
金房权证婺字第 00188979 号	工业园区内宾虹路二段 555 号	2,566.21
金房权证婺字第 00188980 号	工业园区内宾虹路二段 555 号	1,958.97
金房权证婺字第 00188981 号	工业园区内宾虹路二段 555 号	2,259.49
金房权证婺字第 00188983 号	工业园区内宾虹路二段 555 号	2,259.49
金房权证婺字第 00188984 号	工业园区内宾虹路二段 555 号	2,259.49
金房权证婺字第 00188824 号	工业园区内宾虹路二段 555 号	2,259.49
金房权证婺字第 00196331 号	宾虹路以北,秋涛路以东市工业园区内	2,048.10
金房权证婺字第 00190332 号	宾虹路以北,秋涛路以东市工业园区内	3,999.84

截至2007年6月30日上述房产均已抵押用于取得银行贷款。

(二) 无形资产

本公司截至 2007 年 6 月 30 日的无形资产情况如下:

单位: 元

项目名称	取得方式	出让方	原始金额	摊余价值	摊销年限	剩余摊销年限
土地使用权	购买	金华市国土资源局	4,706,775.00	4,224,852.58	50 年	526 个月

天心软件	购买	金华市丰龙软件有限公司	139,051.00	20,857.53	5 年	9 个月
SMD SEAM XTAL 技术	购买	台湾晶技股份有限公司	2,832,200.00	2,271,660.48	8 年	77 个月
SMD GLASS XTAL 技术	购买		3,641,400.00	2,768,981.25	8 年	73 个月
合计	-		11,319,426.00	9,286,351.84	-	-

2003年金华东晶购买国际先进的SMD石英晶体元器件设备后，引进了金属封装SMD谐振器产品的生产技术（SMD SEAM XTAL技术）和玻璃封装SMD谐振器产品的生产技术（SMD GLASS XTAL技术）。该两项技术帮助公司在短时间内形成了SMD石英晶体谐振器产品（规格分别为金属封装SMD7050和玻璃封装SMD8045）的量产，节约了时间，先行占领了市场，并成为国内唯一一家能批量生产玻璃封装SMD产品的内资企业。

公司在完全掌握了上述两项专有技术后，以支付技术转让费 80 万美元的方式取得了相关技术的合法使用权。2005 年以来，本公司在引进上述两项技术的基础之上，通过消化吸收，又相继自主开发了 SMD6035、SMD5032 和 SMD3225 等石英晶体元器件产品。


（三） 土地使用权

截至本招股说明书签署日，本公司共拥有两处 4 宗合计 41,116.7 平方米的土地使用权，为金华东晶以出让方式取得，变更设立本公司后转入。具体如下：

编 号	座 落	用途	使用权类型	面积 ()	终止日期
金市国用(2004)第 6-68831 号	市工业园区 8 幢, 宾虹路以北, 秋涛路以东	住宅	出让	320.90	2071 年 1 月 12 日
金市国用(2004)第 6-68832 号	宾虹路以北, 秋涛路以东市工业园区 9 幢	住宅	出让	625.80	2071 年 11 月 12 日
金市国用(2006)第 6-82627 号	市工业园区 S2-04 地块, 宾虹路以南	工业	出让	14,063.00	2051 年 4 月 28 日
金市国用(2006)第 6-82628 号	市工业园区 S2-04 地块, 宾虹路以南	工业	出让	26,107.00	2051 年 4 月 28 日

（四） 商标


1、发行人现拥有的注册商标

商 标	类别	注册证号	注册日期	有效期截止日
	9	3212425 号	2003 年 8 月 7 日	2013 年 8 月 6 日

商 标	类别	注册证号	注册日期	有效期截止日
ECEC	9	1642225 号	2001 年 9 月 28 日	2011 年 9 月 27 日

2、发行人正在申请的商标

金华东晶于 2003 年 2 月向国家工商行政管理总局商标局提出申请注册商标“^{ECEC}东晶电子”，申请号为 3464418。本公司设立后，上述商标注册的申请人由金华东晶变更为东晶电子。截至本招股说明书签署日，“^{ECEC}东晶电子”商标注册申请处于异议阶段。

为了加强对自有品牌和知识产权的保护，公司于 2007 年 1 月委托浙江广宇商标事务所有限公司向国家工商行政管理总局商标局另行注册“”、“东晶”、“东晶电子”等商标。

（五） 专利

公司以下 3 项实用新型专利已经取得国家知识产权局专利局授予的专利权：

专利名称	专利号	授予专利权公告日
玻璃封装石英晶体谐振器实用新型专利	ZL200420110635.9	2006.1.25
金属封装石英晶体谐振器实用新型专利	ZL200420110632.5	2006.1.25
防潮型瓷介管状电容器实用新型专利	ZL200420110633.X	2006.3.1

（六） 专有技术

1、DIP型石英晶体谐振器的设计制造技术

DIP型石英晶体谐振器是HC-49U、49S等有引线型石英晶体谐振器的统称。虽然产品体积较大，但具有低价格优势，仍然具有较为广阔的市场前景。公司通过多年的生产实践，掌握了DIP型石英晶体谐振器的高精度设计和制造技术。

2、低功耗HC49SMD谐振器设计制造技术

低功耗 HC49SMD 谐振器的技术要点是：一般的 HC49SMD 谐振器的标准高度是 $3.8\pm 0.3\text{mm}$ ，而本公司改进了晶体底座的结构，降低了底座和外壳的高度，使得总高度减少到 $3.0\pm 0.3\text{mm}$ ，下降了 26%。更加适应了便携式产品的需求。目

前该产品已经大量出口日本松下等知名公司。

该技术已通过浙江省科技厅组织的专家鉴定（浙科鉴字 02 第 073 号），技术水平处于国内领先。

3、小尺寸SMD谐振器用晶片设计制造技术

SMD 谐振器的晶片相当微小，由于石英晶体谐振器的主振动采用石英晶体的厚度切变振动，但同时石英晶体存在宽度弯曲振动等寄生振动模式。对于 SMD 谐振器，宽度弯曲振动特别容易产生，当晶片的宽厚比达到某些数值时，寄生振动会非常接近于需要的主振动。当晶体工作时，其输出的频率信号会不稳定。

由于晶体的频率与晶片的厚度成反比，为了晶片的宽厚比避开这些数值，晶片的宽度尺寸加工非常重要。国内其它同行的晶片尺寸通常精确到 0.01mm，其测量仪器一般用测量精度为 0.001mm 的微米千分尺，而本公司通过改善设备使其测量精度达到 0.0001mm。

为了使晶体能够在 0.01 μ W 时稳定工作，必须降低晶体的等效电阻，而晶体的等效电阻与晶片表面的光洁度、清洁度以及晶体加工过程中产生的应力有关。本公司采用了精细抛光工艺和新型的清洗工艺及清洗剂，提高了晶片表面的光洁度和清洁度；采用了电清洗工艺和高温退火工艺，减少了应力。

本公司生产的 SMD 晶片的性能达到或优于国外部分晶片制造厂的水平，已经可以大规模采用。

4、金属封装SMD谐振器设计制造技术

由于 SMD 谐振器的尺寸很小，采用传统的普通电阻焊方式已经无法满足上盖和底座的准确对位的要求。国内其他同行通常采用机械夹具的方式来调整上盖和底座的相对位置。这种方式比传统的方式有了较大的改进，但是对于更小尺寸的 SMD 谐振器则无法满足精确对位的要求，本公司采用了 CCD 摄像技术，利用高精度的 CCD 摄像机来计算上盖和底座之间的相对误差，并通过高精度的马达调整相对位置，保证上盖和底座的精确对位。同时通过控制焊接时环境中的露点温度和氧气含量，从而保证了产品的年老化率。

该技术通过了浙江省科技厅组织的专家鉴定（浙科鉴字 05 第 457 号），技术水平处于国内领先。

5、玻璃封装SMD谐振器设计制造技术

该技术关键点在于采用了玻璃烧结密封的方式。玻璃封装方式是采用玻璃

成分在高温烧结的方式进行密封。该技术的难点是必须将烧结的环境中的氧气含量控制在 30PPM 以下。玻璃封装 SMD 谐振器具有低成本、高性能的优点。

该技术通过了浙江省科技厅组织的专家鉴定（浙科鉴字 05 第 456 号），技术水平处于国内领先。

6、SMD 石英晶体振荡器设计制造技术

SMD 石英晶体振荡器作为频率信号发生源，是在石英晶体谐振器的基础上配加反馈放大电路制造而成。在石英晶体谐振器的制造技术基础上，SMD 石英晶体振荡器制造技术的关键是电路设计、石英振子与电路配合参数的选择、测试技术，本公司已掌握 SMD 石英晶体振荡器的相关设计制造技术。

7、石英晶体谐振器与应用线路的匹配技术

目前大部分石英晶体谐振器使用厂家并不十分了解石英晶体谐振器的特点以及使用的要点，常常会发生顾客要求的产品规格并不能使石英晶体谐振器在线路中形成最佳匹配的现象。本公司提供石英晶体谐振器与应用线路的匹配测试技术，通过匹配试验或提请顾客修改电路设计或修改石英晶体谐振器参数规格，以使石英晶体谐振器在线路中形成最佳匹配，降低发生潜在问题的可能性。目前，大部分国际知名客户在其采用新规格石英晶体谐振器之前，均送线路板到本公司进行匹配测试。

8、SMD3225 超小型石英晶体谐振器设计制造技术

该项目特别采用了一种真空封装技术，通过该技术的采用，解决了 SMD3225 超小型石英晶体谐振器的阻抗很难降低的难点。

9、防潮型瓷介管状电容器设计制造技术

本项目采用一种特殊的包封材料，解决了部分产品在特别潮湿的工作环境下产品参数会发生变化的缺陷，提高了产品的可靠性。

10、石英晶体谐振器的无铅化技术

石英晶体谐振器的有害物质主要是铅，RoHS 指令及《电子信息产品污染控制管理办法》对本公司产品的要求主要体现为无铅化，一般认为电子组装中铅含量低于 0.1% 属于无铅，索尼绿色伙伴供应商认证标准要求含铅量 0.01% 以下。

由于无铅焊接工艺的焊接温度高达 260℃，针对石英晶体谐振器的特点，除了石英晶体谐振器本身产品的铅含量要降低到 RoHS 指令的要求，还要重点解决石英晶体谐振器产品在高温下特性的变化。本公司自 2002 年开始研究石英晶体

谐振器的无铅化技术，成功地解决了石英晶体谐振器含铅的问题，同时采用了特别的工艺处理，提高了石英晶体谐振器高温稳定性。公司于 2004 年获得索尼公司绿色合作伙伴证书（Certificate of Green Partner），2006 年获得了佳能公司环境管理优良证书（Certificate of Green Activity）。

（七） 特许经营权

公司除拥有自营进出口权以外，未拥有其他特许经营权。

六、 技术情况

（一） 产品生产技术所处的阶段

本公司已掌握生产现有产品的核心技术，且均处于批量生产阶段。

（二） 项目研究开发情况

目前正处于研发阶段的项目简要情况见下表：

序号	项目名称	研发目标	目前进展
1	高可靠性的DIP型石英晶体谐振器	可以应用汽车电子产品	样品试制阶段
2	SMD2520石英晶体谐振器	频率范围：16-40MHZ	样品试制阶段
3	树脂封装SMD谐振器	环保、低成本	样品试制阶段
4	VCXO-SMD石英晶体振荡器	频率范围10-100MHZ	样品试制阶段

（三） 研发投入

年 份	2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度
研发费用（万元）	428.30	1,183.45	755.82	539.62
研发费用占主营业务收入的比重	5.01%	7.50%	6.20%	5.06%

（四） 合作研发情况

金华东晶于2001年7月与浙江大学航天电气与微特电机研究所签订了技术服务合同书，浙江大学为金华东晶的新产品开发提供技术支持，所有研究成果归金华东晶所有。

2001 年金华市工业科技合作洽谈会期间，公司与浙江大学签订了技术合作

协议，合作开发新产品“低功耗 HC49SMD 石英晶体谐振器”，该产品取得成果如下表：

序号	称号	授予部门	年份
1	浙江省新产品鉴定	浙江省科技厅	2002年
2	浙江省技术创新项目	浙江省科技厅	2003年
3	国家火炬计划项目	科技部	2004年

该产品 2004 年、2003 年、2002 年三年销售收入分别为 3,332 万元、2,121 万元、1,509 万元，技术水平处于国内领先，通过产业化立项，扩大规模，带动公司快步发展，创造了良好的经济效益。

2005年9月，本公司与浙江大学电气工程学院续签技术合作协议书，浙江大学继续为本公司提供新产品开发及提高公司现有设备的自动化水平方面的技术咨询，专利申请权双方共有，非专利技术成果的使用权归本公司所有，目前双方合作情况良好。

（五） 技术创新机制和安排

公司一贯重视科研投入，曾获“浙江省高新技术产业科技创新重点企业”称号，2002年被列为“浙江省高新技术企业”，2005年成为国家火炬计划重点高新技术企业，公司新型频率器件研发中心于2001年获“金华市高新技术研究开发中心”称号，2006年被列入省级高新技术研发中心计划。

1、研发机构和研究人员

经过多年的持续性投入和实践，公司已形成了以研发中心为核心的研发体系，最近三年一期公司累计投入的研发资金为 2,907.19 万元。目前公司内部建立了三个层次的研发体系，最高层是以公司核心领导及技术骨干组成的研发领导小组，负责选择确定公司的研发重点、研发项目立项及后续开发协调工作，通过公司高层的积极参与，有利于调动公司各种有效资源并形成合力，使各项研发工作得以顺利开展；研发体系的第二梯队是以公司专业技术负责人组成的研发队伍，通过研发项目经理负责制，既鼓励个人独创，又鼓励团队合作与分工，最大限度发挥研发一线人员的积极性；研发体系的第三梯队为生产车间的技术人员，负责为新产品试制调试设备、对产品进行检测后将有关情况反馈给研发人员。通过研发人员与生产技术人员共同努力，研发工作作为本公司近几年产品的持续推陈出

新、提高产品精度及产品合格率提供了强大的支撑。

此外本公司还与浙江大学合作设立了新型频率器件研发中心，借助浙江大学的强大科研力量，本公司的研发实力得到了进一步的提高。

公司坚持“科技以人为本”的宗旨，拥有一支高素质的科技人员队伍。研发中心人员 92 人，本科以上学历 41 人（包括研究生学历 11 人），专业技术人员结构合理，研发中心拥有日本技术专家 1 人，高级职称技术人员 8 人，中级职称技术人员 24 人，初级职称技术人员 41 人。技术骨干人员具有 10 年以上的晶体行业产品开发实践。

2、技术创新机制

（1）向世界知名企业看齐，积极开发新产品

信息技术的发展不断开拓公司产品的应用领域，同时对产品的要求也日益提高。公司除及时了解本行业最新发展趋势之外，还积极参加国内外举办的高端新产品展示会或交流会，通过与索尼、松下等知名公司的业务合作与交流，了解下游行业的发展趋势及终端客户的需求，并以此来研究策划下一步的产品开发重点和发展方向。

公司通过研究领先企业的技术发展方向，学习、引进及消化吸收关键产品技术，形成自主知识产权体系；通过跟踪下游及终端应用领域的需求趋势，与终端客户在产品领域交流学习，积极介入终端产品设计；通过持续改进和创新产品的制造工艺技术，形成公司特色的高效率、高品质、低成本的制造模式。

（2）与高等院校和科研机构的合作

公司一贯重视与高等院校和科研机构的合作，近几年公司陆续选派骨干人员到各大高校进行长期的在职进修和学习，不断提高公司骨干的专业素质；公司还与国内高校合作建立研究开发中心，充分利用高校具备的人才和科研优势，同时通过产品的合作开发培养公司内部的技术骨干。

（3）与全球行业知名企业的合作

通过多年的发展，公司与台湾晶技等行业知名企业建立了紧密的合作关系，金华东晶于 2003 年引进国际先进的 SMD 石英晶体元器件设备，台湾晶技开始为公司提供 SMD SEAM XTAL 和 SMD GLASS XTAL 技术服务，内容包括厂房设计布置，设备选型、配置与安装调试，建立工艺流程，建立品质管控系统，技术指导及人员培训等。

经双方确认，公司已完全掌握 SMD8045（G）、SMD7050（S）生产技术后，2005 年 3 月 10 日，双方就 SMD SEAM XTAL 和 SMD GLASS XTAL 技术的正式转让签订了《SMD SEAM XTAL 技术移转协议》和《SMD GLASS XTAL 技术移转协议》，公司向台湾晶技支付技术转让费共计 80 万美元。上述两项技术转让后，公司拥有该两项专有技术的使用权和享有权。

公司通过上述技术合作，在短时间内形成了 SMD 产品的量产，节约了时间，获得市场先机，公司在消化吸收两项技术的基础上，后续自主开发了更小型的 SMD6035（S）、SMD5032、SMD3225 等高精度、小型化、附加值更高的新产品，提升了产品的市场竞争力，并创造了较好的经济效益。

公司通过与行业知名企业签订技术服务合同等多种方式达到快速积累公司技术实力的目标，该措施对公司近几年的快速发展提供了技术支持。

（4）高效的项目开发机制

项目立项批准后，公司组织专业人才组成项目开发团队，按《科技项目奖励实施办法》与项目组签订协议，通过加大项目开发的奖励力度，激励科技人员开发新产品、改进工艺等，通过团队内部的合理分工与合作，使项目开发能以较快的时间达到较好的效果。

（5）鼓励全员创新的企业文化

公司提倡全体员工积极创新，鼓励员工立足于本职工作，提出各项改良和创新建议。公司专门制定了鼓励员工进行技术创新的奖励办法，每年对参与创新并取得一定成绩的员工进行表彰并给予一定的物质奖励，这种基于生产第一线的改良与创新对公司的各项生产起到节约成本或提高生产效率的作用。

七、公司境外生产经营情况

截至本招股说明书签署日，公司除开展正常进出口业务外，未拥有境外资产。

八、公司质量控制情况

（一）质量控制标准

公司2006年通过ISO9001:2000质量管理体系换版认证，通过ISO14001:1996环境管理体系认证，分别取得注册号为QAIC/CN/60345质量管理体系认证证书和

QAIC/CN/60346—A环境管理体系认证证书。

公司产品的企业标准按照 GB/T1.1《标准化工作导则第 1 部分：标准的结构和编写规则》，并参考 GB/T15020-94《电子设备用石英晶体元件 空白详细规范 电阻焊石英晶体元件 评定水平 E》的要求。性能指标和测试方法按照 IEC122—1《频率控制和选择用石英晶体元件 第 1 部分 标准值和试验条件》和 GB12273—90《石英晶体元件总规范》的要求。公司产品达到世界知名公司有关产品检测标准，在国际市场有一定的品牌优势。

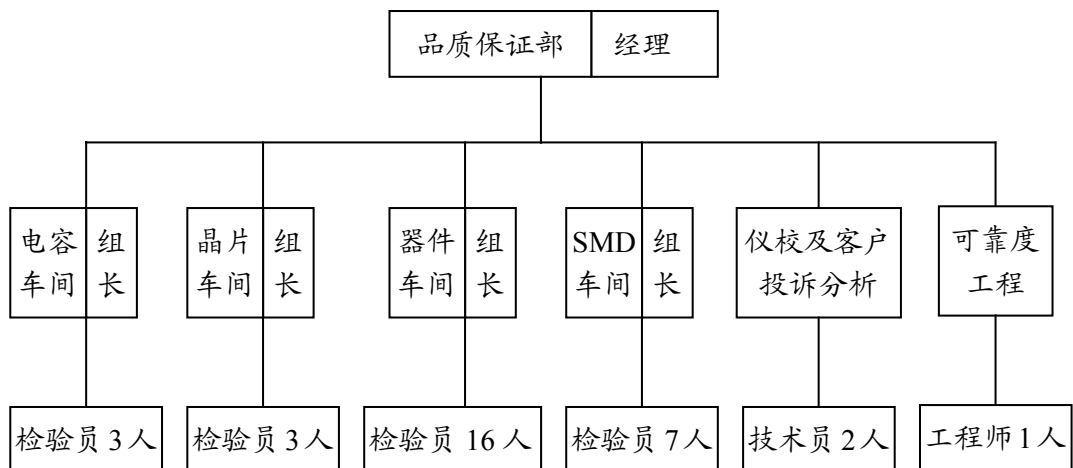
本公司始终坚持“满足顾客，挑战自我，共同发展”的质量方针，制订了“产品交收不良率 100PPM 以下，顾客投诉率 1%以下”的质量目标。

（二）质量控制措施

公司依据 GB/T19001 2000 idt ISO9001: 2000 质量管理体系要求，结合本公司产品的形成过程编制《质量手册》和《质量控制程序文件》等 20 个程序文件及相应的第三层文件（作业指导书、检验文件）等，现已形成一套行之有效的制度化质量管理体系，并加以贯彻和实施。

公司设有品质保证部，拥有一支由 30 余名质检人员组成的专职检验人员队伍，主要负责宣传、贯彻、落实有关质量工作方面的各项方针、政策、法律、法规及本公司的各项质量管理规定；负责公司主要原材料进货检验，参与供应商的评定；负责产品生产过程的监控；负责不合格品及不合格项的原因分析；负责纠正和预防措施验证；负责统计技术的推广应用；负责对工艺规程、工艺卫生和作业指导书实施情况的监督检查；负责公司的成品检验和出厂检验；受理顾客投诉和退货的质量分析。

下图为本公司质量控制部门结构及人员构成情况：



(三) 产品质量纠纷

公司成立至今未发生因产品质量问题发生法律纠纷。

第七节 同业竞争与关联交易

一、关于同业竞争

(一) 发行人与关联方之间的同业竞争关系

发行人的发起人为 12 名自然人股东，该 12 名自然人及关系密切的家庭成员均没有投资控股或参股其他电子元器件企业，公司所有董事、监事、现任高级管理人员、核心技术人员均没有控股或参股其他石英晶体元器件企业。因此发行人与上述人员不存在同业竞争关系。

(二) 发行人采取的避免同业竞争的措施

《公司章程》规定，董事“未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务”。

所有发起人签订了《全体发起人股东关于避免同业竞争的承诺》。具体内容如下：

1、目前未从事或参与与公司存在同业竞争的行为。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、上述承诺在承诺人持有公司股份或者在公司任职期间有效，如违反上述承诺，承诺人愿意承担因此而给公司造成的全部经济损失。

二、关于关联方和关联关系

根据《公司法》和《企业会计准则》，公司报告期内存在的关联方和关联关系如下：

关联方名称	关联关系
(一) 控股股东	
李庆跃	公司控股股东、实际控制人，持股比例 39.60%
(二) 持有发行人股份 5%以上的其他股东	
池旭明、吴宗泽、金良荣、陈利平、杨亚平、俞尚东、赵晖、蒋旭升、方琳、陈玉花、方永进	
(三) 关键管理人员	
骆红莉、王骥、许永斌、杜归真	职工代表董事、独立董事
钱建昀、郭雄伟	职工代表监事
井上博宪、方兆彩、刘洋	高级管理人员
(四) 发行人参股公司	
浙江大通集团股份有限公司	公司参股企业，持有 0.20%的股权
(五) 受控股股东家庭成员直接控制的企业	
金华市宏凯电子有限公司	公司控股股东李庆跃之子李凯、父李玄鸿分别持有 70%、30%的股权
金华市宏凯科技有限公司	公司控股股东李庆跃之妹李庆环持有 70%的股权
(六) 与发行人曾存在关联关系的企业	
金华市东晶经贸有限公司	与发行人关联关系详见本节“二、关于关联方和关联关系(六)金华市东晶经贸有限公司”。2006年11月该公司注销。
金华惠成投资担保有限公司	与发行人关联关系详见第五节“发行人基本情况”之“三、发行人股本形成、变化及重大资产重组情况”之“(二)发行人资产重组情况”。

(一) 发行人的控股股东

公司董事长李庆跃持有发行人股份1,821.6万股，占总股本的39.60%，是公司的控股股东。李庆跃的具体情况参见本招股说明书第五节“发行人基本情况”。该关联方与发行人之间的关联关系为股权关系，且该关联方担任本公司的法定代表人、董事长、总经理。

(二) 持有发行人股份 5%以上的其他股东

持有发行人股份5%以上的其他股东包括池旭明、吴宗泽、金良荣、陈利平、杨亚平、俞尚东、赵晖、蒋旭升、方琳、陈玉花、方永进等11人，上述人员情况参见本招股说明书第五节“发行人基本情况”。

（三） 关键管理人员

除股东担任的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员外，公司其他的关键管理人员有：骆红莉为职工代表董事，王骥、许永斌、杜归真为独立董事，钱建昀、郭雄伟为职工代表监事，井上博宪为副总经理、方兆彩为财务总监、刘洋为董事会秘书。上述人员简历参见第八节“董事、监事、高级管理人员和核心技术人员”。

（四） 发行人参股公司——浙江大通集团股份有限公司

详见第五节 发行人基本情况之“五、发行人的组织结构（二）控股或参股公司情况”。

（五） 受控股股东的家庭成员直接控制的企业

1、金华市宏凯电子有限公司

金华市宏凯电子有限公司成立于1997年9月30日，现有注册资本100万元，注册号：33070029033766。该公司住所：金华市工业园区秋涛北街123号；法定代表人：李玄鸿。经营范围：电线、电缆、电器接插件的生产、销售；营业期限自1997年9月30日至2025年2月10日止。宏凯电子与发行人不存在同业竞争。

宏凯电子设立时，注册资本50万元，其中李庆跃出资20万元，占注册资本的40%，担任宏凯电子监事；李玄鸿（李庆跃之父亲）出资30万元，占注册资本的60%。2004年7月，李庆跃将其持有的宏凯电子的全部股份转让给李凯（李庆跃之子），转让后李凯出资20万元，占注册资本的40%，同时李庆跃辞去监事职务；李玄鸿出资额及比例均不变。2005年8月，宏凯电子增加注册资本至100万元，增资后李凯出资70万元，占注册资本的70%；李玄鸿出资30万元，占注册资本的30%。

2、金华市宏凯科技有限公司

金华市宏凯科技有限公司成立于2006年2月23日，现有注册资本100万元，注册号：3307002905236。该公司住所：金华市工业园区秋涛北街123号；李庆环（李庆跃之妹）持有该公司70%的股权并担任法定代表人。经营范围：各类包装物料的研发、生产、销售，模具设计、制作、加工；五金、建材化工产品（除化学危

险品、易制毒品、监控化学品)销售。营业期限自2006年2月23日至2018年2月22日。宏凯科技与发行人也不存在同业竞争关系。

(六) 与发行人曾存在关联关系的企业

1、金华市东晶经贸有限公司

(1) 东晶经贸成立

东晶经贸成立于2001年8月27日,注册资本100万元,其中金华东晶以现金出资90万元,占注册资本的90%;金华东晶股东杨亚平以现金出资10万元,占注册资本的10%。金华天鉴会计师事务所有限公司对各方投入的资本进行了审验,并出具了金华天鉴验(2001)第031号验资报告。李庆跃担任东晶经贸法定代表人兼执行董事。

(2) 东晶经贸增资

2002年7月,东晶经贸增加注册资本至500万元,并办理了工商变更登记。其中金华东晶以现金增资360万元,杨亚平以现金增资40万元。增资后金华东晶共出资450万元,占注册资本的90%;杨亚平共出资50万元,占注册资本的10%。金华中健联合会计师事务所有限公司对各方新增投入的资本进行了审验,并出具了金华中健验(2002)第008号验资报告。

(3) 东晶经贸第一次股权转让

2002年10月10日,杨亚平与金华东晶工会委员会(以下简称“金华东晶工会”)签订股权转让协议,杨亚平将其持有的东晶经贸10%的股份全部转让给金华东晶工会。转让后金华东晶出资450万元,占注册资本的90%;金华东晶工会出资50万元,占注册资本的10%。

(4) 东晶经贸第二次股权转让

2004年6月24日,金华东晶与余松土签订股权转让协议,金华东晶将持有的东晶经贸90%股权转让给余松土,截至2003年12月31日,东晶经贸经审计净资产值为5,004,402元,90%股权净值为4,503,961元,以此作为股权转让作价参考依据,按1:1的价格比例转让,股权转让价格为450万元。该项价款已于2004年6月25日由余松土支付给金华东晶,股权已于当日交割完毕,并于2004

年 6 月 30 日在金华市工商局办妥变更登记手续。股权转让后，东晶经贸的股权结构为余松土出资 450 万元，占注册资本的 90%；金华东晶工会出资 50 万元，占注册资本的 10%。李庆跃辞去在东晶经贸的所有职务，余松土担任东晶经贸法定代表人兼执行董事。经保荐人和发行人律师核查，余松土与金华东晶及其全体股东无关联关系。

自此，本公司不再持有东晶经贸的任何权益。

（5）东晶经贸减资

2005 年 2 月 4 日，东晶经贸履行法定程序后减少注册资本至 200 万元，减资后的股权结构为余松土出资 150 万元，占注册资本的 75%；本公司工会出资 50 万元，占注册资本的 25%。由于金华东晶于 2004 年 7 月 30 日整体变更为浙江东晶电子股份有限公司，东晶经贸股东金华市东晶电子有限公司工会委员会更名为浙江东晶电子股份有限公司工会委员会。金华中健联合会计师事务所有限公司对减资实现进行了审验，并出具了金华中健验字（2005）第 006 号验资报告。

（6）东晶经贸第三次股权转让

2005 年 12 月 8 日，本公司工会与方彩珍签订了股权转让协议，将其持有的东晶经贸 25%的股权全部转让给方彩珍，转让后的股权结构为余松土出资 150 万元，占注册资本的 75%；方彩珍出资 50 万元，占注册资本的 25%。

截至本招股说明书签署日，本公司工会无对外投资。

（7）东晶经贸注销

2006 年 11 月 23 日，东晶经贸履行法定程序后经金华市工商行政管理局核准注销。

2、金华惠成投资担保有限公司

详见本招股说明书第五节“发行人基本情况”之“三、发行人股本形成、变化及重大资产重组情况”之“（二）“发行人资产重组情况”。

（七）董事、监事、高级管理人员等在关联方单位的任职情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员均未在本公司的关联方单位担任职务。

三、关联交易的性质和内容

类型	内容	关联方	关联交易性质
一、购买关联方产品	购买包装物	宏凯电子	经常性
二、关联方资金往来	借入资金	惠成公司	偶发性
		主要股东	偶发性
	借出资金	惠成公司	偶发性
三、关联方担保	接受担保	惠成公司	经常性
四、关键管理人员报酬	向关联方支付报酬	董事、监事、高级管理人员	经常性

(一) 经常性的关联交易

1、购买商品

最近三年一期，公司从关联企业宏凯电子购入包装物等辅助材料的具体金额如下：

年份	向宏凯电子采购辅助材料的金额（元）	占年度购入原材料金额的比例
2007年1~6月	-	-
2006年度	282,711.40	0.30%
2005年度	1,563,000.86	2.54%
2004年度	661,061.11	0.87%

公司向宏凯电子购买包装物属正常的业务往来，占同期主营业务成本比例不大，采购价格为市场价格，未对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

2、接受惠成公司担保

单位：元

交易内容	2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度
接受担保	-	13,207,000.00	48,915,000.00	9,500,000.00
支付保费	-	161,206.90	168,242.00	54,955.00

2006年度惠成公司为本公司取得1,000万元人民币银行借款提供担保，为公司开具银行承兑汇票320.70万元提供担保，本公司合计接受惠成公司担保的金额为1,320.70万元。

2005 年惠成公司为本公司取得 350 万元人民币银行借款提供担保，为本公司多次开具银行承兑汇票累计发生额 4,541.50 万元提供担保，本公司接受惠成公司担保的金额累计为 4,891.50 万元。

2004 年度惠成公司为本公司取得 850 万元人民币银行借款提供担保，为公司开具银行承兑汇票 100 万元提供担保，本公司合计接受惠成公司担保的金额为 950 万元。

本公司向惠成公司支付的担保费，系依据惠成公司《经营实施细则》，股东企业担保期限在 3 个月内的，月担保费率为 1‰，3~6 个月内的，月担保费率为 1.2‰，6 个月~12 个月的，月担保费率为 1.5‰。

3、与关联方应收应付款项余额

关联方	科目内容	2007.6.30.		2006.12.31.		2005.12.31.		2004.12.31.	
		金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例	金额(元)	比例
应付账款	宏凯电子	-	-	-	-	241,192.60	0.95%	183,735.00	0.85%

4、向关键管理人员支付报酬

公司除向在本公司担任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员等人士支付劳务报酬以外，未向其他关联方人士支付报酬。2007年1~6月、2006年度、2005年度、2004年度公司支付给上述人员的报酬总额分别为51.13万元、131.66万元、122.29万元、89.30万元，具体情况请参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“四、公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员收入情况”的相关内容。

(二) 偶发性的关联交易

1、与惠成公司拆借资金

单位：元

交易内容	2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度
累计借入资金	-	4,000,000.00	27,500,000.00	17,600,000.00
支付资金占用费	-	80,180.00	285,600.00	49,925.00
累计借出资金	-	3,000,000.00	7,500,000.00	4,500,000.00
收取资金占用费	-	30,000.00	165,110.00	29,125.00

惠成公司系当地政府为缓解地方中小企业融资困难而设立的，金华市财政局为该公司第一大股东，旨在“扶持民营企业，解决其在金融机构贷款、担保难的问题，减少和化解银行贷款风险，为国家和地方培植税源”。根据其《经营实施细则》，实际从事的主要业务为：（1）为中小企业向金融机构的融资提供担保和再担保；（2）为信誉较好、经营情况较好、有还款能力的中小企业，在其资金紧张的情况下，给予短期借款（主要为企业在银行续贷时置换周转和有第三方担保或充分的抵（质）押物的短期借款等）；（3）国家法律、法规和政策允许的投资业务；（4）开展经财政部门批准的其他担保和资金运用业务。其服务对象主要为股东企业。

公司与惠成公司之间的资金拆借是为了解决日常生产经营的临时资金周转需要。根据惠成公司《经营实施细则》，惠成公司股东、会员企业在规定的额度和期限内借款费率每天为借款金额的万分之四附近适当浮动。最近三年，公司单笔借款利率在万分之四左右。公司与惠成公司的短期拆借资金均在当期偿还完毕，自2006年3月31日起，公司与惠成公司未再发生资金拆借行为。

2、公司于2003年向赵晖、陈利平、杨亚平、俞尚东、金良荣、方琳等6名股东借入79万元资金，按照年费率10%支付资金占用费，2004年度支付资金占用费3.86万元。上述资金已于2004年6月归还完毕。

（三） 公司目前存续的关联交易合同

公司目前没有存续的关联交易合同。

公司本次发行募股资金投资项目不涉及关联交易。

（四） 关联交易对公司财务状况和经营成果的影响

根据公司最近三年一期经审计的财务报告，本公司从宏凯电子采购辅助材料的金额占年度原辅材料采购成本的比例最大为2.54%，2007年1~6月已无关联交易发生，对公司财务状况影响较小；本公司与惠成公司的短期资金拆借及担保行为出于满足公司短期的资金周转需求，最近三年累计支付给惠成公司的资金占用费和担保费用为575,838.90元，占本公司最近三年累计财务费用支出（利息支出+金融机构手续费+其他）的比例为3.78%；公司与股东之间的资金往来金额较小，时间也较短，且已在2004年度全部清理完毕。因此，关联交易对公司财务

状况和经营成果的影响较小。

四、关联交易决策的制度安排

为了避免和消除可能出现的控股股东或其他股东利用对公司经营和财务决策的影响，在有关商业交易中有损害公司及其他股东利益的行为，公司已在《公司章程》、《关联交易决策权限与程序规则》、《独立董事工作制度》及其他有关规定中明确规定了股东大会、董事会在对有关关联交易进行表决时，关联股东、关联董事进行回避以进行公允决策等有关规定，主要包括：

（一）《公司章程》的有关规定

1、关于控股股东的诚信义务。《公司章程》第三十九条规定：公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

2、关于关联交易决策权力。《公司章程》第一百一十条第（五）款规定：公司与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）不超过占公司最近一期经审计净资产值的5%且不超过3,000万元的，需经董事会批准；关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续12个月内达成的关联交易累计金额）超过占公司最近一期经审计净资产值5%或超过3,000万元的，需由董事会审议后提请股东大会批准。

3、关于关联股东回避制度。《公司章程》第七十九条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东因特殊情况无法回避时，在公司征得证券监管部门同意后，可以参加表决，但公司应当在股东大会决议中做出详细说明，同时对非关联方的股东投票情况进行专门统计，并在决议公告中予以披露。

4、关于关联董事回避制度。《公司章程》第一百一十九条规定：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也

不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

（二） 公司《关联交易决策权限与程序规则》有关规定

1、第八条规定：公司关联交易应当遵循以下基本原则：

（1） 诚实信用原则；

（2） 平等、自愿、等价、有偿的原则；

（3） 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露；

（4） 公司不得为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保；

（5） 与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时，应采取回避原则；

（6） 公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问发表意见。

2、除《公司章程》中规定的董事会、股东大会决策权限外，第十条“关联交易决策权限”还规定：

（1） 董事长：董事会闭会期间，除关联交易与董事长相关联的情形外，公司拟与关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）低于最近一期经审计的净资产 2%且低于 300 万元（含 300 万元）以下的，由公司董事长批准。

（2） 独立董事：公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近一期经审计净资产值 5%的关联交易，应由独立董事认可后提交董事会讨论。独立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

3、第十四条规定：公司关联人与公司签署涉及关联交易的协议，应当采取的回避措施：

(1) 任何个人只能代表一方签署协议；

(2) 关联人不得以任何方式干预公司的决定；

(3) 公司董事会审议关联交易时，该关联交易是与董事个人利益有关或董事个人在关联企业任职或拥有控股权，相关的董事或当事人可以参与该关联事项的审议讨论并提出自己的意见，但不得参与对该关联交易事项的表决。

(三) 《独立董事工作制度》有关规定

独立董事除具有公司法和其他相关法律法规赋予董事的职权外，还享有以下特别职权：重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近一期经审计净资产值5%的关联交易）需由二分之一以上独立董事认可后，方能提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据，独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

独立董事对公司股东、实际控制人及其关联企业与公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款向董事会或股东大会发表独立意见。

五、 发行人最近三年一期关联交易决策的执行情况及独立董事的意见

(一) 最近三年一期关联交易决策执行情况

2004年1月3日，金华东晶董事会临时会议决议，与宏凯电子签订《采购框架协议》，向宏凯电子主要采购编带盘等包装物，采购单价为采购产品当地市场价上下浮动10%范围内，本年度内采购总额不超过200万元。

2004年1月30日，金华东晶临时股东会决议，2004年度拟向惠成公司借入短期资金累计总额不超过2,500万元，公司也可应惠成公司要求，为其提供短期周转资金，但不得超过1,000万元。金华东晶在向银行借款时，可要求惠成公司为金华东晶提供担保。

2004年12月10日，公司董事会临时会议决议，与宏凯电子签订《采购框架协议》，公司向其采购编带、编带盘等产品，采购单价为采购产品的当地市场价上下浮动10%，在2005年度的采购总额为300万元内。关联董事李庆跃回避表决。

2005年3月6日，公司2005年第二次临时股东大会决议，授权公司董事会2005

年度向其他公司（包括关联公司）累计借入短期资金不超过人民币3,000万元的权限，单次借入短期资金在300万元以上的需董事会通过，300万元以下授权董事长行使，即使为关联交易事项。

2005年7月10日、9月14日，公司董事会临时会议分别决议，为解决公司经营资金短缺问题，向惠成公司借入短期资金400万元、500万元，资金占用费以每天万分之三计算。关联董事李庆跃回避表决。

2006年1月17日，公司董事会临时会议决议：

（1）为解决公司经营资金短缺问题，向惠成公司借入短期资金400万元，资金占用费以每天万分之四计算；

（2）2006年2月向惠成公司提供300万元短期资金，资金占用费同样为每天万分之四计算，期限为30天；

（3）公司与宏凯电子签订《采购框架协议》，向宏凯电子主要采购SMD垫片、编带盘、49U、49S托盘，采购单价为采购产品当地市场价上下浮动10%范围内，协议有效期为2006年1月1日至2006年12月31日，在有效期内采购总额不超过100万元。

关联董事李庆跃对以上议案回避表决。

2006年6月25日公司董事会临时会议、2006年7月10日公司2006年第一次临时股东大会分别决议，公司因经营活动资金周转需要，拟向银行申请贷款及需向银行进行相关承兑事项。惠成公司为公司提供贷款及承兑担保。本年度担保额度不超过公司最近一期经审计净资产值的20%。关联董事李庆跃回避表决。

（二） 独立董事的意见

独立董事对2006年6月25日公司董事会临时会议、2006年7月10日公司2006年第一次临时股东大会上，惠成公司为公司提供贷款担保及银行承兑事项提供担保而构成的关联交易事项发表如下独立意见：

1、我们认为惠成公司为公司的银行贷款和与银行签订的相关承兑协议提供担保，以及董事会及股东大会的审议程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

2、我们认为本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

独立董事对公司最近三年一期关联交易程序合法性及交易价格公允性发表如下独立意见：

公司2004年度、2005年度、2006年度及2007年1~6月与关联方进行的关联交易公平、合理，不存在损害公司及股东利益的问题；关联交易的审批均履行了《公司章程》、《关联交易决策权限与程序规则》等规定的决策程序；公司的有关关联方、关联关系及关联交易已经充分披露。

六、 发行人拟采取的减少关联交易的措施

公司为减少关联交易已采取和将采取的措施有：

2004年度，公司全面清理了与股东之间的资金往来。

2006年底，公司与中国进出口银行浙江省分行签订了5,000万元期限为两年半的贷款合同，此举有利于缓解公司与关联方的短期资金拆借行为。

鉴于公司与惠成公司最近三年均存在资金占用情形，为规范公司财务管理运作，公司特承诺如下：自2007年1月1日起公司不再与惠成公司发生资金占用情形，短期内资金的短缺坚决通过向银行融资解决。若有发生与关联方的资金占用情形，公司将直接追究董事、监事、高级管理人员的相关责任。

2007年1月20日，公司全体发起人股东签署《承诺书》，承诺：截至承诺日之前，若公司因收取资金占用费事宜而受到相关部门的处罚，本人作为公司的发起人股东承诺与其他发起人按现有的所占公司的股份承担公司所受的处罚金额。

公司已建立了独立的生产、供应、销售系统，与关联企业在业务、资产、机构、人员、财务等方面相互独立。

公司建立了独立的公司治理制度，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等规定了有关关联董事、关联股东的回避表决制度，以保证公司股东大会、董事会关联交易决策对其他股东利益的公允性。

公司完善了规范关联交易的制度安排，制定了《关联交易决策权限与程序规则》，对于正常的、有利于公司发展的关联交易，公司遵循公开、公平、公正的市场原则，认真履行关联交易决策程序，确保交易的公允，并对关联交易予以充分及时披露。

第八节 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介

公司独立董事王骥为美国籍、拥有在美国的永久居留权，核心技术人员井上博宪为日本籍，拥有在日本的永久居留权，其余董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均为中国国籍，公司董事、监事、高管与核心技术人员的任职期限均为2007年9月至2010年9月。

(一) 董事

1、李庆跃，2004年7月至今任公司董事长。个人简历请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司发起人、持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况”的相关内容。

2、池旭明，2004年7月至今任公司董事兼技术总监。个人简历请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司发起人、持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况”的相关内容。

3、金良荣，2004年7月至今任公司董事兼副总经理。个人简历请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司发起人、持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况”的相关内容。

4、吴宗泽，2004年7月至今任公司董事。个人简历请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司发起人、持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况”的相关内容。

5、陈利平，2004年7月至今任公司董事。个人简历请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司发起人、持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况”的相关内容。

6、骆红莉，2006年4月至今任公司职工代表董事，女，1968年出生，硕士研究生学历，曾就职于中国建设银行金华市分行、华通电子、金华东晶电子有限公司，2004年7月至今任公司业务部经理。

7、王骥，2006年4月至今任公司独立董事，男，1962年出生，博士学历，

现任宁波大学特聘教授，宁波大学技术压电器件实验室主任，专门从事固体力学和石英晶体频控器件的教学和研究工作，拥有三项石英晶体谐振器的美国专利。1990年~1995年，在Princeton大学学习，专门研究应用于无线通讯的小型石英晶体器件；1995至2002年在美国一家公司专门从事石英晶体谐振器的小型化程序设计等工作。在石英晶体谐振器的设计和研究获得众多荣誉，研究方向主要是石英晶体材料和弹性波理论在压电器件分析、模拟和设计中的应用。

8、许永斌，2006年4月至今任公司独立董事，男，1962年出生，1995年获浙江大学管理学硕士学位；会计学教授，现任浙江工商大学财务与会计学院院长、校学术（学位）委员会委员，兼任中国会计学会理事，浙江省审计学会理事兼副秘书长，浙江省总会计师协会常务理事兼信息化专业委员会主任。主要研究领域有：企业（会计）信息化、电子商务、衍生金融工具会计等。许永斌同时兼任上市公司浙江东日股份有限公司（股票代码：600113）独立董事。

9、杜归真，2006年4月至今任公司独立董事，女，1964年出生，硕士学历、律师，1985年至1990年工作于浙江省司法厅；1991年至1995年工作于浙法律师事务所，1996年至今工作于浙江省律师协会，任副秘书长。杜归真同时兼任上市公司美都控股股份有限公司（股票代码：600175）独立董事、浙江海纳科技股份有限公司（股票代码：000925）独立董事。

（二） 监事

1、杨亚平，2004年7月至今任公司监事会主席。个人简历请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司发起人、持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况”的相关内容。

2、俞尚东，2004年7月至今任公司股东代表监事。个人简历请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司发起人、持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况”的相关内容。

3、方琳，2004年7月至今任公司股东代表监事。个人简历请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司发起人、持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况”的相关内容；方琳是公司财务总监方兆彩之女。

4、钱建昀，2004年7月至今任公司职工代表监事，男，1972年出生，大专

学历（硕士研究生在读）。曾就职于华通电子、金华东晶。

5、郭雄伟，2004年7月至今任公司职工代表监事，制造中心生产部经理，男，1977年出生，本科学历。历任金华东晶车间主任、生产部经理。

（三） 高级管理人员

1、李庆跃，2004年7月至今任公司总经理。个人简历请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司发起人、持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况”的相关内容。

2、金良荣，2004年7月至今任公司副总经理。个人简历请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司发起人、持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况”的相关内容。

3、井上博宪，2004年7月至今任公司副总经理。男，1966年出生，本科学历。曾就职于日本高千穗通信株式会社、KAI电子、南京华联兴电子有限公司，在SMD晶体谐振器开发方面有深厚的理论基础和丰富的实践经验。

4、池旭明，2004年7月至今任公司技术总监。个人简历请参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司发起人、持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况”的相关内容。

5、方兆彩，2004年7月至今任公司财务总监，男，1939年出生，历任金华食品厂财务负责人、金华制药厂计划财务科科长、金华市经济委员会企业管理科科长、助理调研员。方兆彩是本公司股东、监事方琳之父。

6、刘洋，2004年7月至今任公司董事会秘书，男，1977年出生，本科学历（硕士研究生在读），毕业于中南财经政法大学金融学院，曾任浙江金华康恩贝生物制药有限公司有限公司总经理秘书。

（四） 核心技术人员

1、池旭明，2004年7月至今任公司技术总监（个人简介详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、公司发起人、持有公司5%以上股份的主要股东、实际控制人的基本情况”的相关内容）；

2、井上博宪，个人简介详见本节“高级管理人员”。

（五） 发行人董事、监事的提名和选聘情况

1、董事提名和选聘情况

2004年7月27日，公司创立大会选举李庆跃、金良荣、池旭明、吴宗泽、陈利平为第一届董事会成员。同日公司第一届董事会第一次会议选举李庆跃为董事长。

2006年4月13日，公司第一届职工代表大会2006年第一次会议，选举产生骆红莉为职工代表董事。2006年4月28日，公司2005年度股东大会选举王骥、许永斌、杜归真为公司独立董事。董事会成员由5人增至9人。

2007年9月3日，公司第二届职工代表大会第三次会议，选举产生骆红莉为公司第二届职工代表董事。

2007年9月6日，公司2007年第一次临时股东大会选举李庆跃、金良荣、池旭明、吴宗泽、陈利平为第二届董事会成员，选举王骥、许永斌、杜归真为公司独立董事，上述人员与职工代表董事骆红莉共九人组成公司第二届董事会。同日，公司第二届董事会第一次会议选举李庆跃为董事长。

2、监事提名和选聘情况

2004年7月6日，公司第一届职工代表大会2004年第二次会议，选举产生郭雄伟、钱建昀为公司职工代表监事。

2004年7月27日，公司创立大会选举杨亚平、俞尚东、方琳为股东代表监事，上述五人共同组成公司第一届监事会。同日，公司第一届监事会第一次会议选举杨亚平为监事会主席。

2007年9月3日，公司第二届职工代表大会2007年第三次会议，选举钱建昀、郭雄伟为职工代表监事。

2007年9月6日，公司2007年第一次临时股东大会选举杨亚平、俞尚东、方琳为股东代表监事，上述人员与职工代表监事钱建昀、郭雄伟共五人组成公司第二届监事会。同日，公司第二届监事会第一次会议选举杨亚平为监事会主席。

二、 公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在发行前持有发行人股份的情况

股东名称	持有股数(万股)	持股比例	在公司任职情况
李庆跃	1,821.60	39.60%	董事长、总经理
池旭明	345.00	7.50%	董事、技术总监
吴宗泽	345.00	7.50%	董事、管理者代表
金良荣	248.40	5.40%	董事、副总经理
陈利平	230.00	5.00%	董事、办公室主任、工会主席
杨亚平	230.00	5.00%	监事会主席、制造中心 SMD 车间副主任
俞尚东	230.00	5.00%	监事, 制造中心晶片车间副主任
方琳	230.00	5.00%	监事、制造中心统计主管
合计	3,680.00	80.00%	

上述董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有本公司的股份自公司设立以来未发生增减变化, 且不存在质押或冻结情况。

三、公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的对外投资情况

截至本招股说明书签署日, 上述本公司董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员除持有本公司股份外, 不存在其他经营性投资, 也不存在有关对外投资与发行人利益冲突的情况。

四、公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员收入情况

股东名称	职务	2006 年度薪酬总额(元)
李庆跃	董事长、总经理	251,349.00
池旭明	董事、技术总监	98,818.00
金良荣	董事、副总经理	98,228.00
吴宗泽	董事、管理者代表	97,877.00
陈利平	董事、办公室主任、工会主席	77,680.00
骆红莉	董事、业务部经理	76,720.00
杨亚平	监事会主席、制造中心 SMD 车间副主任	36,842.00
俞尚东	监事, 制造中心晶片车间副主任	35,918.00
方琳	监事、制造中心统计主管	24,325.00
钱建昀	监事	24,312.00
郭雄伟	监事、制造中心生产部经理	53,152.00

井上博宪	副总经理	288,000.00
方兆彩	财务总监	104,856.00
刘洋	董事会秘书	48,473.00
合计		1,316,550.00

2005年4月19日，公司2004年度股东大会通过决议，规定独立董事年度津贴标准为人民币2~8万元/人（含税）。2006年度公司独立董事津贴为3万元/人（含税）。

上述人员不存在从关联企业领取报酬的情况。

五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员兼职情况及相互亲属关系

除李庆跃担任惠成公司董事外，公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员、核心技术人员未有在其他企业兼职的情形。

除公司财务总监方兆彩与股东、监事方琳为父女关系外，其余董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

六、与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所签定的协议及上述人员重要承诺

（一）公司与董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所签定的协议

在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与公司签有长期《劳动合同》和《关于保守企业商业秘密的协议》，合同就上述人员的诚信义务，特别是在任职期间和离职以后保守公司技术秘密和其他商业秘密方面的义务进行了详细规定。

（二）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的重要承诺

1、全体董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均承诺：

（1）避免同业竞争承诺：详细内容请参见本招股说明书第七节“同业竞争与关联交易”之“一、关于同业竞争（二）发行人采取的避免同业竞争的措施”；

（2）本人目前不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项及行政处罚事项；

（3）本人目前不存在受到刑事诉讼的情形；

(4) 本人任职期间直接或间接所持公司股份的变动情况将如实向公司申报。

2、担任公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的股东均承诺：

(1) 不存在以本人作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项以及受到刑事诉讼的情况；

(2) 本人所持有的公司股份目前不存在质押或冻结的情形；

(3) 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理所持有的公司的股份，也不由公司收购该股份（包括由该部分派生的股份如送红股、资本公积金转增等）；

(4) 在前述承诺期限后，本人承诺严格遵守《公司法》对股份转让的限制（即董事、监事或高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，本人不转让所持公司股份）；

(5) 及时向公司申报所持有公司的股份及变动情况。

截至本招股说明书签署日，上述有关协议、合同及承诺均履行正常，不存在违约情形。

七、稳定董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的措施

公司采取了一系列稳定管理层的有效措施，规定对公司经理层实行岗位绩效工资制，岗位绩效工资由岗位工资、绩效工资和特殊奖励三部分构成。绩效工资与公司整体经营效益以及个人工作业绩相结合而浮动。特殊奖励指对经理层在工作业绩、创新水平以及在公司生产经营中作出突出贡献者由公司给予的一次性特别奖励。

八、董事、监事、高级管理人员是否符合法律法规规定的任职资格的情况

发行人的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，且不存在下列情形：

1、被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；

2、最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查，尚未有明确结论意见。

九、发行人董事、监事、高级管理人员最近三年变动情况

1、公司董事、监事最近三年的变动情况详见本节“一、（五）发行人董事、监事的提名和选聘情况”。

2、2004年7月24日公司第一届董事会第一次会议聘任李庆跃为总经理；聘任刘洋为董事会秘书；经总经理李庆跃提名，聘任金良荣、井上博宪为公司副总经理；方兆彩为公司财务总监。

3、2006年4月28日公司2005年度股东大会修订《公司章程》，增加技术总监为公司高级管理人员。池旭明自2004年7月以来一直担任公司技术总监。

4、2007年9月6日公司第二届董事会第一次会议聘任李庆跃为总经理；刘洋为董事会秘书；经总经理李庆跃提名，聘任金良荣、井上博宪为副总经理；方兆彩为财务总监；池旭明为技术总监。

第九节 公司治理

一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

本公司于2004年7月27日召开创立大会，通过了《公司章程》，选举了董事会、监事会成员；2005年4月19日召开的2004年度股东大会通过了《关于修改公司章程的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《关联交易决策权限与程序规则》等。新的《公司法》和《证券法》生效后，公司于2006年3月23日召开的董事会会议审议通过了《募集资金专项存储制度》，2006年4月28日召开的2005年度股东大会上又对公司治理相关规则作了全面的修改和完善，重新修订了《公司章程》，并补充制定了《独立董事工作制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《重大生产经营决策制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理工作制度》，建立了董事会各专门委员会等，对公司治理结构在制度上进行了严格的规定，从而初步建立健全了符合上市公司要求的公司治理结构。上述机构自设立以来依法规范运作，未出现违法违规现象。

（一）股东大会制度的建立健全及运行情况

根据《公司法》及有关规定，发行人于创立大会、2004年度股东大会、2005年度股东大会分别对《公司章程》的制定和修改进行了审议，并制定完善了《股东大会议事规则》，本公司股东大会规范运行。

1、股东的权利和义务

根据《公司章程》，公司股东为依法持有公司股份的人，享有的权利包括：

- （1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
- （2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
- （3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

(4) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

(5) 查阅《公司章程》、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

(6) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

(7) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

(8) 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销；

(9) 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；

(10) 监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者《公司章程》的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼；

(11) 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利。

公司股东的义务主要包括：

(1) 遵守法律、行政法规和《公司章程》；

(2) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；

(3) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；

(4) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；

(5) 不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；

(6) 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任；

(7) 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；

(8) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当承担的其他义务。

2、股东大会的职权

股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- (1) 决定公司的经营方针和投资计划；
- (2) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- (3) 审议批准董事会的报告；
- (4) 审议批准监事会报告；
- (5) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (8) 对发行公司债券作出决议；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (10) 修改《公司章程》；
- (11) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
- (12) 审议《公司章程》规定的担保事项；
- (13) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
- (14) 审议批准变更募集资金用途事项；
- (15) 审议股权激励计划；
- (16) 审议法律、行政法规、部门规章或章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

3、股东大会议事规则

(1) 会议的召开和举行

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

- ①董事人数不足6名时；
- ②公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；
- ③连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；
- ④董事会认为必要时；
- ⑤监事会提议召开时；

⑥法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。

发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

（2）提案的提交与表决

提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（3）股东出席的方式

公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（4）大会决议

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。股东大会作

出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

下列事项由股东大会以普通决议通过：董事会和监事会的工作报告；董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；公司年度预算方案、决算方案；公司年度报告；除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

下列事项由股东大会以特别决议通过：公司增加或者减少注册资本；公司的分立、合并、解散和清算；《公司章程》的修改；公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；股权激励计划；法律、行政法规或《公司章程》规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

4、股东大会运行情况

自公司设立以来，公司召开股东大会具体情况如下表所示：

序号	名称	召开时间	召开地点
1	创立大会	2004年7月27日	公司二楼会议室
2	2004年第一次临时股东大会	2004年9月15日	公司二楼会议室
3	2004年第二次临时股东大会	2004年11月10日	公司二楼会议室
4	2005年第一次临时股东大会	2005年1月10日	公司二楼会议室
5	2005年第二次临时股东大会	2005年3月6日	公司二楼会议室
6	2004年度股东大会	2005年4月19日	公司三楼会议室
7	2005年度第三次临时股东大会	2005年10月31日	公司二楼会议室
8	2005年度股东大会	2006年4月28日	公司三楼会议室
9	2006年第一次临时股东大会	2006年7月10日	公司二楼会议室
10	2006年第二次临时股东大会	2006年10月9日	公司二楼会议室
11	2006年第三次临时股东大会	2006年12月27日	公司二楼会议室
12	2006年度股东大会	2007年2月11日	公司三楼会议室
13	2007年第一次临时股东大会	2007年9月6日	公司三楼会议室
14	2007年第二次临时股东大会	2007年11月9日	公司三楼会议室

股东大会根据《公司法》、《公司章程》的规定，审议通过了重大事项和一系列基本规章制度等，加强决策监督、考核与激励，保证了公司有效的治理和促进了经营活动的开展。

（二） 董事会制度的建立健全及运行情况

发行人制定了《董事会议事规则》，董事会规范运行。发行人董事严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利。

1、董事会构成

根据《公司章程》，公司设董事会，对股东大会负责。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。每届董事任期三年，任期届满，可连选连任，在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。公司董事会成员的情况请参见本招股说明书第八节“董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

2、董事会职权

董事会行使下列职权：

- （1） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- （2） 执行股东大会的决议；
- （3） 决定公司的经营计划和投资方案；
- （4） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- （5） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- （6） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
- （7） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- （8） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- （9） 决定公司内部管理机构的设置；
- （10） 聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；
- （11） 根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
- （12） 制订公司的基本管理制度；
- （13） 制订《公司章程》的修改方案；管理公司信息披露事项；
- （14） 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(15) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作及法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、贷款的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会具体权限和决策程序如下：

(1) 对外投资：董事会根据公司生产经营发展的需要，具有在所涉金额单次或 12 个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 30%且不超过 5,000 万元的权限；

(2) 收购出售资产、资产抵押、委托理财：董事会根据公司生产经营发展的需要，具有在所涉金额单次或 12 个月内为同一项目累计不超过公司最近一期经审计的净资产值的 30%且不超过 5,000 万元的权限；

(3) 对外担保：除《公司章程》规定须由股东大会作出的对外担保事项外，其他对外担保由董事会作出；且还需遵守以下规则：对于董事会权限范围内的对外担保，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意，并经全体独立董事三分之二以上同意；董事会若超出以上权限而作出公司对外担保事项决议而致公司损失的，公司可以向由作出赞成决议的董事会成员追偿；

(4) 贷款：董事会根据公司生产经营发展的需要，具有在所涉金额单次不超过公司最近一期经审计的净资产值的 30%且不超过 5,000 万元的权限；

(5) 关联交易：公司与其关联人达成的关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）不超过占公司最近一期经审计净资产值的 5%且不超过 3,000 万元的，需经董事会批准；关联交易总额（含同一标的或同一关联人在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额）超过占公司最近一期经审计净资产值 5%或超过 3,000 万元的，需由董事会审议后提请股东大会批准；

(6) 董事会在其权限范围内，可建立对董事长的授权制度。以上事项中若涉及关联交易的，同时适用《公司章程》关于关联交易的规定。

3、董事会议事规则

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。

有下列情形之一的，董事长应在十个工作日内以内召集董事会临时会议：董事长认为必要时；三分之一以上的董事联名提议时；监事会提议时；由独立董事总数二分之一以上的独立董事联名提议时；总经理提议时。

董事会召开董事会临时会议的，可以在会议召开三日以前以传真、电子邮件、邮寄等方式书面通知全体董事。

董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集董事会临时会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推荐一名董事负责召集会议。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。如不出席会议，也不委托代表、也未在董事会召开之时或之前对所议事项提供书面意见的董事应视作未表示异议，不免除责任。

4、董事会运行情况

公司自设立以来，共召开了18次董事会会议。

董事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，及时审议重大事项，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

（三） 监事会制度的建立健全及运行情况

发行人制定了《监事会议事规则》，监事会规范运行。监事严格按照《公司章程》和监事会议事规则的规定行使自己的权利。

1、监事会构成

公司设监事会，由五名监事组成，其中两名职工监事。监事每届任期三年。股东代表担任的监事由股东大会选举产生，更换时亦同；职工代表担任的监事由职工代表大会组织职工选举产生或更换。监事连选可以连任。

2、监事会职权

监事会行使下列职权：

- （1）检查公司的财务；

(2) 对董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者《公司章程》及股东大会决议的行为进行监督；

(3) 当董事和高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事和高级管理人员予以纠正，必要时向股东大会报告；

(4) 提议召开临时股东大会；

(5) 有权列席董事会会议；

(6) 《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

3、监事会议事规则

监事会每年至少召开二次会议。但经监事会主席或二分之一以上的监事提议，可召开监事会临时会议。监事会会议因故不能如期召开，应书面通知说明原因。

监事会会议应由二分之一以上（含二分之一）的监事出席方可举行。监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，应书面委托其他监事代为出席，并行使表决权。监事连续二次不能亲自出席监事会会议，且不委托他人代为出席会议的，视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。

监事会会议的议题应经监事会主席审核并签发，会议通知按以下形式送达全体监事：监事会议召开十日前以书面形式通知全体监事；临时监事会议召开三日前以书面、电话、电子邮件、传真形式通知全体监事；监事会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

监事会采用逐项审议，最后统一记名投票表决的表决方式。每名监事有一票表决权。监事会决议需经全体监事的二分之一以上通过方为有效。

4、监事会运行情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，自公司设立以来召开监事会7次。监事多次列席股东大会和董事会，认真开展监督工作，监事会认为公司决策程序合法，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（四） 独立董事制度的建立健全及运行情况

1、独立董事情况

根据《公司章程》的规定，公司建立了独立董事制度，设3名独立董事。公

公司于2006年4月28日召开的2005年度股东大会上，选举了许永斌、王骥和杜归真三名独立董事，独立董事人数占董事会人员总数的三分之一，其中许永斌是会计专业人士。

2007年9月6日，公司召开了2007年第一次临时股东大会，选举王骥、许永斌、杜归真担任公司第二届董事会独立董事。

2、独立董事制度安排

根据公司股东大会审议通过的《独立董事工作制度》，公司董事会、监事会可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定；独立董事每届任期三年，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。

独立董事除具有董事的一般职权外，还具有下列特别职权：

(1) 重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近一期经审计净资产值5%的关联交易）需由独立董事认可后，方能提交董事会讨论；

(2) 独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；

(3) 向董事会提议聘请或解聘会计师事务所；

(4) 向董事会提请召开临时股东大会；

(5) 提议召开董事会；

(6) 独立聘请外部审计机构和咨询机构；

(7) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事应对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

(1) 提名、任免董事；

(2) 聘任或解聘高级管理人员；

(3) 公司董事、高级管理人员的薪酬；

(4) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司享有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

(5) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；

(6) 《公司章程》规定的其他事项。

独立董事就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；

反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。

如有关事项属于需要披露的事项，董事会应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

3、独立董事实际发挥作用的情况

本公司引进独立董事后，独立董事积极参与公司决策，公司治理结构有较大改善，在关联交易及重大生产经营投资决策时，独立董事发挥了在财务、法律及战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益。

(1) 独立董事出席董事会会议的情况

公司自建立独立董事制度以来，共召开了 8 次董事会，独立董事均出席了所有的董事会会议。

(2) 独立董事对关联交易发表意见

详见本招股说明书第八节“同业竞争与关联交易”之“五、发行人最近三年关联交易决策的执行情况及独立董事的意见（二）独立董事的意见”。

(五) 董事会秘书的职责

董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书的主要职责是：

- 1、准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；
- 2、筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；
- 3、负责公司信息披露事务，保证公司信息的披露的及时、准确、合法、真实和完整；
- 4、保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件；
- 5、使公司董事、监事、高级管理人员明确应当担负的责任，遵守国家有关法律、法规、规章、《公司章程》等有关规定；
- 6、协助董事会行使职权。在董事会决议违反法律、法规、规章、《公司章程》等有关规定时，应当及时提出异议；
- 7、为公司重大决策提供咨询和建议；

8、负责公司的咨询服务，协调处理公司与股东之间的相关事务和股东日常接待及信访工作；

9、负责管理和保存公司股东名册资料，保管董事会印章；

10、《公司章程》规定的其他职责。

（六） 发行人董事会专门委员会设置情况

2006年4月28日公司董事会临时会议通过决议，设立董事会审计、战略、提名、薪酬委员会等四个专门委员会。

其中，董事会审计委员会由许永斌、杜归真、王骥、金良荣、骆红莉组成，许永斌任主任委员；

战略委员会由李庆跃、王骥、杜归真、许永斌、池旭明组成，李庆跃任主任委员；

提名委员会由杜归真、王骥、许永斌、陈利平、吴宗泽组成，杜归真任主任委员；

薪酬委员会由王骥、许永斌、杜归真、陈利平、骆红莉组成，王骥任主任委员。

各专门委员会成立以来，积极开展工作，截至招股说明书签署日，已分别召开了3次工作会议，全体独立董事和各专门委员会委员均参加了历次会议。

二、 发行人最近三年一期违法违规行为情况

发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书工作制度。自成立至今，发行人及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营，不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

三、 发行人最近三年一期资金占用和对外担保的情况

发行人有严格的资金管理制度，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

发行人的《公司章程》中已明确对外担保的审批权限和审议程序，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

2005年9月26日公司第一届董事会第四次会议和2005年10月31日公司

2005年第三次临时股东大会决议：因经营活动资金周转需要，与浙江今飞机械集团有限公司、浙江今飞凯达轮毂有限公司签订银行借款互保协议，互保最高额度为1,500万元人民币，有效期自2005年10月31日至2007年12月31日。

2005年11月1日，本公司（甲方）与浙江今飞机械集团有限公司（乙方）及浙江今飞凯达轮毂有限公司（丙方）签署《银行借款互保协议书》，协议约定：甲方为乙方、丙方的银行借款累计额度不超过人民币1,500万元提供担保，乙方、丙方单独或共同为甲方银行借款累计额度不超过人民币1,500万元提供担保，乙方、丙方其中一方为甲方单独提供担保的，其它另一方同意承担连带责任；协议履行期为自2005年10月31日至2007年12月31日。

2005年12月28日，本公司与浙江今飞凯达轮毂有限公司签署《反担保合同》，合同约定：为减少本公司就浙江今飞凯达轮毂有限公司向中国银行金华市分行借款1,500万元所提供担保的风险，浙江今飞凯达轮毂有限公司提供反担保；浙江今飞凯达轮毂有限公司提供保证的保证形式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期间届满之日起三年。

本公司与浙江今飞凯达轮毂有限公司不存在关联关系。根据浙江今飞凯达轮毂有限公司2006年度审计报告，截至2006年12月31日，该公司资产总额为45,476.90万元，净资产为19,298.70万元，资产负债率为57.56%，2006年度实现销售收入48,953.14万元，净利润2,615.47万元，财务状况较好。

发行人律师认为：以上对外担保事项符合当时有效的《公司章程》第八十八条等规定，真实、合法、有效。

保荐人核查后认为：发行人该等担保事项符合公司章程和《对外担保决策管理制度》规定的担保决策权限并履行了相应的决策和执行程序。

四、发行人内部控制制度情况

（一） 发行人内部控制制度的自我评估意见

公司2007年6月30日与会计报表相关的内部控制制度设置情况如下：

1、内部控制结构

（1）控制环境

①管理制度：公司已建立了较为合理的决策机制，能较正确、及时、有效

地对待和控制经营风险及财务风险，重视企业的管理及会计信息的准确性。

②组织结构：公司为有效地计划、协调和控制经营活动，已合理地确定了本公司的形式和性质，并贯彻不相容职务相分离的原则，比较科学地划分了公司内部各部门的责任权限，形成相互制衡机制。公司建立了监事会及独立董事制度，内审机构已经建立。

③人事政策与实际运作：公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、教育管理、考勤、考核等人事管理制度。

④管理控制的方法：为对授权使用情况进行有效控制及对公司的活动实行监督，公司逐步建立了预算控制制度，能较及时地按照情况的变化修改会计系统的控制政策。

⑤外部影响：影响公司的外部控制环境主要是有关管理监督机构的监督、审查以及国家经济形势及行业动态等。公司能适时地根据外部环境的变化不断提高控制意识，强化和改进内部控制政策及程序。

（2）会计系统

公司已按《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规及其补充规定的要求制定了适合公司的会计制度和财务管理制度，并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，以达到以下目的：

①较合理地保证业务活动按照适当的授权进行。

②较合理地保证交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间及时地记录于恰当的账户，使会计报表的编制符合会计准则和相关要求。

③较合理地保证对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权。

④较合理地保证账面资产与实存资产定期核对相符。

公司切实实行会计人员岗位责任制，并已聘用了较充足的会计人员并给予足够的资源，使其能完成所分配的任务。

（3）控制程序

为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、电子信息系统控制等。

①交易授权控制：明确了授权批准的范围、权限、程序、责任等相关内容，单位内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权，经办人员也必须在授

权范围内办理经济业务。

②责任分工控制：合理设置分工，科学划分职责权限，贯彻不相容职务相分离及每一个人工作能自动检查另一个人或更多人工作的原则，形成相互制衡机制。不相容的职务主要包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与业务稽核、授权批准与监督检查等。

③凭证与记录控制：合理制定了凭证流转程序，经营人员在执行交易时能及时编制有关凭证，编妥的凭证及早送交会计部门以便记录，已登账凭证依序归档。各种交易必须作相关记录（如：员工工资记录、永续存货记录、销售发票等），并且将记录同相应的分录独立比较。

④资产接触与记录使用控制：严格限制未经授权的人员对财产的直接接触，采取定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以使各种财产安全完整。

⑤公司已制定了较为严格的电子信息系统控制制度，在电子信息系统开发与维护、数据输入与输出、文件储存与保管等方面作了较多的工作。

2、公司主要内部控制的执行情况：

公司主要内部控制的执行情况如下：

（1）货币资金的收支和保管业务，公司已建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系。公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《内部会计控制规范——货币资金（试行）》，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。已按中国人民银行《支付结算办法》及有关规定制定了银行存款的结算程序。

（2）公司已制定《募集资金专项存储制度》，对筹资规模和筹资结构能选择恰当的方式，同时也能有效地控制财务风险，降低资金成本。公司没有筹措的资金严重背离原计划使用的情况。

（3）公司已较合理地规划和落实了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收程序。应付账款和预付款项的支付必须在相关手续齐备后才能办理。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

（4）公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。

(5) 公司已建立了较完备的成本费用控制系统,基本能做好成本费用管理的各项基础工作、明确费用的开支标准和范围。

(6) 公司已制定了比较可行的销售政策,已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确。公司已建立一套完整的货款催收和考核制度。公司出口货物采用一般贸易方式。

(7) 公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。对工程项目的预算、决算管理制度已建立。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实,审批手续齐备下才能支付。工程项目中不存在重大舞弊行为。

(8) 为严格控制投资风险,公司建立了较科学的对外投资决策程序,按公司重大投资决策的管理制度,对外投资的权限按不同的投资额分别由公司不同层次的权力机构决策。

公司现有内部控制基本能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。对于目前公司在内部控制方面存在的不足,公司拟采取下列措施加以改进提高:

进一步完善公司的内部管理和控制制度,对公司的相关审批制度及业务流程进行细化,同时建立健全公司的内部审计流程。

(二) 注册会计师对公司内部控制制度的评价意见

立信会计师事务所对本公司内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了审核,并于2007年7月26日出具了《内部控制审核报告》(信长会师报字(2007)第23245号),认为:发行人“按照《企业内部会计控制规范—基本规范(试行)》等标准于2007年6月30日在所有重大方面保持了与会计报表相关的有效的内部控制。”

第十节 财务会计信息

以下引用的财务数据，非经特别说明，均依据公司经立信会计师事务所审计的财务报告。本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了本公司最近三年一期经审计的会计报表及附注的主要内容，本公司提醒投资者关注本招股说明书所附财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、 审计意见类型及会计报表编制基准

（一） 注册会计师意见

本公司已聘请立信会计师事务所对本公司财务报表，包括 2007 年 6 月 30 日、2006 年 12 月 31 日、2005 年 12 月 31 日、2004 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年 1~6 月、2006 年度、2005 年度的利润表、2004 年度的利润表和合并利润表，2007 年 1~6 月、2006 年度、2005 年度的股东权益变动表、2004 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，2007 年 1~6 月、2006 年度、2005 年度的现金流量表和 2004 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注进行了审计。立信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字（2007）第 23241 号）。

立信会计师事务所认为：东晶电子公司财务报表已经按照新《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了东晶电子公司 2007 年 6 月 30 日、2006 年 12 月 31 日、2005 年 12 月 31 日、2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年 1~6 月、2006 年度、2005 年度、2004 年度的经营成果、股东权益变动和现金流量。

（二） 会计报表的编制基准

公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司期间，未进行资产剥离。设立股份有限公司以前年度会计报表的编制主体是金华东晶，执行《企业会计制度》。

公司 2006 年度、2005 年度、2004 年度原执行《企业会计制度》及有关补充规定，并相应编制会计报表。

根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》，公司从2007年1月1日起，执行新《企业会计准则》。

根据中国证监会证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》、证监会会计字[2007]10号《关于发布<公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露>的通知》的规定，对《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定需要追溯调整的，对相应科目进行了调整。

根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，对2006年度、2005年度、2004年度财务报表的列报进行了相应的调整。

后附的2006年度、2005年度、2004年度财务报表根据上述编制基础编制而成。

（三） 合并报表编制办法及范围

合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。

母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

2001年8月公司与杨亚平出资组建东晶经贸，注册资本100万元，公司出资90万元，占注册资本的90%。2002年7月东晶经贸增资400万元，其中公司出资360万元，增资后公司股权占注册资本的90%。2004年6月公司将持有东晶经贸90%股权转让给余松土，转让后公司不再持有东晶经贸股权。故东晶经贸自2004年6月起不再纳入合并范围。

二、 简要会计报表

（一） 简要资产负债表

单位：元

资 产	2007.6.30.	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.
-----	------------	-------------	-------------	-------------

浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

流动资产:				
货币资金	36,594,173.96	33,663,464.78	53,145,662.17	11,298,768.53
应收账款	35,213,249.73	28,578,772.34	25,894,996.72	27,959,589.61
预付款项	1,612,963.20	1,180,749.57	358,455.97	34,418.99
其他应收款	50,235.03	378,205.97	110,725.65	148,919.36
存货	40,874,357.62	31,438,825.16	22,798,380.51	24,662,901.15
流动资产合计	114,344,979.54	95,240,017.82	102,308,221.02	64,104,597.64
非流动资产:				
长期股权投资	-	5,300,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
固定资产	135,066,778.62	135,536,053.33	105,146,827.77	92,992,620.62
工程物资	-	1,281,753.90	-	-
无形资产	9,286,351.84	9,753,049.18	10,686,443.86	4,556,196.91
长期待摊费用	856,750.00	1,080,250.00	1,160,000.00	-
递延所得税资产	1,041,862.00	700,994.62	814,135.25	1,085,790.08
非流动资产合计	146,251,742.46	153,652,101.03	120,907,406.88	101,734,607.61
资产总计	260,596,722.00	248,892,118.85	223,215,627.90	165,839,205.25

(二) 简要资产负债表 (续)

单位: 元

负债和所有者权益 (或股东权益)	2007.6.30.	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.
流动负债:				
短期借款	9,082,415.00	9,371,412.80	36,382,153.60	49,504,492.40
应付票据	10,608,000.00	8,930,000.00	15,500,000.00	8,161,978.64
应付账款	35,797,024.27	35,827,231.70	25,378,656.68	21,640,371.25
预收款项	12,922.10	2,370.00	-	-
应付职工薪酬	192,032.35	1,017,355.75	3,519,077.33	2,919,503.28
应交税费	1,017,034.65	2,491,128.55	1,273,209.67	484,769.75
应付利息	175,974.34	187,993.16	127,385.95	102,643.80
应付股利	7,820,000.00	-	-	170,605.84
其他应付款	88,528.60	2,325,087.60	341,327.92	1,152,607.08
递延收益	1,995,999.98	300,000.00	-	650,000.00
一年内到期的非流动负债	7,509,300.00	10,313,220.00	8,655,467.36	16,260,598.02
流动负债合计	74,299,231.29	70,765,799.56	91,177,278.51	101,047,570.06
非流动负债:				
长期借款	85,130,250.00	80,358,181.25	55,398,000.00	10,039,137.96
非流动负债合计	85,130,250.00	80,358,181.25	55,398,000.00	10,039,137.96
负债合计	159,429,481.29	151,123,980.81	146,575,278.51	111,086,708.02

浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

所有者权益 (或股东权益):				
实收资本(或股本)	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
资本公积	7,320,000.00	7,320,000.00	6,620,000.00	920,000.00
盈余公积	6,853,489.36	6,853,489.36	4,580,710.49	1,965,032.66
未分配利润	40,993,751.35	37,594,648.68	19,439,638.90	5,867,464.57
所有者权益 (或股东权益)合计	101,167,240.71	97,768,138.04	76,640,349.39	54,752,497.23
负债和所有者权益 (或股东权益)总计	260,596,722.00	248,892,118.85	223,215,627.90	165,839,205.25

(三) 简要利润表

单位: 元

项目	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度	
				合并	母公司
一、营业收入	85,701,192.47	158,334,046.82	122,620,510.11	108,821,605.03	103,806,310.02
减: 营业成本	62,079,358.64	116,210,385.26	91,181,022.09	83,945,539.08	79,269,989.80
加 营业税金及附加	634,970.58	783,628.21	722,136.73	-	-
销售费用	2,405,300.91	4,247,889.94	3,382,114.93	3,164,979.66	3,141,711.88
管理费用	5,202,365.63	8,073,817.28	7,368,863.43	6,934,485.63	6,762,026.85
财务费用	3,765,764.92	6,288,700.62	2,394,752.88	3,984,599.71	3,975,802.77
资产减值损失	956,841.06	-490,756.05	-848,659.33	493,370.42	486,204.40
投资收益(损失以“-”号填列)	-	600,000.00	-	12,791.99	127,016.63
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,656,590.73	23,820,381.56	18,420,279.38	10,311,422.52	10,297,590.95
加: 营业外收入	4,154,000.02	4,615,000.00	2,935,536.00	3,286,724.00	3,286,724.00
减: 营业外支出	102,980.94	218,334.03	149,589.93	410,330.35	410,330.35
其中: 非流动资产处置损失	7,236.16	-	32,541.22	381,602.34	381,602.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,707,609.81	28,217,047.53	21,206,225.45	13,187,816.17	13,173,984.60
减: 所得税费用	3,488,507.14	5,489,258.88	3,768,373.29	1,589,701.41	1,540,479.68
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,219,102.67	22,727,788.65	17,437,852.16	11,598,114.76	11,633,504.92
归属于母公司所有者的净利润	-	-	-	11,585,423.13	-
少数股东损益	-	-	-	12,691.63	-
五、每股收益:					
(一)基本每股收益	0.24	0.49	0.38	0.25	0.25
(二)稀释每股收益	0.24	0.49	0.38	0.25	0.25

(四) 备考利润表

单位：元

项目	2006 年度	2005 年度	2004 年度	
			合并	母公司
一、营业收入	158,334,046.82	122,620,510.11	108,821,605.03	103,806,310.02
减：营业成本	116,210,385.26	91,181,022.09	83,945,539.08	79,269,989.80
营业税金及附加	783,628.21	722,136.73	-	-
销售费用	4,247,889.94	3,382,114.93	3,164,979.66	3,141,711.88
管理费用	8,886,006.60	9,891,051.14	5,331,479.44	5,194,666.79
财务费用	6,288,700.62	2,394,752.88	3,984,599.71	3,975,802.77
资产减值损失	-490,756.05	-848,659.33	493,370.42	486,204.40
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-	-
投资收益(损失以“-”号 填列)	600,000.00	-	127,016.63	127,016.63
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	23,008,192.24	15,898,091.67	12,028,653.35	11,864,951.01
加：营业外收入	5,428,166.71	6,101,285.98	3,428,198.97	3,428,198.97
减：营业外支出	218,334.03	149,589.93	410,330.35	410,330.35
其中：非流动资产处 置损失	-	32,541.22	381,602.34	381,602.34
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	28,218,024.92	21,849,787.72	15,046,521.97	14,882,819.63
减：所得税费用	5,489,258.88	3,768,373.29	1,589,701.41	1,540,479.68
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	22,728,766.04	18,081,414.43	13,456,820.56	13,342,339.95
归属于母公司所有者 的净利润	-	-	13,456,820.56	-
少数股东损益	-	-	-	-
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.49	0.39	0.29	0.29
(二) 稀释每股收益	0.49	0.39	0.29	0.29

(五) 简要所有者权益变动表

单位：元

项目	2007年1~6月				
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	46,000,000.00	7,320,000.00	6,853,489.36	37,594,648.68	97,768,138.04
二、本年年初余额	46,000,000.00	7,320,000.00	6,853,489.36	37,594,648.68	97,768,138.04
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	3,399,102.67	3,399,102.67
(一) 净利润	-	-	-	11,219,102.67	11,219,102.67
(二) 利润分配	-	-	-	-7,820,000.00	-7,820,000.00
对所有者(或股 东)的分配	-	-	-	-7,820,000.00	-7,820,000.00
四、本年年末余额	46,000,000.00	7,320,000.00	6,853,489.36	40,993,751.35	101,167,240.71

(六) 简要所有者权益变动表(续一)

单位：元

项目	2006年度				
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	46,000,000.00	6,620,000.00	4,580,710.49	19,439,638.90	76,640,349.39
二、本年年初余额	46,000,000.00	6,620,000.00	4,580,710.49	19,439,638.90	76,640,349.39
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	700,000.00	2,272,778.87	18,155,009.78	21,127,788.65
(一) 净利润	-	-	-	22,727,788.65	22,727,788.65
(二) 直接计入所有 者权益的利得和损失	-	700,000.00	-	-	700,000.00
上述(一)和(二) 小计	-	700,000.00	-	22,727,788.65	23,427,788.65
(三) 利润分配	-	-	2,272,778.87	4,572,778.87	4,572,778.87
1. 提取盈余公积	-	-	2,272,778.87	2,272,778.87	2,272,778.87
2. 对所有者(或股 东)的分配	-	-	-	2,300,000.00	2,300,000.00
四、本年年末余额	46,000,000.00	7,320,000.00	6,853,489.36	37,594,648.68	97,768,138.04

(七) 简要所有者权益变动表(续二)

单位：元

项目	2005年度				
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	46,000,000.00	920,000.00	1,965,032.66	5,867,464.57	54,752,497.23
二、本年年初余额	46,000,000.00	920,000.00	1,965,032.66	5,867,464.57	54,752,497.23

浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	5,700,000.00	2,615,677.83	13,572,174.33	21,887,852.16
(一) 净利润	-	-	-	17,437,852.16	17,437,852.16
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	5,700,000.00	-	-	5,700,000.00
上述(一)和(二)小计	-	5,700,000.00	-	17,437,852.16	23,137,852.16
(四) 利润分配	-	-	2,615,677.83	3,865,677.83	3,865,677.83
1. 提取盈余公积	-	-	2,615,677.83	2,615,677.83	2,615,677.83
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	1,250,000.00	1,250,000.00
四、本年年末余额	46,000,000.00	6,620,000.00	4,580,710.49	19,439,638.90	76,640,349.39

(八) 简要所有者权益变动表(续三)

单位: 元

项目	2004 年度(合并)					
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	1,837,011.62	6,235,174.57	26,748,349.14	479,884.12	40,300,419.45
加: 会计政策变更	-	-	220,006.92	1,294,787.69	6,002.92	1,520,797.53
二、本年年初余额	5,000,000.00	1,837,011.62	6,455,181.49	28,043,136.83	485,887.04	41,821,216.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	41,000,000.00	-917,011.62	-4,490,148.83	-22,175,672.26	-485,887.04	12,931,280.25
(一) 净利润	-	-	-	11,585,423.13	12,691.63	11,598,114.76
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	-	2,002,350.00	-	-	-	2,002,350.00
上述(一)和(二)小计	-	2,002,350.00	-	11,585,423.13	12,691.63	13,600,464.76
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-498,578.67	-498,578.67
(四) 利润分配	31,845,463.81	-	1,745,025.74	33,761,095.39	-	1,915,631.58
1. 提取盈余公积	-	-	1,745,025.74	1,745,025.74	-	1,745,025.74
2. 对所有者(或股东)的分配	31,845,463.81	-	-	32,016,069.65	-	170,605.84
(五) 所有者权益内部结转	9,154,536.19	2,919,361.62	6,235,174.57	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	2,919,361.62	2,919,361.62	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	6,235,174.57	-	6,235,174.57	-	-	-
四、本年年末余额	46,000,000.00	920,000.00	1,965,032.66	5,867,464.57	-	54,752,497.23

(九) 简要所有者权益变动表 (续四)

单位: 元

项目	2004 年度 (母公司)				
	实收资本 (或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益 合计
一、上年年末余额	5,000,000.00	1,837,011.62	6,235,174.57	26,748,349.14	39,820,535.33
加: 会计政策变更	-	-	220,006.92	1,246,705.90	1,466,712.82
二、本年年初余额	5,000,000.00	1,837,011.62	6,455,181.49	27,995,055.04	41,287,248.15
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	41,000,000.00	-917,011.62	-4,490,148.83	-22,127,590.47	13,465,249.08
(一) 净利润	-	-	-	11,633,504.92	11,633,504.92
(二) 直接计入所有者 权益的利得和损失	-	2,002,350.00	-	-	2,002,350.00
上述(一)和(二) 小计	-	2,002,350.00	-	11,633,504.92	13,635,854.92
(三) 利润分配	31,845,463.81	-	1,745,025.74	33,761,095.39	1,915,631.58
1. 提取盈余公积	-	-	1,745,025.74	1,745,025.74	1,745,025.74
2. 对所有者(或股 东)的分配	31,845,463.81	-	-	32,016,069.65	170,605.84
(五) 所有者权益内 部结转	9,154,536.19	2,919,361.62	6,235,174.57	-	-
1. 资本公积转增资 本(或股本)	2,919,361.62	2,919,361.62	-	-	-
2. 盈余公积转增资 本(或股本)	6,235,174.57	-	6,235,174.57	-	-
四、本年年末余额	46,000,000.00	920,000.00	1,965,032.66	5,867,464.57	54,752,497.23

(十) 简要现金流量表

单位: 元

项 目	2007 年 1~6 月	2006 年度	2005 年度	2004 年度	
				合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量:					
销售商品、提供劳务收到的现金	79,356,231.10	161,985,683.98	126,253,152.82	102,298,985.43	93,669,905.01
收到的税费返还	6,869,695.37	12,557,497.78	9,997,345.27	9,401,755.47	7,514,893.13
收到的其他与经营活动有关的 现金	3,196,167.27	2,313,181.19	1,877,063.44	541,933.00	1,609,836.00
现金流入小计	89,422,093.74	176,856,362.95	138,127,561.53	112,242,673.90	102,794,634.14
购买商品、接受劳务支付的现 金	62,737,348.24	114,734,733.21	71,636,213.17	79,166,484.18	70,788,639.06
支付给职工以及为职工支付的 现金	9,025,234.72	17,882,772.97	13,744,918.10	8,969,163.97	8,865,642.97
支付的各项税费	5,339,304.36	6,015,475.06	3,417,420.41	1,918,787.42	1,877,787.04

浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

支付的其他与经营活动有关的现金	4,262,569.21	6,379,414.07	6,913,280.21	7,875,572.03	7,644,793.26
现金流出小计	81,364,456.53	145,012,395.31	95,711,831.89	97,930,007.60	89,176,862.33
经营活动产生的现金流量净额	8,057,637.21	31,843,967.64	42,415,729.64	14,312,666.30	13,617,771.81
二、投资活动产生的现金流量:					
收回投资所收到的现金	5,300,000.00	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	600,000.00	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额	8,000.00	-	9,700.00	265,000.00	265,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	3,696,441.82	4,500,000.00
现金流入小计	5,308,000.00	600,000.00	9,700.00	3,961,441.82	4,765,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,172,662.07	47,123,156.21	26,752,441.86	21,334,186.33	21,291,688.24
投资所支付的现金	2,200,000.00	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00
现金流出小计	12,372,662.07	47,123,156.21	26,752,441.86	22,434,186.33	22,391,688.24
投资活动产生的现金流量净额	-7,064,662.07	-46,523,156.21	-26,742,741.86	-18,472,744.51	-17,626,688.24
三、筹资活动产生的现金流量:					
借款所收到的现金	36,190,155.00	187,026,624.15	145,937,889.26	70,903,441.12	69,633,441.12
收到的其他与筹资活动有关的现金	2,940,000.00	13,967,600.00	6,803,920.00	4,452,700.00	4,452,700.00
现金流入小计	39,130,155.00	200,994,224.15	152,741,809.26	75,356,141.12	74,086,141.12
偿还债务所支付的现金	33,942,965.55	187,419,431.06	119,888,545.67	65,017,740.41	63,747,740.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,249,455.41	7,940,301.91	5,479,357.73	3,447,938.35	3,438,759.42
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	20,437,500.00	1,200,000.00	-	-
现金流出小计	37,192,420.96	215,797,232.97	126,567,903.40	68,465,678.76	67,186,499.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,937,734.04	-14,803,008.82	26,173,905.86	6,890,462.36	6,899,641.29
四、汇率变动对现金的影响额	-	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	2,930,709.18	-29,482,197.39	41,846,893.64	2,730,384.15	2,890,724.86
加: 期初现金及现金等价物余额	23,663,464.78	53,145,662.17	11,298,768.53	8,568,384.38	8,408,043.67
六、期末现金及现金等价物余额	26,594,173.96	23,663,464.78	53,145,662.17	11,298,768.53	11,298,768.53
补充资料					
1、将净利润调节为经营活动现金净流量:					
净利润	11,219,102.67	22,727,788.65	17,437,852.16	11,598,114.76	11,633,504.92
加: 资产减值准备	956,841.06	-490,756.05	-848,659.33	493,370.42	486,204.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,912,591.00	13,485,546.16	10,223,024.08	9,085,186.21	9,065,718.46
无形资产摊销	466,697.34	933,394.68	474,848.05	124,194.70	124,194.70
长期待摊费用摊销	223,500.00	517,250.00	40,000.00	-	-
处置固定资产、无形资产和其	7,236.16	-	32,541.22	381,602.34	381,602.34

浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

他长期资产的损失（减：收益）					
财务费用	2,669,398.09	5,179,135.02	2,665,543.03	3,424,284.65	3,415,105.72
投资损失（减：收益）	-	-600,000.00	-	-12,791.99	-127,016.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-340,867.38	113,140.63	271,654.83	323,907.67	326,896.46
存货的减少（减：增加）	-9,963,962.62	-8,014,093.63	2,353,974.45	-8,476,541.27	-8,356,279.56
经营性应收项目的减少（减：增加）	-3,345,267.46	-1,768,513.92	2,137,955.14	-2,919,014.61	-5,177,075.47
经营性应付项目的增加（减：减少）	-803,631.63	2,728,676.10	8,730,916.01	2,778,053.42	4,332,616.47
其他（财政贴息）	-944,000.02	-2,967,600.00	-1,103,920.00	-2,487,700.00	-2,487,700.00
经营活动产生的现金流量净额	8,057,637.21	31,843,967.64	42,415,729.64	14,312,666.30	13,617,771.81
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动					
3、现金及现金等价物的净增加情况：					
现金的期末余额	26,594,173.96	23,663,464.78	53,145,662.17	11,298,768.53	11,298,768.53
减：现金的期初余额	23,663,464.78	53,145,662.17	11,298,768.53	8,568,384.38	8,408,043.67
现金及现金等价物净增加额	2,930,709.18	-29,482,197.39	41,846,893.64	2,730,384.15	2,890,724.86
补充资料					
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：					
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：					
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	-	-	-	4,500,000.00	4,500,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-	-	4,500,000.00	4,500,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-	-	803,558.18	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	3,696,441.82	4,500,000.00
4. 处置子公司的净资产	-	-	-	4,985,786.68	-
流动资产	-	-	-	5,446,035.75	-
非流动资产	-	-	-	1,876,260.92	-
流动负债	-	-	-	2,336,509.99	-
三、现金和现金等价物的的有关信息：					
1、现金	26,594,173.96	23,663,464.78	53,145,662.17	11,298,768.53	11,298,768.53
其中：库存现金	2,699.20	574.03	19,012.61	5,293.71	5,293.71
可随时用于支付的银行存款	21,856,274.76	19,277,268.75	44,434,257.16	7,384,258.15	7,384,258.15
可随时用于支付的其他货币资金	4,735,200.00	4,385,622.00	8,692,392.40	3,909,216.67	3,909,216.67
2、现金等价物	-	-	-	-	-
3、期末现金及现金等价物余额	26,594,173.96	23,663,464.78	53,145,662.17	11,298,768.53	11,298,768.53

三、 发行人采用的主要会计政策和会计估计

(一) 收入确认和计量方法

1、 销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

2、 提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

3、 让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

(二) 存货计量方法

1、 存货分类为：原材料、包装物、库存商品、在产品、低值易耗品等。

2、 取得和发出的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的公允价值为基础确定其入账价值。

在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性交易换入的存货通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按公允价值确定其入账价值。

3、 低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次摊销法。

4、 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

（三） 长期股权投资的核算方法

1、 初始计量

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，应当按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性交易换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取

得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额（以被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其净利润进行调整后确认），确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

3、共同控制和重大影响

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（四） 固定资产的计价和折旧方法

1、 固定资产标准：本公司将使用期限在 1 年以上，单位价值在人民币 2,000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、器具等资产，作为固定资产。

2、 固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备、固定资产装修、经营租入固定资产改良等。

3、 固定资产的取得计价。

一般遵循实际成本计价原则计价。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30%的，则按最低租赁付款额作为入账值。

4、 固定资产折旧采用年限平均法分类计提：按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧；经营租赁方式租入的

固定资产改良支出，在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产发生的符合资本化条件的装修费用，在两次装修期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

固定资产类别	预计使用年限(年)	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	30	5.00%	3.17%
专用设备	10	5.00%	9.50%
通用设备	5-10	5.00%	19.00~9.50%
运输工具	10	5.00%	9.50%

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。

已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

(五) 无形资产核算方法

1、取得的计价方法

按取得时的实际成本入账。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。

2、摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

（六）主要资产的资产减值准备的确定方法

1、坏账准备的计提方法

按账龄分析法并结合个别认定法估算坏账损失。

（1）本公司根据董事会的决定，依据债务单位的实际财务状况、偿债能力等相关信息，确定按账龄计提坏账准备的具体方法如下：

应收款项账龄	坏账准备提取比例
一年以内	5%
一至二年	20%
二至三年	40%
三年以上	100%

（2）对于某项期末余额的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如、债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷等），导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例。

2、存货跌价准备的计提方法

中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

存货跌价准备按单个存货项目计提。对由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。

存货可变现净值按企业在生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

3、长期股权投资减值准备计提方法

中期末及年末，本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原

因导致长期投资项目的可收回金额低于账面价值,并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额逐项提取长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

4、委托贷款减值准备计提方法

中期末及年末,对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备。

5、固定资产减值准备的计提方法

中期末及年末,对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提固定资产减值准备。

固定资产减值准备按单项资产计提。

6、在建工程减值准备的计提方法

中期末及年末,对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程,或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程,计提在建工程减值准备。

在建工程减值准备按单项工程计提。

7、无形资产减值准备的计提方法

中期末及年末,对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产,按预计可收回金额低于其账面价值的差额,计提无形资产减值准备。

无形资产减值准备按单项资产计提。

(七) 借款费用资本化的依据及方法

1、借款费用资本化的确认原则:

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能

达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2、借款费用资本化期间：

按季度计算借款费用资本化金额。

3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，应当按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(八) 预计负债

与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

- 1、该义务是企业承担的现时义务；
- 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
- 3、该义务金额可以可靠地计量。

（九） 报告期主要会计政策和会计估计和重大会计差错更正的变更及其影响

1、 会计政策变更

公司 2006 年度、2005 年度、2004 年度原执行《企业会计制度》及其补充规定，根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号—存货>等 38 项具体准则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的规定，对部分项目进行了追溯调整。具体如下：

（1） 所得税

原政策为应付税款法，新的政策采用资产负债表观债务法，申报会计报表对 2004 年初留存收益的累计影响数为 1,514,794.61 元，其中：期初未分配利润 1,294,787.69 元，盈余公积 220,006.92 元；增加 2004 年度净利润-347,917.75 元，2005 年度净利润-271,654.83 元，2006 年度净利润-113,140.63 元；影响 2006 年末留存收益 700,994.62 元，其中：期末未分配利润 590,188.39 元，盈余公积 110,806.23 元。

（2）除所得税外无其他需要追溯调整会计政策。

2、 会计估计变更

申报期内未发生会计估计变更。

3、 前期差错更正

申报期内未发现重大前期会计差错更正。

（十） 适用的主要税率及享受的主要财政税收优惠政策

1、 流转税及附加

（1） 流转税

应税项目	税种	税率
产品销售收入	增值税	17%
材料转让收入	增值税	17%
租金收入	营业税	5%

（2） 城市维护建设税

按流转税税额的 7% 计算和缴纳。

(3) 教育费附加及地方教育费附加

2006年5月前按流转税额的4%计缴；根据浙政发[2006]31号“关于开征地方教育附加的通知”，自2006年5月1日起按流转税额的3%计缴教育费附加，同时按流转税额的2%计缴地方教育费附加。

(4) 水利基金

按销售收入的1%计算和缴纳。

2、企业所得税

本公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税，税率为33%。

根据金华市地方税务局金市地税投批(2007)2、3号批复书,公司2005年度、2006年度公司购买国产设备共可抵免所得税1,716,100.40元，2006年度抵免额1,716,100.40元。

根据金华市地方税务局金市地税投批(2006)09号批复书，公司2005年度购买国产设备共可抵免所得税1,173,859.20元，2005年度已抵免额1,173,859.20元。

根据金华市地方税务局金市地税投批(2004)29号、30号、(2005)20号批复书，公司购买国产设备共可抵免所得税2,439,598.00元，公司2004年度抵免1,724,673.92元，在2005年度抵免714,924.08元。

四、最近一年收购兼并情况

发行人最近一年无收购兼并情况。

五、非经常损益明细表

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号—非经常性损益》的规定，经立信会计师事务所信会师报字(2007)第23244号《关于浙江东晶电子股份有限公司非经常性损益及净资产收益率和每股收益的专项审核说明》审核的公司非经常性损益列报如下：

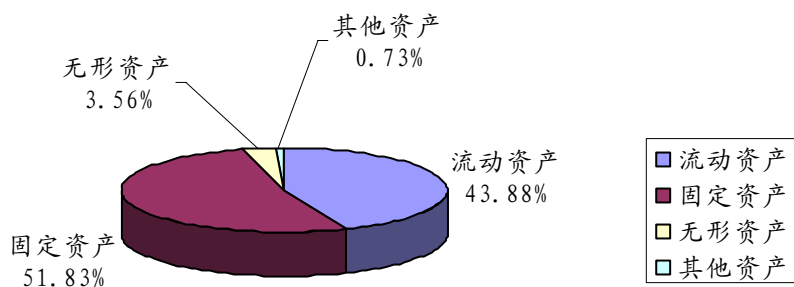
单位：元

项 目	2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度
1、非流动资产处置损益	4,848.23	-	-21,802.62	-204,447.42
2、计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外；	4,154,000.02	4,615,000.00	2,935,536.00	3,286,724.00
3、除上述各项之外的其他营业外收支净额	64,149.00	-162,783.80	-82,792.63	-19,247.77
非经常性损益合计	4,222,997.25	4,452,216.20	2,830,940.75	3,063,028.81
扣除非经常性损益后的净利润	6,996,105.42	18,275,572.45	14,606,911.41	8,535,085.95

六、主要资产

截至2007年6月30日，本公司的资产合计26,059.67万元，由流动资产、固定资产、无形资产及其它资产（包括长期待摊费用和递延所得税资产）构成，分别为11,434.50万元、13,506.68万元、928.64万元及189.86万元。单位构成情况如下图：

公司资产结构（2007.6.30.）



（一）流动资产

公司2007年6月30日、2006年12月31日、2005年12月31日、2004年12月31日的流动资产分别为11,434.50万元、9,524.00万元、10,230.82万元、6,410.46万元，主要包括货币资金、应收账款、存货。

1、货币资金

公司 2007 年 6 月 30 日、2006 年 12 月 31 日、2005 年 12 月 31 日、2004 年 12 月 31 日货币资金分别为 3,659.42 万元、3,366.35 万元、5,314.57 万元、1,129.88 万元，分别占期末流动资产的 32.00%、35.35%、51.95%、17.63%。2006 年末货币资金比 2005 年末减少 36.66%的原因是 2005 年末获得的中国进出口银行上海分行 4,000 万元贷款部分投入使用，货币资金相应减少所致，2005 年末货币资金余额较 2004 年末增加了 370.37%的原因是公司于 2005 年末获得中国进出口银行上海分行 4,000 万元贷款未及使用。

2、 应收预付款项

2007年6月30日、2006年12月31日、2005年12月31日、2004年12月31日公司应收账款净额分别为3,521.32万元、2,857.88万元、2,589.50万元、2,795.96万元。截至2007年6月30日，公司应收账款中无持本公司5%或以上股份的主要股东欠款；单项金额重大的应收账款（余额前五名或占余额10%以上的明细之和）余额总计为1,962.67万元，占应收账款账面余额的52.83%。

2007年6月30日、2006年12月31日、2005年12月31日、2004年12月31日公司其他应收款净额分别为5.02万元、37.82万元、11.07万元、14.89万元，截至2007年6月30日，公司其他应收款无持本公司5%或以上股份的股东欠款。

2007年6月30日、2006年12月31日、2005年12月31日、2004年12月31日公司提取的坏账准备（含应收账款和其他应收款）余额分别为193.67万元、150.83万元、137.27万元、173.19万元。

2007年6月30日、2006年12月31日、2005年12月31日、2004年12月31日公司预付款项分别为161.30万元、118.07万元、35.85万元、3.44万元，截至2007年6月30日，公司预付款项中无持本公司5%或以上股份的股东款项。

3、 存货

2007年6月30日、2006年12月31日、2005年12月31日、2004年12月31日公司存货净额分别为4,087.44万元、3,143.88万元、2,279.84万元、2,466.29万元，分别占当期期末流动资产的35.75%、33.01%、22.28%、38.47%。

公司存货主要由原材料、自制半成品、库存商品和在制品构成。如下表：

单位：元

项目	2007.6.30.			2006.12.31.		
	账面余额	跌价准备	占比	账面余额	跌价准备	占比
原材料	17,404,718.11	246,592.22	1.42%	12,956,188.47	37,828.44	0.29%
自制半成品	6,491,778.64	251,390.54	3.87%	5,948,402.04	90,749.42	1.53%
库存商品	9,448,109.16	159,025.26	1.68%	6,130,053.7	-	-
在产品	8,040,249.73	-	-	6,532,758.81	-	-
委托加工物资	146,510.00	-	-	-	-	-
合计	41,531,365.64	657,008.02	1.58%	31,567,403.02	128,577.86	0.41%

单位：元

项目	2005.12.31.			2004.12.31.		
	账面余额	跌价准备	占比	账面余额	跌价准备	占比
原材料	9,788,066.32	37,828.44	0.39%	13,517,976.56	37,828.44	0.28%
自制半成品	4,913,781.10	717,100.44	14.59%	5,224,060.41	738,235.58	14.13%
库存商品	4,589,796.54	-	-	2,940,068.92	468,318.67	15.93%
在产品	4,094,465.43	-	-	4,225,160.50	-	-
委托加工物资	167,200.00	-	-	17.45	-	-
合计	23,553,309.39	754,928.88	3.21%	25,907,283.84	1,244,382.69	4.80%

（二） 固定资产

2007年6月30日、2006年12月31日、2005年12月31日、2004年12月31日，本公司固定资产净额分别为13,506.68万元、13,553.61万元、10,514.68万元、9,299.26万元。固定资产主要由房屋建筑物和专用设备构成。截至2007年6月30日的固定资产情况如下表所示：

单位：元

类别	固定资产原值	累计折旧	减值准备	固定资产净额	折旧年限	年折旧率
房屋建筑物	18,040,601.24	2,763,129.64	45,177.24	15,232,294.36	30	3.17%
专用设备	164,011,741.98	50,841,414.13	235,141.55	112,935,186.30	10	9.50%

通用设备	8,631,518.29	3,432,401.50	49,531.05	5,149,585.74	5-10	19.00-9.50%
运输设备	2,435,143.34	670,995.08	14,436.04	1,749,712.22	10	9.50%
合计	193,119,004.85	57,707,940.35	344,285.88	135,066,778.62		

固定资产的折旧采用年限平均法计算，并按固定资产的类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的5%）确定其折旧，2007年6月末抵押或担保的固定资产原价为70,516,985.52元，无融资租入固定资产情况，2007年6月末固定资产减值准备余额为344,285.88元，系报告期以前年度转入本期尚未转销所致，2007年6月末无足以证明存在固定资产减值的情况，故不补充计提固定资产减值准备。

截至2007年6月30日，公司有形资产净值（有形资产净值=总资产-无形资产-长期待摊费用-递延所得税资产）为249,411,758.16元，有形资产净值率为95.71%。

（三） 无形资产

本公司无形资产按取得时的实际成本入账，采用直线法摊销，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

本公司截至2007年6月30日的无形资产情况如下：

单位：元

项目名称	取得方式	原始金额	摊余价值	摊销年限	剩余摊销年限
土地使用权	购买	4,706,775.00	4,224,852.58	50年	526个月
天心软件	购买	139,051.00	20,857.53	5年	9个月
SMD SEAM XTAL 技术	购买	2,832,200.00	2,271,660.48	8年	77个月
SMD GLASS XTAL 技术	购买	3,641,400.00	2,768,981.25	8年	73个月
合计		11,319,426.00	9,286,351.84		

（四） 长期待摊费用

2005年12月公司与中国银行金华市分行签定保函合同（编号：2005年金中银字1005号），合同规定中国银行金华市分行为公司向中国进出口银行贷款

4,000 万元（合同号：2005 进出银（杭信合）字第 047 号）提供担保，保函有效期为 30 个月，公司支付 120 万元保函费用，根据保函有效期，每月摊销 4 万元。至 2006 年 12 月已摊销 52 万元，还剩余 68 万元。2006 年 12 月公司归还中国进出口银行贷款 4,000 万元，之后与中国进出口银行签定 5,000 万元的贷款合同（合同号 2006 进出银（浙信合）101），该贷款由中国银行金华市分行提供保函（保函号:LGC9100601925），为此公司应向中国银行金华市分支支付 111.75 万元保函费，其中 2005 年支付的尚剩余保函费 68 万元，中国银行金华市分行允许抵付该保函费，故 2006 年 12 月公司实际支付 43.75 万元保函费用。根据该保函期限为从 2006 年 12 月至 2009 年 6 月共计 30 个月，每月应摊 37,250 元，2007 年 6 月末该项余额为 85.675 万元，剩余年限为 23 个月。

由于该保函费属于摊销期限超过一年的费用，故列示长期待摊费用，摊销期限的制定依据为该保函费的有效期限。

七、主要负债

截至2007年6月30日，公司负债合计15,942.95万元，其中，流动负债7,429.92万元，非流动负债8,513.03万元，占总负债的比例分别为46.60%和53.40%。

公司流动负债主要包括短期借款、应付票据、应付账款、一年内到期的非流动负债等。非流动负债全部为长期借款。

（一） 流动负债

1、 银行短期借款

截至 2007 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 908.24 万元，如下表所示：

单位:万元

贷款单位	币种	金额	折合人民币	借款方式
工行金华市分行	美元	93.00	708.24	抵押借款
金华市商业银行	人民币	200.00	200.00	保证借款
合计			908.24	

2、 应付票据

2007年6月30日、2006年12月31日、2005年12月31日、2004年12月31日公司

应付票据余额分别为1,060.80万元、893.00万元、1,550.00万元、816.20万元。2006年末余额较2005年末余额减少42.39%，减少原因主要为结算方式改变，2006年度累计开具应付票据4,157万元，较2005年减少384.5万元；另一方面，应付票据期限在2006年度基本为3月期，而2005年大部分为6月期，减少了跨期交易。

2005年末余额较2004年末余额增加89.90%，增加原因为公司生产经营规模扩大，更多地采用应付票据结算方式有利于延缓资金紧张压力。

截至2007年6月30日，公司不存在已到期未付的应付票据。

3、应付账款

2007年6月30日、2006年12月31日、2005年12月31日、2004年12月31日公司应付账款余额分别为3,579.70万元、3,582.72万元、2,537.87万元、2,164.04万元，账龄情况如下：

单位：元

账龄	2007.6.30.		2006.12.31.	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	35,687,329.27	99.69%	35,677,056.30	99.58%
一至二年	58,995.00	0.16%	88,353.00	0.25%
二至三年	50,700.00	0.14%	61,822.40	0.17%
合计	35,797,024.27	100.00%	35,827,231.70	100.00%

单位：元

账龄	2005.12.31.		2004.12.31.	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	25,316,834.28	99.76%	21,006,893.64	97.07%
一至二年	61,822.40	0.24%	630,457.61	2.91%
二至三年	-	-	3,020.00	0.01%
合计	25,378,656.68	100.00%	21,640,371.25	100.00%

公司的应付账款主要为材料采购款，上述应付账款余额中无应付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东的款项。2006年末余额较2005年末余额增加41.17%，主要系公司生产经营规模扩大，材料采购增加，应付账款余额亦增大所致。

4、其他应付款

截至 2007 年 6 月 30 日，其它应付款余额中无应付持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东账款。其它应付款账龄如下表。

单位：元

账龄	2007.6.30.	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.
一年以内	88,528.60	2,323,414.60	288,014.01	937,090.23
一至二年	-	-	53,313.91	118,454.11
二至三年	-	1,673.00	-	97,062.74
合计	88,528.60	2,325,087.60	341,327.92	1,152,607.08

5、一年内到期的非流动负债

2007 年 6 月末一年内到期非流动负债均为中国工商银行金华市分行的长期借款。最近三年一期末的余额情况如下表：

单位：万元

	2007.6.30.	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.
一年内到期非流动负债	750.93	1,031.32	865.55	1,626.06

(二) 非流动负债

截至 2007 年 6 月 30 日，公司长期借款余额 8,513.03 万元，其中保证借款 7,080 万元，抵押借款 1,433.03 万元。

单位：万元

贷款单位	币种	金额	折合人民币	借款方式
工行金华市分行	人民币	290.70	290.70	抵押借款
	美元	150.00	1,142.33	抵押借款
中国进出口银行浙江省分行	人民币	5,000.00	5,000.00	保证借款
金华市商业银行	人民币	1,800.00	1,800.00	保证借款
金华市财政局	人民币	280.00	280.00	保证借款
合计	人民币		8,513.03	

注：根据国家发改委发改投资[2004]2758 号文《国家发展改革委关于下达 2004 年信息产业企业技术进步和产业升级专项、企业信息化专项国家预算内专项资金（国债）投资计划的通知》，金华东晶共获得国家预算内专项资金 900 万元，为国家投资补助，其中中央预算内专项资金 620 万元、地方预算内专项资金 280 万元。据此，2005 年 6 月 20 日，本公司与金华市财政局签订《专项资金借款合同》，合同约定，浙江省财政厅批准本公司向金华市财

政局申请国债专项资金贷款人民币 280 万元, 借款期限 5 年, 自 2005 年 6 月 20 日起至 2010 年 6 月 20 日止。借款利息自财政部拨款之后第十天起算, 利率按同期中国人民银行公布的一年期存款利率再加 0.3 个百分点确定, 借款本金于 2010 年 6 月 20 日前一次性全额归还。该笔贷款已于 2005 年 6 月 22 日到账。

2006 年末余额较 2005 年末余额增加比例为 45.06%, 增加原因为公司为改善负债结构, 减少短期借款而增加长期借款所致。

2005 年末长期借款余额较 2004 年末增加 451.82%, 系新增中国进出口银行上海分行的 4,000 万元贷款所致。

(三) 对关联方负债

截至 2007 年 6 月 30 日, 公司无对关联方的负债。

(四) 或有负债

被担保单位	担保金额(元)	担保到期日	对本公司的财务影响
浙江今飞凯达轮毂有限公司	5,000,000.00	2010 年 9 月 25 日	如被担保公司到期不能还款, 本公司将承担连带还款责任, 但至 2007 年 6 月 30 日, 尚未发现有此迹象出现
浙江今飞凯达轮毂有限公司	10,000,000.00	2010 年 10 月 13 日	同上
合计	15,000,000.00		

八、股东权益

自整体变更设立股份有限公司以来, 公司股本未发生变化, 截至 2007 年 6 月 30 日, 总股本 4,600 万股, 均为每股面值人民币 1.00 元的普通股, 股本总额为 4,600 万元。公司盈余公积金的提取是按税后利润 10% 计提法定盈余公积, 2004 年、2005 年按 5% 计提法定公益金, 根据修改后的《公司法》和《公司章程》规定, 自 2006 年起不再提取法定公益金。

公司最近三年一期末的股东权益构成情况如下表:

单位: 元

项 目	2007.6.30.	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.
股 本	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00
资本公积	7,320,000.00	7,320,000.00	6,620,000.00	920,000.00

盈余公积	6,853,489.36	6,853,489.36	4,580,710.49	1,965,032.66
其中：法定盈余公积	5,326,585.87	5,326,585.87	3,053,807.00	1,310,021.78
法定公益金	-	-	1,526,903.49	655,010.88
任意盈余公积	1,526,903.49	1,526,903.49	-	-
未分配利润	40,993,751.35	37,594,648.68	19,439,638.90	5,867,464.57
其中：拟分配现金股利	-	7,820,000.00	2,300,000.00	1,250,000.00
股东权益合计	101,167,240.71	97,768,138.04	76,640,349.39	54,752,497.23

最近三年一期末，公司资本公积均系拨款转入形成。其中：

1、2006 年末余额较 2005 年末增加 70 万元，形成原因为：

(1) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教字[2005]205 号文，公司于 2006 年度收到科技项目补助经费 500,000.00 元，鉴于已形成资产，计入 2006 年度资本公积。

(2) 根据国家发展和改革委员会发改投资[2004]2758 号文，公司于 2006 年度收到财政专项补助资金 200,000.00 元，鉴于已形成资产，计入 2006 年资本公积。

2、2005 年末余额较 2004 年末增加 570 万元，形成原因为：

(1) 根据国家发展和改革委员会发改投资[2004]2758 号文，公司 2005 年收到信息产业技术升级和机构调整固定资产投资项目补助资金 6,000,000.00 元，在扣除相应的技术咨询支出 210 万元后，鉴于剩余资金已形成资产，故差额 390 万元计入资本公积。

(2) 根据金华市经济贸易委员会金经贸投资[2005]105 号、金华市财政局金市财工[2005]58 号文，公司 2005 年收到金华市区工业企业技术改造专项资金 570,000.00 元。根据中国信息产业部信部运[2005]9 号文，2005 年公司收到电子信息产业发展基金项目补助 1,000,000.00 元。根据浙江省财政厅、浙江省信息产业厅浙财企字[2005]50 号文，公司 2005 年收到电子信息产业发展基金项目补助资金 230,000.00 元，鉴于上述资金均已形成资产，故计入资本公积。

3、2004 年末资本公积余额为 92 万元，较 2003 年末减少 58 万元，其形成原因为：

(1) 根据金华市经济贸易委员会与金华市财政局金经贸投资[2004]8 号、

金市财工[2004]5号文，公司2004年收到工业企业技术改造专项资金104.50万元；根据金华市经济贸易委员会与金华市财政局金经贸投资[2004]455号、金市财工[2004]230号文，公司于2004年收到重点技改项目专项资金50万元；根据浙江省信息产业厅与浙江省财政厅浙信综（2004）280号文，公司于2004年收到信息产业电子财政专项补助资金42万元，鉴于该等补贴资金已形成相应资产，故转入资本公积。以上共增加资本公积196.5万元。

（2）2004年6月12日金华东晶股东会决议通过，将净资产折股，从而减少资本公积254.5万元。

九、现金流量

公司最近三年一期现金流量情况如下表所示：

单位：元

项 目	2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度
经营活动产生的现金流量净额	8,057,637.21	31,843,967.64	42,415,729.64	14,312,666.30
投资活动产生的现金流量净额	-7,064,662.07	-46,523,156.21	-26,742,741.86	-18,472,744.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,937,734.04	-14,803,008.82	26,173,905.86	6,890,462.36
现金及现金等价物净增加额	2,930,709.18	-29,482,197.39	41,846,893.64	2,730,384.15

最近三年一期的经营活动产生的现金流量净额均为正值，累计约9,663.00万元，是同期净利润合计金额的1.53倍，说明公司业务能产生较好的现金回流，收益质量较高。

最近三年一期的投资活动产生的现金流量净额均为负值，且呈增大趋势，主要是因为公司近几年业务拓展迅速，销售规模扩大，相应的资本性支出增多，以进一步提高产能，扩大规模。

最近三年一期的筹资活动产生的现金流量净额有正有负，说明公司能够根据实际情况来进行资金筹措，在满足资金需求的同时，提高资金使用效率，降低财务费用。

十、其他重要事项

（一）或有事项

截至2007年6月30日，无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

（二）承诺事项

1、对外经济担保事项

详见本节“七、主要负债（四）或有负债”。

2、其他重大财务承诺事项

（1）截至2007年6月30日，公司无形资产中原值为4,706,775.00元、净值为4,224,852.58元的土地使用权与固定资产中原值为70,516,985.52元、净值为55,032,958.50元的房屋建筑物及机器设备已设抵押权，取得人民币借款5,847,000.00元，美元借款2,100,000.00元。在这些借款中，一年内到期的长期借款有人民币2,940,000.00元，美元借款600,000.00元。

（2）截至2007年6月30日，公司以1,040,000.00美元的应收账款作为质押取得美元短期借款930,000.00元。

（3）截至2007年6月30日，公司以承兑汇票保证金4,735,200.00元担保开具10,608,000.00元银行承兑汇票。

（4）截至2007年6月30日，中国银行金华市分行为公司向中国进出口银行浙江省分行长期借款50,000,000.00元提供担保。公司以原值为5,212,400.00元、净值为4,565,900.00元的房屋建筑物提供7,110,000.00元反担保，以原值为65,353,400.00元、净值为40,619,200.00元的设备提供15,000,000.00元反担保，以定期存款10,000,000.00元提供反担保。金轮机电实业有限公司、浙江今飞凯达轮毂有限公司分别为公司向中国银行金华市分行提供7,890,000.00元和10,000,000.00元担保。

（三）收到的政府补贴

1、2007年1~6月

（1）根据金华市科学技术局金市科字[2006]66号、金华市财政局金市财工[2006]313号文件，公司于2006年度收到技术创新项目资金300,000.00元，已计

入 2007 年 1~6 月的营业外收入。

(2) 根据浙江省财政厅浙财企[2006]319 号文件,公司于 2007 年 1~6 月收到机电产品技术更新改造贷款贴息 880,000.00 元,已计入 2007 年 1~6 月营业外收入。

(3) 根据金华市经济技术开发区管理委员会金市开通报[2007]1 号文,公司于 2007 年 1~6 月收到出口信用保险补助 412,700.00 元、企业加工贸易出口创汇奖励 79,400.00 元、工业企业参展摊位补助 10,000.00 元和经济密度达标企业奖励 50,000.00 元、工业企业销售增长奖励 44,200.00 元、企业技术创新资助 210,000.00 元,均已计入 2007 年 1~6 月营业外收入。

(4) 根据金华市经济委员会与金华市财政局金经投资(2007)87 号、金市财工(2007)85 号文件,公司于 2007 年 1~6 月收到企业技术改造财政专项补助资金 1,560,000.00 元,其中根据相关资产寿命期限摊销 39,000.00 元,已计入 2007 年 1~6 月营业外收入,其余 1,521,000.00 元计入 2007 年 1~6 月递延收益。

(5) 根据浙江省财政厅与浙江省经济贸易委员会浙财企[2006]285 号文件,公司于 2007 年 1~6 月收到省建设先进制造基地财政专项资金 500,000.00 元,其中根据相关资产寿命期限摊销 25,000.02 元,已计入 2007 年 1~6 月营业外收入,其余 474,999.98 元计入 2007 年 1~6 月递延收益。

(6) 根据浙江省财政厅与浙江省科学技术厅浙财教字[2007]24 号文件,公司于 2007 年 1~6 月收到 2007 年第一批科技项目补助经费 200,000.00 元,已计入 2007 年 1~6 月营业外收入。

(7) 根据金华市财政局关于下达 2006 年度重点扶持优势工业企业扶持资金的通知,公司于 2007 年 1~6 月收到扶持资金 860,000.00 元,已记入 2007 年 1~6 月营业外收入。

(8) 根据 2007 年 3 月 16 日浙江金华经济开发区经济发展局的通知,公司于 2007 年 1~6 月收到高技术产品出口创汇奖 896,780.00 元,出口规模奖 146,920.00 元,均已计入 2007 年 1~6 月营业外收入。

2、2006 年度

(1) 根据浙江省财政厅浙财企字[2006]13 号文,公司于 2006 年度收到机电产品技术改造项目贷款贴息 820,000.00 元,已计入 2006 年度营业外收入。

(2) 根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教字[2005]205 号文,公

公司于 2006 年度收到科技项目补助经费 500,000.00 元，鉴于已形成资产，已计入 2006 年度资本公积。

(3) 根据金华市经济技术开发区管理委员会金市开通报[2006]2 号文，公司于 2006 年度收到市重点技改项目贴息 1,072,600.00 元、出口信用保险补助 416,000.00 元、企业自营出口创汇奖励 404,000.00 元、企业加工贸易出口创汇奖励 32,300.00 元、工业企业参展摊位补助资金 5,000.00 元和经济密度达标企业奖励 50,000.00 元，均已计入 2006 年度营业外收入。

(4) 根据金华市经济技术开发区管理委员会金市开通报[2006]1 号文，公司于 2006 年度收到市开发区十强工业企业奖励 20,100.00 元，已计入 2006 年度营业外收入。

(5) 根据浙江省财政厅、浙江省对外贸易经济合作厅浙财企字[2006]85 号文，公司于 2006 年度收到国际市场开拓补助 10,000.00 元，已计入 2006 年度营业外收入。

(6) 根据浙江省财政厅浙财企字[2006]72 号文，公司于 2006 年度收到出口机电产品研究开发项目清算资金 160,000.00 元，已计入 2006 年度营业外收入。

(7) 根据金华市财政局关于重点优势工业企业政策扶持资金所有权让渡的通知，公司于 2006 年度收到扶持资金 550,000.00 元，已记入 2006 年度营业外收入。

(8) 根据金华市经济委员会金经投资[2006]106 号、金华市财政局金市财工[2006]70 号文，公司于 2006 年度收到技改专项资金 1,075,000.00 元，已计入 2006 年度营业外收入。

(9) 根据国家发展和改革委员会发改投资[2004]2758 号文，公司于 2006 年度收到财政专项补助资金 200,000.00 元，鉴于已形成资产，计入 2006 年资本公积。

3、2005 年度

(1) 根据金华市科学技术局金市科计[2004]80 号、金华市财政局金市财工[2004]325 号文，公司于 2005 年度收到技术创新项目资金 250,000.00 元，列入专项应付款，鉴于该资金未形成相关资产且已支用完毕，经批准已作核销处理。

(2) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅浙科发计[2005]17 号文，公司于 2005 年度收到高新技术产业化项目财政补助资金 250,000.00 元，列入专项

应付款，鉴于该资金未形成相关资产且已支用完毕，经批准已作核销处理。

(3) 根据中国信息产业部信部运[2005]9 号文，公司于 2005 年度收到挖潜改造拨款 1,000,000.00 元，鉴于已形成资产，已计入 2005 年度资本公积。

(4) 根据金华市经济技术开发区管理委员会金市开通[2005]3 号文，公司于 2005 年度收到外贸企业出口退税质押贷款贴息 29,520.00 元、技术改造贴息 1,074,400.00 元、企业出口信用保险补助资金 229,755.00 元、出口创汇奖励 503,861.00 元和企业参展摊位补贴 20,000.00 元，均已计入 2005 年度营业外收入。

(5) 根据金华市经济技术开发区管理委员会金市开通[2005]4 号文，公司于 2005 年度收到市开发区十强企业奖励 50,000.00 元，已计入 2005 年度营业外收入。

(6) 根据金华市经济贸易委员会金经贸投资[2005]105 号、金华市财政局金市财工[2005]58 号文，公司于 2005 年度收到工业企业技术改造专项资金 570,000.00 元，鉴于已形成资产，已计入 2005 年度资本公积。

(7) 根据金华市人民政府金政发[2000]67 号、金政办[2002]49 号文，公司于 2005 年度收到优势企业两率考核奖励 273,000.00 元，已计入 2005 年度营业外收入。

(8) 根据金华市财政局金市财工[2002]48 号、金华市科学技术局金市科字[2002]8 号文，公司于 2005 年度收到金华市技术创新资金 40,000.00 元，已计入 2005 年度营业外收入。

(9) 根据金华市人事局金市人[2003]10 号文，公司于 2005 年度收到自聘外国专家资助 20,000.00 元，已计入 2005 年度营业外收入。

(10) 根据浙江省财政厅、浙江省对外贸易经济合作厅浙财企字[2005]37 号文，公司于 2005 年度收到中小企业国际市场开拓项目资金 25,000.00 元，已计入 2005 年度营业外收入。

(11) 根据金华市经济委员会金经投资[2005]285 号、金华市财政局金市财工[2005]170 号文，公司于 2005 年度收到市区工业企业技术改造专项资金 20,000.00 元，已计入 2005 年度营业外收入。

(12) 根据国家发展和改革委员会发改投资[2004]2758 号文，公司 2005 年收到信息产业技术升级和机构调整固定资产投资项目补助资金 6,000,000.00 元，在扣除相应的技术咨询支出 2,100,000.00 元后，鉴于剩余资金已形成资产，故差

额 3,900,000.00 元计入资本公积。

(13) 根据金华市人民政府金政发[2000]67 号和金政发[2002]49 号,经金华市财政局考核并发函通知,公司 2005 年收到市重点扶持优势工业企业“两率”扶持资金 650,000.00 元。2005 年公司达到相关考核要求,已计入 2005 年度营业外收入。

(14) 根据浙江省财政厅、浙江省信息产业厅浙财企字[2005]50 号文,公司于 2005 年度收到电子信息产业发展基金项目财政补助资金 230,000.00 元,鉴于已形成资产,已计入 2005 年度资本公积。

4、2004 年度

(1) 公司于 2004 年度收到金华市就业管理服务局拨付的就业难点贷款贴息 50,000.00 元,已计入 2004 年度营业外收入。

(2) 根据金华市经济贸易委员会金经贸投资[2004]8 号、金华市财政局金市财工[2004]5 号文,公司于 2004 年度收到技术改造专项资金 1,045,000.00 元,鉴于已形成资产,已计入 2004 年度资本公积。

(3) 根据金华市科学技术局金市科计[2004]4 号、金华市财政局金市财工[2004]6 号文,公司于 2004 年度收到中科院科技园经费 46,700.00 元,已计入 2004 年度营业外收入。

(4) 公司于 2004 年度收到金华市财政局拨付的国家外贸出口补贴款 52,990.00 元,已计入 2004 年度营业外收入。

(5) 公司于 2004 年度收到中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会拨付的国外展览补贴 17,091.00 元,已计入 2004 年度营业外收入。

(6) 根据金华市科学技术局金市科计[2004]4 号、金华市财政局金市财工[2004]6 号文,公司于 2004 年度收到中科院金华科技园专项经费 53,300.00 元,已计入 2004 年度营业外收入。

(7) 根据金华市经济技术开发区管理委员会金市开通[2004]6 号文,公司于 2004 年度收到技术改造贴息 1,957,700.00 元,已计入 2004 年度营业外收入。

(8) 根据金华市经济技术开发区管理委员会金市开通[2004]8 号文,公司于 2004 年度收到商标奖励 1,000.00 元,已计入 2004 年度营业外收入。

(9) 根据金华市经济技术开发区管理委员会金市开通[2004]5 号文,公司于 2004 年度收到开发区企业参展摊位补助 13,000.00 元,已计入 2004 年营业外

收入。

(10) 根据金华市经济技术开发区管理委员会金市开通[2004]14 号文, 公司于 2004 年度收到自营出口创汇奖励 129,943.00 元, 已计入 2004 年度营业外收入。

(11) 根据浙江省财政厅、浙江省对外贸易经济合作厅浙财企二字[2004]84 号文, 公司于 2004 年度收到国际市场开拓资金 15,000.00 元, 已计入 2004 年度营业外收入。

(12) 根据浙江省财政厅、浙江省对外贸易经济合作厅浙财企二字[2004]85 号文, 公司于 2004 年度收到出口机电产品研究开发资金 240,000.00 元, 已计入 2004 年度营业外收入。

(13) 根据浙江省财政厅浙财企二字[2004]144 号文, 公司于 2004 年度收到技术更新改造项目贷款贴息 480,000.00 元, 已计入 2004 年度营业外收入。

(14) 公司于 2004 年度收到金华市科技局拨付的技术进步奖励 10,000.00 元, 已计入 2004 年度营业外收入。

(15) 公司于 2004 年度收到金华市人事局拨付的引进专家资助费 20,000.00 元, 已计入 2004 年度营业外收入。

(16) 根据金华市经济贸易委员会金经贸投资[2004]455 号、金华市财政局金市财工[2004]230 号文, 公司于 2004 年度收到技术改造专项资金 500,000.00 元, 鉴于已形成资产, 已计入 2004 年度资本公积。

(17) 根据浙江省信息产业厅、浙江省财政厅浙信综[2004]280 号文, 公司于 2004 年度收到企业挖潜改造资金 420,000.00 元, 鉴于已形成资产, 已计入 2004 年度资本公积。

(18) 根据金华市科学技术局金市科计[2004]83 号、金华市财政局金市财工[2004]255 号文, 公司于 2004 年度收到中科院金华科技园专项经费 200,000.00 元, 已计入 2004 年度营业外收入。

十一、财务指标

(一) 主要财务指标

财务指标	2007.6.30.	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.
流动比率（倍）	1.54	1.35	1.12	0.63
速动比率（倍）	0.99	0.90	0.87	0.39
无形资产占总资产的比例	1.94%	2.20%	2.83%	0.05%
无形资产占净资产的比例	5.00%	5.61%	8.24%	0.17%
资产负债率	61.18%	60.72%	65.67%	66.98%
指 标	2007 年 1~6 月	2006 年度	2005 年度	2004 年度
应收账款周转率	2.68	5.79	4.52	4.59
存货周转率	1.71	4.27	3.81	3.98
息税折旧摊销前利润（元）	26,547,834.74	48,854,147.49	36,027,591.62	25,821,481.73
利息保障倍数（倍）	5.54	5.95	6.19	4.85
每股经营活动的现金流量净额（元）	0.18	0.69	0.92	0.31

上述指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额

存货周转率=主营业务成本/存货平均余额

无形资产占总资产比例=无形资产（土地使用权除外）/期末总资产

无形资产占净资产的比例=无形资产（土地使用权除外）/期末净资产

资产负债率=负债总额/资产总额

息税折旧摊销前利润（EBITDA）=净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销

利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/总股本

（二） 报告期内的净资产收益率与每股收益

本公司按《公开发行证券公司信息披露规则第 9 号—净资产收益率和每股收益计算及披露》计算的报告期净资产收益率和每股收益如下：

项 目		净资产收益率		每股收益 (元/股)	
		全面摊薄	加权平均	基本每股 收益	稀释每股 收益
2007年1~6月	归属于公司普通股股东的净利润	11.09%	11.43%	0.24	0.24
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.92%	7.13%	0.15	0.15
2006年度	归属于公司普通股股东的净利润	23.25%	26.14%	0.49	0.49
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.69%	21.02%	0.40	0.40
2005年度	归属于公司普通股股东的净利润	22.75%	26.29%	0.38	0.38
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.06%	22.02%	0.32	0.32
2004年度	归属于公司普通股股东的净利润	21.16%	24.10%	0.25	0.25
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.57%	17.73%	0.19	0.19

上述指标计算公式如下：

- 1、全面摊薄净资产收益率=报告期净利润÷期末净资产
- 2、全面摊薄每股收益=报告期净利润÷期末股份总数
- 3、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：

$$ROE = \frac{N_p}{E_0 + N_p \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：N_p 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

- 4、加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

$$EPS = \frac{N_p}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：N_p 为报告期净利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

十二、资产评估情况

2000年2月，金华东晶注册资金由50万元增加至500万元，其中，股东用

于出资的资产包括经评估价值为 3,458,770 元的机器设备。以下为金华东晶股东用于出资的机器设备的评估具体情况：

1999 年 11 月，建德市人民法院委托建德市同兴拍卖有限责任公司对杭州建兴电子有限公司的电子产品配套机器设备进行拍卖。金华东晶因自有资金较少，申请银行贷款也比较困难，直接参与竞拍不具备可行性，而金华东晶股东根据企业发展的要求，有增加出资的意愿，因此采用了股东筹集资金参与竞拍并将购得的机器设备作为出资投入金华东晶的方案。同时，为便于办理竞拍手续及资金结算，1999 年 11 月 11 日，金华东晶的 28 名股东与金华东晶签定协议，委托金华东晶以金华东晶的名义参加竞拍活动。

杭州建兴电子有限公司进行拍卖的机器设备账面价值为 7,277,266.90 元，账面净值为 5,233,755.40 元。在拍卖过程中，因只有金华东晶一家企业参与竞拍，该部分机器设备以 1,020,000.00 元价格成交，金华东晶另外支付了 45,900.00 元的拍卖手续费。其间，金华东晶的 28 名股东向金华东晶缴纳了购买设备的上述款项。

2000 年 2 月金华东晶股东以购得的机器设备（剔除了一小部分生产经营中无法使用的资产后，实际投入的机器设备账面价值为 7,191,982.67 元，账面净值为 5,168,786.45 元）对金华东晶进行增资，并聘请金华天鉴会计师事务所有限公司（以下简称“金华天鉴”）对其拟投入的 105 台（套）机器设备进行了评估。

金华天鉴采用重置成本法对金华东晶股东用于出资的机器设备进行评估，并于 2000 年 1 月 24 日出具了金华天鉴评报字（2000）第 3 号《李庆跃等二十八位投资者资产评估报告书》，确认：列入评估范围的机器设备合计 105 台（套），其账面原值 7,191,982.67 元，账面净值 5,168,786.45 元；评估后重置价值为 6,393,100.00 元，评估价值为 3,458,770.00 元。该评估结果于 2000 年 2 月经金华东晶股东会审议通过。

金华天鉴出具的金华天鉴评报字（2000）第 3 号《李庆跃等二十八位投资者资产评估报告书》后附的评估机构资产评估资格证书上所注机构名称为“金华正大会计师事务所”。其原因为：金华天鉴出具该资产评估报告书时，正处于金华正大会计师事务所改制时期，根据浙江省财政厅及浙江省国有资产管理局批复意见，同意将原金华正大会计师事务所改制为金华天鉴会计师事务所有限公司，资产评估资格也相应转入金华天鉴。此后，根据有关资产评估机构脱钩改制的相

关文件，金华天鉴各出资人拟按相同出资比例设立金华天鉴资产评估有限公司，原拟由金华天鉴会计师事务所有限公司重新申领的资产评估资质改由金华天鉴资产评估有限公司申领。

鉴于金华天鉴在上述评估报告出具日未申领到资产评估资质，发行人委托浙江勤信资产评估有限公司对金华天鉴出具的金华天鉴评报字（2000）第3号资产评估报告进行复核。浙江勤信资产评估有限公司于2007年1月28日出具了浙勤评报字[2007]第6号《关于“李庆跃等二十八位投资者资产评估报告书”的复核报告》，认为《李庆跃等二十八位投资者资产评估报告书》中列示的评估依据充分合理，选用的评估方法基本正确，评估结果基本合理。

发行人律师认为：李庆跃等二十八位股东委托金华东晶竞得机器设备并经评估作价后，对金华东晶进行增资真实、合法、有效。

保荐人核查后认为：金华东晶股东以机器设备评估作价后对金华东晶进行增资，并未违反公允性原则。

十三、公司历次验资情况

公司历次验资情况见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性”之“（一）历次验资情况”。

第十一节 管理层讨论与分析

一、财务状况分析

(一) 资产负债分析

1、资产结构分析

公司最近三年一期末资产结构如下：

项目	2007.6.30.	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.
流动资产比例	43.88%	38.27%	45.83%	38.65%
其中：货币资金占总资产比例	14.04%	13.53%	23.81%	6.81%
应收账款占总资产比例	13.51%	11.48%	11.60%	16.86%
存货占总资产比例	15.68%	12.63%	10.21%	14.87%
非流动资产比例	56.12%	61.73%	54.17%	61.35%
其中：长期股权投资占总资产比例	-	2.13%	1.39%	1.87%
固定资产占总资产比例	51.83%	54.46%	47.11%	56.07%
无形资产占总资产比例（含土地使用权）	3.56%	3.92%	4.79%	2.75%
长期待摊费用占总资产比例	0.33%	0.43%	0.52%	-
递延所得税资产占总资产比例	0.40%	0.28%	0.36%	0.65%
合 计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

(1) 应收账款分析

截至2007年6月30日，公司应收账款余额为3,714.73万元，提取坏账准备193.40万元，应收账款净额为3,521.32万元，应收账款净额占流动资产的比例为30.80%，占总资产的比例为13.51%。

截至2007年6月30日，公司不存在账龄在两年以上的应收账款，欠款企业多为本公司长期业务合作单位，不存在潜在的金額较大的应收账款坏账及其它资产减值的情况。

根据公司的会计估计，一年内应收账款的坏账计提比例为5%，公司多年来

实际发生坏账的比例很低，坏账计提充分。本公司与可比上市公司晶源电子（股票代码：002049）、安徽铜峰电子股份有限公司（股票代码：600237，以下简称“铜峰电子”）、南京华东电子信息科技股份有限公司（股票代码：000727，以下简称“华东科技”）计提坏账准备比例的比较如下：

应收款项账龄	东晶电子	晶源电子	铜峰电子	华东科技
一年以内	5%	3%	6%	5%
一至二年	20%	6%	7%	10%
二至三年	40%	12%	8%	30%
三至四年	100%	24%	10%	50%
四至五年	100%	48%	10%	50%
五年以上	100%	100%	100%	50%

注：1、晶源电子主营压电石英晶体元器件，主营产品为石英晶体谐振器、振荡器等；铜峰电子主营薄膜电容器，其子公司铜陵市三科电子有限责任公司、铜陵市峰华电子有限公司主营产品分别为石英晶体频率片、石英晶体频率器件；华东科技主营真空电子器件、电光源产品等，其子公司南京华联兴电子有限公司主营产品为石英晶体谐振器；

2、华东科技对特殊项目计提比例为100%，特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏账核销手续的款项。

（2）存货分析

截至2007年6月30日，公司存货净额为4,087.44万元，占流动资产的比例为35.75%，占总资产的比例为15.68%。公司的存货主要是根据客户订单所采购的原材料、自制半成品、在产品及库存商品，为公司生产经营正常的资金占用。存货的构成如下图所示：

单位：万元

项目	余额	比例	存货跌价准备
原材料	1,740.48	41.91%	24.66
自制半成品	649.18	15.63%	25.14
库存商品	944.81	22.75%	15.90
在产品	804.02	19.36%	0.00
委托加工物资	14.65	0.35%	0.00
合计	4,153.14	100%	65.70

公司2007年6月末存货余额较2006年末余额增加31.56%，2006年末存货余额较2005年末余额增加34.03%，主要是由于公司生产规模扩大，产品规格品种增加，使备货品种和数量增加，以及生产过程中周转量增加所致。2007年6月末存货增长较快还有受国际采购因素的影响：由于公司的产品日益向高端发展，产品技术要求不断提高，为了保证产品质量、提高产品合格率及对冲人民币升值影响等多方面的考虑，本公司增加了从国际市场采购原材料的比例，但国际采购造成采购周期延长，为了保证原材料的及时供应，本公司加大了每次的采购数量，从而导致库存原材料增长较快。

原材料是公司存货的主要部分，占存货余额的40%以上，公司按订单制定采购计划，原材料周转较快。因生产规模扩大，公司2007年6月末的原材料余额较2006年末增长了34.34%，2006年末原材料余额较2005年末增长了32.37%。

公司2007年6月末的库存商品和在产品分别比2006年末增加331.80万元和150.75万元，主要原因公司2007年上半年订单增长较快，公司的库存商品和在产品相应增长。

（3） 固定资产分析

2007年6月30日、2006年12月31日、2005年12月31日及2004年12月31日，固定资产分别为13,506.68万元、13,553.61万元、10,514.68万元及9,299.26万元，占公司总资产的比例分别为51.83%、54.46%、47.11%及56.07%。公司固定资产主要是与生产经营紧密相关的机器设备、房屋建筑物以及辅助生产设备等，其中房屋建筑物是公司于2002年新建的办公楼和生产厂房，关键机器设备大多从国外进口，处于国内领先水平，不存在数额较大的闲置和潜在的固定资产损失。固定资产减值准备余额为34.43万元，系2004年本公司改制设立时提取的跌价准备，此后固定资产减值准备未有增减情况。截至2007年6月30日，公司固定资产成新率为70.12%，固定资产状况良好。

（4） 无形资产分析

公司的无形资产主要为土地使用权、软件及两项SMD技术。2007年6月30日、2006年12月31日、2005年12月31日及2004年12月31日无形资产（含土地使用权）占公司净资产的比例分别为9.18%、9.98%、13.94%及8.32%。2005年末无形资产余额较2004年末余额增加134.55%，主要是公司购买了两项SMD技术。截至2007年6月30日未发现无形资产存在减值的迹象。

综上所述，资产结构配置合理，公司资产质量较优，不存在资产减值或减值准备计提不充分的情况。

2、公司负债结构分析

项目	2007.6.30.	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.
流动负债比例	46.60%	46.83%	62.21%	90.96%
其中：短期借款占总负债比例	5.7%	6.20%	24.82%	44.56%
应付票据占总负债比例	6.65%	5.91%	10.57%	7.35%
应付账款占总负债比例	22.45%	23.71%	17.31%	19.48%
应付职工薪酬占总负债比例	0.12%	0.67%	2.40%	2.63%
应交税费占总负债比例	0.64%	1.65%	0.87%	0.44%
其他应付款占总负债比例	0.06%	1.54%	0.23%	1.04%
一年内到期的非流动负债占总负债比例	4.71%	6.82%	5.91%	14.64%
非流动负债比例	53.40%	53.17%	37.79%	9.04%
其中：长期借款占总负债比例	53.40%	53.17%	37.79%	9.04%
合计	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

截至2007年6月30日，公司应付账款余额为3,579.70万元，占流动负债余额的48.18%，占负债总额的22.45%。2006年末应付账款余额较2005年末增长41.17%，主要系公司生产经营规模扩大，材料采购增加所致，另一方面，由于结算方式的调整，2006年末应付票据余额较2005年末减少657万元，应付账款的比重相应增加。

最近三年以来，公司逐步提高长期借款的比重，以调整负债结构。公司于2005年底取得了中国进出口银行上海分行4,000万元期限24个月的贷款，2006年底公司与中国进出口银行上海分行终止了2005年底签订的贷款合同并与中国进出口银行浙江省分行签定了金额为5,000万元，期限为30个月的贷款合同。公司取得中国进出口银行浙江省分行的贷款后，负债期限结构趋于合理。

(二) 偿债能力分析

1、偿债能力指标

指标	2007.6.30.	2006.12.31.	2005.12.31.	2004.12.31.	三年一期末平均
资产负债率	61.18%	60.72%	65.67%	66.98%	63.64%
流动比率（倍）	1.54	1.35	1.12	0.63	1.16

速动比率(倍)	0.99	0.90	0.87	0.39	0.79
指标	2007年 1~6月	2006年度	2005年度	2004年度	三年一期 平均
息税折旧摊销 前利润(万元)	2,654.78	4,885.41	3,602.76	2,582.15	3,431.28
利息保障倍数 (倍)	5.54	5.95	6.19	4.85	5.63

公司短期偿债能力指标与同行业上市公司比较如下:

2006年末财务指标	资产负债率(母公司)	流动比率	速动比率
晶源电子	34.63%	1.47	0.85
铜峰电子	35.93%	1.16	0.77
华东科技	38.40%	0.49	0.41
平均值	36.32%	1.04	0.68
本公司	60.72%	1.35	0.90

注:晶源电子于2005年6月在深圳证券交易所上市。股份发行前,截至2004年12月31日,该公司资产负债率(母公司口径)为54.86%,流动比率为1.35,速动比率为0.67。公司本次发行前,截至2007年6月30日,资产负债率为61.18%,流动比率为1.54,速动比率为0.99。

最近三年一期末,公司的资产负债率均在60%以上,处于较高的水平,但尚不对公司的经营造成重大影响。公司最近三年一期末流动比率和速动比率平均值分别为1.16和0.79,总体水平较低,但逐年改善,且优于同行业上市公司平均水平。其原因为公司调整负债结构,流动负债比重下降较多,相应降低了短期偿债风险。

2、现金流量

公司最近三年一期经营性现金净流量均为正值,累计约9,663.00万元,为同期净利润合计金额的1.53倍,说明公司收益质量较高,偿还债务的现金来源有较为充分的保障。公司2007年1-6月的的经营性净现金流量为805.76万元,低于同期净利润,主要系以下两方面因素的影响:

(1) 从提高产品质量、提高产品合格率及对冲人民币升值等多方面因素的考虑,公司加大了从国际市场采购原材料的比例,公司2007年1~6月以外币采购的原材料金额比2006年1~6月同比增加672万元。而国际采购的支付结算周期较国内采购短,从而使公司原材料增加的同时支付的现金增长更快,在公司2007年6月末原材料与2006年末相比增加943.55万元的情况下,公司的应付帐款余额与

2006年末相比不增反降；

(2) 由于公司2006年四季度销售数量增长较快，利润增长相应较高，从而使公司在2007年上半年对2006年度的所得税进行汇算清缴时支付的税费金额较大。公司2006年度全年支付的各项税费为601.55万元，2007年1~6月支付的各项税费达533.93万元。

最近三年一期，公司投资活动产生的现金净流量均为负值。主要原因为公司根据市场需求，调整产品结构，开发新型石英晶体元器件，每年投入较多资金，用于引进先进设备。公司最近三年一期累计购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为10,538.24万元，而近三年一期投资活动现金流入累计仅为987.91万元，因此，造成投资活动现金流量为负。

公司2006年度筹资活动产生的现金流量净额为-1,480.30万元，主要是由于2006年度应收账款周转率和存货周转率较2005年有较大提升，资金使用效率提高，在经营规模扩大的情况下，借入资金比归还资金减少39.28万元，此外，公司分配股利、利润或偿付利息支付现金794.03万元。公司2006年度支付的其他与筹资活动有关的现金比2005年增加843.75万元，主要是公司2006年度增加质押定期存款2,000万元。

公司经营活动现金流量与同行业上市公司的比较情况如下：

每股经营活动现金流量(元)	2006年度	2005年度	2004年度
晶源电子	0.56	0.49	0.49
铜峰电子	0.13	0.20	0.24
华东科技	0.15	-0.16	0.13
平均值	0.28	0.23	0.29
本公司	0.69	0.92	0.31

注：华东科技2005年度经营活动现金流量为负，在计算平均值时仅对晶源电子、铜峰电子该项指标算术平均。

由上表可见，报告期公司每股经营活动现金流量均优于同行业上市公司，其原因为：本公司产品90%以上出口，客户资信较好，均能按合同约定支付货款，最近三年一期末一年以上的应收账款余额很少，应收账款账龄一般在半年以内。

3、其他偿债能力

公司资信状况良好，企业信用等级连续7年被杭州资信评估公司、中国银行

浙江省分行评为 AAA 级，连续 4 年被浙江省工商行政管理局评为“浙江省工商企业信用 AAA 级守合同重信用单位”。

（三） 资产周转效率分析

1、 资产周转率分析

公司资产周转率与同行业上市公司比较情况如下：

单位：次

2006年度财务指标		应收账款周转率	存货周转率	总资产周转率
晶源电子		4.55	3.18	0.63
铜峰电子		4.59	2.60	0.37
华东科技		2.86	5.72	0.22
平均值		4.00	3.83	0.41
本公司	2005年度	4.52	3.81	0.63
	2006年度	5.79	4.27	0.67

2005年，公司的存货周转率略低于同行业上市公司平均水平，2006年，公司加大了存货和应收账款管理力度，存货周转率、应收账款周转率和总资产周转率水平均高于同行业上市公司，显示公司资产管理能力良好，整体的资产周转效率较高。

2、 公司业务模式对公司资产周转率的影响

（1） 产销模式对存货周转率的影响

公司约提前一周时间根据客户订单进行备料，产品的生产周期约为3~7天，销售收入确认时间在发货后取得报关单即可确认。根据以上产销模式的分析，公司2006年度从原材料入库到销售收入的确认约85天时间，存货周转率为4.27次。

（2） 结算模式对应收账款周转率的影响

公司与主要客户如台湾晶技等均为长期合作关系，客户于确认应收账款金额后不超过90天支付现汇。公司2006年度的平均收款期间约63天，应收账款周转率为5.79次。

二、 盈利能力分析

（一） 营业收入构成

1、 按产品类别划分

浙江东晶电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书

单位：万元

项 目		2007年1~6月		2006年度		2005年度		2004年度
		金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅	金额
主营业务收入		8,540.01	23.80%	15,776.98	29.49%	12,183.60	19.92%	10,159.65
SMD 谐振器	销售收入	4,819.46	34.63%	8,810.81	57.30%	5,601.13	55.45%	3,603.11
	占主营业务收入比例	56.43%	-	55.85%	-	45.97%	-	35.46%
DIP 谐 振器	销售收入	3,393.32	13.79%	6,270.36	7.28%	5,844.73	2.61%	5,696.27
	占主营业务收入比例	39.73%	-	39.74%	-	47.97%	-	56.07%
瓷介管 状电容 器	销售收入	327.23	-2.76%	695.81	-5.68%	737.74	-14.24%	860.27
	占主营业务收入比例	3.84%	-	4.41%	-	6.06%	-	8.47%

注：2004年合并报表含东晶经贸相关数据，2005年度、2006年度公司无合并事项，为增强可比性，本节“二、盈利能力分析”关于2004年度数据及其描述、比较分析采用母公司数据。2007年1~6月的增幅系与2006年1-6月数据（未审计数，以下同）相比较得出。

公司营业收入的绝大部分为石英晶体谐振器销售收入，瓷介管状电容器销售收入占公司主营业务收入的比重较小且逐年下降。

根据行业发展趋势和市场需求的变化，公司不断开发新产品，调整产品结构，工艺水平更先进、质量性能更优的SMD晶体谐振器的生产规模、产品档次、设备自动化程度名列国内同行业首位。2007年1~6月、2006年度、2005年度公司SMD谐振器的销售收入分别增长34.63%、57.30%和55.45%，在主营业务收入中所占的比重分别为56.43%、55.85%和45.97%。DIP谐振器销售收入保持平稳增长，在主营业务收入中的比例有所下降。

2、按地区划分

单位：万元

项 目		2007年1~6月		2006年度		2005年度		2004年度
		金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅	金额
主营业务收入		8,540.01	23.80%	15,776.98	29.49%	12,183.60	19.92%	10,159.65
内销	销售收入	386.85	-14.64%	1,231.27	89.54%	649.60	-31.74%	1,367.09
	占主营业务收入比例	4.53%	-31.05%	7.80%	46.34%	5.33%	-43.12%	13.46%
外销	销售收入	8,153.15	26.50%	14,545.71	26.11%	11,534.00	25.26%	8,792.56
	占主营业务收入比例	95.47%	2.18%	92.20%	-2.61%	94.67%	4.46%	86.54%

注：2007年1~6月的增幅系与2006年1-6月数据相比得出。

本公司产品主要销往海外市场，其中对中国台湾、新加坡、日本等企业的销售在公司销售中占有很大比重。

3、按销售模式划分

单位：万元

项 目	2007年 1~6月	2006年度		2005年度		2004年度	
	金额	金额	增幅	金额	增幅	金额	
主营业务收入	8,540.01	15,776.98	29.49%	12,183.60	19.92%	10,159.65	
自有品牌销售	直销	3,389.37	6,093.26	39.98%	4,353.06	20.22%	2,630.33
	占主营业务收入比例	39.69%	38.62%	-	35.73%	-	25.89%
	中间商销售	2,502.48	5,146.26	23.68%	4,160.84	36.06%	1,905.95
	占主营业务收入比例	29.30%	32.61%	-	34.15%	-	18.76%
OEM	销售额	2,648.16	4,537.46	23.65%	3,669.70	5.43%	5,623.37
	占主营业务收入比例	31.01%	28.76%	-	30.12%	-	55.35%

OEM业务具有风险小、订单稳定、占用资金少等特点，通过OEM业务可以较快地积累技术和资金，融入国际知名企业的供应商队伍，参与全球市场的国际分工。随着公司规模的不不断扩大，公司与主要客户之间已不再是单方面的依赖，而是一种较为稳定的相互依存的关系。本公司倾向于选择订单量大而且稳定的企业作为客户，客户也倾向于选择本公司为其提供价格适中、质量可靠的OEM产品。

公司2003年8月引入SMD生产线后，2004年度SMD产品的生产比例提升较大，而SMD产品的销售初期主要以OEM的方式，随着公司SMD产品逐步获得市场的认同，公司加大了自主品牌产品的开拓力度，OEM方式的销售比例逐渐下降；公司2007年1~6月OEM比例有所提高，主要原因是公司根据国际市场对高端产品的需求增长较快这一趋势，在2007年上半年产品结构优化力度较大，增加了产品技术含量和附加值较高的小规格产品的生产，这些产品的售价相对较高，公司在依托现有销售渠道和多年合作的老客户基础上，逐步开拓新客户，表现为公司与OEM主要客户的交易额有所增长。

4、主营业务收入变化分析

2007年1~6月主营业务收入较2006年同期（未经审计）增长23.80%，2006年

度主营业务收入较2005年度增长29.49%，2005年度较2004年度增长19.92%，主营业务收入呈快速增长趋势。

2007年1~6月、2006年度、2005年度主营业务收入增长的主要原因为：

(1) 公司通过技术改造，最近三年生产能力不断扩大

截至2007年6月30日，SMD谐振器产能达到900万只/月，DIP谐振器达到1,500万只/月。

(2) 产品结构调整，高附加值产品比重增加较快

公司加大了代表行业未来发展趋势的SMD谐振器的生产和销售，2006年度、2005年度同比分别增长了55%以上。

(3) 客户销量增加及开拓客户致使收入增加

由于本公司的产品日益向高端发展，而这些产品的应用终端生产商核心组件生产尚未大规模进入国内市场，导致本公司的产品目前基本定位与国际市场。公司稳步开拓国际市场，报告期内公司产品外销保持了持续增长的趋势。

(二) 经营成果变化的原因

1、主营业务成本

单位：万元

项 目	2007年1-6月		2006年度		2005年度		2004年度	
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅	金额	
主营业务收入	8,540.01	23.80%	15,776.98	29.49%	12,183.60	19.92%	10,159.65	
主营业务成本	6,172.02	16.94%	11,567.37	27.99%	9,037.69	17.29%	7,705.44	
SMD 谐振器	成本	3,365.89	19.18%	6,592.27	53.34%	4,299.09	37.12%	3,135.34
	占主营业务 成本比例	54.53%	-	56.99%	-	47.57%	-	40.69%
DIP 谐 振器	成本	2,471.73	14.28%	4,353.49	4.06%	4,183.55	6.19%	3,939.79
	占主营业务 成本比例	40.05%	-	37.64%	-	46.29%	-	51.13%

注：2007年1-6月的增幅系与2006年1-6月数据相比得出。

由于公司经营规模的扩大，公司近三年一期主营业务成本以平均超过 20% 的速度增长，但主营业务成本的增长率均低于主营业务收入的增长率，公司总成本得到了较好的控制。同时，由于公司重点扩大了 SMD 谐振器的销售比例，使 SMD 谐振器成本增长较快。

2、费用分析

项 目	2007年1-6月		2006年度		2005年度		2004年度	
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅	金额	
销售费用	销售费用总额	240.53	18.52%	424.79	25.60%	338.21	6.86%	316.50
	销售费用率	2.81%	-	2.68%	-	2.76%	-	2.91%
管理费用	管理费用总额	520.24	28.98%	807.38	9.57%	736.89	6.26%	693.45
	管理费用率	6.07%	-	5.10%	-	6.01%	-	6.37%
财务费用	财务费用总额	376.58	29.63%	628.87	162.60%	239.48	-39.90%	398.46
	财务费用率	4.39%	-	3.97%	-	1.95%	-	3.66%
合计	三项费用合计	1,137.34	26.82%	1,861.04	41.57%	1,314.58	-6.66%	1,408.41
	三项费用率	13.27%	-	11.75%	-	10.72%	-	12.94%
营业利润	营业利润总额	1,065.66	37.90%	2,382.04	29.32%	1,842.03	78.64%	1,031.14
	营业利润率	12.43%	-	15.04%	-	15.02%	-	9.48%

注：2007年1-6月的增幅系与2006年1-6月数据相比得出。

公司的销售费用主要为产品运输费用，报告期内销售费用的增长幅度小于主营业务营业收入增长幅度。

公司2007年1-6月管理费用增长率略高于营业收入的增长率，主要系研发费用、管理人员办公场所水电费、管理办公用品折旧、管理人员工资等均出现了不同程度的上涨。

公司2007年1-6月、2006年度财务费用增幅分别为29.63%和162.60%，主要因素是随着公司生产规模的不断扩大，维持日常生产经营所需要的流动资金以及为扩大生产规模、提升生产能力的固定资产更新改造资金主要通过银行借款解决，因此，公司的借款规模不断扩大，以及近期银行的多次加息，人民币升值产生的汇兑损失等因素导致财务费用相应增加。其中2006年度，公司利息支出比2005年度增加114.71万元，同时汇兑收益比2005年度减少209.95万元。

3、投资收益、营业外收入和营业外支出分析

单位：万元

项 目	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
	金额	金额	金额	金额
投资收益	-	60.00	-	1.28
营业外收入	415.40	461.50	293.55	328.67
营业外支出	10.30	21.83	14.96	41.03

公司 2006 年度取得的 60 万元的投资收益源于惠成公司分红。

公司最近三年一期的营业外收入主要是收到的各种形式的政府补助，最近三年一期营业外支出主要为水利建设基金、固定资产清理损失。

4、 利润变化情况

单位：万元

项 目	2007 年 1-6 月		2006 年度		2005 年度		2004 年度
	金额	增幅	金额	增幅	金额	增幅	金额
营业利润	1,065.66	37.90%	2,382.04	29.32%	1,842.03	78.64%	1,031.14
利润总额	1,470.76	32.31%	2,821.70	33.06%	2,120.62	60.80%	1,318.78
净利润	1,121.91	27.58%	2,272.78	30.34%	1,743.79	50.35%	1,159.81

注：2007 年 1-6 月的增幅系与 2006 年 1-6 月数据相比得出。

公司的各项利润指标保持了持续、快速的增长，主要原因是公司产品根据市场需求，及时调整产品结构，使公司主要产品保持了较高的毛利率水平，通过规模生产和采购节约成本，以及通过提高产品合格率等多项措施降低成本。

（三） 影响发行人盈利能力的主要因素

1、 主要客户的稳定性

公司已经通过松下、索尼、佳能供应商资格认证，并且培育了一批稳定的客户群体，与主要客户建立起良好的互利合作关系。2007 年 1-6 月、2006 年度、2005 年度和 2004 年度，公司对前五名客户合计的销售额占当期主营业务收入的比重分别为 59.99%、42.90%、46.41%和 83.63%。公司 2007 年 1~6 月客户集中度有所上升，主要原因在于本公司产品结构优化力度较大，增加了产品技术含量和附加值较高的 SMD5032 等产品的生产，这些产品的售价相对较高，公司开拓新的高端客户需要时间的逐步积累，从而使这些高端产品的客户仍以多年合作的老客户为主，以公司前三大客户为例，其 2007 年 1~6 月的采购量已达 2006 年全年 84%。

公司与主要客户稳定的战略合作关系是公司健康、稳定发展的重要保障，如果未来这些客户出现财务困难或采购意愿发生变化，而公司未及时开拓新的客户群，则可能影响公司未来的盈利能力。

2、 公司主要产品的价格和毛利率变动

单位：元/万只

品种	2007年1-6月		2006年度		2005年度		2004年度
	平均单价	增幅	平均单价	增幅	平均单价	增幅	平均单价
SMD 谐振器	10,554.03	-4.21%	10,815.88	-4.55%	11,331.71	-13.95%	13,168.11
DIP 谐振器	3,797.86	-18.88%	4,483.73	-4.93%	4,716.26	-14.11%	5,491.30

品种	2007年1-6月		2006年度		2005年度		2004年度
	毛利率	增幅	毛利率	增幅	毛利率	增幅	毛利率
谐振器	28.92%	20.50%	27.42%	5.93%	25.89%	8.21%	23.92%
电容器	-2.20%	-	10.66%	-57.00%	24.80%	-7.06%	26.68%
公司综合毛利率	27.73%	18.05%	26.68%	3.34%	25.82%	6.89%	24.16%

注：2007年1-6月的增幅系与2006年1-6月数据相比得出。

报告期，公司产品价格呈下降趋势，但本公司通过产品升级、加大了产品附加值较高的产品的生产和销售，毛利率保持稳中有升。

3、汇率变化可能对公司盈利造成影响

2005年我国实施汇率制度改革前，美元对人民币基准汇率为 8.2765，2005年底美元对人民币基准汇率为 8.0702，2006年底美元对人民币基准汇率为 7.8078，2007年6月30日美元对人民币基准汇率为 7.6155。在本公司产品外币标价不变的情况下，人民币对外币的持续升值，将直接减少本公司的销售收入。报告期内，公司产品的出口比例平均为 92.18%，如果按 2005年汇改前美元对人民币的基准汇率计算，公司 2007年1~6月、2006年度、2005年度可增加销售收入分别为 579.10 万元、559.35 万元、125.20 万元。此外，由于结算期的原因，人民币升值将使以外币计价的应收账款等债权给本公司带来汇兑损失，如果按 2005年汇改前美元对人民币的基准汇率计算，公司 2007年1~6月、2006年度、2005年度可减少汇兑损失分别为 89 万元、155 万元、108 万元。

针对人民币持续升值这一状况，为减少出口业务对公司经营业绩的影响，公司主要采取了以下措施：

(1) 加大产品结构调整升级的力度，增加附加值较高的中高档新产品的销售比例，以中高档产品售价优势，抵御汇率波动产生的风险。报告期内，公司 SMD 谐振器产量实现快速增长，SMD 谐振器销售收入占主营业务收入的比重由

2005 年的 45.97% 上升至 2007 年上半年的 56.43%，同期 DIP 谐振器销售收入占主营业务收入的比重由 47.97% 下降至 39.73%，SMD 谐振器的毛利率逐年增长带动公司产品综合毛利率稳定增长，2007 年上半年、2006 年度、2005 年度公司综合毛利率分别为 27.73%、26.68%、25.82%，分别较上年增加 1.05、0.86、1.66 个百分点。

(2) 公司通过向中国出口信用保险公司投保，以应收账款向银行融资并结汇，2006 年、2005 年累计以应收账款向银行融资并提前结汇 872 万美元、560.20 万美元，分别比上年增长 55.66%、64.11%，公司应收账款从原先的 3 个月后收款结汇缩短为 1 个月内结汇，该措施有利于减少人民币升值对公司造成的汇兑损失。除通过出口信保提前结汇外，公司自 2007 年起与中国工商银行金华市分行合作，针对合作时间长、信誉较好的客户，公司以出口单据向银行融资并提前结汇业务，在节约保费支出的同时，也降低了人民币升值带来的汇兑损失。

此外，为减少人民币持续升值对公司经营业绩的影响，公司还采取了以下措施：

(1) 合理安排采购进口计划，通过扩大原材料和设备进口，平衡外汇收支。如原材料采购方面，公司 2005 年度 7~12 月以日元、美元采购原材料金额分别为 24,388,500 日元、165,884 美元，节约采购成本人民币 2.83 万元；2006 年度，公司以外币采购原材料的金额大幅度增加，以日元、美元结算的采购金额较 2005 年度分别增长 557.88%、360.73%，全年节约采购成本人民币 96.85 万元；此外，公司 2006 年度、2005 年 7~12 月以日元采购机器设备分别达 53,022 万日元、8,592 万日元，分别节约采购成本人民币 212.21 万元、17.10 万元。

(2) 调整负债结构，2006 年末较 2005 年末新增外币借款余额 66.35 万美元（短期外币借款减少 97.4 万美元，长期外币借款增加 168.75 万美元），在人民币升值预期较强的情况下，公司通过适当增加外币借款部分对冲了人民币升值带来的损失。

今后本公司还将积极调整出口市场结构和结算币种，与现有客户或潜在客户洽商以欧元等强势货币进行结算；根据汇率变动情况，相应地调整采购计划和采购对象，选择有利购销时机及合适的结算货币；顺应全球电子元器件产品加工生产向中国转移的趋势，开拓国内市场，提高内销收入占主营业务收入的比例；委托金融机构为公司设计和运用外汇套期保值等金融工具等。公司努力通过上述多

项措施的综合运用，尽可能降低人民币持续升值给公司经营业绩造成的不利影响。

4、商标注册可能对公司盈利造成影响

截至本招股说明书签署日，本公司申请注册的“^{ECEC}东晶电子”商标因百容电子股份有限公司（主要生产程式开关、磁簧继电器、端子台、连接器、导线架等产品）提出异议而尚未注册成功。公司使用“^{ECEC}东晶电子”商标的产品在报告期内的销售金额及其占主营业务收入的比重如下表所示：

商标	2007年1~6月		2006年度		2005年度		2004年度	
	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比	金额 (万元)	占比
^{ECEC} 东晶电子	713.03	8.35%	1,265.31	8.02%	968.60	7.95%	595.36	5.86%

公司报告期内使用该商标的产品销售收入占公司当期主营业务收入的8%左右，如果公司以后不能使用上述商标，可能会对会对公司部分客户的采购造成一定影响，如减少甚至取消对本公司产品的采购，从而影响本公司的生产经营。此外，如果未来不能使用上述商标，公司采用新的品牌销售可能会增加营销费用，从而影响公司的盈利水平。

公司对商标注册问题的影响分析说明如下：

(1) 由于百容电子在中国大陆申请注册的“^{ECEC}东晶电子”商标也处于异议复审阶段，其商标未获核准。公司以前和目前使用“^{ECEC}东晶电子”商标并不存在侵权问题。

(2) 公司报告期内使用“^{ECEC}东晶电子”商标销售的产品占当期主营业务的收入的比例平均仅在8%左右，即使以后该产品不使用“^{ECEC}东晶电子”商标，对公司经营影响也较小。

(3) 由于石英晶体元器件为电子整机产品的重要零配件，客户对供应商的选择较谨慎，一般需要对公司现场和产品进行长期持续性考察和质量认证，公司品牌在客户选择供应商中的作用不同于普通消费品购买中品牌的作用。因此公司若调整所使用的商标，对生产经营的影响相对较小。

5、影响公司盈利能力连续性和稳定性的其他因素

(1) 非经常性损益——政府补贴

公司 2007 年 1~6 月、2006 年度、2005 年度、2004 年度取得的非经常性损益分别为 422.30 万元、445.22 万元、283.09 万元、306.30 万元，占当期利润总额的比例分别为 28.71%、15.78%、13.35%、23.23%，公司非经常性损益主要是各种形式的政府补贴。

公司获得的各种形式的政府补贴主要由两部分组成：一是公司自主研究、开发项目以及技术改造项目获得各级政府部门的补贴，二是公司作为出口创汇企业获得的政府部门的各种补贴。

因公司所获得上一年的地方政府补贴多在本年的上半年发放，故公司 2007 年 1~6 月非经常性损益占同期利润总额的比例较高，达 28.71%。随着本公司主营业务收入和主营业务利润的稳步增长，非经常性损益金额对公司经营成果的影响将会下降。

(2) 税收优惠政策

公司购买国产设备享受所得税抵免的优惠政策，2006 年度抵免 171.61 万元、2005 年度抵免 188.88 万元、2004 年度抵免所得税 172.47 万元。

(四) 发行人产品价格及主要原材料价格的变动分析

1、产品销售价格变动分析

报告期内，DIP 谐振器和 SMD 谐振器每年的合计销售收入占当年总销售收入的 90%以上，DIP 谐振器和 SMD 谐振器报告期内各年的销售单价如下：

单位：元/万只

年份	2007 年 1~6 月	2006 年度		2005 年度		2004 年度
产品	销售单价	销售单价	增幅	销售单价	增幅	销售单价
谐振器	6,082.96	6,814.54	3.21%	6,602.52	-7.21%	7,115.48
其中：DIP 谐振器	3,797.86	4,483.73	-4.93%	4,716.26	-14.11%	5,491.30
其中：SMD 谐振器	10,554.03	10,815.88	-4.55%	11,331.72	-13.95%	13,168.11

上表可以看出，DIP 谐振器和 SMD 谐振器在 2005 年大幅降价，2006 年小幅降价，但基本趋于平稳，2007 年 1~6 月 DIP 谐振器综合售价下降幅度较大，而 SMD 谐振器仍基本保持平稳。

DIP 谐振器和 SMD 谐振器各年占主营业务收入比例如下：

年份	2007年1-6月	2006年度		2005年度		2004年度
产品	占收入比例	占收入比例	增幅	占收入比例	增幅	占收入比例
谐振器	96.16%	95.59%	1.75%	93.94%	2.64%	91.53%
其中：SMD 谐振器	56.43%	55.85%	21.48%	45.97%	29.63%	35.46%
DIP 谐振器	39.73%	39.74%	-17.15%	47.97%	-14.44%	56.07%

可以看出，谐振器的合计销售收入占总体收入的比例一直保持在 90%以上，且在报告期内逐年增长。同时谐振器内部销售结构则逐年往销售单价高的 SMD 谐振器倾斜，2004 年度至 2006 年度，SMD 谐振器销售收入占总收入的比例以每年 20 个百分点以上的幅度在增长，而 DIP 谐振器销售收入占总收入的比例则以每年约 16 个百分点的幅度下降。该变化主要由于 2005 年开始人民币大幅升值，公司为抵御汇率波动产生的风险，大力调整产品结构，增加附加值较高的中高档新产品的销售比例。也因此，虽然 DIP 谐振器和 SMD 谐振器 2006 年的销售单价较 2005 年稍有下降，但由于售价高的 SMD 谐振器销售比例大幅上升，导致谐振器总体销售单价反而上升。

从销售方式来看，公司产品销售分为自主品牌销售和贴牌销售（OEM），公司各年外销占总销售额的比例均很高，选取外销主要客户的各年的销售方式进行分析。对外销主要客户销售产品按大类分各年的不同销售方式单价如下：

单位：元/万只

产品	方式	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
SMD 谐振器	自主品牌	10,526.63	10,426.97	11,173.41	12,412.82
	OEM	11,172.01	11,395.58	11,546.52	13,336.71
DIP 谐振器	自主品牌	4,122.71	4,611.19	4,982.86	6,810.74
	OEM	3,655.74	3,705.87	4,147.68	4,952.46

从上表可见，DIP 谐振器 OEM 方式较自主品牌单价各年有所降低，但 SMD 谐振器 OEM 方式较自主品牌单价各年有所上升，销售方式的不同与销售价格无很强的关联程度。而影响公司的销售定价主要为产品规格与技术参数的不同以及与不同客户谈判能力。故自主品牌销售及 OEM 销售对销售单价并无明显的影响。

2、产品单位成本变动分析

报告期内由于产品所用的主要原材料采购价格有所降价,对降低产品单位成本有较大影响。主要产品的单位成本变化如下:

单位:元/万只

产品	2007年1-6月	2006年度		2005年度		2004年度
	单位成本	单位成本	增幅	单位成本	增幅	单位成本
谐振器	4,323.75	4,954.88	1.26%	4,893.34	-9.60%	5,413.26
其中:SMD谐振器	7,370.91	8,132.39	-6.51%	8,698.66	-24.08%	11,458.31
DIP谐振器	2,780.16	3,113.04	-7.78%	3,375.58	-11.46%	3,812.49

由上表可以看出,报告期内DIP谐振器和SMD谐振器的单位成本持续下降。其中,2006年DIP谐振器和SMD谐振器的单位成本年均下降幅度约为7%左右,而谐振器整体平均单价反而上升1.26%左右,主要由于销售成本结构变化引起,公司各年销售成本结构如下表所示:

产品	2007年1-6月	2006年度		2005年度		2004年度
	销售成本比重	销售成本比重	增幅	销售成本比重	增幅	销售成本比重
谐振器	94.58%	94.63%	0.81%	93.86%	2.23%	91.81%
其中:SMD谐振器	54.53%	56.99%	19.79%	47.57%	16.92%	40.69%
DIP谐振器	40.05%	37.64%	-18.69%	46.29%	-9.46%	51.13%

报告期内,谐振器的销售成本占公司总销售成本的90%以上。2004年度至2006年度,DIP谐振器的比重持续下降,SMD谐振器的比重则不断上升,而由于SMD谐振器的单位成本较之DIP谐振器高出一倍多,因此在DIP谐振器和SMD谐振器的各自单位成本普遍下降的情况下,由于SMD谐振器比重的上升使得谐振器2006年度单位成本反而有所上升。

公司产品成本构成情况如下表:

单位:元/万只

产品	成本构成	2007年1~6月		2006年度		2005年度		2004年度	
		单位成本	比例	单位成本	比例	单位成本	比例	单位成本	比例
SMD谐振器	原材料	5,910.37	80.19%	6,567.58	80.76%	6,815.73	78.35%	8,928.07	77.92%

器	制造费用	1,164.88	15.80%	1,229.82	15.12%	1,361.36	15.65%	1,830.66	15.98%
	工资及福利	124.10	1.68%	145.21	1.79%	241.12	2.77%	269.54	2.35%
	动力	171.56	2.33%	189.79	2.33%	280.45	3.22%	430.05	3.75%
	小计	7,370.91	100.00%	8,132.39	100.00%	8,698.66	100.00%	11,458.31	100.00%
DIP 谐振器	原材料	2,190.98	78.81%	2,329.72	74.84%	2,494.44	73.90%	2,890.63	75.82%
	制造费用	217.55	7.82%	342.09	10.99%	295.29	8.75%	346.46	9.09%
	工资及福利	264.99	9.53%	283.58	9.11%	413.73	12.26%	413.10	10.84%
	动力	106.64	3.84%	157.65	5.06%	172.12	5.10%	162.29	4.26%
	小计	2,780.16	100.00%	3,113.04	100.00%	3,375.58	100.00%	3,812.49	100.00%

原材料在产品成本中占 73%以上,各产品各年原材料单位成本及占总成本比例如下表所示:

单位: 元/万只

产品	2007 年 1~6 月	2006 年度		2005 年度		2004 年度
	原材料单 位成本	原材料单 位成本	增幅	原材料单 位成本	增幅	原材料单 位成本
其中: SMD 谐振器	5,910.37	6,567.58	-3.64%	6,815.73	-23.66%	8,928.07
DIP 谐振器	2,190.98	2,329.72	-6.60%	2,494.44	-13.71%	2,890.63

产品	2007 年 1~6 月	2006 年度		2005 年度		2004 年度
	原材料 占总成 本比例	原材料 占总成 本比例	增幅	原材料 占总成 本比例	增幅	原材料占 总成本比 例
其中: SMD 谐振器	80.19%	80.76%	3.07%	78.35%	0.56%	77.92%
DIP 谐振器	78.81%	74.84%	1.27%	73.90%	-2.54%	75.82%

从上表可见, DIP 谐振器的原材料成本年均下降 10%左右,而原材料在成本中的比例保持在 73%以上,原材料成本的下降直接导致产品成本的下降。原材料成本下降的幅度与 DIP 谐振器产品单位成本的下降幅度基本一致。

SMD 谐振器的原材料成本占产品成本比例达到 77%以上,2004 年度至 2006 年度,由于公司产品逐步向高端发展,采购的原材料档次也在提升,导致原材料在 SMD 谐振器中的比例逐年小幅提升,与此同时,原材料成本的年均下降幅度

则达到了 13%左右，2005 年原材料成本的下降幅度与产品单位成本的下降幅度基本一致，2006 年原材料成本的下降幅度 3%低于产品单位成本的下降幅度 6%，系由于 SMD 谐振器规模效益的逐步体现，人工及动力成本也有一定幅度的下降。

原材料成本下降，一方面由于近年来 DIP 谐振器和 SMD 谐振器的主要原材料采购价格均有不同程度的下降，公司的主要原材料为基座、外壳、晶片，其各年价格变动如下表所示：

单位：元/万只

产品	材料名称	2007 年 1~6 月	2006 年度		2005 年度		2004 年度
		单价	单价	增幅	单价	增幅	单价
SMD 谐振器	基座	3,444.12	3,594.59	9.30%	3,288.80	-33.88%	4,974.30
	外壳	932.66	1,107.24	-15.37%	1,308.28	24.94%	1,047.15
	晶片	760.48	780.78	-15.86%	927.97	-35.53%	1,439.36
DIP 谐振器	基座	762.80	823.61	-9.12%	906.27	-5.60%	960.04
	外壳	239.79	245.83	-1.41%	249.35	-10.66%	279.09
	晶片	607.39	627.36	-10.94%	704.41	-16.10%	839.60

可以看出，DIP 谐振器主要原材料的单价逐年下降，SMD 谐振器的主要原材料单价也基本逐年下降。

由于 2004 年度至 2006 年度间 SMD8045 的原材料采购比例变动较大，导致 SMD 基座和外壳的平均采购成本变动较大，具体原因如下：

2004 年度、2005 年度和 2006 年度 SMD8045 基座采购量占 SMD 产品采购量的比例分别为 52%、73%和 44%，由于 SMD8045 基座单价相对其它 SMD 产品较低，导致 2005 年度 SMD 产品基座的平均采购成本较 2004 年度大幅下降而 2006 年度 SMD 产品基座的平均采购成本较 2005 年度有所上升。2004 年度、2005 年度和 2006 年度 SMD8045 外壳采购量占 SMD 产品采购量比例的分别为 51%、77%和 43%，由于 SMD8045 外壳单价较其它 SMD 产品高，导致 2005 年度 SMD 产品外壳的平均采购成本较 2004 年度有较大上升而 2006 年度 SMD 产品外壳的平均采购成本较 2005 年度有所下降。

2007 年 1-6 月谐振器的主要原材料的平均采购价格均有不同幅度的下降。

另一方面，随着生产技术趋于成熟，公司在生产过程中材料的单耗率有所下

降，也会一定程度上降低产品单位成本，各年主要原材料的耗用率如下：

产品	材料名称	单 耗			
		2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度
SMD	基座	1.07	1.08	1.11	1.26
	外壳	1.02	1.03	1.07	1.23
	晶片	1.06	1.07	1.09	1.13
DIP	基座	1.11	1.12	1.18	1.35
	外壳	1.05	1.06	1.11	1.37
	晶片	1.17	1.19	1.10	1.22

注：单耗指一只产成品所耗用的原材料数量。

可见，2005年度原材料单耗较之2004年度大幅下降，而2006年则小幅下降但总体趋于稳定，这与产品单位成本的下降幅度基本一致。

由于SMD谐振器规模效益的逐步体现，采用自动化生产，2007年上半年与2006年度工资及福利所占的比例下降幅度较大。由于新引进的机器设备更节能，自动化程度更高，使SMD谐振器中动力消耗占成本的比例下降。

2006年度DIP谐振器制造费用所占的比例出现较大幅度的提高，原因是2006年度公司新购置了1条生产线，固定资产投入309万元，设备至当年底全部到位，由于安装调试、试生产等原因，产能未完全发挥，制造费用比例有一定增长。同时公司加大了部分非自动化设备的改造，增加了改造费用，进入当期成本。从长远看，提高设备自动化程度，不仅可以降低人工费用，而且有利于提高产品合格率。

3、主要产品销售价格和主要原材料价格变动对公司收入影响的敏感性分析

(1) 主要产品销售价格变动对公司利润影响的敏感性分析

报告期内，DIP谐振器和SMD谐振器的合计销售收入占总收入的90%以上，其销售价格的变化直接影响公司收入的变化。

主要产品售价变动和利润的敏感性分析表

项目	2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度
DIP谐振器和SMD谐振器占总收入的比重(%)	96.16	95.59	93.94	91.53
DIP谐振器占总收入的比重(%)	39.73	39.74	47.97	56.07

谐振器	加权平均单价变动1%对总收入的影响程度(%)	0.40	0.40	0.48	0.56
	加权平均单价(元/万只)	3,797.86	4,483.73	4,716.26	5,491.30
	加权平均单价比上一年的变动(%)	-15.29	-4.93	-14.11	-
	加权平均单价对总收入的影响(%)	-6.12	-1.96	-6.77	-
SMD 谐振器	占总收入的比重(%)	56.43	55.85	45.97	35.46
	加权平均单价变动1%对总收入的影响程度(%)	0.56	0.56	0.46	0.35
	加权平均单价(元/万只)	10,554.03	10,815.88	11,331.72	13,168.11
	加权平均单价比上一年的变动(%)	-2.42	-4.55	-13.95	-
	加权平均单价对总收入的影响(%)	-1.36	-2.54	-6.41	-
DIP谐振器和SMD谐振器加权平均单价对收入的影响合计(%)		-7.48	-4.50	-13.18	-

从上表可以看出，DIP 谐振器和 SMD 谐振器售价每变动 1%，公司总收入将变动 0.94%，公司收入对 DIP 谐振器、SMD 谐振器售价变动的敏感性很强。

(2) 主要原材料价格变动对公司成本影响的敏感性分析

公司生产所用的主要原材料基座的采购价格报告期内逐年小幅下降，致使产品单位成本下降，对公司利润有一定的提升作用。

① DIP 谐振器的主要原材料价格对成本的敏感性分析

项目		2007年 1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
DIP 谐振器原材料占 DIP 谐振器总成本的比重(%)		78.81	74.84	73.90	75.82
外壳、基座及晶片占 DIP 谐振器总成本的比重(%)		57.91	55.25	53.84	55.89
基座	基座占 DIP 谐振器总成本的比重(%)	27.44	26.62	25.69	25.53
	基座采购单价变动1%对 DIP 谐振器总成本的影响程度(%)	0.27	0.27	0.26	0.26
	基座采购单价(元/万只)	762.80	823.61	906.27	960.04
	基座采购单价比上一年的增幅(%)	-7.38	-9.12	-5.60	-
	基座采购单价对 DIP 谐振器总成本的影响(%)	-1.99	-2.43	-1.44	-
外壳	外壳占 DIP 谐振器总成本的比重(%)	8.63	7.80	7.37	7.46
	外壳采购单价变动1%对 DIP 谐振器总成本的影响程度(%)	0.09	0.08	0.07	0.07
	外壳采购单价(元/万只)	239.79	245.83	249.35	279.09
	外壳采购单价比上一年的增幅(%)	-2.46	-1.41	-10.66	-

	外壳采购单价对 DIP 谐振器总成本的影响 (%)	-0.22	-0.11	-0.79	-
晶片	晶片占 DIP 谐振器总成本的比重 (%)	21.85	20.84	20.77	22.90
	晶片采购单价变动 1%对 DIP 谐振器总成本的影响程度 (%)	0.22	0.21	0.21	0.23
	晶片采购单价 (元/万片)	607.39	627.36	704.41	839.60
	晶片采购单价比上一年的增幅 (%)	-3.18	-10.94	-16.10	-
	晶片采购单价对 DIP 谐振器总成本的影响 (%)	-0.70	-2.28	-3.34	-
基座、外壳和晶片采购单价对 DIP 谐振器成本的影响合计 (%)		-2.91	-4.82	-5.57	-

基座、外壳和晶片价格每变动 1%，DIP 谐振器总成本将变动 0.56%，DIP 谐振器产品成本对原材料价格上涨的敏感性较强。

② SMD 谐振器的主要原材料价格对成本的敏感性分析

项目		2007 年 1~6 月	2006 年	2005 年	2004 年
SMD 谐振器原材料占 SMD 谐振器总成本的比重 (%)		80.19	80.76	78.35	77.92
外壳、基座及晶片占 SMD 谐振器总成本的比重 (%)		69.70	55.16	54.28	50.80
基座	占 SMD 谐振器总成本的比重 (%)	46.73	45.36	43.16	38.12
	采购单价变动 1%对 SMD 谐振器总成本的影响程度 (%)	0.47	0.45	0.43	0.38
	采购单价 (元/万只)	3,444.12	3,594.59	3,288.80	4,974.30
	采购单价比上一年的增幅 (%)	-0.04	9.30	-33.88	-
	采购单价对 SMD 谐振器总成本的影响 (%)	-0.02	4.22	-14.62	-
外壳	占 SMD 谐振器总成本的比重 (%)	12.65	13.24	13.68	9.45
	采购单价变动 1%对 SMD 谐振器总成本的影响程度 (%)	0.13	0.13	0.14	0.09
	采购单价 (元/万只)	932.66	1,107.24	1,308.28	1,047.15
	采购单价比上一年的增幅 (%)	-15.77	-15.37	24.94	-
	采购单价对 SMD 谐振器总成本的影响 (%)	-2.05	-2.04	3.41	-
晶片	占总成本的比重 (%)	10.32	9.80	11.13	12.68
	采购单价变动 1%对 SMD 谐振器总成本的影响程度 (%)	0.10	0.10	0.11	0.13
	采购单价 (元/万片)	760.48	780.78	927.97	1,439.36
	采购单价比上一年的增幅 (%)	-2.60	-15.86	-35.53	-

	采购单价对 SMD 谐振器总成本的影响 (%)	-0.26	-1.55	-3.95	-
基座、外壳和晶片采购单价对 SMD 谐振器成本的影响合计 (%)		-2.33	-0.63	15.17	-

基座、外壳和晶片价格每变动 1%，SMD 谐振器总成本将变动 0.57%，SMD 谐振器产品成本对原材料价格上涨的敏感性较强。

4、公司规避主要产品和原材料价格波动风险采取的措施

公司主要采取了以下措施来规避主要产品和原材料价格波动风险：

(1) 提高产品技术含量和产品附加值，优化产品结构，从而保持公司产品利润率，如公司从普通的带引线的谐振器向表面贴装化发展，表面贴装化产品的规格不断向小型化发展。

(2) 不断改善工艺，提高产品合格率和机器使用效率，减少物料损耗。

(3) 对供应商进行定期严格考核，确保在质量保证和供货及时的前提下实现最优惠的价格。对部分原材料与同行进行采购平台共享，通过规模采购提高议价能力。

(4) 在人民币持续升值的情况下，公司着力调整产品结构、客户结构，确保在产品销售中的议价能力，报告期内毛利率逐年递增，2007年1-6月、2006年、2005年、2004年毛利率分别为27.73%、26.68%、25.82%、24.16%，一定程度上规避和降低了利润波动风险。

①产品结构升级：公司不断加快产品开发，生产附加值较高的中高档新产品，尤其加大了代表国内领先水平的高精度SMD系列产品的产量，来抵御汇率波动产生的或行业整体价格下滑的风险。公司募集资金项目投产后，产品结构进一步优化，议价能力也将进一步提升。

②客户结构调整：在DIP产品方面，公司避开国内同行的价格战，供应国际知名客户，满足客户提出的高质量要求，产品供货价格比同类产品高，且每年价格波动较小，公司具有较强的议价能力；在代表行业发展方向的SMD产品方面，公司凭借明显的规模、质量优势和行业地位，向电子行业内知名企业供货，公司所选择的高端客户偏重于对产品高质量的要求，价格相对比较稳定。

③借助行业壁垒：石英晶体谐振器性能直接影响着电子整机产品的稳定性，石英晶体谐振器应用于整机产品线路板时需要进行长时间的应用线路的匹配测试，使石英晶体谐振器在线路中形成最佳匹配，产品经客户的鉴定认可后才能按

单供应，供应商认证时间较长（松下、索尼认证为期1~2年），且认证供应商品质、技术、设备、管理等综合实力，客户更换供应厂家需要对新厂家进行重新认证，重新进行线路的最佳匹配测试，对客户而言，转换成本较高。公司近几年陆续通过松下、索尼、佳能供应商资格认证，相对于其他竞争对手而言，取得了进军国际中高端市场的准入先机，具备了较强的议价能力。

④在国际市场上发挥性价比优势：在电子整机产品价格下降的驱动下，电子整机厂家倾向于采购国内电子元器件厂家质量稳定且价格相对较低的产品，尤其是代表国内领先水平的SMD5032（G）、SMD5032（S）等产品，与国外同类产品相比，公司产品价格竞争优势较为明显。此外本公司为国内内资企业中唯一一家能大批量生产玻璃封装SMD产品的企业，产品议价能力较强。

通过以上措施，公司最近三年在产品平均售价逐年下降，人民币处于升值趋势的前提下，产品毛利率水平不仅没有同比下降，反而逐年小幅提升。

（五） 毛利率变动分析

1、主要产品毛利率变动分析

年份	2007年1-6月	2006年度	2005年度	2004年度
产品	毛利率	毛利率	毛利率	毛利率
谐振器	28.92%	27.42%	25.89%	23.92%
其中：SMD 谐振器	30.16%	25.18%	23.24%	12.98%
DIP 谐振器	27.16%	30.57%	28.43%	30.84%
综合毛利率	27.73%	26.68%	25.82%	24.16%

从上表可以看出，报告期内公司综合毛利率呈小幅稳步上升趋势，主要产品谐振器的总体毛利率也呈相同的趋势，其毛利率水平基本与公司综合毛利率水平持平。

谐振器整体毛利率逐年上升，2005年度DIP谐振器毛利率小幅下降，但由于SMD谐振器毛利率大幅提升，且该产品销售收入所占比例也大幅上升，导致谐振器整体毛利率呈小幅上升趋势；2006年度DIP谐振器及SMD谐振器毛利率均稳步小幅上升，谐振器整体毛利率上升；2007年1-6月DIP谐振器毛利率下降，但由于SMD谐振器毛利率提升幅度较大，使谐振器整体毛利率仍呈小幅上

升的趋势。

DIP 谐振器的毛利率处于一个较高的水平，达到 30%左右。近年来，该产品的销售单价和单位成本均有下降，其中 2007 年 1-6 月和 2005 年的毛利率稍有下降主要由于成本的下跌幅度小于售价的下跌幅度所引起；2006 年毛利率有所回升，则因为单位成本下降幅度大于销售单价下降幅度所致。

SMD 谐振器的毛利率在报告期稳步上升，该产品固定投入较大，随着生产技术的逐渐成熟，规模效益日益明显，同时原材料单价也有较大幅度的下降，因此在销售单价下降的基础上大幅降低单位成本，提高了毛利率。SMD 谐振器不同品种的毛利率情况如下表所示：

品 种	2007 年 1~6 月	2006 年度	2005 年度	2004 年度
SMD8045	17.79%	25.03%	26.45%	16.97%
SMD7050	27.08%	21.93%	16.85%	20.90%
SMD6035	33.97%	23.48%	12.25%	6.00%
SMD5032 (G)	35.54%	28.42%	19.39%	-
SMD5032 (S)	34.60%	28.71%	26.38%	-

注：S 表示金属封装的 SMD 石英晶体元器件，G 表示玻璃封装的 SMD 石英晶体元器件。

SMD5032 产品毛利率较高，本公司 2007 年 1~6 月和 2006 年度在募股资金到位前先利用银行贷款和自有资金购置了部分机器设备，并安装投入生产，虽然尚未实施完毕，但 SMD5032 产量在主营业务中的比例已有较大的增长，且存在较大提升空间。

2005 年度与 2004 年度相比，SMD8045、SMD6035 毛利率增长较快，公司 2005 年度在 SMD8045、SMD6035 两项产品扩大了产量，规模效应及生产技术的成熟使产品的毛利率提高较快。

2、与同行业上市公司比较分析

项 目	2007 年 1-6 月	2006 年度	2005 年度	2004 年度
东晶电子	27.73%	26.68%	25.82%	24.16%
晶源电子	-	29.11%	25.42%	26.15%

注：由于铜峰电子、华东科技仅为子公司从事石英晶体元器件生产，为更准确地反映公司与同行业上市公司的比较情况，仅选取晶源电子作为样本上市公司。

与同行业上市公司晶源电子相比，本公司的产品毛利率近三年一期均处于增长趋势中。

三、 资本性支出分析

(一) 报告期重大资本性支出

公司报告期内的重大资本性支出主要为：

1、公司陆续购入设备用于满足 DIP 谐振器生产规模扩大的需要，通过对现有生产线进行添置新设备或对原设备进行改造，达到提高生产自动化程度，进一步提升产品质量。

2、公司已利用银行贷款和自有资金进行募股资金投资项目的前期投资，截至 2007 年 6 月 30 日，公司已投入资金 3,621.35 万元，主要用于生产车间的改造和引进关键生产设备等。

(二) 未来可预见的重大资本性支出计划

截至本招股说明书签署日，除本次发行募股资金有关投资外，发行人无可预见的重大资本性支出计划。本次发行募股资金投资项目详见本招股说明书“第十三节 募股资金运用”。

四、 财务趋势分析

(一) 主要财务优势及面临的主要困难分析

1、主要财务优势分析

根据公司财务状况、经营成果和现金流量状况，董事会及管理层认为，本公司的主要财务优势为：

公司资产质量好，应收账款和存货周转正常，固定资产成新率高；产品结构合理，销售利润率逐步提高；公司资产负债结构合理；主营业务收入稳定增长，盈利能力较强，经营性现金流量充足。

2、主要财务困难分析

(1) 本公司目前90%以上产品出口，主要结算货币为美元，外汇汇率的波动对公司的利润影响较大。

(2) 面对压电晶体行业的快速发展,公司目前资产规模不能满足公司在技术投入、产品开发和市场拓展上的资金需求。

(3) 为抓住行业的快速发展良好机遇,公司加大了技术改造投资力度,因而需要大量的资金支持,而本公司目前负债率高且主要资产已用于融资担保,进一步举债融资的能力较小。

(二) 财务状况趋势

1、资产状况趋势

公司资产结构中固定资产所占比重较高,募股资金主要用于新增固定资产投资,预计未来几年固定资产规模将有较大幅度增长。流动资产结构中,以应收账款和存货的金额最大、比重最高,应收账款的质量和存货的减值情况对公司的财务状况尤其重要。由于公司主要客户均具有良好的资信和雄厚的实力,应收账款的发生坏账的概率较低。公司的生产模式是根据客户订单进行生产,进而确定材料采购计划,加上公司产品的生产周期不长,存货发生减值的可能性很小。预计公司此种资产结构仍将保持相当长一段时间。

2、负债状况趋势

公司负债结构逐步优化,今后仍将与各银行密切联系,利用银行短期贷款额度补充企业短期性资金需求,由于结算周期的原因,公司的应付账款金额较大,其与银行借款一起构成了公司流动负债的主体,预计此种负债结构仍将保持。

3、所有者权益趋势

公司近年来业务发展很快,所有者权益增长主要表现为滚存利润,预计本次发行成功后,公司所有者权益将大幅增长,公司不排除上市后通过增发新股来筹集资金,以满足公司发展的需要,但公司对再融资将采取谨慎的态度。

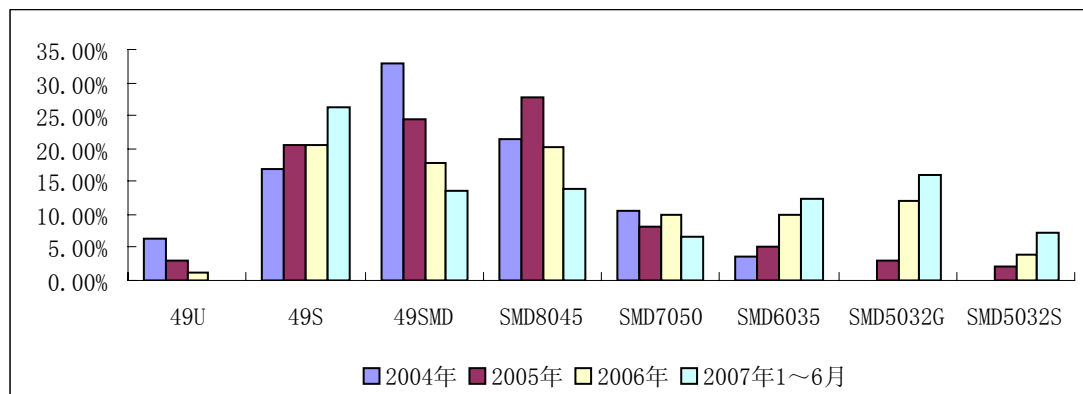
(三) 盈利能力趋势

1、毛利率变动趋势

公司综合产品毛利率呈逐年小幅增长的趋势,主要原因是 SMD 谐振器的迅速扩大,从整体上提高了公司产品的档次和技术含量。在传统 DIP 谐振器中,49SMD 保持了较高的毛利率水平;在 SMD 谐振器中,SMD5032 的毛利率增长趋势较好,本公司募股资金投资项目的重点即通过大规模提升公司生产

SMD5032 产品及规格更小的 SMD3225 产品的生产, 如果未来市场环境不发生大变化的前提下, 本次募股资金投资项目的实施将有利于进一步提高公司综合的产品毛利率。

2、产品结构的优化



从公司近三年一期产品收入结构的情况看, 49S、49SMD、SMD8045 一直处于较高的比例, 从增长趋势看, SMD6035、SMD5032 增长最快, 公司产品结构的变化与近三年一期各产品毛利率的变化情况基本一致。

第十二节 业务发展目标

一、经营宗旨及发展战略

(一) 经营宗旨

- | | |
|------------------|---|
| 1、经营宗旨： | 自主创新、重点跨越、持续发展、引领未来 |
| 2、愿景 | 全球领先的石英晶体元器件供应商 |
| (1) 国际化的东晶电子： | 在全球化程度很高的行业内竞争，并做到产品、品质、市场、服务、管理的国际化 |
| (2) 制造领先的东晶电子： | 努力形成以高效率、低成本、高品质为核心的生产制造能力领先，在市场竞争中构建自己的核心竞争力 |
| (3) 专注晶体行业的东晶电子： | 公司将专注于晶体元器件领域，追求产业链的协同效应 |
| (4) 集成的东晶电子： | 公司将形成产业链整合的综合优势，成为国内晶体行业的集成供应商 |

(二) 总体发展战略

公司 2006~2010 年总体发展战略是：利用行业快速发展的有利契机，积极探索上下游产业链的协同发展，通过不断优化产品结构，培育与提升低成本制造能力，提高规模经济的成本优势；通过资源整合，树立公司在国际晶体元器件领域的总成本领先的品牌制造商形象。

在总体战略的指导下，公司的未来发展可以划分为三个阶段

1、巩固期（2006~2007 年）

(1) 公司专注于制造，优化业务组合，提升品质管理水平，总结和提升生产管理经验，挖掘内部成本空间，形成公司独特的生产管理模式；

(2) 加强内部管理，培育优秀的管理团队和稳定的员工队伍，培育成本领先的企业文化，实现管理出效益。

2、 发展期（2008~2010 年）

（1）通过技术提升和产品结构的持续优化调整，积极参与下游客户企业的产品设计和开发，初步具备 ODM（Original Design Manufacturer，原始设计制造商的英文缩写）能力和 OEM 外包管理能力，成为公司的核心竞争力；

（2）积极寻求在技术、生产、供应、营销各方面的战略合作联盟，助力公司发展。

3、 扩展期（2011~）

依靠公司品牌和实力，积极整合外部资源，实现上下游的协同发展，优化整体价值链，为实现愿景目标奠定基础。

二、 总体经营目标

为了实现总体发展战略，在未来的 5 年内，公司在经济规模和管理能力上都需有一个大突破。根据公司的战略发展，对未来 5 年的经济发展和管理提升制定如下目标：

	2006~2007 年	2008~2010 年	2011 年~
内部管理提升	建设高效率、规范化管理制度和业务流程，并初见成效	初步搭建科学的内部管理平台	完善的科学内部管理平台，使管理成为效益的主要来源
人力资源发展	打造基于专业化的高效率管理团队和稳定的员工队伍	建立科学、规范、健全的人力资源管理体系	公司成为本地区的最佳雇主，人力资源成为公司成长的核心能力之一
生产管理能力	生产管理规范化、高效化	形成完善的生产管理能力和 OEM 外包管理能力	形成一套系统的生产管理模型，能进行生产管理模式的输出与复制
应用技术提升	配备应用技术研发专业团队，形成规范化的技术研发管理	在应用技术领域获得突破	在行业中保持应用技术领先地位
市场领域开拓	直销客户比例获得一定突破	建立直销客户为主的渠道体系，参与末端客户的开发	在传统领域占据主导地位，在新兴领域保持领先地位
品牌建设目标	在行业内建立具有一定知名度的加工生产企业品牌	获得省级、国家级核心品牌产品称号	建成在国际电子元器件领域具有领导地位和国际影响力的企业品牌

三、主要发展规划

(一) 业务发展规划

1、基础业务——DIP 石英晶体元器件

业务定位：公司实现业务持续发展的基础

业务目标：5 年内成为国内 DIP 业务领域规模、品质、应用能力领先的品牌制造企业。

战略重点：通过扩张规模，标准化品质，拓展应用领域，实现大规模、高品质、低成本制造，在行业内树立制造品牌，为公司发展构筑稳定的基础。

(1) 进一步扩大产能，发挥规模经济效应

产能保障是持续扩大市场份额的基础，通过因时制宜的扩大自主产能、OEM 外包等途径，整合内外部生产资源，达到以有限的资源实现更大规模的生产，实现低成本竞争优势。同时加强品质管理，总结和提升生产管理经验，形成公司独特的生产管理模式，为未来利用外部生产资源实现扩张奠定基础。

(2) 加大应用设计投入，实现产业链协同

增强对下游终端产品的技术掌握能力，有针对性地参与下游产品的设计和开发，以参与设计的方式为客户提供增值服务；同时积极整合上下游资源，建成原材料、营销渠道的战略合作联盟体系，通过上下游的一体化实现整个产业链的互动。

(3) 注重制造品牌建设，准确定位品牌形象

形成知名制造品牌，是扩大市场份额、形成差异性竞争优势的有力保障。通过向客户提供末端产品设计，向市场提供国际品质、国内价格的产品，确立公司低成本、高品质制造品牌的国际影响力和品牌形象。

2、核心业务——SMD 谐振器

业务定位：公司核心主导业务

业务目标：持续稳定扩大行业领先优势，成为国内规模最大、产品技术最先进、品质最稳定的 SMD 谐振器制造商。

战略重点：整合外部资源，倾斜资源投放，重点培育渠道拓展能力、工艺技术能力和产品开发能力，扩大生产规模，通过 OEM、直销等方式迅速扩大市场份额，实现盈利快速增长。

(1) 重点保障资源投放

SMD 谐振器业务在国内已处于领先地位，下一步将引进国际先进生产和检测设备，配备充足的技术、管理等人力资源，整合外部资源，通过与国际一流公司建立战略合作伙伴关系，突破原材料及技术制约。

(2) 提升技术实力

进一步巩固并扩大领先优势，拉开与其他晶体制造企业的实力差距，以开放的视野关注国际技术发展趋势，以国际一流公司为标杆，通过与之建立战略合作伙伴关系，前瞻性地开发和管理产品系列，不断提升技术和品质，以扩大产能和市场。

(3) 优化产品营销模式

加强市场开拓力度，积极开拓国际性的行业领先客户，利用领先客户的样板效应，搭建营销网络，加快直销客户开发，重点发展直销客户和具有制造背景的进口商，以优化客户结构，确保产品市场份额和产品盈利能力。按照不同的产品区分管理不同的渠道，建立起 OEM、自主品牌两种市场开拓和渠道管理体系。

3、新兴业务——SMD 振荡器等业务

业务定位：公司未来新的经济增长点

业务目标：成为国内 SMD 振荡器领域的总成本领先企业之一。

战略重点：借助在谐振器领域积累的资源和能力，通过资源和能力的共享转移，采用跟进策略，争取与领先企业进行战略合作，推进 SMD 振荡器协同发展。

(1) OEM 奠定基础

通过为国际知名企业做 OEM 来提升技术水平，积累生产经验和培养专家团队；通过 OEM 等形式进行联合开发，公司可以获得技术支持和品质提升；同时，合作及 OEM 的市场技术壁垒小，竞争程度较小，是公司介入这一新领域较为稳妥的方式。

(2) 时机成熟后自主开拓市场

加快晶体元器件相关产品如振荡器、应用于通讯领域的谐振器、更先进的汽车电子晶体元器件等产品研发，加强技术支持和品质提升，在实现自主化批量生产后，再进行积极主动的市场开拓，采用“捆绑销售”、“渗透销售”等营销策略，迅速扩张，为规模化低成本生产奠定基础。

4、非战略性业务——电容业务

战略重点：机制转变，注入新的活力

重点关注实现电容业务的机制转变，转变经营模式，给予独立发展空间，从而为其注入新的活力。通过选配合适人才，分立运作，专人负责；建立独立核算机制，以事业部、子公司、承包等独立运作方式提高经营机制的灵活性，通过利益挂钩，激发活力。

（二） 研究开发计划

公司产品研发着眼点在于：加强应用研发，注重工艺改进，提升研发实力

1、 推行“三化”策略

（1）关键技术自主化

跟踪当前下游行业的主要终端应用领域，学习领先企业的技术发展方向，加大关键技术的学习和引进力度，提升自主设计能力，在关键技术领域形成自主知识产权体系。

（2）技术应用客户化

跟踪日本、中国台湾领先企业终端市场需求趋势和晶体元器件产品的技术发展趋势，把握客户需求，通过不断的工艺完善与创新，使需求与技术合理匹配，实现在保证质量、满足需求（量与功能）的同时降低成本。

（3）制造工艺特色化

改进和创新现有产品的制造工艺技术，形成与“自动化——手工操作”制造模式相适应，有公司特色的高效率、高品质、低成本的制造模式，构建公司制造核心竞争力。

2、 研发管理科学化

重点抓好项目组建、项目计划、项目进程控制三个关键环节。通过加强市场情报收集和分析，做好立项前的充分调研；同时，组建起结构健全、稳定的项目团队，制订周密而严谨的项目计划，有效控制项目进程；推行项目经理负责制，落实职责，通过项目绩效考核和技术人员的激励体系，确保技术开发有序进行；并注重研发成果利用和保护以及技术档案的整理完善，为高层决策提供支持。

3、 加强技术开发人才队伍建设

加强研发队伍建设，引进和培养具有市场观念的技术人员和具有国际技术

水准的设计开发人员，强化技术开发人员的市场和客户意识，形成工艺改进创新和终端应用设计两支专业队伍，提升研发实力。通过健全三级技术服务体系，将公司的产、销、研有机结合在一起，强化市场反应机制。

（三） 生产运营规划

公司立足于建立低成本、高品质的生产运营系统，并采取如下措施：

1、 进一步扩大产能，获取规模经济的成本优势

加大生产制造能力投入，合理规划不同类别产品产能，充分利用成熟产品外部生产产能，确保产能为扩大市场空间、实现规模效益、达到规划目标提供保障。

2、 确保生产体系高效化运作

建立标准化的运作流程体系和科学的生产调度体系，通过合理安排生产、增加生产灵活性，提高产能利用率；其次，建立精细化的基于产品的成本核算及分析体系，为降低成本提供工具和指明方向；加强人员技能培训，加强设备管理，确保生产高效运作，为总成本领先战略提供有力支持。

3、 积极探索生产管理模式

总结和提炼生产管理经验，结合整体业务发展，针对不同业务产品，积极进行生产管理模式探索，不断积累、总结提炼公司生产管理经验，实现生产管理经验的知識化、规范化、标准化，为未来整合外部生产资源做好准备。

（四） 营销规划

公司着力于建立基于市场和技术的专业营销体系。

1、 利用技术营销，加强市场开拓

建立起涵盖市场、销售、客户服务与技术支持三项职能的专业营销体系，引进和培养销售工程师，通过具有技术背景的人员参与销售，利用现有知名大客户的优势，在国际、国内两个市场大力开发领先客户，实现研、产、销一体化运行的整体营销，巩固并扩大传统领域销售，开拓新兴领域销售，提高市场占有率。

2、 优化客户结构，健全客户管理

通过领先客户开发所形成的样板效应，加大直销客户的比例，优化客户结构，降低客户结构性风险；加强对客户进行价值评估和分类管理，确保对主要客

户的优先服务，保障主要客户的稳定性。

3、构建营销渠道，探索专业贸易

通过自主建设和国际合作，拓展多样化的营销渠道，借助各种外部资源，积极进行专业贸易探索，获取更多产业价值链利润点。

4、加强情报分析，监测市场态势

注重市场动态、技术趋势、竞争对手、政策等信息的采集、分析，密切关注市场现状和发展趋势，充分利用各种机会。

（五） 资源整合规划

公司以整合外部资源，通过竞争性合作实现多赢。整合国际、国内同行企业资源，在技术、产品、原材料、营销等各方面建立战略联盟，通过优势互补，实现多赢；整合上下游产业链资源，与客户及供应商建立良好而紧密的合作，实现整个产业链的系统；整合政府及行业组织资源，与政府、媒体、高校、研究机构、行业协会、专业顾问等建立友好协作关系；做好政策利用、信息共享等工作，为公司发展争取政策资源。

（六） 人力资源计划

1、 建立和完善人力资源管理体系

人力资源工作的长期目标是建成科学系统的人力资源管理体系。通过完善工作分析、职责描述、培训、考核、激励体系建设，营造良好的用人环境，使人力资源成为公司未来的核心竞争力之一，从而保障战略有效实施和企业的可持续发展。

人力资源工作近阶段的重点是抓好人才引进、培养和降低流失率。完善招聘和培训体系，通过引进具有专业知识和技能的专业人才，合理配置人员，形成引进一个，培养多个的人才培养和成长机制；建立起以 KPI（关键业绩指标）为核心、结合态度和能力的绩效考核，实现战略目标的层层分解和落实；建立和完善激励体系，实现对人力资源的组合式激励，建立一个“对内具有公平性、导向性、激励性，对外具有竞争性”的薪酬体系，最终打造一支专业化、高效率的管理团队和稳定的员工队伍。

2、 构建企业文化，培育员工爱岗、敬业、乐群、与公司共创、共赢、共

荣的企业核心理念。

3、针对不同岗位业务人员，定期开展培训。各业务部门要编制年度培训计划。对一般操作工人的培训，由产品设计或工艺技术人员结合操作技术，讲解生产技术原理、不同产品性能要求、生产设备构成、性能以及发展趋势等，提高操作工人的技术水平；通过外聘专家来公司讲授或举办短期培训班提高专业人员水平；鼓励工程技术人员结合业务需要赴高等院校进修深造。

（七）再融资和投资计划

本次股票发行募股资金到位后，公司将按计划投入募股资金投资项目，争取取得预期的经济效益。

公司不排除今后根据情况通过发行新股、债券等方式来筹集资金，以满足公司发展的需要，但公司对再融资将采取谨慎的态度。

公司将充分发挥信用优势，继续与各银行保持密切联系，利用银行短期贷款额度补充企业短期性资金需求；认真进行资本运作，利用各种优惠政策，提高资金的使用水平，努力降低融资成本，防范和降低财务风险，确保股东权益最大化。

同时，公司将重视股东现金回报，形成融资与分红的良性循环。

四、拟定上述计划所依据的假设条件

上述计划的实现，主要取决于公司自身的努力，同时也取决于资金的到位情况和经济环境的良好状态。如果企业扩大生产规模，产品结构升级所需资金不能如期到位，将影响项目建设周期，如果国内或国外的经济环境恶化，上述整体经营目标也可能会受到影响。

公司拟定上述计划所主要依据以下假设条件：

1、本次募股资金计划投资的各项项目能够按预定计划开工建设，并按预定计划顺利投产；

2、国家宏观政治、经济、法律、产业政策和社会环境等，没有发生不利于本公司经营活动的重大变化；

3、公司各主要产品的市场容量、行业技术水平、行业竞争状况没有发生不利于本公司经营活动的重大变化；

4、本公司现有管理层和公司实际控制人在未来三年内没有发生重大变化；

5、无其它人力不可抗拒因素造成的重大不利影响。

五、实施上述计划所面临的主要困难

1、公司所在的浙江省金华市，在吸引、聘用足够数量的高层次专门人才，特别是技术、财务、法律、金融、管理、营销人才等方面，因城市条件的限制，将面临一定的困难。高级专业人才的培养也可能跟不上企业发展的步伐。

2、在较大规模资金运用和公司较快扩张的背景下，公司在战略规划、组织设计、机制建立、资源配置、运营管理，特别是资金管理和内外管理控制等方面都将面临更大挑战。

3、公司生产能力不足，制约了公司对市场的大规模拓展，急需大量资金投入。

4、公司的融资渠道尚待进一步优化。公司目前主要依靠债务融资的手段获取急需的资金，渠道单一，存在较大的局限。同时，债务融资额度有限，难以满足公司快速发展的需要，也不利于改善公司的资产负债结构。

六、上述计划与现有业务的关系

现有业务所取得的成就对实现未来发展目标提供了坚实的基础和支持，上述发展计划是按照公司发展战略要求，对现有业务的进一步发展。未来三年公司在科技创新开发、生产经营和销售、人力资源扩充、国际、国内市场开辟等方面均会比目前有较大提高，尤其是募股资金的运用，会使现有业务规模与公司实力大大提升。

在加速科技创新、增强技术开发能力上，公司拟继续与石英晶体科研院所（如浙江大学、宁波大学）等单位合作。目标是进一步强化自主研发能力，跟踪国际同类产品前沿技术，提高产品的技术含量和附加值，保持公司的产品技术在行业的领先地位，为公司的业务发展增强后劲。

七、本次募股资金运用对实现上述计划的作用

本次募股资金运用对于公司实现发展规划具有重要意义，主要体现在：

1、虽然公司目前在国内同行业中处于领先地位，但与国外先进厂商比还具有一定的差距。必须进一步加大科研投入的力度，增强后续创新能力，加强对新工艺和先进技术装备的投入，为实现计划目标提供保证。

2、项目实施完成后，将新增形成年产 10,800 万只 SMD 谐振器和 1,500 万只 SMD 石英晶体振荡器的生产能力。产品主要应用于移动电话、笔记本电脑、汽车电子设备等领域。产品的技术性能指标和质量达到国内领先水平并接近当代国际先进水平。

第十三节 募股资金运用

一、预计募股资金总量及投向

(一) 预计募股资金总量、投向及其依据

公司本次公开发行股票预计筹集资金约 14,080.00 万元，扣除发行费用约 1,301.42 万元，实募资金净额约 12,778.58 万元。经公司 2005 年度股东大会审议批准，公司本次募股资金拟投资以下项目：

序号	投资项目	总投资(万元)	备案情况
1	新型高精度 SMD 石英晶体元器件技改项目	8,800	金经投资备案 [2006]003 号
2	玻璃封装 SMD 石英晶体谐振器技改项目	3,243	金经投资备案 [2006]014 号
3	表面贴装元件用石英晶体频率片技术改造项目	3,341	金经投资备案 [2006]72 号
	合计	15,384	

(二) 本次募股资金运用计划

1、募股资金投资项目的优先次序和投资计划

单位：万元

优先性	项目名称	项目总投资	已完成投资	募股资金到位后	
				第一年	第二年
1	新型高精度 SMD 石英晶体元器件技改项目	8,800.00	2,084.54	6,715.46	-
2	玻璃封装 SMD 石英晶体谐振器技改项目	3,243.00	1,536.81	1,706.19	-
3	表面贴装元件用石英晶体频率片技术改造项目	3,341.00	-	2,000.00	1,341.00
	合计	15,384.00	3,621.35	10,421.65	1,341.00

2、募股资金的管理

2006年3月23日召开的公司第一届董事会第五次会议审议通过《浙江东晶电子股份有限公司募集资金专项存储制度》，本公司将严格按照该制度的要求管理和使用募股资金。

2006年4月28日召开的公司2005年度股东大会审议通过本次募股资金投向上述三个项目。如本次募股资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将以自有资金或银行贷款解决资金缺口；如本次募股资金超过拟投资项目的资金需求，剩余资金将用于补充公司流动资金。

本次募股资金到位前，公司已利用银行贷款和自有资金先行实施了部分项目，募股资金到位后将优先偿还公司因先行实施上述项目所使用的银行贷款及抵补相应的自有资金。

二、募股资金投资项目的市场前景及必要性分析

公司本次募股资金投资项目所生产的产品均为公司目前的主营业务产品，项目实施后，公司产品结构进一步优化，生产能力、技术含量和附加值得到提升，产品供不应求的矛盾得以缓解，参与国际高端市场的竞争力增强，公司在行业内的领先地位更加稳固。

（一）行业发展趋势

随着信息产业的高速发展，电子产品不断更新换代，极大地带动了石英晶体元器件市场需求的快速增长。同时，电子整机产品向小型化、轻型化、薄型化发展，与之相配套的各类电子元器件也随之迅速向小型化、片式化、表面贴装化发展，以适应整机生产表面贴装化和装配自动化的需要，SMD石英晶体元器件因而成为世界石英晶体元器件制造业的主流产品。日本石英晶体元件SMD比率由1995年的18.8%提高到2005年度的66.29%，我国内资企业石英晶体元器件中，SMD比率由2000年的0.1%增加到2005年度的10%，我国台湾企业几乎全部生产SMD石英晶体元器件。我国《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》明确将“发展相关的片式电子元器件”作为未来5~15年发展的重点之一。

压电晶体元器件除了向SMD方向发展以外，SMD石英晶体元件小型化趋势也在加快，譬如，随着手机向超薄和多功能方向发展，特别是3G手机越来越需

要规格更小的石英晶体元器件。目前手机用SMD石英晶体元器件的主流产品尺寸已发展到3.2mm×2.5mm，今后2.5mm×2.0mm或更小规格的产品将取而代之，其小型化趋势十分明显。

（二） SMD 石英晶体元器件市场情况分析

1、 SMD石英晶体元器件市场需求情况

全球石英晶体元器件的需求情况及其变动趋势详见第六节“业务与技术”之“二、公司所处行业基本情况（九）行业市场容量”。

（1）新型高精度SMD石英晶体元器件的市场需求情况

新型高精度SMD石英晶体元器件主要应用于移动通讯产品和汽车电子等产品中，市场需求广泛，目前国内外市场均呈供不应求状态。

公司本次募股资金投资项目“新型高精度SMD石英晶体元器件技改项目”的产品定位以信息技术领域及汽车电子领域为重点，主要应用于移动电话、汽车电子、数码相机等产品。移动电话是该项目产品最主要的应用对象，近几年一直保持较好的增长势头；与此同时，移动电话的功能也在不断地增多，如增加了彩铃、拍照、上网等附加功能，使其单位产品所需配置的SMD石英晶体元器件数量进一步提高，而3G手机的推出更会促使市场对高精度SMD石英晶体元器件的需求量迅猛增长。2006年通讯领域及汽车电子应用领域石英晶体谐振器和振荡器市场容量达48.6亿只，且每年全球需求量以10%以上的速度增长。预计2007年、2008年通讯领域及汽车电子应用领域石英晶体谐振器和振荡器市场需求53.5亿只和58.8亿只。

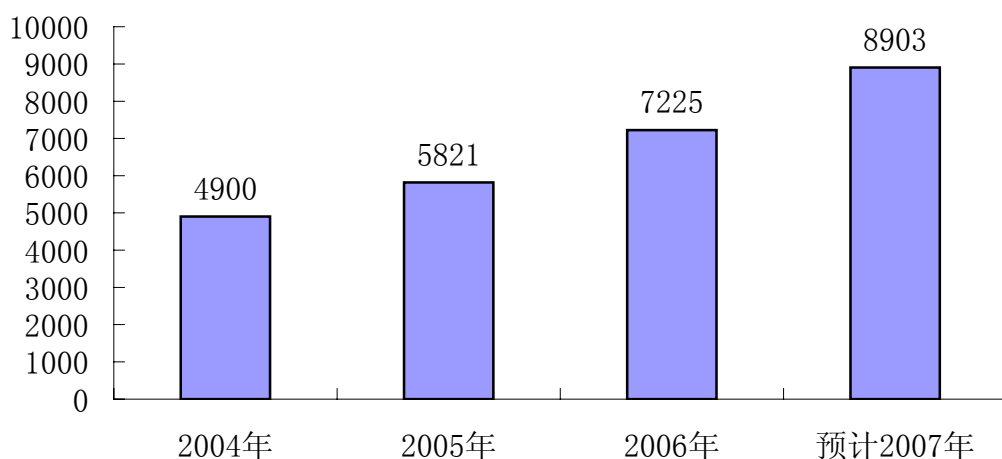
（2）玻璃封装SMD谐振器的市场需求情况

公司本次募股资金投资项目“玻璃封装 SMD 谐振器技改项目”的产品主要应用于资讯领域（笔记本电脑、台式微机、服务器、打印机、移动硬盘、光盘驱动器、传真机）；网络产品（网络控制、网络接口及适配器、网络连接器、网络检测设备）；家用电器（液晶电视、数码摄像机、数码相机、机顶盒、DVD、MP3、光盘刻录机、家用音响）；2006年资讯领域、家用电器领域石英晶体谐振器市场容量达35亿只，且每年全球需求量以10%以上的速度增长。预计2007年、2008年全球需求量38.5亿只和42.4亿只，市场潜力非常大。

以笔记本电脑为例，笔记本电脑是IT领域颇具成长潜力的产品，随着功能

的不断增强，价格的持续下滑，笔记本电脑不再是台式机的补充，而越来越成为消费者的首选。在全球各地区，笔记本电脑的销量增长幅度都要比台式机高，其中，美国市场笔记本电脑的销量已经超过台式机。

全球笔记本电脑销量（万台）



（数据源自：《2006-2007年中国笔记本电脑产业研究报告》，水清木华研究中心）

2、SMD石英晶体元器件生产的主要情况

据中国电子元件行业协会统计，2006年度中国压电晶体元器件产量为65亿只，其中SMD产量20亿只（包括外资企业），占总产量的30.77%；国内前七大晶体元器件企业的SMD产量为2.5亿只，占国内总产量的20%左右。

根据中国电子元件行业协会预测，今后几年我国SMD石英晶体元器件的产量仍将保持高速增长，到2010年，我国内资企业的SMD产量将超过20亿只（其中包括振荡器4亿只）。

从产品结构看，在日本，2000年SMD石英晶体元器件是以SMD8045、SMD7050、SMD6035为主，2005年度已经以SMD5032、SMD3225为主，SMD2520产品也开始量产。据统计，2005年度日本SMD的主要产品规格与产量情况如下表（摘自2006年中国电子元件行业协会压电晶体分会年会资料）：

产品规格	SMD8045	SMD5032	SMD3225	SMD2520
产量（万只）	21,500	51,000	57,000	4,270

我国内陆企业SMD石英晶体元器件起步较晚，除本公司外，目前国内主要的SMD生产企业中，只有少数企业已经实现SMD5032规格的量产并完成SMD3225规格的开发，与手机企业的实际配套不多，基本处于认证、送样试用阶段。

与笔记本电脑配套的玻璃封装SMD谐振器的最大生产企业为日本NDK公司，中国台湾的亚陶晶体科技股份有限公司也是重要的玻璃封装SMD谐振器生产企业。在国内内资企业中，本公司具有批量生产的能力，主要的竞争对手为两家台资企业杭州鸿星电子有限公司和台晶（宁波）电子有限公司。

（三） 公司 SMD 石英晶体元器件的经营情况

公司自2003年实现SMD石英晶体元器件批量生产以来，一直注重相关产品的开发，并采用滚动发展的方式，不断利用自身的积累扩大SMD石英晶体元器件的生产规模。公司在SMD石英晶体元器件的研发水平、生产规模、产品档次和生产设备等方面均处于国内领先水平（关于本公司SMD的经营情况详见本招股说明书之“第六节 业务与技术”中相关内容）。近三年一期公司SMD石英晶体元器件的产销量情况如下表所示：

单位:万只

产品	2007年1~6月		2006年度		2005年度		2004年度	
	产量	销量	产量	销量	产量	销量	产量	销量
8045(G)	1,617.40	1,407.70	3,497.24	3,469.63	3,233.23	3,286.83	1,924.36	1,915.32
7050(S)	465.06	440.71	1,105.12	1,163.64	636.54	698.23	590.06	601.29
6035(S)	936.10	910.00	1,419.61	1,354.23	475.22	471.30	227.02	219.63
5032(S)	458.00	468.80	425.06	411.87	165.91	161.90	-	-
5032(G)	1,370.03	1,339.25	1,749.93	1,746.83	319.00	324.62	-	-
合计	4,849.59	4,566.46	8,196.96	8,146.20	4,829.90	4,942.88	2,741.44	2,736.24

注：S表示金属封装的SMD石英晶体元器件，G表示玻璃封装的SMD石英晶体元器件。

为抓住近年行业迅速发展的好机遇，在本次募股资金到位以前，公司已经利用银行贷款和自有资金对募股资金投资项目进行了投资。截至2007年6月30日，公司共投入资金3,621.35万元，用于生产车间的改造及引进SMD关键生产设备。完成上述投入后，公司SMD谐振器的产量增加了300万只/月，其中，金属封装

SMD5032的产量增加了150万只/月，玻璃封装SMD5032的增加了150万只/月。

公司本次募股资金到位后，所筹资金首先偿还用于募股资金投资项目的银行贷款及抵补相应的自有资金，其余资金用于项目的继续建设。项目全部完成后，SMD石英晶体元器件的年生产能力将达到23,000万只，在产品结构进一步优化的同时，充分发挥规模效应，增强在国际市场上的竞争能力，从而促进公司“全球领先的石英晶体元器件供应商”愿景目标的实现。

（四） SMD 石英晶体频率片配套情况

石英晶体频率片是电子元件石英晶体谐振器的核心，晶片的开发水平直接决定着谐振器的发展水平。晶片是谐振器的设计、生产时所必须考虑的首要因素，其性能的稳定性是衡量谐振器品质的重要技术指标。目前国内生产SMD晶片的企业大多规模偏小，产品集中在产业的中低端市场。国内较知名及具规模的晶片（包括DIP石英晶片和SMD石英晶片）厂家有：

晶片生产企业名称	产能（万片/月）
珠海东锦石英科技有限公司	4,500
深圳泰美克晶体技术有限公司	3,000
菲特晶（南京）电子有限公司	3,500
浙江东晶电子股份有限公司	2,000
湖北致远电子股份有限公司	1,500
北京石晶光电股份有限公司	1,500
南京德研电子有限公司	1,500

国内除了专业加工企业生产石英晶片外，部分石英晶体元器件生产企业采用自配套的方式解决原材料的供应问题。本公司目前生产高频、中频、低频多个频率晶片，规格尺寸主要有 SMD8045、SMD7050、SMD6035、SMD5032 等。

本公司石英晶片产量的变动情况如下表所示：

单位：万片

类别	2007年1~6月	2006年度	2005年度	2004年度
----	-----------	--------	--------	--------

DIP 石英晶片	7,915.85	14,852.46	9,629.08	8,174.33
SMD 石英晶片	3,133.47	6,468.77	2,610.21	281.92
合计	11,049.32	21,321.23	12,239.29	8,456.25

根据企业战略规划，综合分析 SMD 石英晶体元器件的市场需求，公司计划在 2009 年以前 SMD 石英晶体元器件产能达到 24,000 万只/年，DIP 石英晶体元器件达到 21,600 万只/年的产量，按晶片生产供后续谐振器用损耗率 90% 计算，公司目前晶片 24,000 万片/年的生产能力无法满足自产石英晶体元器件的配套需要。

公司本次募股资金投资项目“表面贴装元件用石英晶体频率片技术改造项目”实施后，将增加 SMD 石英晶片 24,000 万片/年的生产能力，用于 SMD 石英晶体元器件的配套，原有的晶片生产线将全部用于 DIP 石英晶体元器件的配套。公司 SMD 石英晶体频率片实现自我配套，保证了及时供货，降低了成本，提高了效率，又可在后续使用中快速反馈晶片的质量，进而提高晶片的生产水平，为 SMD 石英晶体元器件的生产提供有效的保证。

（五）募股资金投资项目新产品与现有产品的联系

		产品	目标客户	营销渠道
公司现有产品		DIP SMD8045 (G)、 SMD8045 (S)、 SMD7050(S)、SMD6035 (S)、SMD5032 (S)、 SMD5032 (G)	台湾、日本等知名企业配套，应用于通讯、资讯、网络、家用电器等领域。	中间商销售、直销和 OEM 并重
募 集 投 资 项 目	新型高精度 SMD 石英晶体元器件技改项目	SMD5032、SMD3225、 OSC7050、OSC5032	日本、美国、台湾为目标市场，增加松下、佳能等长期合作客户供货量，定位以通讯领域及汽车电子领域为重点，主要应用于手机、小灵通、对讲机及汽车 GPS 导航系统、引擎控制系统、车体遥控系统、安全感应、车载娱乐系统等产品。	OEM 和中间商销售为主

目	玻璃封装 SMD 石英晶体谐振器技改项目	SMD8045(G)、SMD5032(G)	目标市场是台湾，主要定位于资讯、网络及家用电器领域。主要应用于笔记本电脑、移动硬盘、服务器、网络控制设备、网络检测设备、数码摄像机、数码相机、机顶盒、DVD、MP3、光盘刻录机、数码相机等产品。	自有品牌销售和 OEM
	表面贴装元件用石英晶体频率片技术改造项目	石英晶体频率片	公司配套用	内部配套

公司拟采取的营销措施如下：

1、现有客户深度开发。本次募集资金投向主要是用于扩大公司现有产品生产能力并拓展其产品系列，可以充分利用公司现有市场、人才、技术和装备，对现有产品客户进行深度开发。这些产品具有自主知识产权和核心竞争力，市场优势明显，市场潜力较大。

2、公司将充分发挥技术创新的优势，不断开发符合市场需要的新产品，保持产品技术和质量的先进性，扩大产品的市场应用领域，有效降低产品市场风险。

3、公司将继续强化管理优势和品牌优势，提高产品质量，降低生产成本，确保公司产品的盈利空间。本次募集资金投资项目的达产，可以在扩大产品规模、增强产品配套能力的同时，进一步降低生产成本，增强公司产品的市场影响力。

4、公司将进一步加强营销机构的建设和营销队伍的培养，充分发挥公司已成为全球众多知名企业合作伙伴的优势，进一步加大市场的开拓力度，提高公司产品的市场占有率。

5、公司将不断提高售前、售中、售后服务质量和客户满意度，以服务带动销售，重视中间商的积极作用，通过各种方式与行业内的经销商及客户形成战略联盟，重视全球视野下的本地化营销计划，以“全球品质，本地营销”的方式开拓市场。

三、募股资金投资项目的技术来源和技术保障

(一) 技术来源

1、新型高精度 SMD 石英晶体元器件技改项目

本项目技术来源于公司自主研发。2003 年金华东晶通过与台湾晶技技术合

作消化吸收 SMD8045 (G)、SMD7050 (S) 生产技术, 为满足电子整机产品向小型化发展, 电子元器件向高精度、低功耗、片式化、小型化发展, 2004 年至今公司自主开发了更小型的 SMD6035 (S)、SMD5032 (S)、SMD5032 (G)、SMD3225 (S) 产品。从技术角度上讲, 本项目产品 SMD5032、SMD3225、OSC7050、OSC5032 都是在原有产品 SMD7050、SMD6035 的基础上向更小型化延伸的高端产品, 适应了电子整机产品向“轻、薄、短、小”以及多功能、数字化、智能化、低功耗的发展方向; 本项目产品 SMD5032 (S) 技术成熟, 已批量供应市场, 且供不应求, 本项目将进一步扩大其产能; 本项目产品 SMD3225 (S)、OSC7050、OSC5032 已从 2007 年 6 月起接受客户订单, 目前部分产品已开始批量供应客户。

2、玻璃封装 SMD 石英晶体谐振器技改项目

本项目技术来源于公司自主研发, 应用了多项技术创新, 2005 年底通过浙江省科技厅新产品鉴定“东晶电子全面掌握了 SMD 石英晶体谐振器的工作原理, 并突破了 SMD 石英晶体谐振器中石英晶片切割、研磨抛光、测试、器件组装等技术难关, 并设计出了有效的相关技术工艺路线, 成功地解决了 SMD 石英晶体谐振器玻璃封装技术, 该产品各项技术性能指标均达到了国外同类产品水平, 技术国内领先”。本项目产品列为 2006 年度浙江省重点高新技术产品。现阶段本项目 8045 (G)、5032 (G) 产品均已经大批量供应市场。

3、表面贴装元件用石英晶体频率片技术

该技术是由公司自行开发的, 拥有自主知识产权。公司的主要开发技术人员具有 10 年以上的石英晶体频率片开发技术, 为了增强晶片开发能力, 2005 年公司特别购置了国际最先进的晶片外形检测设备, 增强了产品检测分析能力, 进一步提高了产品开发水平。同时公司通过与行业内知名企业进行技术交流, 消化吸收先进技术并应用于产品的研发和生产, 通过不断改进生产工艺, 提升产品品质, 目前公司自行研发的表面贴装元件用石英晶体频率片已经批量生产, 但由于设备生产能力的限制, 尚无法满足公司自身配套的需求。

(二) 技术保障

1、新型高精度 SMD 石英晶体元器件技改项目

本项目运用公司拥有的专有技术“SMD3225 超小型石英晶体谐振器设计制

造技术”、“金属封装 SMD 石英晶体谐振器设计制造技术”、“石英晶体谐振器与应用线路的匹配技术”和“SMD 石英晶体振荡器设计制造技术”，并对本项目产品进行了三方面的技术创新：

(1) 精确对位封装技术：采用 CCD 摄像技术，计算上盖和底座之间的相对误差，并通过高精度的马达调整相对位置，保证上盖和底座的精确对位，从而保证了封装的气密性和稳定性。

(2) 真空溅射银电极技术：国内率先采用真空溅射的方式来制作银电极，用离子蚀刻的方式调整频率，使 SMD 石英晶体元器件的频率精度更高、可靠性更好。

(3) 特殊的烘烤工艺：采用高真空老化工艺，提高了 SMD 石英晶体元器件耐高温特性，为整机厂的回流焊工艺提供了良好的保障。

本项目产品已获国家专利（专利号：ZL200420110632.5），并被浙江省列为 2006 年度“浙江省重点技改项目”。

2、玻璃封装 SMD 石英晶体谐振器技改项目

本项目运用公司拥有的专有技术“石英晶体谐振器的无铅化技术”、“玻璃封装 SMD 石英晶体谐振器设计制造技术”和“石英晶体谐振器与应用线路的匹配技术”，并对本项目产品进行了两方面的技术创新：

(1) 减少焊点工艺设计。通常的 SMD 谐振器采用 4 个焊接点，其中 2 个焊接点作为接地使用。本项目产品采用了 2 个焊接点设计，减少了 2 个焊接点，不仅节约了两个焊接点的生产成本，而且降低客户的采购成本。

(2) 采用氧气含量在 30PPM 以下的玻璃高温烧结封装。一台烧结炉的价格是一台平行焊接设备的三分之一，而产量可提升 3 倍，通过创新使投入成本更低，产能也得到大幅提升。

本项目产品已获国家专利（专利号：ZL200420110635.9），并被国家科技部列为 2006 年度“国家重点新产品计划”。

3、表面贴装元件用石英晶体频率片技术改造项目

本项目运用公司拥有的专有技术“小尺寸 SMD 石英晶体谐振器用的晶片设计制造技术”，并对本项目产品进行了四方面的技术创新：

(1) 采用独特的晶片加工方法，提高产品的加工精度。公司通过改善设备使晶片尺寸精度高于国内同行业企业的精度标准，确保了产品的高品质和高精

度。

(2) 晶片线切割技术：业内以前采用传统的金属轮单刀切割晶片，目前普遍采用多刀切割，本项目采用先进的线切割技术。

(3) 倒边抛光复合技术：采用新型器具配合更精细的磨料对晶片表面进行抛光，提高晶片表面的光洁度，并形成独特的边缘平凸曲面，改善晶体等效参数及频温特性。

(4) 为了提高晶片表面的清洁度，相对于国内同行的清洗工艺和清洗剂，采用了新型的清洗工艺和清洗剂，达到了更好的清洗效果，同时更加环保。

在技术保障的基础上，公司拥有省级研发中心的技术开发团队，近三年一期累计投入研发费用近 3,000 万元，公司通过研究领先企业的技术发展方向，学习、引进及消化吸收关键产品技术，形成自主知识产权体系，促进项目的顺利实施。

四、募股资金投资项目概况

(一) 新型高精度 SMD 石英晶体元器件技改项目

本项目产品被浙江省经济贸易委员会列为 2006 年浙江省重点技改项目（见浙经贸投资 [2006] 196 号文件）。项目完成后，能够进一步提升产品档次，满足下游电子整机产品小型化、轻型化、薄型化的要求，有利于参与国际高端市场的竞争，提高产品市场占有率，增强企业整体盈利能力。

1、投资概算情况

本项目总投资为 8,800 万元，其中固定资产投资 8,200 万元（含用汇 808 万美元），铺底流动资金 600 万元，具体投资情况如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑工程	设备购置	安装工程	其它费用	合计	占总值比重
一	工程费用	200	6,760	395	252	7,607	86.44%
1.1	引进设备		6,304	378		6,682	
1.2	引进设备附加费				252	252	
1.3	国产设备		286	17		303	

1.4	公用工程		100			100	
1.5	环保设施		50			50	
1.6	消防设施		20			20	
1.7	净化厂房改造	200				200	
二	其它费用				200	200	2.27%
2.1	前期工作费				20	20	
2.2	职工培训费				40	40	
2.3	勘察设计费				30	30	
2.4	研发费用				110	110	
三	预备费用				393	393	4.47%
	基本预备费				393	393	
四	铺底流动资金				600	600	4.82%
	合计	200	6,760	395	1,445	8,800	100.00%

2、产品特性和工艺流程情况

(1) 产品情况

本项目主要是根据公司近几年来生产销售情况以及市场需求,结合公司的技术开发成果而制定。项目实施后,将新增年产 6,000 万只高精度 SMD 谐振器、1,500 万只高精度 SMD 石英晶体振荡器的生产能力。其中 SMD 石英晶体振荡器是在 SMD 谐振器基础上,增加一个 IC 振荡回路。

本项目产品高精度 SMD 石英晶体谐振器被浙江省科技厅列为 2006 年浙江省高新技术产品,具有以下特性:

①高精度。频率精度从 30ppm 提高到以 10ppm,满足网络化时代对 SMD 石英晶体元器件的频率精度(以及长期使用精度)越来越高的要求。

②金属封装。采用金属封装与采用陶瓷或玻璃封装相比,金属封装更适合于整机厂的回流焊工艺,而且产品精度更高,信号屏蔽性能好,相互干扰少。

③小型化。本项目生产 SMD5032、SMD3225 以及更小规格的产品。

产品质量严格按照 GB/T10708-1996《石英晶体元件-电子元器件质量评价体系规范第 3 部分:分规范——鉴定批准 第一部分:空白详细规范》的要求,同

时执行《浙江东晶电子股份有限公司企业标准》(Q/ZDJ001-2005), 此外还将分别满足不同客户的技术要求。

新型高精度 SMD 石英晶体元器件最终产品:

产品名称	产品规格	目标产能	用途
金属封装 SMD 石英晶体谐振器	SMD5032 SMD3225	6,000 万只/年	定位以通讯领域及汽车电子领域为重点, 主要应用于移动电话、汽车电子等产品。
SMD 石英晶体振荡器	OSC7050 OSC5032	1,500 万只/年	

目前, 公司已完成 SMD3225 产品的研发, 拥有 SMD3225 超小型石英晶体谐振器以及 SMD 石英晶体振荡器 OSC7050、OSC5032 产品的设计制造技术。其中 SMD3225 (S)、OSC7050、OSC5032 为公司开发的新产品且已通过台湾晶技、日本松下等公司的认证:

产品	认证客户	通过日期
OSC7050	台湾晶技股份有限公司	2006 年 11 月 12 日
SMD3225 (S)	台湾晶技股份有限公司	2007 年 1 月 10 日
OSC5032	日本松下公司	2007 年 3 月 9 日

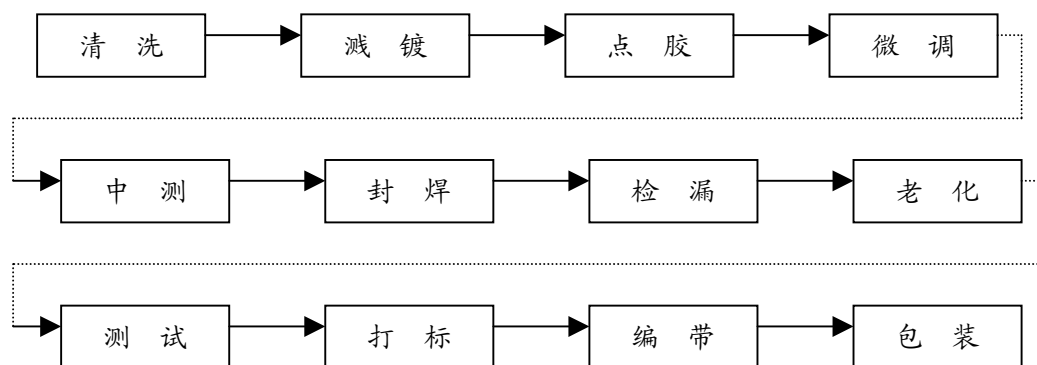
上述产品自 2007 年 6 月起接受客户订单, 已有亚陶晶体科技股份有限公司、上海虹日电子有限公司等 6 家客户与公司签定了《采购意向书》, 自 2007 年 7 月起, 公司的 SMD3225 (S)、OSC7050、OSC5032 产品开始批量供应客户。

SMD 石英晶体振荡器相当于是在 SMD 石英晶体谐振器的基础之上增加一个发振电路, 这个发振电路通常是一个 IC 电路。这个 IC 可以委托 IC 厂商焊接在陶瓷底座上, 其生产流程与 SMD 石英晶体谐振器的生产流程基本相同, 主要的区别是产品的测试设备不同。

该项目产品与公司原有产品目标客户基本相同, 从技术角度上讲, 该项目产品 SMD503232、SMD3225、OSC7050、OSC5032 都是在原有产品 SMD7050、SMD6035 的基础上向更小型化延伸的高端产品, 适应了电子整机产品向“轻、薄、短、小”以及多功能、数字化、智能化、低功耗的发展方向; 本次募集资金投资项目是本公司原有产品基础上的产品附加值提升的扩产项目, 其实施后不会改变本公司目前的生产、销售、结算等经营模式。

(2) 工艺流程

新型高精度 SMD 石英晶体元器件主要生产工艺分清洗、被银、点胶、微调、中测、封焊、检漏、老化、测试、打标、编带、包装等步骤。SMD 石英晶体振荡器与 SMD 谐振器相比，只是振荡器比谐振器多了一个震荡回路，其生产工艺流程基本相同。



3、选用的主要设备

本项目选用设备仪器的原则是：先进性、功能性、适应性和经济性，选用的设备包括排片机、真空溅镀机、真空微调机、自动装载机、上片点胶机、全自动封焊机 etc 关键设备 61 台，同时配套部分国产先进设备。项目选用的主要设备详见下表：

引进进口设备一览表

名称	数量	单价 (万美元)	金额 (万美元)	备注
排片机	4	6	24	日本
真空溅镀机	2	45	90	日本
真空微调机	4	30	120	日本
自动装载机	4	15	60	日本
上片点胶机	8	15	120	日本
He 检漏仪	2	5	10	日本
温测机	2	8	16	日本
烤胶炉	4	15	60	日本
全自动封焊机	3	50	150	日本
烧结炉	1	10	10	日本
晶体特性检测机	12	6	72	日本
检漏机	4	15	60	日本

晶体测试仪	10	1	10	日本
晶片外形测量仪	1	6	6	日本
合计	61	-	808	

新增国产设备一览表

设备名称	数量	单价(万元)	金额(万元)
制氮机	2	15	30
激光印字机	2	20	40
显微镜	6	1	6
测量显微镜	1	8	8
晶片分选机	12	6	72
空气压缩机	1	20	20
氮气柜	20	0.5	10
手动编带机	5	1	5
自动编带机	2	15	30
空调机	1	30	30
超声波清洗机	5	1	5
制冷机	1	30	30
合计	58	-	286

4、主要原材料、辅助材料的供应情况

本项目产品所需的主要原材料有水晶（晶片）、基座、外壳（合金）和芯片，辅料为产品包装物。公司经过多年的经营，已与国内外原材料供应商及相关企业建立了良好的供需渠道及协作关系，能够及时了解材料市场的动态，合理地进行原材料的采购。芯片主要用于振荡器的生产，目前国内、国外市场也均有充足的供应。

5、项目的环保情况

本项目“三废”达标排放。公司将严格按照环境保护的规定，做好各项污染防治工作，确保环保设施正常稳定运行。

公司在项目审批过程中提交了环境影响申请报告，对该工程可能排放的污染物及其治理办法进行了详细的分析和说明。金华市环境保护局对该项目的环境影响评价报告书进行审查，并以金环建[2006]15号文批复同意该项目的建设。

6、项目的选址及场地情况

本项目在公司厂区内实施，生产车间利用现有厂房。

7、投资项目的竣工时间、产量、产品销售方式及营销措施

本项目投资建设预计可以在募股资金到位后一年内完成，生产期第一年为生产能力的80%，第二年开始达产，即年产6,000万只高精度SMD谐振器、1,500万只高精度SMD石英晶体振荡器。

本项目投产后，采取与目前相同的订单管理的营销模式，以销定产，自有品牌和OEM销售共存。在自有品牌销售渠道方面，中间商销售和直销并重，逐步完善优化渠道网络。

本项目产品主要面对国外高端电子元器件市场，产品质量在国内居于领先水平，与日本等地企业相比具有较明显的价格优势，具备较强的市场竞争力，可以满足客户对高精度、小型化SMD石英晶体元器件的需求。公司已与国际知名客户建立了长期稳定的合作关系，为本项目产品的销售奠定了良好的基础。通过巩固同中间商的合作，建立了广泛的市场营销网络，同时开辟了新的客户资源，现已有多家客户向公司表达了购货意向。

8、项目的组织方式及实施进展情况

该项目以本公司为主体组织实施，项目建设完成后，由公司制造中心下属的SMD车间负责生产与日常管理。

目前，公司已经完成该项目的论证、选址、可行性研究报告编制、环境影响分析等前期准备工作。截至2007年6月30日，公司共投入资金2,084.54万元，主要用于生产车间的改造及引进真空溅镀机、微调机、全自动封焊机等关键生产设备。随着上述项目资金的投入，公司金属封装SMD5032石英晶体谐振器的月

产量提高了约 150 万只，新增销售收入约 190 万元/月，毛利约 55 万元/月。

9、项目效益分析

根据该项目的《可行性研究报告》，项目达产后可年新增销售收入 15,150 万元，实现净利润 2,386 万元。项目主要指标如下：

序号	指标名称	单位	计算值	备注
1	静态投资回收期	年	4.29	税前
			4.99	税后
2	动态 (i=12%) 投资回收期	年	5.86	税前
			6.22	税后
3	累计净现金流量	万元	34,591	税前
			23,177	税后
4	财务净现值 (i=12%)	万元	8,763	税前
			6,537	税后
5	全部投资财务内部收益率	%	35.32	税前
			26.58	税后

(二) 玻璃封装 SMD 石英晶体谐振器技改项目

1、投资概算情况

本项目总投资为 3,243 万元，其中固定资产投资 2,780 万元（含用汇 234 万美元），铺底流动资金 463 万元，具体投资情况如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	建筑工程	设备购置	安装工程	其它费用	合计	占总值
一	工程费用	100	2,380	137	37	2,654	81.84%
1.1	引进设备	-	1,872	112	-	1,984	-
1.2	引进设备附加费	-	-	-	37	37	-
1.3	国产设备	-	418	25	-	443	-
1.4	公用工程	-	50	-	-	50	-
1.5	环保设施	-	30	-	-	30	-
1.6	消防设施	-	10	-	-	10	-
1.7	净化厂房改造	100	-	-	-	100	-
二	其它费用	-	-	-	70	70	2.16%
2.1	前期工作费	-	-	-	20	20	-
2.2	职工培训费	-	-	-	20	20	-

2.3	勘察设计费	-	-	-	30	30	-
三	预备费用	-	-	-	56	56	1.73%
	基本预备费	-	-	-	56	56	-
四	铺底流动资金	-	-	-	463	463	14.28%
	合计	100	2,380	137	626	3,243	100.00%

2、产品特性和工艺流程情况

(1) 产品情况

本项目主要是根据公司近几年来生产销售情况以及市场需求，结合公司的技术开发成果而制定的。项目实施后，将新增年产 4,800 万只玻璃封装 SMD 谐振器的生产能力。

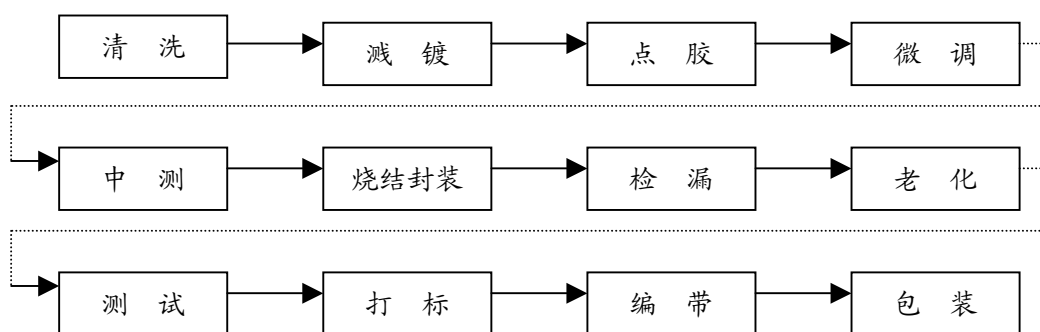
本项目产品被国家科技部列为 2006 年度“国家重点新产品计划”（见国科发计字〔2006〕377 号文件，证书编号：2006GRC20023），被浙江省科技厅列为“2006 年浙江省高新技术产品”，并获得国家专利（专利号：ZL200420110635.9），其特性表现为：

①成本低。相对金属封装等产品，玻璃封装 SMD 石英晶体元器件采用不同的材料和工艺，成本较低，市场竞争力强；

②市场容量大。产品主要用于笔记本电脑、机顶盒、U 盘等产品。

(2) 工艺流程

玻璃封装 SMD 谐振器主要生产工艺分清洗、被银、点胶、微调、中测、烧结封装、检漏、老化、测试、打标、编带、包装等步骤。



3、选用的主要设备

本项目引进排片机、真空微调机、自动装载机、上片点胶机、He 检漏仪、烧结炉、温测机、烤胶炉、晶体特性检测机、检漏机等关键设备 24 台，配套国产先进设备，详见下表：

引进设备一览表

名称	数量	单价(万美元)	金额(万美元)	备注
排片机	2	5	10	日本
真空微调机	2	30	60	日本
自动装载机	2	15	30	日本
上片点胶机	2	20	40	日本
He 检漏仪	1	5	5	日本
烧结炉	1	15	15	日本
温测机	1	8	8	日本
烤胶炉	2	10	20	日本
晶体特性检测机	4	5	20	日本
检漏机	1	15	15	日本
晶体测试仪	5	1	5	日本
晶片外形测量仪	1	6	6	日本
合计	24		234	

新增国产设备一览表

设备名称	数量	单价(万元)	金额(万元)
制氮机	1	15	15
激光印字机	2	20	40
显微镜	6	1	6
晶片分选机	12	7	74
空气压缩机	1	20	20
手动编带机	5	1	5
自动编带机	2	15	30
空调机	1	30	30
超声波清洗机	5	1	5
6S 研磨机	11	2	22

4S 研磨机	10	1.5	15
4B 研磨机	12	5	60
多刀切割机	3	3	9
滚筒机	3	5	15
频率监控仪	25	1.2	30
烘箱	6	0.5	3
水泵	2	2	4
电子除垢仪	1	1	1
冷却塔	1	4	4
制冷机	1	30	30
合 计	110		418

4、主要原材料、辅助材料的供应情况

本项目产品所需的主要原材料有水晶、陶瓷基座和陶瓷外壳，辅料为产品包装物，均有充足的供应。

5、项目的环保情况

本项目“三废”达标排放。公司将严格按照环境保护的规定，认真执行“三同时”，做好各项污染防治工作，确保环保设施正常稳定运行。

公司在项目审批过程中提交了环境影响申请报告，对该工程可能排放的污染物及其治理办法进行了详细的分析和说明。金华市环境保护局对该项目的环境影响评价报告书进行审查，并以金环建[2007]3 号文批复同意该项目的建设。

6、项目的选址及场地情况

本项目在公司厂区内实施，生产车间利用现有厂房。

7、投资项目的竣工时间、产量、产品销售方式及营销措施

本项目投资建设预计可以在募股资金到位后，生产期第一年为生产能力的 80%，第二年开始达产，即年产玻璃封装 SMD 谐振器 4,800 万只。

本项目投产后，将采取与目前相同的自有品牌与 OEM 销售共存的营销模式。公司自 2003 年开始生产玻璃封装 SMD 谐振器产品以来，销售网络已趋于完善，同国外一些主要的电子产品生产企业和经销商有着良好的合作关系。作为国内唯一能够大批量生产玻璃封装 SMD 谐振器的内资企业，公司已经在竞争中确立了市场领先地位。新项目投产后，公司将进一步扩大和提升营销网络体系，为本项目产品的销售提供更有力和切实的保障。

8、项目的组织方式及实施进展情况

该项目以本公司为主体组织实施，项目建设完成后，由公司制造中心下属的 SMD 车间负责生产与日常管理。为提高生产效率，减少工装夹具的更换频率，新项目实施后将主要用于 SMD5032 以下的小规格产品的生产，原有设备则主要用于 SMD5032 以上的大规格产品生产。

目前，公司已经完成该项目的前期准备工作，截至 2007 年 6 月 30 日投入资金 1,536.81 万元，主要用于生产车间的改造及引进了真空微调机、玻璃封焊炉等关键生产设备。上述资金的投入后，公司玻璃封装 SMD5032 石英晶体谐振器产量每月提高了约 150 万只，新增销售收入约 158 万元/月，毛利约 45 万元/月。

9、效益分析

根据该项目的《可行性研究报告》，项目达产后可年新增销售收入 5,760 万元，实现利润 1,068 万元，净利润 716 万元。项目主要指标如下：

序号	指标名称	单位	计算值	备注
1	静态投资回收期	年	4.71	税前
			5.56	税后
2	动态 (i=12%) 投资回收期	年	6.35	税前
			7.22	税后
3	累计净现金流量	万元	10,314	税前
			6,914	税后
4	财务净现值 (i=12%)	万元	2,628	税前
			1,666	税后
5	全部投资财务内部收益率	%	23.68	税前
			19.25	税后

(三) 表面贴装元件用石英晶体频率片技术改造项目

1、投资概算情况

本项目总投资为 3,341 万元，其中固定资产投资 3,200 万元（含用汇 205 万美元），铺底流动资金 141 万元。其中：建筑工程 384.33 万元，设备及安装工程 2,575.46 万元（含外汇 205 万美元），其他费用 240.21 万元。

2、产品特点和工艺流程情况

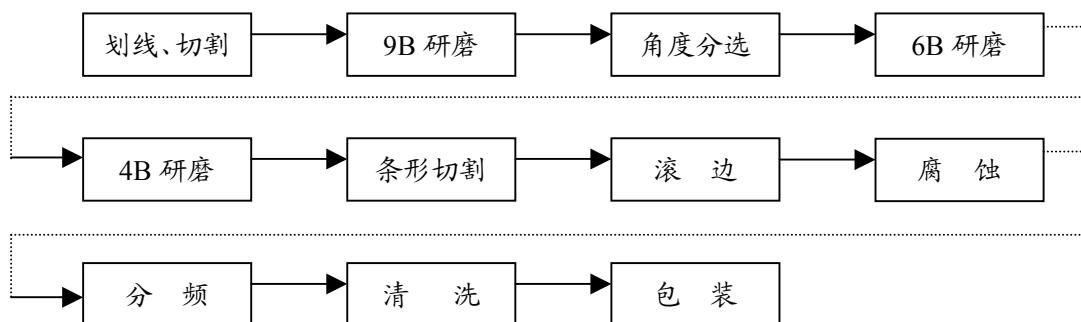
(1) 产品特点

石英晶片是压电石英晶体谐振器的关键部件，也是设计和制造中的关键技术所在。新型 SMD 石英晶体元器件精度高、尺寸小的特点，要求石英晶片在进一步缩小尺寸的同时必须保证其性能的稳定性。而晶片愈小，其性能愈不稳定，因此晶片的设计与加工都非常关键。

(2) 工艺流程

晶棒依设计需要以不同切割角度切成晶片，晶片再依不同规格以机械加工成圆形或长条形。成型后之晶片，经粗研磨、中研磨再精研磨达成预定设计之频率范围，经由自动频率检测机分别选出各种设计规格内之晶片，加以清洗后入库。

工艺流程示意图如下：



3、选用的主要设备

本项目需购置生产设备仪器140台（套），其中国产设备131台（套），进口关键设备仪器9台（套），新增设备清单如下：

序号	设备名称	单位	数量	产地/供应商
一、引进设备				
1	线切割机	台	5	日本
2	EFG 定向仪	台	4	德国
	引进设备小计		9	
二、国产设备				
1	多刀切割机	台	10	
2	X 光定向仪	台	5	
3	粘料机	台	1	
4	6B 研磨机	台	30	
5	4B 研磨机	台	50	
6	频率分选机	台	25	
7	倒边机	台	10	
	国产设备小计		131	
	工艺设备合计		140	

4、主要原材料、辅助材料的供应情况

本项目产品所需的主要原材料为水晶棒材，辅助材料包括研磨砂、切削液、游星轮和切割金属丝。上述材料在国内国际市场均供应充足。

5、项目的环保情况

本项目对环境的影响主要为生产过程中产生的工艺废水、生活污水、噪声以及固体废弃物等。污染防治对策从两个方面考虑：一是推行清洁生产法，把污染控制从原先的末端治理推向生产的全过程控制；二是末端治理措施，对废气、废水、噪声和固废等污染源提出相应的治理和防范措施，达标排放。

公司在项目审批过程中提交了环境影响申请报告，对该工程可能排放的污染物及其治理办法进行了详细的分析和说明。金华市环境保护局对该项目的环境影响评价报告书进行审查，并以金环建[2007]4号文批复同意本项目的建设。

6、项目的选址及场地情况

本项目利用公司现有厂区空余场地，根据生产规模新建频率片生产厂房4,366.60平方米。

7、投资项目的竣工时间、产量、产品销售方式及营销措施

本项目预计于募股资金到位后一年内建成投产，达产后将新增2.4亿片/年表面贴装元件用石英晶体频率片的产量，用于公司SMD石英晶体元器件的配套。

8、项目的组织方式及实施进展情况

该项目以本公司为主体组织实施，项目建设完成后，由公司制造中心下属的晶片车间负责生产与日常管理。本项目将在本次发行股票募股资金到位后实施。

9、项目效益分析

本项目以市场上石英晶片的平均采购价格为依据测算各年度的内部销售收入及效益情况。根据本项目《可行性研究报告》，本项目实施后，每年新增内部销售收入2,880万元，每年形成利润（节约效益）总额为1,560万元。投资利润率为42.5%，投资回收期3.66年。

五、募股资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响

本次发行股票的募股资金运用对公司整体的财务和经营状况的影响主要有：

（一）进一步提高公司核心竞争力

本次发行募股资金投资项目成功实施后，公司将进一步扩大生产规模，提高

产能、增加产品技术含量、提高产品附加值，使公司核心竞争力得到进一步提高，在SMD石英晶体元器件行业的领先地位得到进一步巩固。

（二）提升盈利水平

本次募股资金投资项目具备较好的盈利前景，根据募股资金投资项目的可行性研究报告，项目全部达产后，公司每年可增加销售收入20,910万元，增加税后利润4,147万元。

（三）降低财务风险，优化资本结构

本次募股资金到位后，公司的净资产将大幅增加，资产负债率下降，可进一步优化公司的资产负债结构，有效改善公司的财务状况，提高抵御风险的能力。同时募股资金到位后，引入多元投资主体，公司的股权结构也得到进一步优化。

（四）净资产大幅增长，净资产收益率短期内将下降

本次发行后，公司净资产和每股净资产将大幅增长，而在募股资金到位初期，由于投资项目尚处于投入期，将使公司的净资产收益率在短期内有较大幅度的降低。但随着募股资金投资项目的逐步达产，公司的盈利能力持续提升，公司的净资产收益率将稳步提高。

第十四节 股利分配政策

一、公司最近三年股利分配的一般政策

公司股票全部为普通股，股利分配将遵循“同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金、股票或其他合法的方式进行分配。

在每个会计年度结束后的六个月内，由公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的发展规划提出股利分配政策，经股东大会批准后执行。

公司将本着对投资者负责的态度，提升股票价值，回报投资者。公司将在可分配利润方式的选择范围内，充分考虑到投资者的需要，并根据有关法律法规和《公司章程》，以公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：弥补上一年度的亏损；提取法定公积金 10%，当法定公积金累计额已达到公司注册资本的 50% 以上时，可不再提取；提取任意公积金；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利的派发事项。

二、最近三年股利分配情况

公司 2004 年以来，进行的股利分配情况如下：

根据 2004 年 2 月 26 日召开的股东会决议，按 2003 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积、5% 计提法定公益金。

2004 年 6 月 12 日，金华东晶召开股东会，决议通过将金华东晶组织形式由有限公司变更为股份有限公司，确定拟变更后的股份公司注册资本为 4,600 万元，将公司截至 2004 年 6 月 30 日的净资产中超过 4,600 万元的部分按股东持股比例进行分配，分配完毕并经审计后的公司净资产折合为股份公司的股本。根据该决

议，以 2004 年 6 月 30 日经立信会计师事务所审计的净资产 4,600 万元，按 1:1 的比例折成公司的股本，另向股东分配现金股利 170,605.84 元。

根据 2005 年 4 月 19 日召开的股东大会决议，按 2004 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积、5% 计提法定公益金，派发现金股利 125 万元，剩余利润暂不分配。

根据公司于 2006 年 4 月 28 日召开的 2005 年度股东大会决议，按 2005 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积、5% 计提法定公益金，派发现金股利 230 万元，剩余利润暂不分配。

根据公司 2007 年 2 月 11 日召开的 2006 年度股东大会决议，按 2006 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积，派发 782 万元现金股利，剩余利润暂不分配。

三、本次发行后的股利分配政策

公司本次发行后的股利分配一般政策与发行前将保持一致，根据修改后的《公司法》和《公司章程》规定，公司自 2006 年起不再提取法定公益金。预计本公司本次公开发行股票后第一次派发股利的时间在 2008 年上半年，具体时间和分配方案需经本公司董事会提出由股东大会审议通过后执行。

四、利润共享安排

根据公司 2007 年 2 月 11 日召开的 2006 年度股东大会决议，公司本次发行前滚存利润分配方案为：

2006 年度利润分配完成后剩余未分配利润中的 15,000,000 元归老股东享有，并在本次发行前进行分配。该次分配后剩余未分配利润连同 2007 年 1 月 1 日至本次发行前的滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有。

根据公司 2007 年第二次临时股东大会决议，公司对本次发行前的滚存利润进行了分配，其中归老股东享有的 15,000,000 元滚存利润已于 2007 年 11 月 14 日分配完毕。该次分配后剩余的滚存利润由本次发行后的新老股东共同享有。

第十五节 其他重要事项

本公司本次公开发行股票上市后，将严格按照《公司法》、《证券法》和证券交易所股票上市规则等法律、法规、规则及本公司《公司章程》的规定，认真履行公司信息披露义务，及时、准确、完整公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重要财务决策等方面的事项。

一、信息披露制度和为投资者服务计划

本公司已根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规定，制订了《信息披露管理制度》和投资者服务计划，并计划在公司股票上市后实施，其主要内容包括：

（一）信息披露制度

1、信息披露责任机构

公司信息披露的指定报纸为《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com>。除公共媒体外，公司将在公司网站 <http://www.ecec.com.cn>上发布应当披露的信息，投资者可通过上网查询，亦可通过 E-mail: ecec@ecec.com.cn与公司联系。

公司信息披露的责任人为董事、监事、高级管理人员和各部门负责人，但是公司所有对外披露的信息都必须由董事会秘书和证券事务代表来负责对外披露。

公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人，对公司信息披露中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有法律责任；董事会秘书是信息披露管理工作的直接责任人，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性，并负有相应的法律责任。

为保证董事会秘书充分履行信息披露职责，凡公司有关部门发生重大事项应立即向董事会秘书报告，并提供上述事项的各类资料和信息。

公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人员在信息披露前，负有保密义务。

2、信息披露的基本原则

持续信息披露是公司的责任。公司应严格按照法律、法规、规章、证券交易所的有关规定和《公司章程》的规定，履行信息披露义务。

公司除按强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

公司公开披露信息的公告和相关文件必须在第一时间报送证券交易所。

公司公开披露的信息应当在指定报纸和指定网站上披露，在其它公共传媒包括在公司内、外部互联网等披露的信息不得先于指定报纸和指定网站。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司公告。

3、股东大会信息披露的规定

召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。

4、董事会信息披露的规定

公司召开董事会会议，应当在会后两个工作日内将董事会决议和会议纪要报送深圳证券交易所备案。公司的董事会决议涉及分红派息、公积金转增股本预案、配股预案、公司收购和出售资产、深圳证券交易所规定的应当及时披露的关联交易的事项必须公告。

5、监事会信息披露的规定

公司召开监事会会议，应当在会后两个工作日内将监事会决议报送深圳证券交易所备案，深圳证券交易所认为有必要披露的，经深圳证券交易所审查后在指定报刊上公布。监事会会议通知应载明：举行会议的日期、地点和会议期限，事由、议题以及发出通知的日期。

6、公司信息披露包括定期报告和临时报告，公司必须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和公司有关制度的要求实施相关的信息披露工作。

7、当得知有关尚未披露的信息难以保密或者已经泄露，或者公司股票及其衍生品种交易价格发生异常波动时，公司应当立即将该信息予以披露。

（二） 投资者服务计划

为使公司股东及潜在投资者能及时、充分地了解公司情况，加强公司与投资者的联系，更好地为投资者服务，本公司制定了详细的投资者服务计划，其要点如下：

1、加强公司信息披露管理，提高信息披露质量，将公司生产经营活动及有关重大事项通过新闻媒体及时、充分、准确地告知投资者，以利于投资者作出决策；

2、按照中国证监会有关规定，本公司上市后将编制年度、中期业绩报告、季度业绩报告；

3、通过股东大会听取股东对公司的建议；

4、邀请大型机构投资者或其他相关人士考察公司生产经营情况，增进其对公司业务和经营状况的了解；

5、及时与投资咨询机构、证券分析师进行联络沟通，介绍公司的生产、经营及财务情况，增强其对本公司的了解，使更多的证券分析师就公司的情况写出分析报告供投资者参阅；

6、通过面谈、路演、电话、传真、电子邮件等多种形式，及时解答投资者、

证券分析师提出的问题；

7、收集公司的分析报告以及投资者对公司的意见，每月定期向公司管理层反馈，使公司管理层及时了解把握投资者关心的问题。

（三） 联系办法及方式

发行人信息披露及协调与投资者关系的负责部门：董事会秘书办公室

负责人：刘洋（董事会秘书）

地 址：浙江省金华市宾虹路二段 555 号

邮政编码：321017

电 话：0579-82272001

传 真：0579-82273318

互联网网址：<http://www.ecec.com.cn>

电子信箱：ecec@ecec.com.cn

二、 重大合同

（一） 尚在履行的金额在 500 万元以上的借款合同

1、2006年7月6日，本公司与金华市商业银行营业部签订编号为2006年001所号借字第0275号的《流动资金借款合同》，合同借款金额为1,000万元，月利率为6.03%，借款期限为2006年7月4日至2008年8月20日。本合同的担保方式为保证担保，保证合同编号为2006001保0170号和2006001最高额保109014号。截至2007年6月30日，该合同项下的借款余额为1,000万元。

2、2006年7月26日，本公司与金华市商业银行营业部签订合同编号为2006001借0317号的《流动资金借款合同》，合同借款金额为800万元，月利率为6.03%，借款期限为2006年7月26日至2009年4月20日。本合同的担保方式为保证担保，保证合同编号为2006001保0194号和2006001最高额保109014号。截至2007年6月30日，该合同项下的借款余额为800万元。

3、2005年11月3日，本公司与中国工商银行金华市分行签订编号为2005年营业字第0073号的《小企业借款合同》，合同借款金额为570万元，类型为流动资金贷款，年利率为7.488%，借款期限为2005年11月3日至2008年10月20日。本合同的担保方式为抵押担保，抵押担保合同编号为2005年押字第00100—A。截

至2007年6月30日，该合同项下的借款余额为252.70万元。

4、2006年12月28日，本公司与中国进出口银行浙江省分行签订编号为（2006）进出银（浙信合）字第101号的《借款合同》，合同借款金额为5,000万元，年利率为4.32%，借款期限为30个月。中国银行金华市分行作为本合同项下的代理行，三方另行签订“委托代理协议”，协议号为（2006）进出银（浙信代）字第075号，合同担保方式为由中国银行金华市分行以保函方式进行担保。截至2007年6月30日，该合同项下的借款余额为5,000万元。

5、2006年10月12日，本公司与中国工商银行金华市分行签订编号为2006年营业字第0178号的《外汇借款合同》，合同借款金额为130万美元，性质为外汇固定资产贷款，利率由双方根据贷款行公布的外汇贷款基准利率，每12个月协商确定一次，第一个利息期的年利率为一年期伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+1.2%，借款期限4年，还款期限为：2007年1月12日至2010年7月12日之间，每隔三个月末归还8.125万美元，最后一期于2010年10月8日归还8.125万美元。本合同的担保方式为抵押担保，合同编号为2006年营业（押）字第0026号。截至2007年6月30日，该合同项下的借款余额为113.75万美元。

（二） 借款抵押合同

1、2005年12月1日，本公司与中国银行金华市分行签署20051005号《最高额抵押合同》，合同约定以本公司净值为5,085万元的机器设备为抵押物，为公司在2005年12月1日至2007年12月1日间与该行之间产生的全部不超过1,500万元的债务提供担保。

2、2006年1月14日，本公司与中国银行金华市分行签署20060607号《最高额抵押合同》，合同约定以本公司拥有净值为人民币1,186.0247万元的房产为抵押物，为公司在2006年1月14日至2008年1月14日间与该行之间产生的全部不超过1,186.0247万元的债务提供担保。

3、2006年10月9日，本公司与中国工商银行金华市分行签署编号为2006年押字0026号的《最高额抵押合同》，合同约定以本公司拥有评估价值为人民币2,745.50万元的机器设备为抵押物，为公司在2006年1月14日至2008年1月14日间与该行之间产生的全部不超过2,643万元的债务提供担保。

4、2006年10月17日，本公司与中国工商银行金华市分行签署编号为2006

年押字 0028 号的《最高额抵押合同》，该合同约定以本公司拥有评估价值为人民币 2,480 万元的房地产为抵押物，为公司在 2006 年 10 月 17 日至 2010 年 10 月 17 日间与该行之间产生的全部不超过 2,480 万元的债务提供担保。

5、2006 年 11 月 20 日，本公司与中国工商银行金华市分行签署编号为 2006 年押字 0035 号的《最高额抵押合同》，该合同约定以本公司拥有评估价值为人民币 1,857.02 万元的机器设备为抵押物，为公司在 2006 年 10 月 20 日至 2010 年 10 月 9 日间与该行之间产生的全部不超过 1,800 万元的债务提供担保。

（三） 互保协议及反担保合同

1、2005 年 11 月 1 日，本公司（甲方）与浙江今飞机械集团有限公司（乙方）及浙江今飞凯达轮毂有限公司（丙方）签署《银行借款互保协议书》，协议约定：甲方为乙方、丙方的银行借款累计额度不超过人民币 1,500 万元提供担保，乙方、丙方单独或共同为甲方银行借款累计额度不超过人民币 1,500 万元提供担保，乙方、丙方其中一方为甲方单独提供担保的，其它另一方同意承担连带责任；协议履行期为自 2005 年 10 月 31 日至 2007 年 12 月 31 日。

2、2005 年 12 月 28 日，本公司与浙江今飞凯达轮毂有限公司签署《反担保合同》，合同约定：为减少本公司就浙江今飞凯达轮毂有限公司向中国银行金华市分行借款 1,500 万元所提供担保的风险，浙江今飞凯达轮毂有限公司提供反担保；浙江今飞凯达轮毂有限公司提供保证的保证形式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期间届满之日起三年。

（四） 保证合同

1、2005 年 11 月 11 日，本公司与中国银行金华市分行签署 2005891A 号《保证合同》，合同约定本公司为浙江今飞凯达轮毂有限公司与中国银行金华市分行于 2005 年 11 月 11 日至 2007 年 12 月 31 日之间已经签订或将要签订的多个合同项下金额不超过 1,000 万元的全部债务提供担保。

2、2005 年 12 月 28 日，本公司与中国银行金华市分行签署编号为 2005 年 1037 号的《保证合同》，合同约定本公司为浙江今飞凯达轮毂有限公司与中国银行金华市分行签订的 2005 年 1037 号《借款合同》项下的 500 万元贷款提供担保。

三、重大诉讼或仲裁

(一) 公司作为一方当事人的重大诉讼或仲裁情况

截至本招股说明书签署日，公司不存在尚未了结或可预见之重大诉讼、仲裁或被行政处罚的案件。控股股东（实际控制人）、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均无受到刑事诉讼的情形存在。

(二) 其他诉讼或仲裁情况

山东省日照经济开发区人民法院于2007年1月24日向本公司递送应诉通知书及技宝电子（日照）有限公司的起诉状，技宝电子（日照）有限公司起诉状主要内容为其根据2005年和2006年为发行人加工定做不同规格的电子基座等产品，认为发行人共拖欠163,230元的加工款，诉讼请求为要求发行人支付加工价款163,230元及利息，及承担一切诉讼费用。


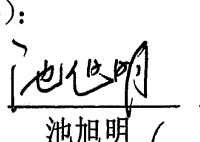


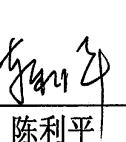
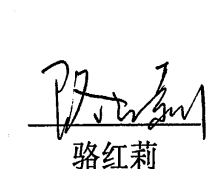


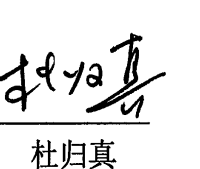
2007年8月6日，诉讼双方经山东省日照经济开发区人民法院主持调解达成和解协议，本公司向技宝电子（日照）有限公司给付货款本金163,230元，原告自愿放弃利息，案件受理费、其他诉讼费、保全费共计8,631元由本公司承担。截至本招股书签署日，本公司已支付完毕上述款项。

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

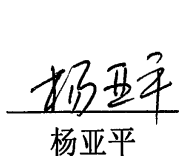
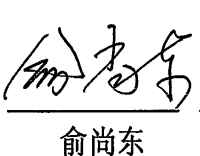
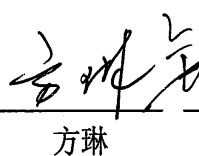
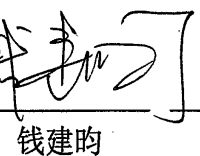
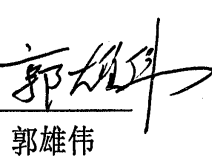
一、发行人全体董事、监事及高级管理人员的声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

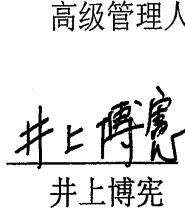
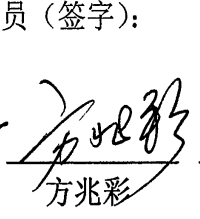

董事（签字）：

 李庆跃	 池旭明	 金良荣	 吴宗泽	 陈利平
 骆红莉	 王骥	 许永斌	 杜归真	

监事（签字）：

 杨亚平	 俞尚东	 方琳	 钱建昀	 郭雄伟
--	--	---	---	--

高级管理人员（签字）：

 井上博宪	 方兆彩	 刘洋
---	--	---

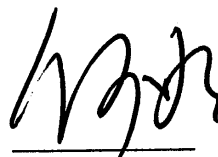
浙江东晶电子股份有限公司

2007年12月6日

二、保荐人（主承销商）声明

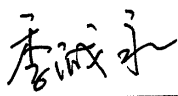
本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

（保荐人）主承销商法定代表人（签字）：

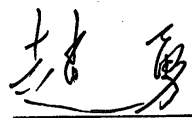


何 如

保荐代表人（签字）：

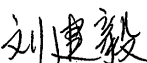


季诚永



赵勇

项目主办人（签字）：



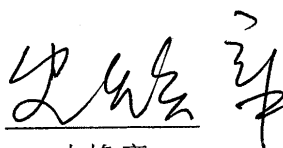
刘建毅



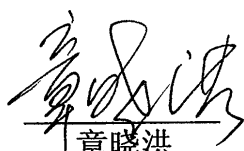
三、发行人律师声明

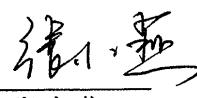
本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人律师事务所负责人签字：


史焕章

经办律师签字：

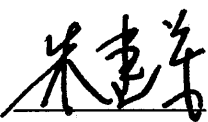


章晓洪






张小燕


上海市锦天城律师事务所
2007年12月6日

四、发行人会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人会计师事务所负责人签字： 
朱建弟



经办注册会计师签字： 
沈建林 沈利刚
 

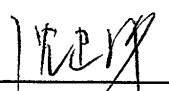
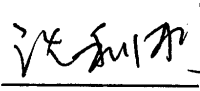

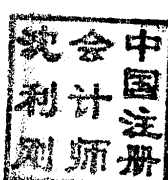
立信会计师事务所有限公司
2007年12月6日



五、验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

验资机构负责人签字： 
朱建弟

经办验资人员签字： 
沈建林 沈利刚
 


立信会计师事务所有限公司
2007年12月6日

六、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估复核报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估复核报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估复核机构负责人签字： 朱永勤

朱永勤

经办注册资产评估师签字： 喻建军、 胡海青

喻建军

胡海青



第十六节 备查文件

一、备查文件

投资者可于本次股票发行期间，查阅与本次发行有关的所有正式法律文件，具体如下：

1、备查文件目录

- (1) 发行保荐书；
- (2) 财务报表及审计报告；
- (3) 内部控制鉴证报告；
- (4) 经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- (5) 法律意见书及律师工作报告；
- (6) 《公司章程》（草案）；
- (7) 中国证监会核准本次发行的文件；
- (8) 其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间

工作日上午 9:00~11:30，下午 13:00~16:30。

三、查阅地址

投资者可于本次发行承销期间，到本公司和保荐人（主承销商）的办公地点查阅。